

목 차

분 기 보 고 서	1
【 대표이사 등의 확인 】	2
I. 회사의 개요.....	3
1. 회사의 개요.....	3
2. 회사의 연혁.....	30
3. 자본금 변동사항.....	35
4. 주식의 총수 등.....	36
5. 의결권 현황.....	41
6. 배당에 관한 사항 등.....	42
II. 사업의 내용	43
III. 재무에 관한 사항	112
1. 요약재무정보	112
2. 연결재무제표	115
3. 연결재무제표 주식	122
4. 재무제표	197
5. 재무제표 주식	204
6. 기타 재무에 관한 사항.....	265
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견.....	297
V. 감사인의 감사의견 등	298
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	300
1. 이사회에 관한 사항	300
2. 감사제도에 관한 사항.....	316
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항.....	322
VII. 주주에 관한 사항.....	323
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항.....	330
1. 임원 및 직원의 현황	330
2. 임원의 보수 등	362
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	365
X. 이해관계자와의 거래내용.....	396
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	400
【 전문가의 확인 】	413
1. 전문가의 확인	413
2. 전문가와의 이해관계	413

분기보고서

(제 51 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

삼성전자주식회사

대 표 이 사 :

김 기 남

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) <https://www.samsung.com/sec>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경팀장 (성 명) 남 궁 범

(전 화) 031-277-7218

【 대표이사 등의 확인 】


확 인 서


우리는 회사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2019. 11. 14

삼성전자 주식회사

대표이사: 김 기 남 

신고업무 담당임원: 노 회 찬 

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성전자주식회사이고 영문명은 Samsung Electronics Co., Ltd.입니다.

나. 설립일자

당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며, 1975년 6월 11일 기업공개를 실시하였습니다.

당사는 1984년 2월 28일 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를 삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경하였습니다.

[회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항]

주권상장 (또는 등록·지정)여부	주권상장 (또는 등록·지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
주권상장	1975년 06월 11일	-	-

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)

전화번호: 031-200-1114

홈페이지: <https://www.samsung.com/sec>

라. 중소기업 해당여부

당사는 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 CE(Consumer Electronics), IM(Information technology & Mobile communications), DS(Device Solutions) 3개의 부문과 전장부품사업 등을 영위하는 Harman부문(Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업)으로 나누어 독립 경영을 하고 있습니다.

각 부문별 제품은 다음과 같습니다.

부문	제 품
CE	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등
IM	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등
DS	DRAM, NAND Flash, 모바일AP, OLED 스마트폰 패널, LCD TV 패널 등
Harman	Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등

당사는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, Harman 산하 종속기업 등 246개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

[CE 부문]

CE 부문은 혁신적인 기술, 독특한 디자인, 편의성과 가치를 겸비한 제품을 통해 디지털시대 소비자들의 현재 요구를 충족시킬뿐만 아니라 미래의 수요를 예측하여 새로운 상품을 지속적으로 선보임으로써 글로벌 디지털 시장을 이끌고 있습니다.

TV는 CE 사업 분야의 핵심 제품으로, 2018년까지 13년 연속으로 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. LCD, LED TV 등 제품의 하드웨어 경쟁우위는 물론 Smart TV 분야에서도 독보적인 우위를 점하며 소프트웨어 산업으로의 전환을 선도하고 있습니다. 앞으로도 8K QLED 및 초대형 제품을 통해서 확고한 경쟁력 우위를 바탕으로 시장 지배력을 계속 확대할 계획입니다.

[IM 부문]

IM 부문은 휴대폰, 태블릿, 웨어러블 제품 등 모바일 관련 스마트 기기를 생산·판매하는 모바일 커뮤니케이션 사업 등을 영위하고 있습니다. 모바일 커뮤니케이션 사업의 핵심 제품인 스마트폰은 '갤럭시(GALAXY)' 브랜드를 통해 프리미엄 제품부터 보급형까지 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 선진시장과 성장시장에서 균형 있는 발전을 이루어 왔습니다.

IM 부문은 Flexible OLED 기반의 폼팩터 혁신, 고성능 카메라 채용, 생체 인식 센서 및 배터리 충전기술 강화 등의 의미 있는 혁신을 지속하고, 모바일 결제 서비스 'Samsung Pay', 지능형 서비스 'Bixby'의 서비스 향상과 더불어 Cloud, IoT, Health, AR/VR 등 미래 성장을 위한 노력을 지속함으로써 고객에게 가치 있는 경험을 제공하고 스마트폰 시장의 발전을 이끌어 나가겠습니다. 또한 단말, 칩셋으로 이어지는 End-to-End 솔루션과 5G 초기 시장에서의 상용화 경험을 바탕으로 글로벌 5G 시장을 리드하겠습니다.

[DS 부문]

DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체 사업과 모바일 AP, 카메라 센서칩 등을 설계·판매하는 System LSI 사업, 반도체 제조 위탁 생산을 하는 Foundry 사업, 그리고 액정화면 표시 장치인 디스플레이 패널(Display Panel)을 생산·판매하는 DP 사업으로 구성되어 있습니다. DRAM 등 정보 저장 용량의 획기적인 개선 및 모바일 제품의 두뇌에 해당하는 AP제품 성능 향상을 통하여 완제품의 신수요를 창출하는 등 시장을 선도할 수 있는 역량을 지속적으로 확대·강화하고 있습니다.

메모리 반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등에 초미세 공정 기술을 적용하여 경쟁사 대비 차별성 있는 제품의 생산과 원가 경쟁력을 통해 전세계 메모리 시장의 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다.

System LSI 사업은 모바일용 반도체 사업에서 차량용 반도체 사업으로 확장을 추진 중이며 당사는 지속적으로 추진해온 선행 공정 개발로 AP, CIS 등의 제품 차별화 및 경쟁력 제고를 통해 시장 지배력을 확대시켜 나갈 것입니다.

Foundry 사업은 2019년 상반기 세계최초 EUV 공정을 적용한 7나노 제품을 성공적으로 출시하였으며, 3나노 등 차세대 공정도 적기 개발하여 시장을 선도할 계획입니다. CIS, DDI, PMIC 등 공정 포트폴리오를 다각화하여 사업을 확장하고 있습니다.

DP의 중소형제품 사업은 차별화된 기술을 바탕으로 OLED 패널의 점유율을 확대하는 한편, Foldable/Notebook/Automotive 등 신규 응용처 출시를 통해 시장 영역을 넓혀 나가고 있습니다. 또한 대형제품 사업은 고화질, 초대형, 퀀텀닷 등 프리미엄제품 중심으로 사업을 특화하고, 지속적으로 기술 및 생산성 향상을 추진하여 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다.

[Harman 부문]

Harman 부문은 커넥티드카 시스템, 오디오/비디오 제품, 프로페셔널솔루션 및 커넥티드 서비스 사업분야에서 전세계 자동차 제조사, 소비자 및 기업을 대상으로 커넥티드 제품과 솔루션을 디자인하고 개발하는 등 전장 부품 시장을 선도하고 있습니다. Harman 부문은 주요시장에서 널리 알려진 브랜드들과 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 자체적인 개발 또는 지속적인 전략적 인수들을 통해 각 사업분야에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

☞ 사업 부문별 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 2019년 3분기말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 1개 회사(주)생보부동산신탁)가 감소하여 61개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 45개사입니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

구 분	회사수	회 사 명	법인등록번호
상장사	16	삼성물산(주)	1101110015762
		삼성전자(주)	1301110006246
		삼성에스디아이(주)	1101110394174
		삼성전기(주)	1301110001626
		삼성화재해상보험(주)	1101110005078
		삼성중공업(주)	1101110168595
		삼성생명보험(주)	1101110005953
		(주)멀티캠퍼스	1101111960792
		삼성증권(주)	1101110335649
		삼성에스디에스(주)	1101110398556
		삼성카드(주)	1101110346901
		삼성엔지니어링(주)	1101110240509
		(주)에스원	1101110221939
		(주)제일기획	1101110139017
		(주)호텔신라	1101110145519
		삼성바이오로직스(주)	1201110566317
비상장사	45	(주)서울레이크사이드	1101110504070
		(주)삼우종합건축사사무소	1101115494151
		(주)씨브이네트	1101111931686
		삼성바이오에피스(주)	1201110601501
		삼성디스플레이(주)	1345110187812
		삼성코닝어드밴스드글라스(유)	1648140000991
		에스유머티리얼스(주)	1648110061337
		스테코(주)	1647110003490
		세메스(주)	1615110011795
		삼성전자서비스(주)	1301110049139
		삼성전자판매(주)	1801110210300
		삼성전자로지텍(주)	1301110046797
		수원삼성축구단(주)	1358110160126
		삼성메디슨(주)	1346110001036
		삼성화재애니카손해사정(주)	1101111595680
		삼성화재서비스손해사정(주)	1101111237703

		(주)삼성화재금융서비스보험대리점	1101116002424
		삼성전자서비스씨에스(주)	1358110352541
		삼성선물(주)	1101110894520
		삼성자산운용(주)	1701110139833
		삼성생명서비스손해사정(주)	1101111855414
		삼성에스알에이자산운용(주)	1101115004322
		(주)삼성생명금융서비스보험대리점	1101115714533
		에스디플렉스(주)	1760110039005
		제일패션리테일(주)	1101114736934
		네추럴나인(주)	1101114940171
		삼성웰스토리(주)	1101115282077
		(주)시큐아이	1101111912503
		에스티엠(주)	2301110176840
		에스코어(주)	1101113681031
		오픈한즈(주)	1311110266146
		(주)미라콤아이앤씨	1101111617533
		삼성카드고객서비스(주)	1101115291656
		(주)휴먼티에스에스	1101114272706
		에스원씨알엠(주)	1358110190199
		신라스테이(주)	1101115433927
		에이치디씨신라면세점(주)	1101115722916
		(주)삼성경제연구소	1101110766670
		(주)삼성라이온즈	1701110015786
		삼성벤처투자(주)	1101111785538
		삼성액티브자산운용(주)	1101116277382
		삼성헤지자산운용(주)	1101116277390
		(주)하만인터내셔널코리아	1101113145673
		레드벤드소프트웨어코리아(주)	1101113613315
		에스비티엠(주)	1101116536556
계	61		

☞ 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속기업 개황

기업회계기준서 제1110호 '연결채무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의 연결 대상 종속기업은 2019년 3분기말 현재 246개사입니다. 전년말 대비 4개 기업이 증가하고 10개 기업이 감소하였습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 기업여부
Samsung Electronics America, Inc.(SEA)	1978.07	85 Challenger Road, Ridgefield Park, NJ, USA	전자제품 판매	30,681,097	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	O
NeuroLogica Corp.	2004.02	14 Electronics Ave. Danvers, MA 01923 USA	의료기기 생산 및 판매	194,709	상동	O
Dacor Holdings, Inc.	1998.12	14425 Clark Ave, City of Industry, CA 91745, USA	Holding Company	57,012	상동	X
Dacor, Inc.	1965.03	14425 Clark Ave, City of Industry, CA 91745, USA	가전제품 생산 및 판매	56,116	상동	X
Dacor Canada Co.	2001.06	Summit Place 6th floor 1601 Lower Water St. Halifax, Nova Scotia, B3J 3P6, Canada	가전제품 판매	12	상동	X
EverythingDacor.com, Inc.	2006.06	1440 Bridge Gate Drive Diamond Bar, CA 91765, USA	가전제품 판매	0	상동	X
Distinctive Appliances of California, Inc.	2014.06	14425 Clark Ave, City of Industry, CA 91745, USA	가전제품 판매	0	상동	X
Samsung HVAC America, LLC	2001.07	3001 Northern Cross Blvd. #361 Fort Worth TX 76137, USA	에어컨공조 판매	44,641	상동	X
SmartThings, Inc.	2012.04	456 University Avenue, Suite 200, Palo Alto, CA 94301 USA	스마트홈기기 판매	171,767	상동	O
Samsung Oak Holdings, Inc.(SHI)	2016.06	3655 N. First St. San Jose, CA 95134, USA	Holding Company	253,670	상동	O
Joyent, Inc.	2005.03	655 Montgomery Street, Suite 1600, San Francisco, CA 94111, USA	클라우드서비스	214,873	상동	O
Stellus Technologies, Inc.	2015.11	3655 N. First St. San Jose, CA 95134, USA	반도체 시스템 생산 및 판매	17,646	상동	X
Prismview, LLC	2007.10	1651 N 1000 W, Logan, Utah 84321, USA	LED 디스플레이 생산 및 판매	63,833	상동	X
Samsung Semiconductor, Inc.(SSI)	1983.07	3655 N. First St. San Jose, CA 95134, USA	반도체/DP 판매	9,306,621	상동	O
Samsung Electronics Canada, Inc.(SECA)	1980.07	2050 Derry Road West, Mississauga, ON, Canada	전자제품 판매	1,070,163	상동	O
AdGear Technologies Inc.	2010.08	481 Viger West, Suite 300, Montreal, QC, H2Z 1G6, Canada	디지털광고 플랫폼	17,399	상동	X
Viv Labs, Inc.	2012.09	10 Almaden Boulevard Suite 560, San Jose, CA 95113, USA	인공지능 서비스	275,861	상동	O

SigMast Communications Inc.	2009.07	26 Union Street, Suite 305, Bedford, Nova Scotia, B4A 2B5, Canada	문자메시지 개발	2,831	상동	X
RT SV CO-INVEST, LP	2014.02	260 East Brown Street, Suite 380 Birmingham, MI 48009, USA	벤처기업 투자	11,957	상동	X
Samsung Research America, Inc(SRA)	1988.10	665 Clyde Avenue, Mountain View, CA 94043, USA	R&D	696,951	상동	O
Samsung Next LLC(SNX)	2016.08	665 Clyde Avenue, Mountain View, CA 94043, USA	Holding Company	111,815	상동	O
Samsung Next Fund LLC(SNXF)	2016.08	665 Clyde Avenue, Mountain View, CA 94043, USA	신기술사업자, 벤처기업 투자	115,679	상동	O
Samsung International, Inc.(SII)	1983.10	9335 Airway Rd. Suite 105, San Diego, CA 92154, USA	CTV/모니터 생산	1,102,174	상동	O
Samsung Mexicana S.A. de C.V.(SAMEX)	1988.03	Parque Ind. El Florido Segunda Seccion Tijuana B.C. Mexico	전자제품 생산	49,836	상동	X
Samsung Austin Semiconductor LLC.(SAS)	1996.02	12100 Samsung Blvd. Austin, Texas 78754, USA	반도체 생산	5,642,117	상동	O
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	1995.07	Col. Chapultepec Morales, Del Miguel Hidalgo D.F. Mexico	전자제품 판매	1,358,641	상동	O
SEMES America, Inc.	1998.10	78754 9701 Dessau Rd. #305, Austin, Texas, USA	반도체 장비 서비스	1,557	상동	X
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV(SEDAM)	2012.12	Av. Benito Juarez #119, Parque Industrial Qro, Sta. Rosa Jauregui C.P 76220 Queretaro, Mexico	전자제품 생산	499,192	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.(SEMI)	1995.05	9800 NW 41st Street Suite 200, Miami, FL 33178, USA	전자제품 판매	253,783	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre), S. A.(SELA)	1989.04	Calle 50 Edificio PH Credicorp Bank Piso 16, Panama City, Panama	전자제품 판매	430,737	상동	O
Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	2010.05	Torre Kepler Piso 1, Av. Blandin Castellana, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela	마케팅 및 서비스	108	상동	X
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	1997.03	Carrera 7 #114-43 Oficina 606 Bogota, Colombia	전자제품 판매	458,091	상동	O
Samsung Electronics Panama. S.A.(SEPA)	2012.07	Torre de Las Americas, TorreC, Piso 23, Panama City, Panama	컨설팅	2,686	상동	X
Samsung Electronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	1995.01	Avenida Dr. Chucuri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil	전자제품 생산 및 판매	6,207,458	상동	O
Samsung Electronics Argentina S.A.(SEASA)	1996.06	Bouchard 7107 Piso Ciudad de Buenos Aires, Argentina	마케팅 및 서비스	53,998	상동	X
Samsung Electronics Chile Limitada(SECH)	2002.12	Americo Vespucio Sur 100 Oficina 102, Las Condes, Chile	전자제품 판매	478,751	상동	O
Samsung Electronics Peru S.A.C.(SEPR)	2010.04	Ricardo Rivera Navarrete 501, 9th floor, Avenue, Peru	전자제품 판매	295,551	상동	O

Samsung Electronics Home Appliances America, LLC(SEHA)	2017.08	284 Mawsons way, SC 29108, USA	가전제품 생산	523,093	상동	O
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	1981.06	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan 48377, USA	오디오제품 생산, 판매, R&D	3,715,631	상동	O
Harman Connected Services, Inc.	2002.02	636 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, USA	Connected Service Provider	2,027,134	상동	O
Harman Connected Services Engineering Corp.	2004.09	636 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, USA	Connected Service Provider	1,502	상동	X
Harman Connected Services South America S.R.L.	2015.04	Tucuman 1, 4th Floor, City of Buenos Aires, Argentina	Connected Service Provider	10	상동	X
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	2005.07	City of Manaus, State of Amazonas, at Avenida Cupiuba, no. 401, L/3, 77/1, Distrito Industrial, Brazil	오디오제품 생산, 판매	43,308	상동	X
Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	1997.02	2290 Ave Delas Torres Cd. Juarez, Chih 32575, Mexico	오디오제품 생산	48,911	상동	X
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	1958.11	Tabai-Canos Highway BR 386, KM 435, City of Nova Santa Rita, Brazil	오디오제품 판매, R&D	231,816	상동	O
Harman Financial Group LLC	2004.06	15th Floor, 400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901, USA	Management Company	615,877	상동	O
Harman International Industries Canada Ltd.	2005.05	2900-550 Burrard St., Vancouver BC V6C 0A3, Canada	오디오제품 판매	373	상동	X
Harman International Industries, Inc.	1980.01	15th Floor, 400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901, USA	Holding Company	15,013,251	상동	O
Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	2014.12	2290 Ave Delas Torres Cd. Juarez, Chih 32575, Mexico	오디오제품 판매	19,887	상동	X
Harman Investment Group, LLC	2015.12	400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901, USA	Financing Company	678,197	상동	O
Harman KG Holding, LLC	2009.03	400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901, USA	Holding Company	0	상동	X
Harman Professional, Inc.	2006.07	8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329, USA	오디오제품 판매, R&D	959,044	상동	O
Red Bend Software Inc.	2001.03	636 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, USA	소프트웨어 디자인	9,564	상동	X
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	2014.12	89 Nexus Way, Cayman Bay, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands	벤처기업 투자	27,892	상동	X
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	2017.09	23 Lime Tree Bay Avenue, Grand Cayman, KY1-II04, Cayman Islands	벤처기업 투자	1,472	상동	X

Zhilabs Inc.	2017.02	850 New Burton Road, Suite 201, Dover, DE 19904, USA	네트워크 Solution 판매	19	상동	X
Samsung Electronics (UK) Ltd.(SEUK)	1995.07	1000 Hillswood Drive, Chertsey Surrey KT16 0PS, UK	전자제품 판매	2,203,583	상동	O
Samsung Electronics(London) Ltd.(SEL)	1999.01	1000 Hillswood Drive, Chertsey Surrey KT16 0PS, UK	Holding Company	5,619	상동	X
Samsung Electronics Holding GmbH(SEHG)	1982.02	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	Holding Company	793,465	상동	O
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	1987.12	Koelner Str. 12, 65760 Eschborn, Germany	반도체/DP 판매	807,318	상동	O
Samsung Electronics GmbH(SEG)	1984.12	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	전자제품 판매	2,202,610	상동	O
Samsung Electronics Iberia, S.A.(SESA)	1989.01	Parque Empresarial Omega Edf. C Avenida de la Transicion Espanola 32. 28108 Alcobendas, Madrid, Spain	전자제품 판매	993,982	상동	O
Samsung Electronics France S.A.S(SEF)	1988.01	1 Rue Fructidor 93400 Saint-Ouen, France	전자제품 판매	1,761,117	상동	O
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.(SEH)	1989.10	Samsung ter 1, Jaszfenyszaru, 5126 Hungary	전자제품 생산 및 판매	1,894,922	상동	O
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.(SECZ)	2010.01	V Parku 14, Praha, 14800, Czech Republic	전자제품 판매	198,450	상동	O
Samsung Electronics Italia S.P.A.(SEI)	1991.04	Via Carlo Donat Cattin 5, Cernusco sul Naviglio, 20073Milan, Italy	전자제품 판매	1,148,534	상동	O
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1991.05	Olof Palmestraat 10, 2616LR Delft, Netherlands	물류	1,904,358	상동	O
Samsung Electronics Benelux B.V.(SEBN)	1995.07	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, Netherlands	전자제품 판매	1,673,470	상동	O
Samsung Display Slovakia s.r.o.(SDSK)	2007.03	919 42 Voderady 401 Voderady, Slovakia	DP 임가공	59,146	상동	X
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	2007.09	Sos. Pipera-Tunari, nr. 1/VII, Nord City Tower Voluntari Ilfov, Romania	전자제품 판매	253,401	상동	O
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	1996.04	ul.Marynarska 15 Warszawa, Poland	전자제품 판매	783,805	상동	O
Samsung Electronics Portuguesa S.A.(SEP)	1982.09	Lagoas Parque, Edificio 5B Piso 0 2740-298 Porto Salvo, Portugal	전자제품 판매	207,183	상동	O
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	1992.03	Kanal Vagen 10A, 194 27, Upplands Vasby, Sweden	전자제품 판매	967,089	상동	O
Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	1997.04	No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, UK	반도체/DP 판매	88,597	상동	O

Samsung Electronics Austria GmbH(SEAG)	2002.01	Praterstraße 31 1020 Vienna, Austria	전자제품 판매	342,392	상동	O
Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	2013.05	CH-8055 Binzallee 4, Samsung Electronics Zurich ZH, Switzerland	전자제품 판매	267,760	상동	O
Samsung Electronics Slovakia s.r.o(SESK)	2002.06	Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia	CTV/모니터 생산	1,302,612	상동	O
Samsung Electronics Baltics SIA(SEB)	2001.10	Duntes iela 6, Riga, Latvia	전자제품 판매	111,715	상동	O
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.(SEEH)	2008.10	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, Netherlands	Holding Company	8,586,022	상동	O
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o(SEPM)	2010.02	ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Poland	가전제품 생산	353,510	상동	O
Samsung Electronics Greece S.M.S.A(SEGR)(구.Samsung Electronics Greece S.A.)	2010.04	280 Kifissias Ave, Halandri 15232 Athens, Greece	전자제품 판매	88,927	상동	O
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.(SEACE)	2017.04	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, Netherlands	에어컨공조 판매	84,623	상동	O
Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	2004.02	Torshamnsgatan 39 164 40 Kista, Sweden	R&D	23,082	상동	X
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	2012.09	c/o Novi Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst, Denmark	R&D	23,056	상동	X
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	2012.09	St. John's Houst, St. John's Innovation Park, CowleyRoad, Cambridge, CB4 0ZT, UK	R&D	124,821	상동	O
Samsung Electronics Overseas B.V.(SEO)	1997.01	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, Netherlands	전자제품 판매	114,563	상동	O
AKG Acoustics GmbH	1947.03	254, Laxenburger Str., Wien (Vienna), 1230, Austria	오디오제품 생산, 판매	364,656	상동	O
AMX UK Limited	1993.03	CLIFTON MOOR YORK NORTH YORKSHIRE, York, YO30 4GD, UK	오디오제품 판매	0	상동	X
Arcam Limited	2004.07	The West Wing, Stirling House, Waterbeach CambridgeCB25 9PB, UK	Holding Company	0	상동	X
A&R Cambridge Limited	1993.12	The West Wing, Stirling House, Waterbeach CambridgeCB25 9PB, UK	오디오제품 판매	0	상동	X
Duran Audio B.V.	1991.11	Koxkampseweg 10, 5301KK Zaltbommel, Netherlands	오디오제품 판매, R&D	553,795	상동	O
Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada(구.Duran Audio Iberia Espana S.L.)	2012.11	C/ ERCILLA 17 3ºBILBAO48, Bizkaia, Spain	오디오제품 판매	55	상동	X
Harman Automotive UK Limited	2012.10	6th Floor, Salisbury House London Wall London England EC2M 5QQ, UK	오디오제품 생산	521,338	상동	O

Harman Becker Automotive Systems GmbH	1990.07	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307, Germany	오디오제품 생산 , 판매, R&D	3,999,992	상동	O
Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	2005.12	17, Viale Luigi Majno, Milano (MI), 20122, Italy	오디오제품 판매	622	상동	X
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	1994.08	Szekesfehervar H-8000 Hungary, Holland Fasor 19-HU, Hungary	오디오제품 생산 , R&D	2,621,720	상동	O
Harman Belgium SA	1967.04	Drukperstraat 4, Brussels, 1000, Belgium	오디오제품 판매	906	상동	X
Harman Connected Services AB.	1984.10	Nordenskioldsgatan 24 211 19 Malmo, Sweden	Connected Service Provider	54,468	상동	X
Harman Finland Oy	1998.07	Hermiankatu 1 A 33720 Tampere, Finland	Connected Service Provider	1,437	상동	X
Harman Connected Services GmbH	2005.12	Massenbergstraße 9a, 44787 Bochum, Germany	Connected Service Provider	47,318	상동	X
Harman Connected Services Limited	1992.12	Vita House, London Street Basingstoke RG21 7PG, UK	Connected Service Provider	8,861	상동	X
Harman Connected Services Poland Sp.zoo	2007.06	Ul Kasprzaka 6 Lodz PL 91-803, Poland	Connected Service Provider	5,316	상동	X
Harman Connected Services UK Ltd.	2008.09	Devonshire House, 60 Goswell Road, London, EC1M7AD, UK	Connected Service Provider	69,055	상동	X
Harman Consumer Nederland B.V.	1995.12	Herikerbergweg 9, Amsterdam, CN 1101, Netherlands	오디오제품 판매	421,646	상동	O
Harman Deutschland GmbH	1998.03	Parkring 3 B. Munich, Garching, 85748, Germany	오디오제품 판매	0	상동	X
Harman Finance International GP S.a.r.l	2015.04	6, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg Grand-Duche de Luxembourg	Holding Company	0	상동	X
Harman France SNC	1995.11	12 bis, rue des Colonnes-du-Trone, Paris, 75012, France	오디오제품 판매	144,325	상동	O
Harman Holding GmbH & Co. KG	2002.06	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307, Germany	Management Company	5,014,885	상동	O
Harman Hungary Financing Ltd.	2012.06	Szekesfehervar H-8000 Hungary, Holland Fasor 19-HU, Hungary	Financing Company	611,191	상동	O
Harman Inc. & Co. KG	2012.06	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307, Germany	Holding Company	3,998,976	상동	O
Harman International Estonia OU	2015.05	Parnu mnt 139a, Tallinna linn, Harju maakond, 11317, Estonia	R&D	247	상동	X
Harman International Industries Limited	1980.03	Westside, Two London Rd, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK	오디오제품 판매 등	333,372	상동	O
Harman International Romania SRL	2015.02	5-7, Bdul. Dimitrie Pompeiu, Metroffice, Cladirea A parter, et. 2 si et. 4, Sector 2, Bucharest, Romania	R&D	10,314	상동	X

Harman Finance International, SCA	2015.04	6, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg Grand-Duche de Luxembourg	Financing Company	465,043	상동	O
Harman International s.r.o	2015.02	Pobe n 394/12, Karl n, 186 00 Pra, Czech Republic	오디오제품 생산	32	상동	X
Harman International SNC	1989.02	2 Route De Tours Chateau De Loir, 72500, France	오디오제품 판매	1,506	상동	X
Harman Management GmbH	2002.04	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307, Germany	Holding Company	0	상동	X
Harman Professional Kft	2014.12	Szekesfehervar H-8000 Hungary, Holland Fasor 19-HU, Hungary	오디오제품 생산 , R&D	63,948	상동	X
Martin Manufacturing (UK) Ltd	1985.05	Belvoir Way, Fairfield Industrial Est, Louth LN11 0LQ, UK	오디오제품 생산	0	상동	X
Harman Professional Denmark ApS	1987.07	Olof Palmes Alle 18., DK-8200 Aarhus N, Denmark	오디오제품 판매 , R&D	203,020	상동	O
Harman Professional France SAS	1990.01	1, rue du Gevaudan, 91090 Lisses, France	오디오제품 판매	307	상동	X
Red Bend Software Ltd.	2004.08	Devonshire House, 1 Devonshire Street, London W1W5DR, UK	소프트웨어 디자인	2,815	상동	X
Red Bend Software SAS	2002.10	Immeuble 15 place Georges Pompidou 78180 MontignyLe Bretonneux, France	소프트웨어 디자인	4,353	상동	X
Studer Professional Audio GmbH	2003.11	Althardstrasse 30, Regensdorf Switzerland, CH 8105, Switzerland	오디오제품 판매 , R&D	34,763	상동	X
Zhilabs, S.L.	2008.11	Numancia 69-73, floor 5, door B, C.P 08029, Barcelona, Spain	네트워크 Solution 개발, 판매	6,118	상동	X
FOODIENT LTD.	2012.03	Cornwall House, 31 Lionel Street, Birmingham, England	R&D	1,603	상동	X
Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	2006.10	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia	전자제품 판매	1,390,623	상동	O
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	2008.09	75A, Zhylianska Str Kiev, Ukraine	전자제품 판매	161,905	상동	O
Samsung R&D Institute Rus LLC(SRR)	2011.11	127018 Office 1401, building 1, 12, Dvintsev Street, Moscow, Russia	R&D	27,397	상동	X
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	2008.09	Naurizbay batyr st. Almaty, Republic of Kazakhstan	전자제품 판매	117,206	상동	O
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	2014.10	1065 Bridge Plaza Biz Centre, 6 Bakikhanov str, 12th FI Baku, Azerbaijan	마케팅	1,806	상동	X
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	2007.07	Kaluga region, Borovsk district, Koryakovo village, Perviy Severniy Drive, 1, Russia	CTV 생산	987,881	상동	O

Harman Connected Services OOO	1998.11	10/16, Alekseevskaya St., Office P5, office 17, Nizhny Novgorod, 603005, Russia	Connected Service Provider	11,153	상동	X
Harman RUS CIS LLC	2011.08	RS 12/1 Dvintsev street, Block B Moscow, 127018, Russia	오디오제품 판매	77,966	상동	O
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	2010.03	Mulliner Tower, Alfred Rewane Road, Ikoyi, Lagos, Nigeria	마케팅	32,499	상동	X
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	2011.12	27577 00506, Milford Suites, 4th Floor, Pa Nairobi, Kenya	마케팅	22,311	상동	X
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.(SGE)	1995.05	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE	전자제품 판매	905,591	상동	O
Samsung Electronics Egypt S.A.E(SEEG)	2012.07	62815 Piece No. 98, Engineering Sector, Kom Abu Radi, Industrial Zone, AlWastaCity, BeniSuef, Egypt	전자제품 생산 및 판매	600,240	상동	O
Samsung Electronics Israel Ltd.(SEIL)	2012.09	60972 1st Fl, Holland Building Europark Yakum, Israel	마케팅	10,818	상동	X
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L(SETN)	2012.09	1053 2eme etage Immeuble Adonis, rue du Lac D'annecy Les Berges du Lac 1053 Tunis, Tunisia	마케팅	3,973	상동	X
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	2012.11	No.4 1st Fl. Park Lane Tower 172 Turfail Road Lahore Cantt, Lahore Pakistan	마케팅	2,378	상동	X
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	1994.06	2929 William Nicol Drive, Bryanston Johannesburg, South Africa	전자제품 판매	421,122	상동	O
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.(SSAP)	2014.07	35 Umkhomazi Drive, La Mercy, Kwa-Zulu Natal, South Africa	CTV/모니터 생산	66,955	상동	X
Samsung Electronics Turkey(SETK)	1984.12	Flatofis Is Merkezi Otakcilar Caddesi No.78 Kat 3 No. B3 Eyup, Istanbul, Turkey	전자제품 판매	510,886	상동	O
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.(SIRC)	2007.10	10 Oholiav Street, Ramat Gan 52522, Israel	R&D	56,937	상동	X
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.(SELV)	2009.07	Building Nr.5, King Hussein Business Park, King Abdullah II St. P.O 962372, Amman 11196, Jordan	전자제품 판매	414,726	상동	O
Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	2009.11	Lot N°9 Mandarouna 300 Route Sidi Maarouf 20190, Ain Chock Hay Hassani Casablanca, Morocco	전자제품 판매	219,897	상동	O
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	2002.01	International Financial Services Ltd, IFS Court, TwentyEight CyberCity, Ebene, Mauritius	Holding Company	40,732	상동	X

Harman Connected Services Morocco	2012.04	Technopark, Route Nouaceur, Rs 114 & CT1029, Casablanca, Morocco	Connected Service Provider	3,330	상동	X
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	2009.10	IFS Court Twenty Eight Cybercity, Ebene, Mauritius	Holding Company	82,749	상동	O
iOnRoad Technologies Ltd	2012.01	7 Ze'ev Jabotinsky Rd., Ramat Gan 5252007, (P.O. Box 13, Ramat Gan 5210001), Israel	R&D	1,220	상동	X
Red Bend Ltd.	1998.02	4 HaCharash St., Neve Ne'eman Industrial Park, Hod Ha'Sharon, Israel	오디오제품 생산	77,623	상동	O
Towersec Ltd.	2008.04	20 Atir Yeda St., Kfar-Saba 4464315, Israel	R&D	4,073	상동	X
Corephotonics Ltd.	2012.01	25 Habarzel St., Tel Aviv 6971035, Israel	R&D	29,223	상동	X
Samsung Japan Corporation(SJC)	1975.12	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan	반도체/DP 판매	1,196,129	상동	O
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.(SRJ)	1992.08	2-7, Sugasawa-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, 230-0027, Japan	R&D	151,975	상동	O
Samsung Electronics Japan Co., Ltd.(SEJ)	2008.09	ROPPONGI T-CUBE 3-1-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8532, Japan	전자제품 판매	873,583	상동	O
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	1995.03	Tuanku Jaafar Industrial Park, 71450 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	전자제품 생산	24,489	상동	X
Samsung Medison India Private Ltd.(SMIN)	2009.01	(110024 IN)C-28 Defence Colony New Delhi South Delhi DL., India	의료기기 판매	0	상동	X
Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.(SEMA)	1989.09	North Klang Straits, Area 21 Industrial Park 42000 Port Klang Selangor, Malaysia	가전제품 생산	168,590	상동	O
Samsung Vina Electronics Co., Ltd.(SAVINA)	1995.01	938 1A Highway, Linh Trung ward, Thu Duc Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam	전자제품 판매	251,818	상동	O
Samsung Asia Private Ltd.(SAPL)	2006.07	3 Church Street #26-01 Samsung Hub, Singapore	전자제품 판매	7,630,154	상동	O
Samsung India Electronics Private Ltd.(SIEL)	1995.08	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India	전자제품 생산 및 판매	6,410,825	상동	O
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited(SRI-Bangalore)	2005.05	Bagmane Tech. Park, Bangalore, Karnataka, India	R&D	256,224	상동	O
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd(SNSL)	2017.11	Ward No 1, Durbar Marg, Kathmandu Municipality, Kathmandu, Nepal	서비스	967	상동	X
Samsung Display Noida Private Limited(SDN)	2019.07	B-1, Sector 81, Phase-II, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India	DP 생산	-	상동	X
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	1987.11	Quad Samsung, 8 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127, Australia	전자제품 판매	433,723	상동	O

Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	2013.09	24 The Warehouse Way, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand	전자제품 판매	98,281	상동	O
PT Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	1991.08	Cikarang Industrial Estate, JL. Jababeka Raya Blok F29-33, Cikarang, Bekasi, West Java, Indonesia	전자제품 생산 및 판매	1,051,835	상동	O
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	2003.03	Prudential Tower 23rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 79 Jakarta 129-10, Indonesia	전자제품 판매 및 서비스	1,029	상동	X
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.(TSE)	1988.10	Empire Tower 1, South Sathorn Road, Yanawa, Sathorn, Bangkok, Thailand	전자제품 생산 및 판매	2,465,999	상동	O
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	2016.09	3rd Floor Kolao Tower 2, 23 Singha Road, Vientiane, Laos	마케팅	641	상동	X
Samsung Electronics Philippines Corporation(SEPCO)	1996.03	8th Floor HanjinPhil Building 1128 University Parkway, North Bonifacio, Global City Taguig 1634, Philippines	전자제품 판매	305,534	상동	O
Samsung Display Vietnam Co., Ltd.(SDV)	2014.07	Yenphong I I.P, Yenprung Commune, Yenphong Dist, Bacninh Province, Vietnam	DP 생산	8,222,472	상동	O
Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.(SME)	2003.05	Suite E-09-01, Level 9, East Wing, No.1 Jalan 1/68F, Jalan Tun Razak, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia	전자제품 판매	474,905	상동	O
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	2010.08	Gualshan-1, Gulshan Avenue, Dhaka, Bangladesh	R&D	8,538	상동	X
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	2008.03	Yenprung Commune, Yenphong Dist, Bacninh Province, Vietnam	전자제품 생산	11,501,682	상동	O
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.(SEVT)	2013.03	Yen Binh 1, Industrial Park, Pho Yen district, Thai Nguyen Province, Vietnam	통신제품 생산	11,360,811	상동	O
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.(SEHC)	2015.02	Lot I-11, D2 Road, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam	전자제품 생산 및 판매	2,042,669	상동	O
AMX Products And Solutions Private Limited	2008.02	10 No. 1305, 13th Mezzanine Floor, Raheja Towers, No.26-27, Mahatma Gandhi Road, Bengaluru, India	오디오제품 판매	589	상동	X
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	2002.04	Survey No. 85 & 86, Sadarmangala Village, Krishnarajapuram Hobli Bangalore, India	Connected Service Provider	367,847	상동	O

Harman International (India) Private Limited	2009.01	Sarjapur Marathahalli Ring Road, Kadubeesanahalli Village, Bangalore, India	오디오제품 판매, R&D	186,837	상동	O
Harman International Industries PTY Ltd.	2014.12	Warehouse 25 26-18, Roberna Street, Moorabbin VIC 3189, Australia	Holding Company	0	상동	X
Harman International Japan Co., Ltd.	1991.06	8F Akihabara Business Center, 1-1 Akihabara, Taito-ku, Tokyo, Japan	오디오제품 판매, R&D	71,303	상동	X
Harman Singapore Pte. Ltd.	2007.08	108, Pasir Panjang Road, #02-08 Golden Agri Plaza, 118535, Singapore	오디오제품 판매	9,537	상동	X
Martin Professional Pte. Ltd.	1995.06	108, Pasir Panjang Road, #02-08 Golden Agri Plaza, 118535, Singapore	오디오제품 판매	4,195	상동	X
Samsung Display Dongguan Co., Ltd.(SDD)	2001.11	High Technology Industrial Zone, Houjie, Dongguan, China	DP 생산	1,417,809	상동	O
Samsung Display Tianjin Co., Ltd.(SDT)	2004.06	NO.25, Mip Fourth Road, Xi qing District, Tianjin, China	DP 생산	996,610	상동	O
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	1988.09	33 F., Central Plaza, 18 Harbour Road, Hong Kong	전자제품 판매	1,208,622	상동	O
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	1995.04	No.501, SuHong East Road, Suzhou Industry Park, China	가전제품 생산	533,301	상동	O
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.(SSEC-E)	1995.04	No.501, SuHong East Road, Suzhou Industry Park, China	가전제품 생산	420,978	상동	O
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	1996.03	Fortune Financial Center, No5. Dongsanhuan ZhongRoad, Chaoyang District, Beijing, China	전자제품 판매	16,090,629	상동	O
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou(SRC-Guangzhou)	2010.01	A3 Building, No.185 Kexue Avenue, Science City, Luogang District, Guangzhou, China	R&D	72,950	상동	X
Samsung Tianjin Mobile Development Center (SRC-Tianjin)	2010.08	No.14 weiliu Rd.Micro-Electronic Industrial Park Xiqing Dist. Tianjin, China	R&D	38,512	상동	X
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	2013.03	12th Fl., EVOC Technology Building, No. 31 Gaoxin Central Avenue 4th,Nanshan District, Shenzhen, China	R&D	18,873	상동	X
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.(SESS)	1994.12	No.15, JinJiHu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	반도체 임가공	1,004,312	상동	O
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	2013.07	Unit 6, No.1, Yicuiyuan 3nd town(North), Jinye 2nd Road Gaoxin District, Xian, China	반도체 장비 서비스	1,483	상동	X

Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. (SEHZ)	1992.12	256,6th Road, Zhongkai Chenjiang Town, Huizhou, China	전자제품 생산	6,539,392	상동	O
Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	1993.04	#12, no 4 Big Street, Dong Ting Road Teda, Tianjin, China	CTV/모니터 생산	578,119	상동	O
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.(SET)	1994.11	10F, No.399, Rui Guang Rd., Nei Hu Dist, Taipei, Taiwan	전자제품 판매	1,168,651	상동	O
Beijing Samsung Telecom R&D Center(SRC-Beijing)	2000.09	12/F Zhongdian fazhan Building, No. 9, xiaguangli, Chaoyang District, Beijing, China	R&D	97,687	상동	O
Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.(TSTC)	2001.03	No.9 WeiWu Rd.Micro Electronic Industrial Park Xiqing Dist, Tianjin, China	통신제품 생산	962,448	상동	O
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.(SSS)	2001.10	No.88, Haide 1st Road, Nanshan District, Shenzhen, China	반도체/DP 판매	5,400,549	상동	O
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.(SESC)	2002.09	NO.198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial park, Suzhou, China	전자제품 생산	920,461	상동	O
Samsung Suzhou Module Co., Ltd.(SSM)	2002.09	NO.318, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	DP 임가공	1,078,821	상동	O
Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.(SSL)	2011.07	No.338, Fangzhou Rd., Suzhou, China	DP 생산	1,845,330	상동	O
Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.(SSET)	2002.02	Samsung Kejian Plant, No.2 songping St., North Area of Hi-tech Park, Nanshan, Shenzhen, China	통신제품 생산	41,371	상동	X
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.(SSCR)	2003.04	No.15, Jinjihu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	R&D	30,543	상동	X
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	2004.05	8/F, Huijie Plaza, 268 Zhongshan Road, Nanjing, China	R&D	52,113	상동	X
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	2012.09	No.1999, Xiaohe Road, Changan District, Xian, China	반도체 생산	10,254,900	상동	O
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	2016.04	8F Customs Clearance Center, No.5 Tonghai First Road, Changan District, Xian, China	반도체/DP 판매	491,590	상동	O
Tianjin Samsung LED Co., Ltd.(TSLED)	2009.05	No 1. Weisan Rd., Miero-Electronic Industrial Park., Xiqing Dist. Tianjin, China	LED 생산	439,574	상동	O
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	2011.03	No. 68, First Yinquan Road, Zhengxing District, Dandong, Liaoning, China	오디오제품 생산	121,071	상동	O
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	2013.03	20F, Modern Logistics No.88 Modern Avenue, Suzhou, China	오디오제품 판매	13,087	상동	X

Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	2006.09	No. 125, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	오디오제품 생산, R&D	264,798	상동	O
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	2010.10	Unit 101, No. 1, Lane 507, Middle Fuxing Road, Huangpu District, China	오디오제품 판매	2,854	상동	X
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	2007.08	Unit 01-10 of Floor 14, Unit 01-10 of Floor 15, No 383Jiaozzi Avenue, High-tech District, Chengdu, China	Connected Service Provider	20,333	상동	X
Harman Holding Limited	2007.05	Flat/RM A 12F, Kiu Fu Commercial BLDG, 300 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong	오디오제품 판매	464,183	상동	O
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	2009.06	Suite 3004, Chong Hing Finance Center, 288 Nanjing Road West, Huangpu District, Shanghai, China	오디오제품 판매, R&D	498,225	상동	O
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	2004.09	Floor 14, China Merchants Bureau Port Building, Merchants Street, Nanshan District, Shenzhen, China	오디오제품 판매, R&D	35,821	상동	X
삼성디스플레이(주)	2012.04	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1	DP 생산 및 판매	47,162,963	상동	O
에스유머티리얼스(주)	2011.08	충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-2	DP 부품 생산	31,679	상동	X
스테코(주)	1995.06	충청남도 천안시 서북구 3공단1로 20	반도체 부품 생산	169,786	상동	O
세메스(주)	1993.01	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 77	반도체/FPD 장비 생산 및 판매	1,080,229	상동	O
삼성전자서비스(주)	1998.10	경기도 수원시 영통구 삼성로 290	전자제품 수리 서비스	387,220	상동	O
삼성전자서비스씨에스(주)	2018.10	경기도 수원시 영통구 중부대로 324	서비스 콜센터	6,939	상동	X
삼성전자판매(주)	1996.07	경기도 성남시 분당구 황새울로 340	전자제품 판매	652,337	상동	O
삼성전자로지텍(주)	1998.04	경기도 수원시 영통구 삼성로 129	종합물류대행	173,309	상동	O
삼성메디슨(주)	1985.07	강원도 홍천군 남면 한서로 3366	의료기기 생산 및 판매	345,288	상동	O
㈜미래로시스템	1994.01	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120	반도체 S/W	24,034	상동	X
SVIC 21호 신기술투자조합	2011.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	83,047	상동	O
SVIC 22호 신기술투자조합	2011.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	132,618	상동	O
SVIC 26호 신기술투자조합	2014.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	200,834	상동	O
SVIC 27호 신기술투자조합	2014.09	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	32,638	상동	X
SVIC 28호 신기술투자조합	2015.02	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	226,667	상동	O
SVIC 29호 신기술투자조합	2015.04	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	38,359	상동	X
SVIC 32호 신기술투자조합	2016.08	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	137,250	상동	O

SVIC 33호 신기술투자조합	2016.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	140,123	상동	○
SVIC 37호 신기술투자조합	2017.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	23,766	상동	X
SVIC 40호 신기술투자조합	2018.06	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	2,159	상동	X
SVIC 42호 신기술투자조합	2018.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	5,007	상동	X
SVIC 43호 신기술투자조합	2018.12	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	3,000	상동	X
SVIC 45호 신기술투자조합	2019.05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	-	상동	X
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	2017.03	서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	75,263	상동	○
㈜하만인터내셔널코리아	2005.01	서울특별시 강남구 강남대로 298(역삼동), 푸르덴셜타워 5층	소프트웨어 개발 및 공급 등	19,711	상동	X
레드밴드소프트웨어코리아㈜	2007.02	경기도 성남시 분당구 성남대로926번길 10(야탑 동)	소프트웨어 개발 및 공급	1,026	상동	X

※ 주요 종속기업 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 75,000백만원 이상입니다.

※ 주요 사업에 대한 상세 내역은 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

※ 당분기 중 Duran Audio Iberia Espana S.L. 사명이 Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada로,
Samsung Electronics Greece S.A. 사명이 Samsung Electronics Greece S.M.S.A로 변경되었습니다.

(종속기업의 변동)

구 분	미주	유럽/ 중아/ CIS	아시아 (중국제 외)	중국	국내	합계	증 가	감 소
제48기 (2016년말)	44	53	23	29	20	169개사		

제49기 (2017년말)	63	109	38	38	22	270개사	<p>[국내: 4개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · 반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁 · ㈜하만인터내셔널코리아 · 레드벤드소프트웨어코리아㈜ · SVIC 37호 신기술투자조합 <p>[미주: 25개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Samsung Electronics Home Appliances America, LLC · Kngine, Inc. · AMX Holding Corporation · AMX LLC · Harman Becker Automotive Systems, Inc. · Harman Connected Services Inc. · Harman Connected Services Engineering Corp. · Harman Connected Services Holding Corp. · Harman Connected Services South America S.R.L. · Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. · Harman de Mexico S. de R.L. de C.V. · Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. · Harman Financial Group, LLC · Harman International Industries Canada Ltd. · Harman International Industries, Inc. · Harman International Mexico S de RL de CV · Harman Investment Group, LLC · Harman KG Holding, LLC · Harman Professional, Inc. · Red Bend Software Inc. · S1NN USA, Inc. · Southern Vision Systems, Inc · TowerSec Inc. · Triple Play Integration LLC · China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership <p>[유럽/CIS/중아: 62개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. · Aditi Technologies Europe GmbH · AKG Acoustics GmbH · AMX GmbH · AMX UK Limited · Duran Audio B.V. · Duran Audio Iberia Espana S.L. · Endeleo Limited · Harman Automotive UK Limited <p>[미주: 6개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Samsung Receivables Corporation · TowerSec Inc. · Kngine, Inc. · PrinterOn Inc. · PrinterOn America Corporation · Simpress Comercio, Locacao e Servicos S.A. <p>[유럽/CIS: 6개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Samsung Electronics Rus LLC · Samsung Electronics Ukraine LLC · SurfKitchen Limited · AMX LLC (Russia) · Martin Professional Ltd. · PrinterOn Europe Limited <p>[아시아: 2개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · VFX Systems PTY Ltd. · I.P.S.G. International Product Solution Group PTY. LTD. <p>[중국: 3개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Samsung Electronics (Shandong) Digital PrintingCo., Ltd. · Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd · Martin Trading Zhuhai Ltd. <p>[국내: 2개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · SVIC 20호 신기술투자조합 · 에스프린팅솔루션㈜
------------------	----	-----	----	----	----	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<ul style="list-style-type: none"> · Harman Becker Automotive Systems GmbH · Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L. · Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft · Harman Belgium SA · Harman Connected Services AB. · Harman Connected Services Finland OY · Harman Connected Services GmbH · Harman Connected Services Limited · Harman Connected Services Poland Sp.zoo · Harman Connected Services UK Ltd. · Harman Consumer Division Nordic A/S · Harman Consumer Finland OY · Harman Consumer Nederland B.V. · Harman Deutschland GmbH · Harman Finance International GP S.a.r.l · Harman France SNC · Harman Holding GmbH & Co. KG · Harman Hungary Financing Ltd. · Harman Inc. & Co. KG · Harman International Estonia OU · Harman International Industries Limited · Harman International Romania SRL · Harman Finance International, SCA · Harman International s.r.o · Harman International SNC · Harman Management GmbH · Harman Professional Kft · Inspiration Matters Limited · Knight Image Limited · Martin Manufacturing (UK) Ltd · Harman Professional Denmark ApS · Harman Professional France SAS · Harman Professional Germany GmbH · Martin Professional Ltd. · R&D International BVBA · Red Bend Software Ltd. · Red Bend Software SAS · Studer Professional Audio GmbH · Surfkitchen Limited · AMX LLC (Russia) · Harman Connected Services OOO · Harman RUS CIS LLC · Broadsense Ltd. · Global Symphony Technology Group Private Ltd. · Harman Connected Services Morocco · Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. 	
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						<ul style="list-style-type: none"> · iOnRoad Ltd · iOnRoad Technologies Ltd · Red Bend Ltd. · TowerSec Ltd. · Innoetics E.P.E. · ARCAM Ltd · A&R Cambridge Ltd <p>[아시아: 17개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · AMX Products And Solutions Private Limited · Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd · Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. · Harman Connected Services Japan Co. Ltd. · Harman International (India) Private Limited · Harman International Industries PTY, Ltd. · Harman International Japan Co. Ltd. · Harman International Singapore Pte. Ltd. · Harman Malaysia Sdn. Bhd. · Harman Professional Singapore Pte. Ltd · I.P.S.G. International Product Solution Group PTY. LTD. · INSP India Software Development Pvt. Ltd. · Martin Professional Pte. Ltd. · Red Bend Software Japan Co., Ltd. · Studer Japan, Ltd. · VFX Systems PTY Ltd. · Samsung Nepal Services Pvt, Ltd <p>[중국: 12개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Harman (China) Technologies Co. Ltd. · Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co. Ltd. · Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co. Ltd · Harman Commercial (Shanghai) Co. Ltd. · Harman Connected Services Solutions (Beijing) Co., Ltd. · Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd. · Harman Connected Services Taiwan Inc. · Harman Holding Limited · Harman International (China) Holdings Co. Ltd · Harman Automotive InfoTech (Dalian) Co., Ltd. · Harman Technology (Shenzhen) Co. Ltd. · Martin Trading Zhuhai Ltd.
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

제50기 (2018년말)	56	100	35	36	25	252개사	<p>[미국: 1개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zhilabs Inc. <p>[유럽/CIS: 1개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zhilabs, S.L. <p>[국내: 4개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · SVIC 40호 신기술투자조합 · SVIC 42호 신기술투자조합 · SVIC 43호 신기술투자조합 · 삼성전자서비스씨에스㈜ 	<p>[미국: 8개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · NexusDX, Inc. · S1NN USA, Inc. · Samsung Pay, Inc. · Harman Connected Services Holding Corp. · AMX LLC · AMX Holding Corporation · Southern Vision Systems, Inc · Triple Play Integration LLC <p>[유럽/CIS: 10개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Joyent Ltd. · Aditi Technologies Europe GmbH · AMX GmbH · Harman Professional Germany GmbH · Endeleo Limited · Harman Consumer Finland OY · Harman Consumer Division Nordic ApS · Inspiration Matters Limited · Knight Image Limited · R&D International BVBA <p>[아시아: 3개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Harman Malaysia Sdn. Bhd. · Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd. · INSP India Software Development Pvt. Ltd. <p>[중국: 2개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · Harman Connected Services Taiwan Inc. · Harman Automotive InfoTech (Dalian) Co., Ltd. <p>[국내: 1개사]</p> <ul style="list-style-type: none"> · SVIC 23호 신기술투자조합
------------------	----	-----	----	----	----	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

제51기 3분기 (2019년 9월말)	56	98	32	34	26	246개사	[유럽/CIS/중아: 2개사]	[유럽/CIS/중아: 4개사]
							[아시아: 1개사]	[아시아: 4개사]
							<ul style="list-style-type: none"> · Corephotronics Ltd. · FOODIENT LTD. 	<ul style="list-style-type: none"> · BroadSense Ltd. · Samsung France Research Center SARL (SFRC) · Innoetics E.P.E. · iOnRoad Ltd
							<ul style="list-style-type: none"> · Samsung Display Noida Private Limited(SDN) 	<ul style="list-style-type: none"> · Harman Connected Services Japan Co., Ltd. · Harman International Singapore Pte. Ltd. · Red Bend Software Japan Co., Ltd. · Studer Japan Ltd.
							<ul style="list-style-type: none"> · SVIC 45호 신기술투자조합 	<ul style="list-style-type: none"> · Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited(SBSC) · Harman Connected Services Solutions (Beijing) Co., Ltd.

(당기 중 종속기업 변동내용)

구분	회사명	변동내용	비 고
신규 연결	Corephotronics Ltd.	지분 취득	-
	FOODIENT LTD.	지분 취득	-
	Samsung Display Noida Private Limited(SDN)	설립	-
	SVIC 45호 신기술투자조합	설립	-
연결 제외	BroadSense Ltd.	청산	-
	Samsung France Research Center SARL(SFRC)	청산	-
	Innoetics E.P.E.	합병	합병존속회사: Samsung Electronics Greece S.M.S.A(SEGR)
	iOnRoad Ltd	청산	-
	Harman Connected Services Japan Co., Ltd.	합병	합병존속회사: Harman International Japan Co., Ltd.
	Harman International Singapore Pte. Ltd.	합병	합병존속회사: Harman Singapore Pte. Ltd.
	Red Bend Software Japan Co., Ltd.	합병	합병존속회사: Harman International Japan Co., Ltd.
	Studer Japan Ltd.	합병	합병존속회사: Harman International Japan Co., Ltd.
	Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited(SBSC)	합병	합병존속회사: Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.(SCIC)
	Harman Connected Services Solutions (Beijing) Co., Ltd.	청산	-

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 무디스(Moody's) 및 S&P로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다. 2019년 3분기말 현재 Moody's의 당사 평가등급은 Aa3, 투자전망은 안정적(Stable)이고, S&P의 당사 평가등급은 AA-, 투자전망은 안정적(Stable)입니다.

평가일	평가대상 유가증권	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사	비고
'17.02	회사채	A1	Moody's(미국)	정기평가
'17.07	회사채	AA-	S&P(미국)	정기평가
'17.08	회사채	A1	Moody's(미국)	정기평가
'18.02	회사채	A1	Moody's(미국)	정기평가
'18.06	회사채	Aa3	Moody's(미국)	정기평가
'18.07	회사채	AA-	S&P(미국)	정기평가
'18.11	회사채	Aa3	Moody's(미국)	정기평가
'19.05	회사채	Aa3	Moody's(미국)	정기평가
'19.07	회사채	AA-	S&P(미국)	정기평가
'19.08	회사채	Aa3	Moody's(미국)	정기평가

※ 회사채: 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '6. 기타 재무에 관한 사항(마. 채무증권 발행실적 등)' 참조

※ 신용평가등급 범위: Moody's (Aaa ~ C), S&P (AAA ~ D)

구분	Moody's		S&P	
	등급	정 의	등급	정 의
투자적격 등급	Aaa	채무상환능력 최상, 신용위험 최소	AAA	채무상환능력이 극히 높음, 최고등급
	Aa1/Aa2/Aa3	채무상환능력 높음, 신용위험 매우 낮음	AA+/AA/AA-	채무상환능력이 매우 높음
	A1/A2/A3	채무상환능력 중상, 신용위험 낮음	A+/A/A-	채무상환능력은 충분하나 경제 상황 악화 및 변화에 다소 취약함
	Baa1/Baa2/ Baa3	채무상환능력 중간, 신용위험 크지 않으나 투기적 요소가 있음	BBB+/BBB/ BBB-	채무상환능력은 충분하나 상위 등급에 비해 경제 상황악화에 좀 더 취약함
투기 등급	Ba1/Ba2/Ba3	투기적 성향, 신용위험 상당함	BB+/BB/BB-	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 낮으나 경영, 재무, 경제 상황 악화에 대한 불확실성이 큼
	B1/B2/B3	투기적 성향, 신용위험 높음	B+/B/B-	경영, 재무, 경제 상황 악화에 좀 더 취약하나 현재로서는 채무상환능력이 있음
	Caa	투기적 성향 높음, 신용위험 매우 높음	CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며 채무상환은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 가능함
	Ca	투기적 성향 매우 높음, 가까운 시일 내 부도 발생 가능, 원리금 상환가능성 존재	CC	채무불이행 가능성이 높음, 부도 상태는 아니지만 사실상 부도가 예상됨
	C	부도 상태, 원리금 상환가능성 낮음	C	현재 채무불이행 가능성이 매우 높으며 최종 회수율은 상위등급 채무보다 낮게 추정됨
			D	금융채무불이행 상태 혹은 묵시적 계약 (imputed promises) 파 기, 또는 파산 신청 혹은 이와 유사한 상태

2. 회사의 연혁

(회사의 연혁)

1969.01.13	삼성전자공업주식회사로 설립
1975.06.11	기업공개
1984.02.28	삼성전자주식회사로 상호 변경
1988.11.01	삼성반도체통신주식회사 흡수 합병
2012.04.01	LCD사업부 분사
2015.01.01	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 STA(Samsung Telecommunications America LLC) 흡수합병
2015.02.23	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 LoopPay사(100%) 지분 인수
2016.01.28	삼성카드(주) 지분(37.5%) 매각
2016.06.24	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Joyent사(100%) 지분 인수
2016.09.07	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Dacor사(100%) 지분 인수
2016.10.07	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Viv Labs사(100%) 지분 인수
2016.11.01	프린팅솔루션사업부 분할(에스프린팅솔루션(주) 설립)
2017.03.10	종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Harman International Industries, Inc.사(100%) 지분 인수
2017.11.01	프린팅솔루션 사업 매각
2018.05.17	종속기업인 NexusDX, Inc.사 지분 매각
2019.01.28	종속기업인 SEBN(Samsung Electronics Benelux B.V.)의 Corephotonics Ltd.사 지분 인수
2019.06.01	관계기업인 삼성전기(주)로부터 PLP(Panel Level Package) 사업 양수

(회사의 본점소재지 및 그 변경)

당사의 본점소재지는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)입니다.
공시대상기간 중 본점소재지의 변경은 없었습니다.

(상호의 변경)

2015년 중 종속기업 Samsung Electronics KZ and Central Asia LLP의 사명이 Samsung Electronics Central Eurasia LLP로, Samsung Electronics Morocco SARLAU의 사명이 Samsung Electronics Maghreb Arab으로, Samsung Display Bac Ninh의 사명이 Samsung Display Vietnam Co., Ltd.로, Samsung Network R&D Center China-Shenzhen의 사명이 Samsung R&D Institute China-Shenzhen로, Samsung Display Suzhou Co., Ltd.의 사명이 Samsung Suzhou Module Co., Ltd.로, LoopPay, Inc.의 사명이 Samsung Pay, Inc.로 변경되었습니다.

2016년 중에는 종속기업 YESCO Electronics LLC의 사명이 Prismview, LLC로 변경되었습니다.

2017년 중에는 종속기업 Quietside LLC의 사명이 Samsung HVAC America, LLC로, NewNet Communication Technologies(Canada), Inc.의 사명이 SigMast Communications Inc.로, Martin Professional ApS의 사명이 Harman Professional Denmark ApS로, Martin Professional France SAS의 사명이 Harman Professional FranceSAS로, Martin Professional GmbH의 사명이 Harman Professional Germany GmbH로, Harman Neusoft Automotive Infotech (Dalian) Co. Ltd의 사명이 Harman Automotive InfoTech (Dalian) Co., Ltd.로 변경되었습니다.

2018년 중에는 종속기업 Harman Consumer Division Nordic A/S의 사명이 Harman Consumer Division Nordic ApS로, Harman Connected Services Finland OY의 사명이 Harman Finland Oy로, Harman Professional Singapore Pte. Ltd의 사명이 Harman Singapore Pte. Ltd.로 변경되었습니다.

2019년 중에는 종속기업 Samsung Electronics Greece S.A. 사명이 Samsung Electronics Greece S.M.S.A로 로 변경되었습니다.

(경영진의 중요한 변동)

당사는 2015년 3월 13일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 권오현 사내이사가 재선임되었으며, 사외이사 임기만료자 2인(김한중, 이병기)이 재선임되었습니다.

2016년 3월 11일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 3인(윤부근, 신종균, 이상훈)이 재선임되었습니다. 또한 사외이사 임기만료자 3인(이인호, 송광수, 김은미) 중 김은미 사외이사는 퇴임하고, 이인호, 송광수 사외이사가 재선임되었으며, 박재완 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2016년 10월 27일 임시 주주총회를 통해 이재용 사내이사가 신규 선임되었으며, 이상훈 사내이사가 사임하였습니다.

2018년 3월 23일 주주총회를 통해 이상훈, 김기남, 김현석, 고동진 사내이사와 김종훈, 김선욱, 박병국 사외이사가 신규 선임되었으며, 사내이사 임기만료자(권오현)와 사외이사 임기만료자 2인(김한중, 이병기)이 퇴임하고 윤부근, 신종균 사내이사가 사임하였습니다. 2018년 3월 23일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.

2019년 3월 20일 주주총회를 통해 사외이사 임기만료자 박재완 사외이사가 재선임되었으며 김한조, 안규리 사외이사가 신규 선임되었습니다. 또한 사외이사 임기만료자 2인(이인호, 송광수)이 퇴임하였습니다.

2019년 10월 26일 임기만료자 이재용 사내이사가 퇴임하였습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이상훈, 김기남, 김현석, 고동진), 사외이사 6인(박재완, 김선욱, 박병국, 김종훈, 안규리, 김한조), 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다.

(최대주주의 변동)

해당사항 없음

(회사의 업종 또는 주된 사업의 변화)

해당사항 없음

(그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용)

당사는 2015년 12월 LED사업부를 LED사업팀으로 조직개편하였습니다.

2016년 11월 프린팅솔루션사업부를 에스프린팅솔루션(주)로 분할하였습니다.

2017년 6월 System LSI사업부를 Foundry사업부와 System LSI사업부로 분리하였습니다.

[2015년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

[2016년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

[2017년 6월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, Foundry, DP)
	-	Harman부문
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

※ 2018년 1분기부터 의료기기사업부는 CE 부문에서 제외되었습니다.

3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종 류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2019년 3분기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 보통주) 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 우선주)의 수는 각각 7,780,466,850주와 1,194,671,350주입니다. 당사는 2019년 3분기말 현재까지 보통주 1,810,684,300주와 우선주 371,784,650주를 이사회 결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다.(주식분할 반영 기준) 2019년 3분기말 현재 유통주식수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고	
	보통주	우선주	합계		
I. 발행할 주식의 총수	20,000,000,000	5,000,000,000	25,000,000,000	-	
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,780,466,850	1,194,671,350	8,975,138,200	-	
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	-	
1. 감자	-	-	-	-	
	2. 이익소각	1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	자사주소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	5,969,782,550	822,886,700	6,792,669,250	-	
V. 자기주식수	-	-	-	-	
VI. 유통주식수 (IV-V)	5,969,782,550	822,886,700	6,792,669,250	-	

※ 상기 주식의 총수 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.

당사는 2018년 5월 3일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주 및 기명식 우선주 (각 1주당 액면가 5,000원)를 각 50주(각 1주당 액면가 100원)로 분할하였습니다.

나. 자기주식

당사는 보유한 자기주식을 주주환원의 목적으로 2018년 중 모두 소각하였습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 주)

취득방법		주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
				취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당가능 이익 범위내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-
	소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	
		우선주	-	-	-	-	-	
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유수량	보통주	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-
		현물보유수량	보통주	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-
기타 취득(c)		보통주	-	-	-	-	-	
		우선주	-	-	-	-	-	
총 계(a+b+c)		보통주	-	-	-	-	-	
		우선주	-	-	-	-	-	

다. 다양한 종류의 주식

당사는 기명식 보통주 외 비누적적 무의결권 기명식 우선주가 있습니다. 동 우선주는 보통주의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을 더 받을 수 있도록 하고 있습니다.

2019년 3분기말 현재 비누적적 무의결권 기명식 우선주의 발행주식수는 822,886,700주입니다.

[우선주 발행현황]

구 분		내 용		
발행일자		1989년 08월 25일(최초 발행일)		
주당 액면가액		100원		
발행총액(액면가기준) / 발행주식수		119,467백만원	1,194,671,350주	
현재 잔액/ 현재주식수		82,289백만원	822,886,700주	
주식의 내용	이익배당에 관한 사항		액면금액 기준 보통주보다 1%의 금전배당을 추가로 받음	
	잔여재산분배에 관한 사항		-	
	상환에 관한 사항	상환조건	-	
		상환방법	-	
		상환기간	-	
		주당 상환가액	-	
		1년 이내 상환 예정인 경우	-	
	전환에 관한 사항	전환조건	-	
		전환청구기간	-	
		전환으로 발행할 주식의 종류	-	
		전환으로 발행할 주식수	-	
	의결권에 관한 사항		의결권 없음	
	기타 투자 판단에 참고할 사항		-	

※ 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면 총액은 82,289백만원으로 납입자본금(119,467백만원)과 상이합니다.

상기 발행주식수, 현재주식수 등은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.

일 자	변 동	증가(감소)한 주식의 내용					
		종류	수량(주)	주 당 액면가액(원)	액면가액 합계(원)	주 당 발행가액(원)	발행가액 합계(원)
1989.08.25	유상증자	우선주	3,400,000	5,000	17,000,000,000	28,800	97,920,000,000
1989.08.25	무상증자	우선주	340,000	5,000	1,700,000,000	5,000	1,700,000,000
1990.10.29	전환권 행사	우선주	371,620	5,000	1,858,100,000	29,600	10,999,952,000
1991.03.19	전환권 행사	우선주	40,898	5,000	204,490,000	29,341	1,199,988,218
1991.03.30	전환권 행사	우선주	5,112	5,000	25,560,000	29,341	149,991,192
1991.04.08	전환권 행사	우선주	1,704	5,000	8,520,000	29,341	49,997,064
1991.05.17	DR 발행	우선주	1,907,671	5,000	9,538,355,000	37,973	72,439,990,883
1991.07.24	전환권 행사	우선주	34,081	5,000	170,405,000	29,341	999,970,621
1991.07.30	전환권 행사	우선주	20,449	5,000	102,245,000	29,341	599,994,109
1991.07.31	전환권 행사	우선주	64,754	5,000	323,770,000	29,341	1,899,947,114
1991.08.30	전환권 행사	우선주	214,716	5,000	1,073,580,000	29,341	6,299,982,156
1991.09.30	전환권 행사	우선주	20,448	5,000	102,240,000	29,341	599,964,768
1993.06.17	DR 발행	우선주	2,542,372	5,000	12,711,860,000	47,312	120,284,704,064
1993.10.29	전환권 행사	우선주	105,999	5,000	529,995,000	28,302	2,999,983,698
1993.11.12	DR 발행	우선주	2,158,273	5,000	10,791,365,000	55,975	120,809,331,175
1993.11.29	전환권 행사	우선주	58,295	5,000	291,475,000	28,302	1,649,865,090
1993.11.30	전환권 행사	우선주	19,079	5,000	95,395,000	28,302	539,973,858
1994.04.06	DR 발행	우선주	1,086,956	5,000	5,434,780,000	74,502	80,980,395,912
1994.06.03	전환권 행사	우선주	16,027	5,000	80,135,000	25,809	413,640,843
1994.06.06	전환권 행사	우선주	9,072	5,000	45,360,000	25,809	234,139,248
1994.06.13	전환권 행사	우선주	17,236	5,000	86,180,000	25,809	444,843,924
1994.06.22	전환권 행사	우선주	1,209	5,000	6,045,000	25,809	31,203,081
1994.06.27	전환권 행사	우선주	16,632	5,000	83,160,000	25,809	429,255,288
1994.06.28	전환권 행사	우선주	54,131	5,000	270,655,000	25,809	1,397,066,979
1994.06.29	전환권 행사	우선주	292,127	5,000	1,460,635,000	25,809	7,539,505,743
1994.06.30	전환권 행사	우선주	52,922	5,000	264,610,000	25,809	1,365,863,898
1994.07.01	전환권 행사	우선주	232,854	5,000	1,164,270,000	25,809	6,009,728,886
1994.07.04	전환권 행사	우선주	116,426	5,000	582,130,000	25,809	3,004,838,634
1994.07.05	전환권 행사	우선주	188,401	5,000	942,005,000	25,809	4,862,441,409
1994.07.06	전환권 행사	우선주	686,164	5,000	3,430,820,000	25,809	17,709,206,676
1994.07.07	전환권 행사	우선주	270,349	5,000	1,351,745,000	25,809	6,977,437,341
1994.07.08	전환권 행사	우선주	977,068	5,000	4,885,340,000	25,809	25,217,148,012
1994.07.12	전환권 행사	우선주	6,048	5,000	30,240,000	25,809	156,092,832
1994.07.19	전환권 행사	우선주	68,040	5,000	340,200,000	25,809	1,756,044,360
1994.07.20	전환권 행사	우선주	4,232	5,000	21,160,000	25,809	109,223,688
1994.08.12	전환권 행사	우선주	944	5,000	4,720,000	25,502	24,073,888
1995.03.13	무상증자	우선주	3,028,525	5,000	15,142,625,000	5,000	15,142,625,000
1996.03.13	무상증자	우선주	5,462,593	5,000	27,312,965,000	5,000	27,312,965,000
2003.04.14	이익소각	우선주	△470,000	5,000	△2,350,000,000	-	-
2004.01.15	이익소각	우선주	△330,000	5,000	△1,650,000,000	-	-
2004.05.04	이익소각	우선주	△260,000	5,000	△1,300,000,000	-	-
2016.01.15	이익소각	우선주	△1,240,000	5,000	△6,200,000,000	-	-

2016.04.20	이익소각	우선주	△530,000	5,000	△2,650,000,000	-	-
2016.07.19	이익소각	우선주	△320,000	5,000	△1,600,000,000	-	-
2016.09.28	이익소각	우선주	△230,000	5,000	△1,150,000,000	-	-
2017.04.12	이익소각	우선주	△255,000	5,000	△1,275,000,000	-	-
2017.05.02	이익소각	우선주	△1,614,847	5,000	△8,074,235,000	-	-
2017.07.24	이익소각	우선주	△225,000	5,000	△1,125,000,000	-	-
2017.10.25	이익소각	우선주	△168,000	5,000	△840,000,000	-	-
2018.01.30	이익소각	우선주	△178,000	5,000	△890,000,000	-	-
2018.05.03	주식분할	우선주	885,556,420	100	-	-	-
2018.12.04	이익소각	우선주	△80,742,300	100	△8,074,230,000	-	-
우선주 계			822,886,700		82,288,670,000		642,261,376,652

[△는 부(-)의 값임]

5. 의결권 현황

당사 보통주 발행주식총수는 5,969,782,550주이며 정관 상 발행할 주식 총수(250억주)의 23.9%에 해당됩니다. 보통주 외 822,886,700주의 우선주를 발행하였습니다. 이 중 우선주는 의결권이 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(598,050,438주)을 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 5,371,732,112주입니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	5,969,782,550	-
	우선주	822,886,700	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	822,886,700	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	596,959,200	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 제한 (삼성생명보험(주) 508,157,148주, 삼성화재해상보험(주) 88,802,052주)
	보통주	1,091,238	「보험업법」에 의한 제한 (삼성생명보험(주) 특별계정 일부)
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	5,371,732,112	-
	우선주	-	-

※ '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한'된 주식 중, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 제한
주식수 596,959,200주(삼성생명보험(주) 고유계정 508,157,148주, 삼성화재해상보험(주) 88,802,052주) 중
일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사가 가능합니다.

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 등을 실시하고 있습니다. 현금배당 등의 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제51기 3분기	제50기	제49기
주당액면가액(원)		100	100	100
(연결)당기순이익(백만원)		16,277,059	43,890,877	41,344,569
(별도)당기순이익(백만원)		11,737,687	32,815,127	28,800,837
(연결)주당순이익(원)		2,396	6,461	5,997
현금배당금총액(백만원)		7,213,815	9,619,243	5,826,302
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		44.3	21.9	14.1
현금배당수익률(%)	보통주	2.2	3.7	1.7
	우선주	2.6	4.5	2.1
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	1,062	1,416	850
	우선주	1,062	1,417	851
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ 제51기 1분기 배당금은 2,404,605백만원(주당 354원), 2분기 배당금은 2,404,605백만원(주당 354원), 3분기 배당금은 2,404,605백만원(주당 354원)이며, 제50기 1분기 배당금은 2,404,605백만원(주당 354원),

2분기 배당금은 2,404,605백만원(주당 354원), 3분기 배당금은 2,404,605백만원(주당 354원)입니다.

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.

※ 기본주당이익 산출근거는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주식' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 당사는 2018년 5월 3일을 효력 발생일로 하여 주식분할[기명식 보통주 및 기명식 우선주(각 1주당 액면가 5,000원)를 각 50주(각 1주당 액면가 100원)]을 실시하였습니다.

상기 제49기의 경우 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, Harman 산하 종속기업 등 246개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업군별로 보면 Set 사업에서는 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기 등을 생산·판매하는 CE 부문과 스마트폰 등 HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산·판매하는 IM 부문이 있습니다. 부품사업에서는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산·판매하고 있는 반도체 사업과 모바일·TV·모니터·노트북 PC용 등의 OLED 및 TFT-LCD 디스플레이 패널을 생산·판매하고 있는 DP 사업의 DS 부문으로 구성되어 있습니다. 또한 2017년 중 인수한 Harman 부문에서 Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등을 생산·판매하고 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문		주요 제품
CE 부문		TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등
IM 부문		HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등
DS 부문	반도체 사업	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등
	DP 사업	OLED 스마트폰 패널, LCD TV 패널, 모니터 패널 등
Harman 부문		Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등

지역별로 보면 국내에는 CE, IM 부문 및 반도체 사업을 총괄하는 본사와 26개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다.

본사는 수원, 구미, 기흥, 화성, 평택, 광주사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매, 제품의 서비스를 담당하는 삼성전자서비스 및 제품의 운송을 담당하는 삼성전자로지텍 등 총 26개의 비상장 종속기업으로 구성되어 있습니다.

해외는 미주, 유럽, 아시아, 아프리카 등지에서 생산, 판매, 연구활동을 담당하는 220개의 해외 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주는 TV, HHP 등 Set제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(뉴저지, 미국), TV 생산을 담당하는 SII(샌디에고, 미국), 반도체 제조를 담당하는 SAS(오스틴, 미국), Harman 등을 포함하여 총 56개의 판매·생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽은 Set제품 판매를 담당하는 SEUK(영국), SEF(프랑스), SEG(독일), SEI(이탈리아) 등의 판매법인이 있으며, TV 생산을 담당하는 SESK(슬로바키아), SEH(헝가리) 및 냉장고 등 가전생산을 담당하는 SEPM(폴란드) 등의 생산법인 등을 포함하여 총 69개의 법인이 운영되고 있습니다.

아시아(중국 제외)는 SAPL(싱가포르)을 중심으로 SEAU(호주), SEPCO(필리핀), SME(말레이시아) 등 판매법인이 있으며, HHP 생산법인 SEV·SEVT(베트남), TV 등생산법인 SEHC(베트남), HHP 등 복합 생산법인 SIEL(인도) 등을 포함하여 총 32개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국은 중국 내 Set제품 판매를 담당하는 SCIC(북경), SEHK(홍콩) 등의 판매법인과 Set제품의 생산, 부품 생산 및 임가공을 담당하는 혜주, 서안 및 소주 등의 생산법인(SEHZ, SCS, SESS 등)을 포함하여 총 34개의 법인이 운영되고 있습니다.

아프리카, 중동, CIS에서는 판매·생산 등을 담당하는 29개 법인이 운영되고 있습니다.

[CE 부문]

(산업의 특성 등)

TV산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산·판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관(1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV사업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 디지털 방송 확산(영·미 1998년~)을 통해 TV 시장은 성장 모멘텀을 되찾았으며, FPTV는 화질, 디자인 등 제품 성능 향상과 지속적인 Set가격 하락을 통해 성장을 지속하며 기존 CRT 시장을 빠르게 대체하였습니다.

또한 2010년 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고, 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스 업체들의 부상과 스마트기기에 대한 사용자들의 관심 확대로 스마트 TV 시장이 태동하였습니다. 2013년에는 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV, 2014년에는 새로운 Form Factor인 Curved TV가 출시되었으며 2015년에는 퀀텀닷 TV가 상용화되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하였습니다.

전체 TV 수요는 2017년 기준 2억 1,510만대 수준으로 LCD TV 수요가 2억 1천만대로 99% 이상의 시장 점유를 이어 나갔으며, OLED 수요는 159만대로 성장하였으나 비중은 0.7%로 영향이 미미하였습니다. 2018년도 전체 TV 수요는 2억 2,100만대 이상을 기록하며 전년 대비 2.9% 성장하였습니다.

2019년 TV시장은 고해상도 대형화면에 대한 Needs가 지속적으로 증가하여, UHD TV는 전년 대비 16% 증가한 1억 1,478만대로 시장 비중 52% 수준이 될 전망이며, 75"이상 초대형 시장도 당사의 수요 창출 노력으로 전년 대비 60% 이상 성장이 전망되고 있습니다. 또한 QLED 연간 수요도 당사의 지속적인 제품력 개선 및 프리미엄 수요층 확대 등으로 전년 대비 약 102% 성장할 것으로 예상됩니다.

(국내외 시장여건 등)

TV시장의 Mega Trend인 대형화·고화질화가 Device간, 업체간 경쟁 격화에 따라 더욱 빠른 속도로 진행되고 있으며, 이에 제품력, 브랜드파워를 앞세운 Major 업체의 강세가 지속되고 있습니다. 또한 고화질 및 슬림 제품에 대한 소비자 Needs가 높아짐에 따라 친환경 소재인 LED BLU(Back Light Unit)를 적용하여 TV의 밝기와 명암비는 높이고 소비전력을 낮춘 LED TV가 시장의 Main Stream으로 자리 잡았습니다

한편 시청자가 콘텐츠를 구매하는 생태계 변화에 맞춰, 당사는 TV에서 다양한 콘텐츠를 쉽게 사용할 수 있도록 스마트UX 혁신을 이뤄냈으며(2015년), 연결된 주변기기를 자동으로 인식할뿐만 아니라 하나의 리모컨으로 인식된 주변기기를 컨트롤 하고, TV 시청을 방해 받지 않고 다양한 소스를 한 화면에서 이용할 수 있도록 하였습니다.(2016년)

또한 TV에서의 경험을 모바일로 확장하여 모바일 기기를 통해 쉽게 스마트 허브를 이용하고 TV를 제어할 수 있도록 하였으며, 지능형 음성인식 기능을 이용하여 볼륨,채널 이동, 화면 모드 변경까지 사용자가 원하는 TV 제어 기능을 더욱 쉽게 활용 할 수 있도록 했습니다.(2017년)

그리고 점차 대형화되는 TV 시장 변화에 맞추어 75"와 82" 초대형 사이즈 TV 판매를 주도하여 수요를 확대했고, 동시에 새로운 Lifestyle 가치를 제공하는 Ambient Mode(한국: 매직 스크린 모드)를 Q라인업 차별화로 도입하였습니다. Bixby 전사 음성 솔루션 도입을 통해 IoT / AI로 소비자와 시장 변화 대응의 근간을 마련하였고, 이를 통해 콘텐츠·정보를 이어 보고 들을 수 있는 MDE(Multi Device Experience) 이용경험을 제공하고 있습니다.(2018년)

QLED는 더욱더 강화된 제품력으로 시장에서 큰 호평을 얻고 있습니다. 초대형에서 중형까지 다양한 사이즈의 라인업으로 소비자에게 넓은 선택의 기회를 제공하고 있으며, 작년보다 한층 개선된 화질로 전문가 및 소비자로부터 좋은 평가를 받고 있습니다.

Q900 제품은 UHD보다 4배의 해상도를 표현할 수 있는 QLED 8K TV로, 이 모델은 당사가 독자 개발한 '퀀텀 프로세서'가 탑재돼 있습니다. 퀀텀 프로세서는 저해상도와 고해상도 영상 간 특성 차이를 머신러닝 기반으로 분석해 알맞은 시청 경험을 제공합니다. 올해 새롭게 강화된 Ambient Mode와 One Invisible Connection을 통해서도 TV가 Lifestyle 제품이자 인테리어 제품으로서 고객 Needs에 맞는 프리미엄 이미지를 강화하였습니다. 고해상도 TV인 QLED 8K TV의 글로벌시장 도입을 통해 대형화·고화질화 Trend 및 소비자 Needs에 맞는 프리미엄 시장을 창출해 나가겠습니다.

2019년에는 2018년에 도입한 주요 서비스와 초고해상도 기술력을 더욱 고도화하고 소비자들에 대한 lock-in effect를 통한 고객의 충성심을 확보하여 이를 기반으로 다양한 콘텐츠 수익화 모델을 발굴 및 강화하고자 합니다.

<CE 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 3분기	2018년	2017년
TV	30.5%	29.0%	26.5%

※ 2017년, 2018년 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 세계시장점유율 자료(금액기준)를 활용하였으며, 2019년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2006년 이후 2018년까지 13년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하였습니다. 특히 2009년에는 세계 최초로 LED TV(LED BLU, 초슬림·초경량화, 친환경)라는 신규 category를 창출하였고, 2010년 1분기 세계 최초로 3D TV뿐만 아니라 3D 블루레이 플레이어·3D 홈시어터·3D 콘텐츠·3D 안경 등을 총망라한 '3D Total Solution'을 갖추며 압도적인 경쟁력 우위로 3D TV시장을 선점하였습니다. 이에 더하여 2010년에 세계 최초 TV용 App Store 'Samsung Apps'를 론칭한 이후 2011년에는 다양한 스마트 서비스를 지속 추가하여 '스마트 TV = SAMSUNG'이라는 이미지를 확립하였습니다. 또한 2012년 당사는 음성·제스처 기반의 신개념 입력방식(Smart Interaction)을 활용한 콘텐츠 개발을 통해 온 가족이 이용할 수 있는 서비스를 강화하였고, 2013년에는 기존 대비 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV를 출시하였습니다. 2014년에는 신규 Form factor인 Curved TV 출시, 2015년은 나노입자의 퀀텀닷 SUHD TV의 최초 출시를 통해 Premium 시장을 주도하며 리더십을 유지하였고, 2016년은 2세대 퀀텀닷, HDR 1000 기술로 화질의 디테일을 한층 끌어 올렸습니다.

2017년에 당사는 QLED TV로 신규 카테고리 창출을 통해 어떤 밝기 영역에서나 정확한 컬러를 표현할 수 있는 컬러 볼륨 100%를 구현하고, 최고 2,000 nit 밝기까지 제공하여 더 이상의 화질 논쟁이 필요 없는 궁극의 화질을 제공하였습니다. 또한, 유명 아티스트와 갤러리·미술관과의 협업을 통해 세계적인 명화, 사진 작품부터 개인 사진 등을 예술 작품처럼 감상할 수 있는 '더 프레임(The Frame) TV'를 선보여 소비자의 Lifestyle과 일체화된 'Screen Everywhere'의 비전을 제시하였습니다.

2018년에 당사는 QLED TV에 로컬디밍 기술을 적용하여 블랙 및 콘트라스트 등 화질 개선을 통한 시청 경험 향상뿐만 아니라, 다양한 콘텐츠를 보다 쉽고 편리하게 탐색하고 즐길 수 있으며 기기 간의 연결성 강화 및 AI·IoT 경험을 선사하여 Lifestyle 경험을 확대하였습니다. 또한 데이터 신호 케이블과 TV 전원선을 결합한 단 하나의 투명 케이블을 통한 선처리, 비시청시간에도 TV를 공간과 조화롭게 꾸미고 사용자가 원하는 다양한 정보들을 실시간 제공하는 혁신적 기능인 Ambient Mode로 TV 자체의 아름다움을 넘어 공간과 자연스럽게 어울리는 TV를 지향하였습니다.

2019년에 당사는 UHD보다 4배의 해상도인 8K 초고화질 QLED TV를 선보이는 등, TV 업계 리더로서, 소비자에게 진정으로 TV의 가치를 전달하고자 지속적 변화와 혁신적인 제품으로 시장 정체 국면에서도 끊임없이 노력하도록 하겠습니다.

이 제품들은 주거 공간에 자신의 취향과 라이프스타일을 반영하고자 하는 밀레니엄 세대의 특성을 고려했을뿐만 아니라 '누구든지 자신의 취향을 존중 받아야 한다'는 제품 철학을 기반으로 만들어졌습니다.

'더 프레임(The Frame)'은 '아트모드(Art Mode)' 기능을 통해 TV를 시청하지 않을 때에는 미술 작품이나 사진을 스크린에 띄워 마치 액자처럼 활용할 수 있습니다. 올해로 출시 3년차인 2019년형 '더 프레임'은 QLED 디스플레이가 채용되어 보다 생생한 고화질을 구현하며 TV와 연결되는 모든 선을 투명한 하나의 케이블로 통합한 '매직케이블'이 적용되어 공간에 구애 받지 않고 자유롭게 TV를 배치할 수 있습니다.

'더 세리프(The Serif)'는 2016년 프랑스 출신의 세계적인 가구 디자이너 로낭&에르완 부홀렉(Ronan & Erwan Bouroullec) 형제가 참여해 탄생한 제품으로 심미적 가치에 중점을 두었습니다. 2019년형 '더 세리프'는 대형 TV 선호 트렌드를 반영해 기존 24~40"에서 중대형 43·49·55"로 재출시하였습니다.

'더 세로(The Sero)'는 모바일로 콘텐츠를 즐기는데 익숙한 밀레니얼 세대의 특성을 심층적으로 분석해 기존의 TV와는 달리 세로 방향의 스크린을 기본으로 하는 신개념 TV입니다. 이 제품은 모바일 콘텐츠에 최적화된 세로 스크린을 지원해 딱 찬 화면으로 콘텐츠를 즐길 수 있으며, TV 화면을 가로로 회전시켜 기존 TV와 같은 시청 경험도 가능합니다.

[IM 부문]

(산업의 특성 등)

휴대폰 산업은 1980년대 초 음성 통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였으며, 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 글로벌로 확산되어 2018년에 판매된 휴대폰의 78%가 LTE를 지원하고 있습니다.(출처: Strategy Analytics 2019.8월) 또한 2019년 초 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국에서 본격 상용화되었으며, 유럽과 호주 등으로 확산되고 있습니다. 5G 스마트폰은 2019년 1,200만대 판매가 예상되고 있습니다.(출처: Strategy Analytics 2019.8월)

스마트폰은 2007년 이후 큰 폭으로 성장해 왔으며, 2019년 전체 휴대폰 중 스마트폰의 비중은 76% 수준이 될 것으로 전망되고 있습니다. 일부 성장 시장에서의 LTE 피쳐폰 수요 등으로 피쳐폰 비중도 24% 수준을 유지하고 있습니다.(출처: Strategy Analytics 2019.9월) 스마트폰 보급률은 2018년 46%에서 2019년 48%로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다.(출처: Strategy Analytics 2019.7월)

스마트폰 시장이 성숙됨에 따라 고성능 AP, 대화면 AMOLED Display, 멀티카메라, 센서, 방수 방진, 생체 인증과 같은 Hardware뿐 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Mobile Payment, AI, AR 등의 Software와 서비스 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

시장 성숙과 제품 고사양화에 따른 차별화 부족으로 단말 교체 주기가 증가함에 따라 스마트폰 시장 규모는 2018년 14.3억대에서 2019년 13.8억대로 감소할 것으로 전망되며, 태블릿 시장은 스마트폰 대화면화 및 교체 수요 감소 영향 등으로 전년 수준인 1.7억대를 유지할 것으로 예상됩니다.(출처: Strategy Analytics 스마트폰 2019.9월, 태블릿 2019.5월)

<IM 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 3분기	2018년	2017년
H H P	18.2%	17.4%	19.5%

※ 2017년, 2018년, 2019년 3분기 시장점유율은 외부조사기관인 Strategy Analytics의 세계시장 점유율 자료(수량기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

당사는 주력사업인 휴대폰 시장에서 글로벌 1위의 위상을 유지하고 있으며, 특히 스마트폰은 2011년 이후 현재까지 글로벌 1위의 입지를 확고히 하고 있습니다. 또한 휴대폰뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블, 액세서리 등의 제품들과 함께 서비스, 온라인, B2B 등 미래 성장 동력이 될 수 있는 육성사업을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다.

스마트폰은 당사가 보유한 Premium에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 Premium 스마트폰은 갤럭시 S와 갤럭시 Note 시리즈를 통하여 대화면 AMOLED Display와 Edge 디자인, Infinity Display, 트리플 카메라, 블루투스 S펜, 방수 방진, 고속·무선 충전, 무선 배터리 공유, 초음파 방식의 온 스크린 지문인식 등 고객 Needs 기반의 차별화된 기능을 지속적으로 선보이고 있으며, 2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이가 적용된 Galaxy Fold 등 폼팩터 혁신으로 새로운 시장을 개척하며 모바일 트렌드를 이끌어 나가고 있습니다.

또한 빠르게 변화하는 시장과 고객 Needs에 민첩하게 대응하기 위해 중저가 스마트폰에도 쿼드 카메라, 트리플 카메라, 로테이팅 카메라와 새로운 Infinity Display, 5G 등 혁신 기술을 적극 채택하여 제품경쟁력을 높이고 있습니다.

스마트폰 외에도 갤럭시 Tab S 등의 Premium 태블릿 및 스마트워치, 무선 블루투스이어폰과 같은 웨어러블 제품과 급속 무선 충전을 지원하는 무선충전스탠드 등 다양한 액세서리 제품을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부하고 편리한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

제품과 더불어 당사는 그동안 Samsung Pay, Samsung Health, Bixby, SmartThings 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔으며, 한층 더 진화한 New Bixby를 통해 일상 어디에서나 사용자에게 최적화된 서비스 경험을 제공하고 있습니다.

이러한 서비스 경쟁력 강화뿐만 아니라 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 끊김 없는 경험을 할 수 있는 Multi Device Experience를 제공하기 위해 스마트폰 외에도 TV, 냉장고, 에어컨 등 다양한 제품군에 Bixby를 적용하고 있으며, Ecosystem확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있습니다.

또한 5G, MEC, AI, IoT, Cloud, AR, Blockchain, Mobile B2B 시장 등 미래 성장에 대비한 투자를 지속하고 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하여 글로벌 위상을 더욱 높여 가도록 하겠습니다.

[DS 부문]

- 반도체 사업

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 메모리 반도체는 크게 읽고(Read) 쓸 수(Write)있는 램(RAM) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주 기억장치, 응용프로그램의 일시적 로딩>Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. System LSI 제품은 응용처 등에 따라 종류가 다양하며 가장 규모가 큰 것이 PC 및 모바일 기기, Server 등의 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit)이고 가전, 네트워크, 게임 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일 일용 AP제품과 이미지 센서, 기타 주문형 반도체 등을 공급하고 있습니다.

반도체 시장은 스마트폰 시장의 성장률 저하 및 태블릿 시장 역성장 등 모바일 기기의 수요 감소로 성장률 감소의 요인이 있으나, 서버 등 정보 저장 기기의 고용량화로 메모리 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 사물인터넷(IoT), Automotive 등 신규 시장이 창출되어 향후 수요가 급속히 증가할 것으로 예상되며, 수요 기반 또한 다변화되어 공급의 변동은 과거 대비 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

DRAM은 2019년 상반기 데이터센터 중심의 재고 조정으로 일부 약세가 있었으나, 재고 건전화로 2020년 구매 수요는 회복될 전망입니다. 미·중 무역 분쟁 및 일본 수출 규제 등 대외적 요인들로 시장의 불확실성이 가중되고 있으나 신규 CPU 고용량 시장 선점 및 스마트폰 탑재량 증가를 통해 M/S 확대를 추진할 계획입니다.

NAND는 Cloud Service 확대에 의한 SSD 대용량화, 신규 모바일 기기의 NAND 탑재량 증가 등으로 수요가 지속 증가하고 있으며, 공급 과잉에 따른 가격 하락은 전년 대비 완화될 전망입니다.

<반도체 사업 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 3분기	2018년	2017년
DRAM	46.3%	43.9%	45.8%

※ 2017년, 2018년 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장 점유율 자료(금액기준)를 활용하였으며, 2019년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2019년 10나노급 3세대 DRAM을 세계 최초로 개발하였으며, AI·슈퍼컴퓨터에 구현되는 고성능 고대역폭 메모리(HBM2) 공급을 본격적으로 확대하고 있습니다. NAND의 경우 경쟁사 대비 앞선 기술력을 확보한 Vertical NAND 는 6세대 적층제품 개발에 성공하여, 고성능 SSD에 탑재하여 프리미엄 시장에 진입할 예정입니다.

또한 2세대 Z-SSD, 신뢰성과 성능을 향상시킨 4비트 서버 SSD, 빅데이터에 특화된 Smart SSD 등을 통해 메모리 시장을 확대해 나갈 계획입니다.

메모리 반도체 시장의 성장이 지속될 것으로 예상됨에 따라, 당사는 선단 공정을 기반으로 한 차별화 제품 확대 및 다양한 제품 라인업을 이용한 응용처별 최적 대응을 통해 메모리 1위 업체로서 시장을 선도해 나갈 것입니다.

또한 System LSI는 스마트폰, 태블릿 등 모바일 제품 중심으로 성장하고 있으며, 앞으로 확대가 예상되는 IoT, Wearable, Automotive 등 신규 시장에서의 성장도 준비하고 있습니다. SOC 제품은 스마트폰의 교체 주기 증가 등으로 모바일 시장 성장은 제한적이거나, 5G / Automotive / AI 등 신규 기술에 대한 수요는 증가하고 있습니다. 당사는 모바일 고성능 및 중저가용 AP모뎀 통합칩을 공급하고 있으며, 2G~5G를 동시에 지원하는 멀티모드 모뎀을 세계 최초로 개발하고 사업화하여 5G 기술을 선도하고 있습니다.

Foundry는 2019년 상반기 세계최초 EUV 공정을 적용한 7나노 제품을 성공적으로 출시하였으며, 3나노 등 차세대 공정도 적기 개발하여 시장을 선도할 계획입니다. CIS, DDI, PMIC 등 공정 포트폴리오를 다각화하여 사업을 확장하고 있습니다.

- DP 사업

(산업의 특성 등)

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 많은 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD 디스플레이의 단점을 극복할뿐만 아니라, 앞으로 Foldable, Rollable, Automotive 등 다른 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화되는 추세를 보이고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

중소형 OLED 패널은 패널 업체 간 경쟁 심화로 시장내 불확실성이 상존할 것으로 전망되나, 5G 스마트폰 교체 수요 확대에 따른 채용 증가가 예상됩니다.

당사 주력 제품인 스마트폰용 디스플레이 시장 규모는 2018년 기준 16억대 수준이었으며, TFT-LCD는 11.9억대, OLED는 4.1억대 규모였습니다. 2019년 스마트폰 OLED 패널 시장은 4.8억대 수준으로 예상되며, 스마트폰에서 점차 주류로 자리매김할 것으로 기대됩니다.
(출처: IHS 중소형 패널, 스마트폰 OLED 패널, 2019.10월)

한편, 대형 LCD 패널의 경우 초대형, 초고화질 TV 및 Curved, Gaming 모니터 등 프리미엄 제품시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상되지만 업계 내 Capa 증가에 따른 공급 과잉으로 수요와 공급의 불균형이 지속될 것으로 보입니다.

<DP 사업 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 3분기	2018년	2017년
스마트폰패널	44.8%	47.6%	43.8%

※ 2017년, 2018년, 2019년 3분기 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 세계시장점유율 자료(스마트폰패널-금액기준)를 활용하였습니다.

※ 대형패널-금액기준에서 스마트폰패널-금액기준으로 작성기준을 변경함에 따라 2018년, 2017년 시장점유율을 재작성하였으며, 기존 대형패널-금액기준의 2019년 3분기 시장점유율은 9.7%입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한, 스마트폰 외에도 Foldable, Tablet, Watch, Notebook, Automotive 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선두 업체로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 스마트폰까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하였으며, 차별화된 기능과 디자인의 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

앞으로는 5G 이동통신 확산이 본격화될 것으로 보여 저소비전력, 초박형 디자인 등에 강점을 가지고 있는 OLED 패널의 채용 확대가 기대되고 있으며, 당사는 OLED 패널의 기본 성능을 더욱 향상시키는 것은 물론 차별화된 기술 적용 확대를 통해 고객 기반을 강화해 나가도록 하겠습니다. 또한, Foldable 제품 대중화를 앞당기기 위해 관련 기술 확보에 주력하는 한편, 다양한 고객과의 협력을 통해 제품 완성도를 제고해 나가겠습니다.

한편 대형 LCD 패널은 TV 패널 시장 수요가 정체된 가운데, 경쟁사 10.5G Capa 증가에 따른 공급 과잉으로 판가 하락이 지속되고 있습니다. 이에 당사는 초고화질, 초대형 TV 등 프리미엄 제품의 판매 비중을 확대하는 한편, 모니터, PID 등으로 제품을 다변화하여 수익성을 확보할 수 있도록 노력하겠습니다.

[Harman 부문]

(산업의 특성 등)

전장부품 사업과 연관성이 높은 자동차 Global 생산량이 2019년에는 전년 대비 큰 변화가 없고 2021년까지 연간 약 1~3% 성장할 것으로 전망됩니다.(출처: LMC 세계생산량 전망 자료, 2019.6월) 최근 수년간 자동차 산업 내에서 커넥티비티와 엔터테인먼트에 대한 수요는 증가해 왔습니다. 자동차 제조사들이 자율주행 자동차와 공유 모빌리티를 두 축으로 기술발전의 선두에 서는 것을 지향하면서 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

소비자 오디오 산업(커넥티드홈, 헤드폰, 스마트 오디오 등)은 2022년까지 연평균 약 4% 성장할 것으로 전망되며,(출처: FutureSource, 2019.3월) 프로페셔널 시장은 지난 5년간 연간 약 5~6% 성장률을 보였습니다.(출처: AVIXA, Future Source, Global Info & Arizton, 2019.6월)

커넥티드 홈과 스마트 오디오에서의 기술혁신 결과로 산업의 수요가 크게 증가해왔으며, 세계적인 성장 기조 속에 이 분야의 기술이 지속적으로 발전함에 따라 이러한 수요 증가 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

(국내외 시장여건 등)

자동차와 프로페셔널/소비자 오디오 시장은 경쟁이 매우 심한 가운데 급속하게 발전하고 있습니다.

커넥티드카 분야에는 자동차 제조사들과 협력하는 여러 회사들(Alpine, Aptiv, Continental, Mitsubishi, Panasonic 등)이 있습니다. 시장은 지속적으로 커넥티드카 영역에서 자동차 제조사들에게 자율주행 등 가장 앞선 기술을 지속적으로 요구하고 있어 이 분야는 현재 주요 업체들과 신규업체들간 경쟁이 지속될 것으로 예상됩니다.

카오디오시스템 분야도 주요 업체들(Bose, Pioneer, Panasonic)간 경쟁이 매우 치열합니다. 미래에도 이 분야의 지속적인 기술 발전이 예상되며 여러 카오디오 업체들은 다양한 음향관리 솔루션 개발 등으로 차별화해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 이 사업분야 또한 향후에도 지속적으로 업체간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

소비자오디오 산업은 상대적으로 시장점유율 집중도가 낮으며 소수의 선도업체들(Amazon, Beats, Bose, Ultimate Ears 등)이 있습니다. 특히 커넥티드홈과 스마트스피커 제품이 시장을 계속 포화 상태로 만들고 있기 때문에 다른 산업에서 진입하는 새로운 업체들과 기존 업체들간 경쟁 상황이 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.

프로페셔널 산업은 제품 종류에 따라 세분화되어 있고 제품의 응용방식에 따라 다양한 업체들이 진출한 상태입니다. QSC와 Yamaha는 프로페셔널 산업 내에서 널리 알려진 선도업체입니다. 향후 현재 동 산업 내 진출업체간 경쟁은 더욱 치열해질 것이며 커넥티드홈과 스마트스피커 제품의 대중화에 따라 서비스 등 다른 산업분야로부터의 신규 진출 업체들로 인한 경쟁은 치열해질 것입니다.

<Harman 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 3분기	2018년	2017년
Headunits	24.8%	18.8%	25.4%

※ Headunits은 디스플레이 오디오, 텔레메틱스, 뒷좌석 연결 박스 등을 제외한 별도 제품입니다.

※ 2017년, 2018년, 2019년 3분기 시장점유율은 외부조사기관인 IHS와 LMC의 자료를 활용한 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 전장부품 및 프로페셔널/소비자 오디오 시장에서 뛰어난 성과를 이어 나가는데 집중하고 있으며, 이를 달성하기 위해 혁신, 전략적 인수합병, 그리고 널리 알려진 브랜드들을 통해 지속적으로 성장해 나갈 것입니다.

당사의 Harman 부문은 전장부품시장에서 선도업체의 위상을 유지하고 있습니다. 대량판매 시장에서부터 고급특화시장에 걸쳐 차량들에 지속적으로 폭넓고 다양한 브랜드들을 활용하는 한편 Harman 브랜드에 부합하는 품질수준을 유지할 계획입니다. 더불어, 카오디오와 커넥티비티 분야에서 끊임없이 혁신에 집중하는 것은 자동차 제조사들과의 공존을 견고히 하는데 도움이 될 것입니다. 추가적으로 선도기술인 OTA(Over the Air)와 소프트웨어 서비스를 통해 커넥티드 서비스를 지속적으로 제공할 것입니다.

자동차시장에서의 성공요인들은 프로페셔널/소비자 오디오 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 Harman 브랜드들은 일상적인 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야들에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객들을 당사로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다. 이러한 노력들을 통해 당사가 사업을 영위하는 전장부품 등의 산업분야에서 선도업체로서의 역할을 유지할 수 있을 것입니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 억원, %)

부문	구분	제51기 3분기		제50기		제49기		
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	
CE 부문	총매출액	737,473	18.5%	951,876	16.9%	1,020,430	18.2%	
	내부매출액	417,037	18.4%	530,802	16.6%	574,416	17.8%	
	순매출액	320,436	18.8%	421,074	17.3%	446,013	18.6%	
	영업이익	18,013	8.7%	20,232	3.4%	18,020	3.4%	
	총자산	487,749	9.4%	473,545	10.0%	453,014	10.0%	
IM 부문	총매출액	1,725,779	43.4%	2,148,844	38.2%	2,260,042	40.2%	
	내부매출액	902,631	39.7%	1,142,067	35.8%	1,193,358	37.0%	
	순매출액	823,148	48.3%	1,006,777	41.3%	1,066,683	44.5%	
	영업이익	67,521	32.8%	101,720	17.3%	118,273	22.0%	
	총자산	1,456,563	28.2%	1,243,340	26.2%	1,114,418	24.5%	
DS 부문	반도체	총매출액	903,724	22.7%	1,657,625	29.4%	1,418,200	25.2%
		내부매출액	422,251	18.6%	794,715	24.9%	675,644	21.0%
		순매출액	481,472	28.2%	862,910	35.4%	742,556	31.0%
		영업이익	105,695	51.3%	445,739	75.7%	352,041	65.6%
		총자산	1,836,644	35.6%	1,515,782	31.9%	1,316,593	29.0%
	DP	총매출액	484,647	12.2%	693,495	12.3%	721,087	12.8%
		내부매출액	254,565	11.2%	368,844	11.6%	376,434	11.7%
		순매출액	230,083	13.5%	324,650	13.3%	344,654	14.4%
		영업이익	13,617	6.6%	26,198	4.4%	53,984	10.1%
		총자산	677,939	13.1%	641,543	13.5%	698,544	15.4%
	계	총매출액	1,407,176	35.4%	2,395,650	42.6%	2,187,817	38.9%
		내부매출액	699,350	30.8%	1,209,994	37.9%	1,106,142	34.3%
		순매출액	707,826	41.5%	1,185,656	48.6%	1,081,675	45.1%
		영업이익	119,250	57.9%	465,164	79.0%	403,279	75.2%
		총자산	2,728,147	52.8%	2,425,593	51.1%	2,272,502	50.0%
Harman 부문	총매출액	86,020	2.2%	109,711	1.9%	91,718	1.6%	
	내부매출액	12,581	0.6%	21,274	0.7%	20,692	0.6%	
	순매출액	73,439	4.3%	88,437	3.6%	71,026	3.0%	
	영업이익	1,991	1.0%	1,617	0.3%	574	0.1%	
	총자산	162,922	3.2%	150,599	3.2%	146,767	3.2%	

※ 본사 및 연결대상 해외법인의 부문간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 실적입니다.

※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

2019년(제51기) 3분기 매출은 CE 부문이 32조 436억원(18.8%), IM 부문이 82조 3,148억원(48.3%)이며, 반도체 사업이 48조 1,472억원(28.2%), DP 사업이 23조 83억원(13.5%) 등 DS 부문이 약 41.5% 수준입니다. Harman 부문은 7조 3,439억원(4.3%)입니다.

2019년(제51기) 3분기 영업이익은 CE 부문이 1조 8,013억원으로 전체이익의 8.7%,IM 부문이 6조 7,521억원으로 전체이익의 32.8%를 차지하며, DS 부문이 전체이익의 57.9%인 11조 9,250억원을 달성하였습니다. Harman 부문은 1,991억원입니다.

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준 적용)

- 1) 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품/모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품/모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 컴퓨터 등 완제품과 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산·판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 인포테인먼트, 텔레메틱스 등을 생산·판매하고 있습니다.

2019년 3분기 당사 제품별 순매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

부문	주요 제품	순매출액	비중	
CE 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등	320,436	18.8%	
IM 부문	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	823,148	48.3%	
DS 부문	반도체 사업	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	481,472	28.2%
	DP 사업	OLED 스마트폰 패널, LCD TV 패널, 모니터 패널 등	230,083	13.5%
	부문 계		707,826	41.5%
Harman 부문	Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등	73,439	4.3%	
기타	-	△219,688	△12.9%	
전체 계		1,705,161	100.0%	

※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준)

[△는 부(-)의 값임]

2019년 3분기 매출은 CE 부문이 32조 436억원으로 전체 순매출액의 18.8%, IM 부문이 82조 3,148억원으로 48.3%를 차지하며, DS 부문이 70조 7,826억원으로 41.5%를 구성하고 있습니다. Harman 부문은 7조 3,439억원으로 전체의 4.3%입니다.

☞ 세부 제품별 매출은 '5. 매출' 항목을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2019년 3분기 TV의 평균 판매가격은 전년 대비 6.3% 하락하였으며, HHP는 전년 대비 2.6% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 대비 60% 하락하였으며, 디스플레이 패널 평균 판매가격은 전년 대비 5.8% 하락하였습니다. Headunits의 평균 판매가격은 전년 대비 14.7% 하락하였습니다.

3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 현황

(단위 : 억원, %)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처
CE	원재료	디스플레이 패널	화상신호기	23,481	15.2%	AUO, BOE 등
	원재료	기타		131,308	84.8%	
	부문 계			154,789	100.0%	
IM	원재료	Camera Module	휴대폰용 카메라	50,827	17.8%	삼성전기(주), (주)파워로직스 등
	원재료	Base Band Chip	CPU	23,281	8.1%	Qualcomm, Spreadtrum 등
	원재료	모바일용 디스플레이 패널	화상신호기	22,073	7.7%	BOE, China Star Optoelectronics 등
	원재료	기타		189,961	66.4%	
	부문 계			286,142	100.0%	
DS	원재료	FPCA	구동회로	16,154	9.5%	(주)비에이치, 씨유테크(주) 등
	원재료	Window	강화유리	14,695	8.6%	Biel, Lens 등
	원재료	Wafer	반도체원판	13,964	8.2%	SUMCO, GW 등
	원재료	POL	편광판	11,037	6.5%	동우화인켄(주), 삼성SDI(주) 등
	원재료	Chemical	원판가공	9,742	5.7%	동우화인켄(주) 등
	원재료	기타		105,094	61.5%	
	부문 계			170,686	100.0%	
Harman	원재료	시스템온칩	자동차용 제품	3,585	24.7%	NVIDIA, Renesas 등
	원재료	자동차용 메모리	자동차용 제품	3,173	21.8%	Avnet, Microchip 등
	원재료	기타		7,773	53.5%	
	부문 계			14,531	100.0%	
기타				309	-	
총 계				626,457	-	

※ 연결기준입니다.

※ 주요 매입처 중 삼성전기(주), 삼성SDI(주)는 삼성그룹 계열회사입니다.

당사의 주요 원재료는 CE 부문의 경우 TV·모니터용 디스플레이 패널로 AUO 등에서 공급받고, IM 부문의 경우 Camera Module, Base Band Chip 및 모바일용 디스플레이 패널 등으로 삼성전기(주), Qualcomm, BOE 등으로부터 공급받고 있습니다.

DS 부문의 경우 FPCA, Window, Wafer, POL, Chemical 등을 (주)비에이치, Biel, SUMCO, 삼성SDI(주), 동우화인켄(주) 등으로부터 공급받고 있으며, Harman 부문의 경우 시스템온칩, 자동차용 메모리 등을 NVIDIA, Avnet 등에서 공급받고 있습니다.

나. 주요 원재료 가격 변동 추이

CE부문의 주요 원재료인 TV·모니터용 디스플레이 패널 가격은 전년 대비 약 24% 하락하였습니다. IM부문의 Camera Module 가격은 전년 대비 약 44% 상승, Base Band Chip 가격은 약 2% 상승, 모바일용 디스플레이 패널 가격은 약 24% 상승하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 FPCA 가격은 전년 대비 변동이 없으며, 강화유리용 Window 가격은 6% 상승하였습니다. 또한 반도체 Wafer 가격은 전년 대비 약 12% 상승하였으며, 편광판용 POL 가격은 전년 대비 약 14% 하락하였습니다. Harman부문의 원재료 중 시스템온칩 가격은 전년 대비 약 4% 하락, 자동차용 메모리는 약 10% 하락하였습니다.

4. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부문	품 목	제51기 3분기	제50기	제49기
CE	TV	29,180	40,158	44,639
IM	HHP	264,560	397,497	415,200
DS	메모리	692,276,000	711,023,000	530,590,000
	DP	6,404	9,167	8,723
Harman	Headunits	5,922	5,238	5,483

※ 생산능력은 글로벌 기준이며, 주요 제품 기준입니다.

※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.

CE 및 IM 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인수'×'시간당 평균생산실적'× '일평균가동시간'×'가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산기준으로 환산 생산실적(패키지 OUT기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있고, DP의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총면적을 8세대 Glass(2200×2500mm)로 환산하고 있습니다.

Harman 부문의 Headunits 생산능력은 '각 거래선 · 제품별 생산셀(조립, 테스트)수'×'각 생산셀별 시간당 평균생산능력'×'1일 평균 생산시간'×'생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

(단위 : 천대, 천개)

부문	품 목	제51기 3분기	제50기	제49기
CE	TV	28,291	37,217	39,450
IM	HHP	255,810	346,605	393,693
DS	메모리	692,276,000	711,023,000	530,590,000
	DP	5,151	7,599	7,798
Harman	Headunits	4,813	3,906	4,221

※ 생산실적은 글로벌 기준이며, 주요 제품기준입니다.

※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.

2019년 3분기 CE부문의 TV 생산실적은 28,291천대이고 중국, 멕시코, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. IM부문의 HHP 생산실적은 255,810천대이며 한국(구미), 베트남, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS부문의 메모리 생산실적은 692,276백만개(1Gb 환산기준)이며, 한국(화성, 평택) 및 중국에서 생산하고 있습니다. DP 생산실적은 5,151천개이며, 한국(천안, 아산), 중국 등 지역에서 생산 중입니다. Harman부문의 Headunits 생산실적은 4,813천개입니다.

(가동률)

(단위 : 천대)

부문	품 목	제51기 3분기		
		생산능력 대수	실제 생산대수	가동률
CE	TV	29,180	28,291	97.0%
IM	HHP	264,560	255,810	96.7%

당사 CE 및 IM 부문의 2019년 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV가 97.0%, HHP가 96.7%입니다.

(단위 : 시간)

부문	품 목	제51기 3분기		
		가동가능 시간	실제 가동시간	가동률
DS	메모리	52,416	52,416	100.0%
	DP	52,416	52,416	100.0%

DS부문의 메모리와 DP는 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 휴일을 포함하여 2019년 3분기 누적 가동일은 총 273일입니다. $273\text{일} \times \text{생산라인수} \times 24\text{시간}$ 으로 실제가동시간을 산출하여 가동률을 계산하였습니다.

(단위 : 천개)

부문	품 목	제51기 3분기		
		생산능력 개수	실제 생산개수	가동률
Harman	Headunits	5,922	4,813	81.3%

Harman부문의 2019년 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, 81.3%입니다.

나. 생산설비 및 투자현황 등

(생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 기흥, 온양, 광주 등 국내사업장 및 북미, 구주, 중국 등 해외 CE, IM 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄, Harman산하 종속기업 등에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길11 (서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33 (우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1 (농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1 (반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 고덕면 삼성로 114 (여영리)
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465 (성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244 (공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302 (임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107 (오선동)
해외 (CE, IM 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	85 Challenger Road, Ridgefield Park, NJ, USA
	구주 총괄	1000 Hillswood Drive, Chertsey Surrey KT16 0PS, UK
	중국 총괄	Fortune Financial Center, Chaoyang District, Beijing, China
	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Road, Mapletree Business City, Singapore
	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India
	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia
	중동 총괄	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston Johannesburg, South Africa
	중남미 총괄	Avenida Dr. Chucrí Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	3655 N. First St. San Jose, CA 95134, USA
	구주 총괄	Koelner Str. 12, 65760 Eschborn, Germany
	중국 총괄	No.88, Haide 1st Road, Nanshan District, Shenzhen, China
	동남아 총괄	3 Church Street, #26-01/02 Samsung Hub, Singapore
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan
Harman	미국 HQ	15th Floor, 400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901, USA

- ※ Harman 부문의 Connected Car 사업은 미국(Novi) 등, Lifestyle Audio 사업은 독일(Garching) 등, Professional Solution 사업은 미국(Northridge) 등, Connected Service 사업은 미국(Mt. View) 등에서 영위하고 있습니다.

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2019년 3분기말 현재 장부가액은 116조 8,556억원으로 전년말 대비 1조 4,389억원 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

구 분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계
기 초	기초장부가액	93,463	293,459	638,162	97,051	32,032	1,154,167
	- 취득원가	93,463	450,338	2,064,079	97,051	86,651	2,791,582
	- 감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	△156,879	△1,425,917	-	△54,619	△1,637,415
증 감	일반취득 및 자본적지출	1,459	10,942	71,428	84,382	8,543	176,754
	사업결합으로 인한 취득	-	152	3,784	43	14	3,993
	감가상각	-	△19,837	△171,116	-	△9,316	△200,269
	처분/폐기/손상	△792	△3,272	△1,771	△2	△595	△6,432
	기타	3,391	25,758	7,246	△637	4,585	40,343
반 기 말	분기말장부가액	97,521	307,202	547,733	180,837	35,263	1,168,556
	- 취득원가	97,521	486,467	2,115,699	180,837	98,119	2,978,643
	- 감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	△179,265	△1,567,966	-	△62,856	△1,810,087

※ 연결기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 회계변경누적효과, 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.

(시설투자현황)

당사는 2019년 중 반도체와 DP사업의 라인 성능개선 등 시설투자에 16.8조원을 사용하였습니다. 당사는 중장기 수요 대응을 위한 메모리 인프라 투자에 집중하고 있으며, 파운드리 경쟁력 강화를 위한 EUV 7나노 생산능력 확대와 QD디스플레이 투자도 지속할 것입니다.

[부문별 시설투자금액]

(단위 : 억원)

구분	내용	투자기간	대상자산	투자액	비고
반도체	신/증설, 보완 등	2019.01~2019.09	건물/설비	140,214	
DP	신/증설, 보완 등	2019.01~2019.09	건물/설비	12,831	
기타	신/증설, 보완 등	2019.01~2019.09	건물/설비	15,043	
합 계				168,088	

5. 매출

가. 매출실적

2019년 3분기 매출은 170조 5,161억원으로 전년 동기 대비 7.6% 감소하였습니다. 부문별로 보면 전년 동기 대비 CE 부문이 5.7% 증가, IM 부문이 6.4% 증가, DS 부문이 22.0% 감소, Harman 부문이 16.7% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문		매출유형	품 목	제51기 3분기	제50기	제49기
CE 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 계	320,436	421,074	446,013
IM 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등 계	823,148	1,006,777	1,066,683
DS 부문	반도체 사업	상 품 제 품 용 역 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 계	481,472	862,910	742,556
	DP 사업	상 품 제 품 용 역 기타매출	OLED 스마트폰 패널, LCD TV 패널, 모니터 패널 등 계	230,083	324,650	344,654
	부문 계			707,826	1,185,656	1,081,675
Harman 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등 계	73,439	88,437	71,026
기 타		-	- 계	△219,688	△264,230	△269,643
합 계				1,705,161	2,437,714	2,395,754

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준)

[△는 부(-)의 값임]

※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.

※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제51기 3분기	제50기	제49기
영상기기	180,899	252,939	275,154
무선	782,829	965,194	1,036,218
MEMORY	370,320	723,753	603,036
DP	230,083	324,650	344,654

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준)

※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제51기 3분기	제50기	제49기
제·상품	1,615,989	2,380,547	2,368,198
용역 및 기타매출	89,172	57,167	27,556
계	1,705,161	2,437,714	2,395,754

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

(3) 주요지역별 매출현황 (별도기준)

(단위 : 억원)

구 분	제51기 3분기	제50기	제49기
국내(내수)	163,902	168,213	165,684
미주	332,990	464,124	488,864
유럽	137,904	192,783	189,464
아시아 및 아프리카	256,005	330,903	317,661
중국	283,129	547,796	457,477
계	1,173,930	1,703,819	1,619,150

※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 등

(1) 국내

판매자	판매 경로	소비자
생산 및 매입	전속 대리점	소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 인터넷 등)	
	통신사업자(SK텔레콤, 케이티, LG유플러스)	
	B2B 및 온라인	

(2) 해외

판매자	판매 경로				소비자	
생산법인	판매법인	Retailer			소비자	
		Dealer		Retailer		
		Distributor	Dealer	Retailer		
		통신사업자, Automotive OEM				
	물류법인	판매법인	Retailer			
			Dealer	Retailer		
			Distributor	Dealer		Retailer
	직접판매					

(3) 판매경로별 매출액 비중

경로	도매	소매	특직판	기타
비중	20%	27%	46%	7%

※ 글로벌 기준입니다.

다. 판매방법 및 조건

(1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신수금(현금,30일여신) (담보 100%내 여신적용)	사안별 상호 협의 하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 인터넷 등	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤, 케이티, LG유플러스	개별계약조건	없음
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없음

(2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담
Distributor	현지 거래선 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담
B2B	일반기업체 등	개별계약조건	없음

라. 판매전략

- 스마트 제품 등 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객/시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2019년 3분기 당사의 주요 매출처는 Apple, BestBuy, Deutsche Telekom, Huawei, Verizon 등(알파벳순)입니다.

당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 13% 수준입니다.

6. 수주상황

2019년 3분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 특정 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

해외 주요 권역 별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)를 운영하여 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 각 개별회사의 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다.

당사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래 발생시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.

또한 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 헷지 목적 이외의 외환거래는 금지하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당분기 및 전기포괄손익(법인세효과 반영 전)의 변동금액은 각각 39,770백만원 및 28,947백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

당사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 당사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

당사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전 관리하고 있습니다. 이상 징후 발견 시 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 당사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한 유동성위험에 대비하여 당사는 무역금융 등의 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 당사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

당사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 연결재무제표 상 금액을 기준으로 계산합니다.

당사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고 있습니다.

보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	89,943,741	91,604,067
자 본	263,442,244	247,753,177
부채비율	34.1%	37.0%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	26,604,994	(*1)	30,340,505	(*1)
단기금융상품	69,476,971	(*1)	65,893,797	(*1)
단기상각후원가금융자산	4,021,901	(*1)	2,703,693	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	1,842,611	1,842,611	2,001,948	2,001,948
매출채권	40,367,204	(*1)	33,867,733	(*1)
상각후원가금융자산	134,641	(*1)	238,309	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	8,728,038	8,728,038	7,301,351	7,301,351
당기손익-공정가치금융자산	962,889	962,889	775,427	775,427
기타(*2)	9,966,716	249,772	9,313,133	84,089
소 계	162,105,965		152,435,896	
금융부채				
매입채무	11,422,269	(*1)	8,479,916	(*1)
단기차입금	12,330,248	(*1)	13,586,660	(*1)
미지급금	8,630,882	(*1)	9,779,287	(*1)
유동성장기부채(*3)	792,467	(*1)	33,386	(*1)
사채	1,008,058	1,059,938	961,972	964,182
장기차입금(*3)	2,002,565	(*1)	85,085	(*1)
장기미지급금(*2)	2,059,916	2,403	2,860,002	13,417
기타(*2)	9,001,799	183,277	8,832,523	42,723
소 계	47,248,204		44,618,831	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 9,716,944백만원(전기: 9,229,044 백만원)

및 금융부채 10,876,035백만원(전기: 11,636,385백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*3) 유동성장기부채와 장기차입금 중 리스부채는 기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	3,829,183	-	4,898,855	8,728,038
당기손익-공정가치금융자산	147,782	25,954	2,631,764	2,805,500
기타	-	249,772	-	249,772
금융부채				
사채	-	1,059,938	-	1,059,938
장기미지급금	-	-	2,403	2,403
기타	-	183,277	-	183,277

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,884,633	-	4,416,718	7,301,351
당기손익-공정가치금융자산	10,124	18,503	2,748,747	2,777,375
기타	-	84,089	-	84,089
금융부채				
사채	-	964,182	-	964,182
장기미지급금	-	-	13,417	13,417
기타	-	41,639	1,085	42,723

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- 수준 2: 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)
- 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

당사는 수준 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 수준 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 수준 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래 현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	수준 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산				
(주)말타니	10,923	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0% ~ 1.0%(0%)
			가중평균자본비용	8.8% ~ 10.8%(9.8%)
삼성벤처투자(주)	7,720	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0% ~ 1.0%(0%)
			가중평균자본비용	17.5% ~ 19.5%(18.5%)
Corning Incorporated 전환우선주	4,058,926	삼항모형	위험 할인율	4.3% ~ 6.3%(5.3%)
			가격 변동성	22.3% ~ 28.3%(25.3%)
장기미지급금				
조건부금융부채	2,403	확률가중모형	확률적용률	50.0%

(4) 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	7,165,466	3,652,574
매입	3,142,151	247,848
매도	△3,277,968	△59,039
평가(당기손익)	25,104	14,064
평가(기타포괄손익)	384,555	335,396
기타(*)	91,311	1,176,132
분기말	7,530,619	5,366,975

(*) 기타는 회계변경누적효과 등을 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	당분기	전분기
기초	14,502	351,918
결제	△1,127	△322,920
평가(당기손익)	△11,617	5,992
기타	644	862
분기말	2,403	35,852

[△는 부(-)의 값임]

(5) 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*)	-	167,762	-	△126,446

(*) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0% ~ 1.0%)과 변동성(22.3% ~ 28.3%) 및 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 Corning Incorporated의 전환우선주를 보유하고 있으며, 2019년 3분기말 현재 전환우선주의 가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	취득원가	공정가치	평가이익	평가손실
전환우선주	2,434,320	4,058,926	1,624,606	-

※ 공정가치는 삼항모형을 이용, 평가이익은 자본(기타자본항목)에 반영하였습니다.

※ 평가는 신한회계법인에서 수행하였습니다.

환율 변동 리스크 관리를 위하여 당사의 해외법인은 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지합니다.

또한 해외법인은 통화선도를 매매목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도합니다.

2019년 3분기말 현재 USD/EUR/JPY 등 총 34개 통화에 대하여 2,299건의 통화선도 거래를 체결하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	평가이익	평가손실
통화선도	105,027	38,882	636,615	531,588

9. 경영상의 주요계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	-
Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25 / 영구
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약(향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
Cisco	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.23
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	-
GlobalFoundries	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기 및 기간	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
	기타 주요내용	-
InterDigital	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.06.03
	목적 및 내용	특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	-
HP	계약 유형	사업 매각
	체결시기 및 기간	2016.09.12
	목적 및 내용	핵심역량 강화를 통한 사업고도화
	기타 주요내용	계약금액: USD 10.5억
Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약 (기존 계약의 수정)
	체결시기 및 기간	2018.1.1 ~ 2023.12.31
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스/부제소 계약 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	-
Apple	계약 유형	소취하 계약 체결
	체결시기 및 기간	2018.06.26
	목적 및 내용	양사간 미국에서 진행 중인 모든 소송 취하
	기타 주요내용	-
Nokia	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2018.10.19
	목적 및 내용	특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	-
Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약

	체결시기 및 기간	2019.02.28
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	-
Microsoft	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2019.02.11
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	-
Google	계약 유형	EMADA
	체결시기 및 기간	2019.02.27 ~ 2019.12.31
	목적 및 내용	유럽 31개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한 라이선스 계약
	기타 주요내용	-
AMD	계약 유형	기술 라이선스 계약
	체결시기 및 기간	2019.05.30
	목적 및 내용	모바일 및 기타 응용 제품에 활용할 수 있는 그래픽 설계자산 확보
	기타 주요내용	-
Sharp	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2019.07.30
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	-

※ 계약 체결 금액 등 기타 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품,미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다.

창조적이고 혁신적인 제품을 준비하고 있으며 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도기업 (Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

[연구개발비용]

(단위 : 백만원)

과 목		제51기 3분기	제50기	제49기
연구개발비용 총계		15,287,680	18,662,029	16,805,637
(정부보조금)		△13,967	△11,645	△2,484
연구개발비용 계		15,273,713	18,650,384	16,803,153
회계 처리	개발비 자산화(무형자산)	△285,699	△296,304	△447,541
	연구개발비(비용)	14,988,014	18,354,080	16,355,612
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계 ÷ 당기매출액 × 100]		9.0%	7.7%	7.0%

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다.

2019년 3분기 당사의 연구개발비용은 15조 2,877억원이며, 이 중 정부보조금 140억원 및 자산화된 2,857억원을 제외한 14조 9,880억원을 당기 비용으로 회계처리하였습니다.

나. 연구개발 조직 및 운영

(1) 국내

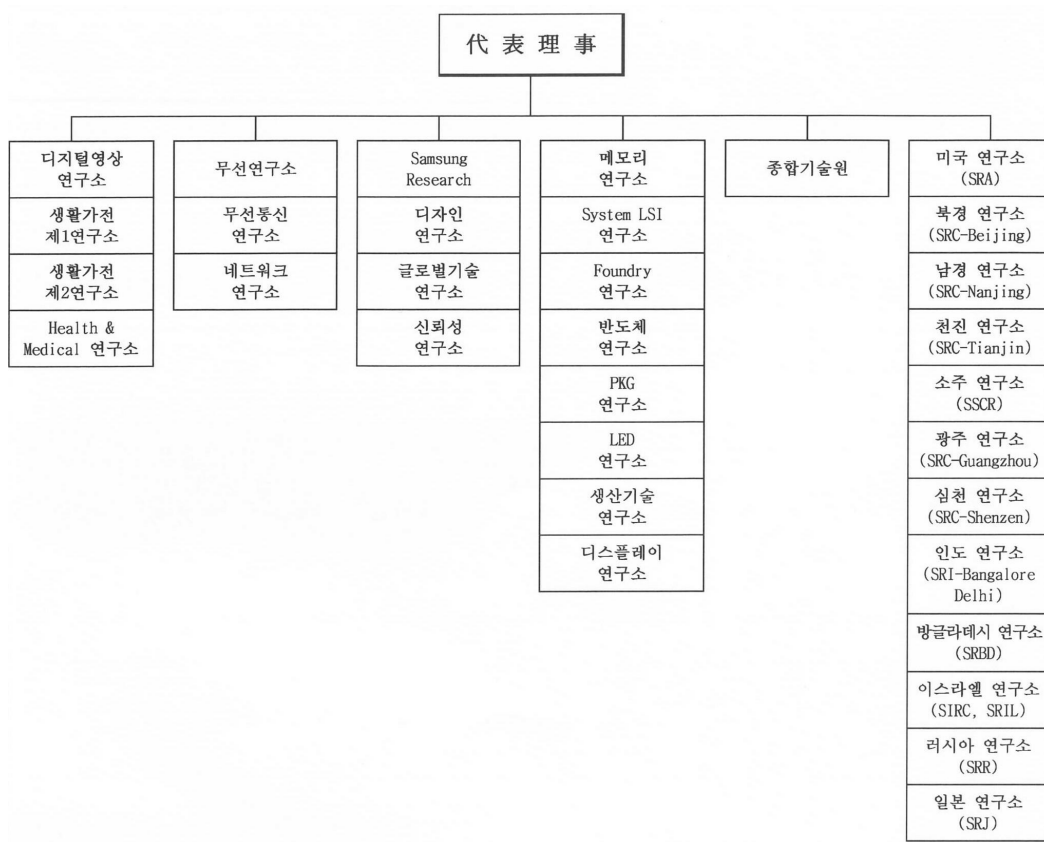
당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

종합기술원은 무한탐구를 실현하며 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R&D 체제를 구축하고 있습니다.

(2) 해외

미국(SRA), 러시아(SRR), 이스라엘(SRIL, SIRC), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 일본(SRJ), 중국(SSCR, SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Tianjin, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzhen), 방글라데시(SRBD) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품개발 및 기초기술연구 등의 연구활동을 수행 중입니다.

또한 영국 캠브리지, 러시아 모스크바, 캐나다 토론토, 몬트리올, 미국 뉴욕에 AI센터를 설립하여 세계적인 전문가들과 한국·미국의 AI 연구인력이 함께 AI 분야 기술력을 강화하고 있습니다.



※ 연구개발조직도는 2019년 3분기말 기준입니다.

☞ 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 'I. 회사의 개요'의 '사. 연결대상 종속기업 개황'을 참조하시기 바랍니다.

다. 연구개발실적

부문	연구과제		연구결과 및 기대효과
CE부문	QLED TV	QLED TV (Q8C) (2017.4월)	<input type="checkbox"/> Curved QLED TV <input type="checkbox"/> 75" <input type="checkbox"/> Design: 4면bezel-less, Simple Edge, Metal Back Stainless Silver, stand(Type-U) Slim Wall Mount <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Platform(H/W, S/W): Kant-M, Tizen OS - Concept: 4면 Bezel-less 디자인 QLED TV - 화질: 최고수준의 밝기, 풍부하고 정확한 컬러, 블랙화질 및 시야각 개선 - Optical Cable과 One Connect로 사용자 환경에 맞는 최적의 연결 편의성 제공
		QLED TV (Q6F) (2018.4월)	<input type="checkbox"/> Flat QLED TV <input type="checkbox"/> 49/55/65/75/82" <input type="checkbox"/> Design: 3면bezel-less, Simple Stand, VESA Wall Mount <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Platform(H/W, S/W): Kant-M2, Tizen OS - Concept: QLED 화질 Value 확대 및 업그레이드 QLED TV - 화질: Color Volume 100%, 최적 밝기 - Mobile/TV 사용성 개선, Bixby 기능 적용, Entertainment 이상의 Smart 경험 제공
		QLED TV (Q6F) (2018.7월)	<input type="checkbox"/> Flat QLED TV <input type="checkbox"/> 49/55/65/75/82" <input type="checkbox"/> Design: 3면bezel-less, Simple Stand, VESA Wall Mount <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Platform(H/W, S/W): Kant-M2, Tizen OS - Concept: QLED 화질 Value 확대 및 업그레이드 QLED TV - 화질: Color Volume 100%, 최적 밝기 - Mobile/TV 사용성 개선, Bixby 기능 적용, Entertainment 이상의 Smart 경험 제공
		QLED TV (Q60T) (2019.2월)	<input type="checkbox"/> Flat QLED 4K TV <input type="checkbox"/> 49/55/65/75" <input type="checkbox"/> Design: Super Narrow Bezel, 미니멀, Simple Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Tizen OS - Concept: 최적의 4K 시청경험과 AI 기반 Lifestyle 가치 및 사용 경험 강화 - 화질: 선명하고 정확한 Life-like 컬러와 AI 기반 Upscale 기능은 콘텐츠에 상관없는 최적의 4K 시청 경험 - AI: TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/사용성을 제공 - Bixby2.0: Voice Assistant, 덕내 사용 경험 확장 - Universal Guide: 콘텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대
		QLED TV (Q70D) (2019.2월)	<input type="checkbox"/> Flat QLED 4K TV <input type="checkbox"/> 55/65/75/82" <input type="checkbox"/> Design: 4면 Bezel-less, Direct Full Array 직하, Simple Stand, Real Metal <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Tizen OS - Concept: Direct Full Array를 통한 깊은 블랙 표현과 QLED화질 경험 제공 - 화질: QLED 고유의 화질 경험(Brightness, Color Volume)과 Direct Full Array 방식의 깊은 블랙 표현감

		<p>AI Upscaling 제공</p> <ul style="list-style-type: none"> - AI: TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/사용성을 제공 - Bixby2.0: Voice Assistant, 덕내 사용 경험 확장 - Universal Guide: 콘텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대
	<p>QLED TV (LS03) (2019.4월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flat QLED 4K TV, Life Style TV <input type="checkbox"/> 43/49/55/65" <input type="checkbox"/> Design: Real Frame Look, No Gap WMT, Invisible Cable <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): Tizen OS - Concept: The Frame의 액자 경험에 QLED 화질을 접목하여, Art 감상과 시청 경험을 강화한 제품 - 화질: 선명하고 풍부한 컬러의 QLED 화질과 AI 기반 Upscale을 통해 최적의 Art 감상경험 및 TV 시청경험
	<p>QLED TV (Q70) (2019.7월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flat QLED 4K TV <input type="checkbox"/> 49/55/65/75/82" <input type="checkbox"/> Design: 4면 Bezel-less, Direct Full Array 직하, Simple Stand, Real Metal <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): Tizen OS - Concept: Direct Full Array를 통한 깊은 블랙 표현과 QLED 화질 경험 제공 - 화질: QLED 고유의 화질 경험(Brightness, Color Volume)과 Direct Full Array 방식의 깊은 블랙 표현감, AI Upscaling 제공
	<p>QLED TV (Q80R) (2019.8월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flat QLED 4K TV <input type="checkbox"/> 55/65/75" <input type="checkbox"/> Design: 4면 Bezel-less, Direct Full Array 직하, Soft-T Stand(W/W)/Flat Foot Stand(복미), Real Metal <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): Tizen OS - Concept: Direct Full Array 기반 완성된 QLED 화질 경험과 Lifestyle 경험을 함께 제공 - 화질: 시야각 개선/초저반사/AI Upscaling 통해 QLED 고유의 화질 경험(Brightness, Color Volume)을 더욱 완벽하게 제공
	<p>QLED TV (LS01) (2019.8월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flat QLED 4K TV <input type="checkbox"/> 43/49/55" <input type="checkbox"/> Design: Life Style TV, 'I' 형태, Metal Floor Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): Tizen OS - Concept: 차별화된 디자인을 통해 공간 내 Objet 경험과 Non TV 경험을 극대화시킨 Lifestyle TV - 화질: 선명하고 정확한 Life-like 컬러의 QLED 화질 및 AI Upscale 제공
	<p>UHD TV (MU7000) (2017.2월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flat UHD TV <input type="checkbox"/> 49/55/65" <input type="checkbox"/> Design: Slim Unibody, Real 360, Bezel-less, Screw-less, Branch Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): Kant-M, Tizen OS - 화질: UHD 120Hz, Flat, Local Dimming - 기능: One Connect mini로 사용자 환경에 맞는 최적의 연결 편의성 제공
	<p>UHD TV (MU6300 /MU6100) (2017.3월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UHD Curved TV <input type="checkbox"/> 40/43/49/50/55/65/75" <input type="checkbox"/> Design: Minimalism Design, V-Shape Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS

		<ul style="list-style-type: none"> - 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공
	<p>UHD TV (MU6400) (2017.3월)</p>	<input type="checkbox"/> UHD Flat TV <input type="checkbox"/> 40/49/55/65" <input type="checkbox"/> Design: Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design, Y-Shape Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS - 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공
	<p>UHD TV (MU6500) (2017.3월)</p>	<input type="checkbox"/> UHD Curved TV <input type="checkbox"/> 49/55/65" <input type="checkbox"/> Design: Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design, Y-Shape Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS - 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공
	<p>UHD TV (MU6100) (2017.4월)</p>	<input type="checkbox"/> UHD Flat TV <input type="checkbox"/> 49/55/58/75" <input type="checkbox"/> Design: Minimalism Design, V-Shape Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS - 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공
	<p>UHD TV (LS003) (2017.5월)</p>	<input type="checkbox"/> Lifestyle TV <input type="checkbox"/> 55/65" <input type="checkbox"/> Design: Frame Edge Design, Zero Gap WMT <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS - 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look - 기능: Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection, Replaceable Deco Frame
	<p>UHD TV (MU6103) (2017.7월)</p>	<input type="checkbox"/> 실속형 UHD Flat TV <input type="checkbox"/> 40/43/49/50/55/65/75" <input type="checkbox"/> Design: Minimalism Design, V-Shape Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS - 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공 - MU6100 대비 BT 미지원(Smart Controller 미지원)
	<p>UHD TV (MU6303) (2017.7월)</p>	<input type="checkbox"/> 실속형 UHD Curved TV <input type="checkbox"/> 49/55/65" <input type="checkbox"/> Design: Minimalism Design, V-Shape Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS - 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공 - MU6300 대비 BT 미지원(Smart Controller 미지원)

		<p>UHD TV (LS003) (2017.12월)</p>	<input type="checkbox"/> Lifestyle TV <input type="checkbox"/> 43" <input type="checkbox"/> Design: Frame Edge Design, Zero Gap WMT <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS - 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look - 기능: Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection, Replaceable Deco Frame
		<p>UHD TV (NU7100) (2018.3월)</p>	<input type="checkbox"/> UHD Flat TV <input type="checkbox"/> 40/43/49/50/55/65/75" <input type="checkbox"/> Design: Sleek & 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS - 화질: UHD 60Hz, HDR 10+ - 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 콘텐츠 탐색(Universal Browse))
		<p>UHD TV (NU7300) (2018.3월)</p>	<input type="checkbox"/> UHD Curved TV <input type="checkbox"/> 49/55/65" <input type="checkbox"/> Design: Sleek & 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS - 화질: UHD 60Hz, HDR 10+ - 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 콘텐츠 탐색(Universal Browse))
		<p>UHD TV (NU7400) (2018.3월)</p>	<input type="checkbox"/> UHD Flat TV <input type="checkbox"/> 43/50/55/65" <input type="checkbox"/> Design: Sleek & 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-type Center Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS - 화질: UHD 60Hz, HDR 10+, Active Crystal Color - 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 콘텐츠 탐색(Universal Browse)) One Remote를 사용한 주변기기 컨트롤 및 음성인식 기능 콘텐츠 사용(BT 지원)
		<p>UHD TV (NU7500) (2018.3월)</p>	<input type="checkbox"/> UHD Curved TV <input type="checkbox"/> 49/55/65" <input type="checkbox"/> Design: Sleek & 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-type Center Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS - 화질: UHD 60Hz, HDR 10+, Active Crystal Color - 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 콘텐츠 탐색(Universal Browse)) One Remote를 사용한 주변기기 컨트롤 및 음성인식 기능 콘텐츠 사용(BT 지원)
		<p>UHD TV (NU8000) (2018.3월)</p>	<input type="checkbox"/> Flat UHD TV <input type="checkbox"/> 49/55/65/75/82" <input type="checkbox"/> Design: 3면bezel-less, Cable Management, T-type Center Stand, VESA Wall Mount <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Platform(H/W, S/W): Kant-M2, Tizen OS

		<ul style="list-style-type: none"> - 화질: UHD 120Hz, Flat, Local Dimming - 기능: Input lag 및 모션 관련 Game 화질 개선으로 최고 Gaming 경험 제공
	<p>UHD TV (NU8500) (2018.3월)</p>	<input type="checkbox"/> Curved UHD TV <input type="checkbox"/> 55/65" <input type="checkbox"/> Design: 3면bezel-less, Cable 정형, T-type Center Stand, VESA Wall Mount <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): Kant-M2, Tizen OS - 화질: UHD 120Hz, Curved, Local Dimming - 기능: Input lag 및 모션 관련 Game 화질 개선으로 최고의 Gaming 경험 제공
	<p>UHD TV (NU7100) (2018.5월)</p>	<input type="checkbox"/> UHD Flat TV <input type="checkbox"/> 43/58" <input type="checkbox"/> Design: Sleek & 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS - 화질: UHD 60Hz, HDR 10+ - 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 콘텐츠 탐색(Universal Browse))
	<p>UHD TV (NU7400) (2018.5월)</p>	<input type="checkbox"/> UHD Flat TV <input type="checkbox"/> 43/50" <input type="checkbox"/> Design: Sleek & 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-type Center Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS - 화질: UHD 60Hz, HDR 10+, Active Crystal Color - 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 콘텐츠 탐색(Universal Browse)) One Remote를 사용한 주변기기 컨트롤 및 음성인식 기능 콘텐츠 사용(BT 지원)
	<p>UHD TV (LS03NA) (2018.6월)</p>	<input type="checkbox"/> Lifestyle TV <input type="checkbox"/> 55/65" <input type="checkbox"/> Design: Frame Edge Design, Zero Gap WMT <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-M2, Tizen OS - 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look - 기능: Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection 2.0 Replaceable Deco Frame
	<p>UHD TV (NU7090) (2018.7월)</p>	<input type="checkbox"/> UHD Flat TV <input type="checkbox"/> 43/50/55/65/75" <input type="checkbox"/> Design: Sleek & 360°Design, Cable Management, Simple Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-SU, Tizen OS - 화질: UHD 60Hz, HDR 10+ - 기능: 개선된 Eden UI로 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공(Live, App 구분 없이 한곳에서 콘텐츠 탐색)
	<p>UHD TV (LS03NA) (2018.8월)</p>	<input type="checkbox"/> Lifestyle TV <input type="checkbox"/> 49/43" <input type="checkbox"/> Design: Frame Edge Design, Zero Gap WMT <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W, S/W): KANT-M2, Tizen OS - 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look

		<ul style="list-style-type: none"> - 기능: Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection 2.0 Replaceable Deco Frame
	<p>UHD TV (RU7100) (2019.2월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UHD Flat TV <input type="checkbox"/> 43/49/55/65/75" <input type="checkbox"/> Design: Sleek & 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Tizen OS - 화질: UHD 해상도와 당사만의 화질 개선 알고리즘 적용으로 선명한 UHD 화질 시청 경험 제공 - 신규 서비스 및 개인화된 콘텐츠 검색 강화: TV Plus, iTunes, Airplay(New) - IR Blaster: 편리한 One Remote 경험 확대
	<p>UHD TV (RU7300) (2019.2월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UHD Curved TV <input type="checkbox"/> 55/65" <input type="checkbox"/> Design: Sleek & 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Tizen OS - 화질: UHD해상도와 당사만의 화질 개선 알고리즘 적용으로 선명한 UHD 화질 시청 경험 제공 - 신규 서비스 및 개인화된 콘텐츠 검색 강화: TV Plus, iTunes, Airplay(New) - IR Blaster: 편리한 One Remote 경험 확대
	<p>UHD TV (RU7400) (2019.2월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UHD Flat TV <input type="checkbox"/> 50/55/65" <input type="checkbox"/> Design: Sleek & 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-Shape Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Tizen OS - 화질: Dynamic Crystal Color를 통해 원본 콘텐츠의 컬러를 풍부하게 표현하는 UHD 화질 - AI: TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/사용성을 제공 - Bixby2.0: Voice Assistant, 맥내 사용 경험 확장 - Universal Guide: 콘텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대
	<p>UHD TV (RU8000) (2019.3월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UHD Flat TV <input type="checkbox"/> 49/55/65" <input type="checkbox"/> Design: Super Narrow Bezel, 미니멀, Simple Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Tizen OS - Concept: 120Hz의 선명한 화질 및 Lifestyle 기반 스마트 기능 제공 4K TV - 화질: 선명하고 정확한 Life-like 컬러와 MR240의 선명한 이미지가 최적의 4K 시청 경험 제공 - AI: TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/사용성을 제공 - Bixby2.0: Voice Assistant, 맥내 사용 경험 확장 - Universal Guide: 콘텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대
	<p>HD-TV HF690 (2017.8월)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Product Concept <ul style="list-style-type: none"> - Market Segment별 특화 제품 및 솔루션 제공 - 3~4성급 대상 지역 별 Premium Smart HF590/690 도입 - KANT-M(Tizen3.0)적용 도입 <input type="checkbox"/> 32/43/49/55" <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Panel: 기존 M5500 동일 사양 32/43/49/55" 도입 - 회로 Platform: Kant-M(Tizen3.0) 적용 <ul style="list-style-type: none"> • SMPS: M5500 SMPS 공용설계 • HDMIx3, USBx2, RJ12, LAN, Opt, Comp/AV, RJP, BathSPK, LAN OUT

	<ul style="list-style-type: none"> - 기구 Design: M5500 시리즈 공용 설계 · Swivel Stand/Box: 16년 호텔 690동일 사양
LFD QMH (2017.8월)	<input type="checkbox"/> Product Concept <ul style="list-style-type: none"> - Premium UHD Line Up 도입 · 고해상도 UHD급 Signage 라인업 도입 운영 · SoC 적용을 통한 Signage 솔루션 제공 - UHD 라인업 Size 경쟁력 확대 · 다양한 사이즈의 Full Line-up 구축을 통한 시장의 고해상도 Needs 대응 - Non-Glare 및 24/7 사용 대응, 16년 QMF 동일 · LFD Usage 대응을 위한 사양 적용 <input type="checkbox"/> 49/55/65" <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform: Orsay → Tizen 3.0 도입, DTS, DIVX 삭제 - 회로: FHD/UHD 모델 플랫폼 통합 Kant-M SoC 적용 · 성능/기능 개선: SE13U(Scaler) → Kant-M(SoC) - 패널: 24/7, V-PID 및 Non-Glare 적용 (Haze 25%)
LM CJ89 (2018.3월)	<input type="checkbox"/> Product Concept <ul style="list-style-type: none"> - B2B 모니터 시장에 없던 압도적인 사이즈(32:9 비율 49") 출시, 향상된 업무 생산성 / 비용절감 효과 제공 - Pain Point 해결한 B2B 모니터 · Bezel의 간섭 없는 완벽한 Dual 모니터 사용성 제공 / USB-C 적용으로 최신 I/F 사양 제공 <input type="checkbox"/> 49" <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - CHG9 대비 게이밍 기능 제외하고, USB-C 사양 추가 - 기존 CHG9 패널에서 QD Sheet 제외
AV(HAV) HW-N650 (2018.4월)	<input type="checkbox"/> Soundbar (One Body) <ul style="list-style-type: none"> - Hole Array - Game 매니아를 위한 음장 특화 - TV 영상에 따른 자동 음장 조절 - TV와 일체감을 높이는 One Experience - One Remote, 360W(3.1ch) Power, Bluetooth, HDMI In/Out, USB
AV(HAV) HW-NW700 (2018.4월)	<input type="checkbox"/> Soundbar (One Body) <ul style="list-style-type: none"> - Built-in 서브우퍼를 통한 One Body - TV 영상에 따른 자동 음장 조절 - TV와 일체감을 높이는 One Experience - One Remote, 210W(7ch) Power, WiFi/Bluetooth, HDMI In/Out, USB - Voice Interaction: 3PDA(Amazon)
LFD QBN (2018.7월)	<input type="checkbox"/> Product Concept <ul style="list-style-type: none"> - '18년 Standalone Signage QB 라인업 도입 - UHD 해상도, Tizen 솔루션 적용 Mainstream 라인업 · Tizen 플랫폼 적용을 통한 솔루션 경쟁력 강화 · UHD 라인업 가격 경쟁력 강화 <input type="checkbox"/> 49/55/65/75" <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - 패널: TV New Edge NU7.1K 공용. 단, 휘도 상향으로 광학 Sheet 변경 · 350nit (MOP → 고DPP), Glare 패널 - Kant-M2e, Tizen 4.0 W/W 공용 설계

		- SMPS: TV NU7.1K 공용. 단, MTBF 수명 대응으로 AL Cap 변경
LFD QMN (2018.10월)		<input type="checkbox"/> Product Concept - '18년 Standalone 제품에 B2C New Edge 모델의 공용 대응을 통한 효율화 및 경쟁력 확보 - B2C 공용화(NU7.1K)로 투자비 Zero화 및 개발/생산 효율화 · Panel 및 Bottom Chassis 공용화로 투자비 Zero화 <input type="checkbox"/> 49/55/85/98" <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - Signage 특화 사양 사전 공용 설계, · Pivot 기능 구조 및 IT 규격 사전 반영 · 패널, 기구, SMPS, 스피커 공용화 - TV NU7.1 과 BLU, 기구 공용 · 단, 휘도 450nit 상향으로 광학 Sheet 파생. · 450nit (MOP → DBEF 복합 Sheet), Non Glare 패널
LCD 모니터 SR75 (2019.1월)		<input type="checkbox"/> Product Concept - 모니터 사용자의 Key Pain Point를 해결하는 모니터 · 모니터가 차지하는 공간을 최소화하여 사용자에게 작업 공간을 돌려주는 모니터 · 일체형 Arm Stand 적용하여 모니터 설치 공간 최소화/깔끔한 정리 구현 - 공간에 녹아 드는 프레임 디자인 <input type="checkbox"/> 27/32" <input type="checkbox"/> 사양 - 3면bezel-less/일체형 Arm Stand/프레임 디자인 - 고해상도 지원: 32" UHD (3840 X 2160), 27" WQHD (2560 X 1440)
LCD 모니터 CRG5 (2019.3월)		<input type="checkbox"/> Product Concept - 게이밍 시장 내 가장 큰 FHD 24"세그에 보급형 모델 도입하여 당사 M/S 확보 - 게임 시 눈에 편안하고 몰입감 넘치는 게임 화질 제공 - 후면에 Gaming Identity 적용 된 디자인 요소 적용 <input type="checkbox"/> 49" <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - 144Hz 주사율 끊김 없고 잔상 없는 부드러운 움직임 - Free-sync 지원 재생률 조정으로 화면 깨짐(Screen Tearing) 없이 매끄러운 게임 화면 선사 - 게임에 최적화된 게임모드 제공
LCD 모니터 CRG9 (2019.3월)		<input type="checkbox"/> Product Concept - 32:9 49" 성능 Upgrade 를 통해 Gaming 시장 내 'Curved, Wide, 대형/고해상도' Trend를 Lead - 5K + HDR1000을 적용 한 최고의 Flagship 모델 출시 <input type="checkbox"/> 49" <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - QD 기술 적용 보다 풍부하고 Vivid한 Color 제공 - 32:9 Wide Curved Form Factor로 높은 몰입감 제공, Dual 모니터 Pain Point 해결 된 사용 경험 제공 - Tilt, HAS, Swivel 기능 적용 편안한 사용성 제공
Sound Bar SBQ70R (2019.3월)		<input type="checkbox"/> Product Concept - TV의 트렌드 변화에 맞춘 현장감 극대화 및 공간을 채우는 사운드 구현 - 당사 TV와 디자인 & Color 매칭을 통한 연계 판매 극대화 <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - ATMOS와 Acoustic beam 특허기술로 TV Sound 및 Game Experience확장 - 소비자 사용 콘텐츠에 최적화한 신규 음장 적용(AI sound, Game Pro) - Hole Array 기술을 통해 3D Virtual Surround 제공
생활가전	청소기 파워스틱	<input type="checkbox"/> 제품 특성

		(VS8000ML) (2017.8월)	<ul style="list-style-type: none"> - 세계 최고 흡입력 POWERStick 청소기 - Suction Power 150W, 40분 - Flex Body, 듀얼 드럼 브러시 - EzClean Dustbin & Brush - Hygienic Solution: HEPA Filter 적용
		SBS 냉장고 (2019.2월)	<input type="checkbox"/> RS5000RC SBS 신규 Platform <ul style="list-style-type: none"> - 대용량: 617ℓ(2 Door Plumbing 기준) - Flex Zone 구현 → 0/1/3도 Mono 구현 - Flat Duct 구현 → Twin Cooling Look 구현 - 가로 헤어라인 → 품위품질 향상
반도체 사업	메모리	모바일용 4세대(64단) V낸드기반 512GB eUFS 양산 (2017.11월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 64단 V낸드기반 512GB eUFS 2.1 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 512Gb V낸드 탑재로 고용량 메모리 시장 확대 - 업계 유일 최고 속도 · 최대 용량 솔루션 제공 <input type="checkbox"/> 512Gb V낸드 라인업 확대로 프리미엄 시장 성장 주도 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰/태블릿 시장 선점에 이어 SSD 사업 확대
		PC/서버용 2세대 10나노급(1y) 8Gb DDR4 D램 양산 (2017.11월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 2세대 10나노급(1y) 8Gb DDR4 D램 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 1x나노 대비 생산성 +30%, 속도 +10%, 절전 +15% 향상 - 독자 개발 '3대 혁신 기술'로 제품 경쟁력 우위 강화 <input type="checkbox"/> 차세대 D램 양산 기술 선행 확보로 시장 성장 주도 <ul style="list-style-type: none"> - 차세대 DDR5/LPDDR5/HBM3/GDDR6 양산 기반 확보
		슈퍼컴용 3세대(48단) Z낸드기반 800GB NVMe Z-SSD양산 (2018.1월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 슈퍼컴퓨터용 800GB NVMe Z-SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> - NVMe SSD대비 응답속도 5배, 수명 35배 향상 - 시스템에서 최고 '성능 · 내구성 · 신뢰성' 구현 <input type="checkbox"/> 2세대 Dual Port Z-SSD 라인업 출시로 시장 확대 <ul style="list-style-type: none"> - HPC 시장 선점에 이어 스토리지 시장까지 공략
		서버용 4세대(64단) V낸드기반 30.72TB SAS SSD양산 (2018.1월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 서버용 30.72TB SAS SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 512Gb V낸드 탑재로 2.5인치 30.72TB 유일 제공 - 기존 대비 용량 2배, 임의 읽기속도 2배 향상 <input type="checkbox"/> 초고용량 라인업 지속 확대로 SAS시장 성장 주도 <ul style="list-style-type: none"> - 데이터센터에 이어 엔터프라이즈 시장까지 확대
		서버용 4세대(64단) V낸드기반 8TB NF1 NVMe SSD양산 (2018.5월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 서버용 8TB NF1 NVMe SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 512Gb V낸드 탑재로 NF1 규격에서 8TB 용량 제공 - 8TB 라인업 탑재로 시스템 메모리 용량 3배 증대 <input type="checkbox"/> 업계 유일 8TB 라인업 출시로 NF1 시장 창출 성공 <ul style="list-style-type: none"> - 프리미엄 NVMe SSD 시장 주력제품을 8TB로 확대
		PC용 5세대(9x단) 256Gb V낸드기반 SSD양산 (2018.6월)	<input type="checkbox"/> 세계 최고 속도 5세대 V낸드기반 PC SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 90단 이상 셀 적층 V낸드 탑재 SSD 세계 최초 양산 - 기존 대비 속도 1.4배, 생산성 30% 이상 향상 <input type="checkbox"/> 초고속/초절전 특성 우위로 스토리지 시장 성장 주도 <ul style="list-style-type: none"> - 1Tb 및 QLC V낸드기반 차세대 제품 개발 역량 확보
		모바일용 2세대 10나노급(1y) 16Gb LPDDR4X D램 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최고 속도 최대 용량 16Gb LPDDR4X D램 양산 <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최초 2세대 10나노급(1y) 16Gb 라인업 양산 - 기존 20나노 D램 대비 속도와 생산성 2배 향상 <input type="checkbox"/> 평택라인에서 최첨단 D램 양산으로 시장 성장 견인

		(2018.7월)	- 초고속·초절전·초소형 12GB 양산 고용량 시장 확대
		PC용 4세대(64단) 1Tb 4비트 V낸드기반 SSD양산 (2018.9월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 1Tb 4비트 V낸드기반 PC SSD 양산 - 64단 셀 적층 1Tb 4비트 V낸드 업계 최초 본격 양산 - 기존 3비트 SSD 대비 동등 읽기/쓰기 속도 구현 <input type="checkbox"/> 초고용량/원가경쟁력 우위 확보로 시장 성장 주도 - 1Tb 및 QLC V낸드로 차세대 시장 창출 역량 확보
		서버용 1세대 10나노급(1x) 256GB 3DS DDR4 D램 양산 (2018.10월)	<input type="checkbox"/> 세계 최대 용량 256GB 3DS DDR4 D램 양산 - 초고성능·초고용량 256GB D램 세계 최초 양산 - 128GB 대비 용량 2배/소비전력 효율 30% 향상 <input type="checkbox"/> 차세대 IT 시스템 시장 선점으로 사업 역량 강화 - 프리미엄 라인업 확대에 EUV기반 D램 수요 창출
		모바일용 5세대(9x단) 512Gb 3비트 V낸드기반 eUFS양산 (2019.2월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 스마트폰 메모리 eUFS 3.0 양산 - 9x단 셀 적층 512Gb 3비트 V낸드 업계 최초 탑재 - eUFS 2.0 대비 2배 빠른 읽기/쓰기 속도 구현 <input type="checkbox"/> 초고해상도 차세대 모바일 시장 선점으로 고성능 주도 - 512GB/128GB출시에 이어 1TB/256GB 라인업 확대
		서버용 3세대 10나노급(1z) 8Gb DDR4 D램 개발 (2019.3월)	<input type="checkbox"/> 세계 최고 차세대 1z 나노기반 8Gb DDR4 D램 개발 - DDR5/LPDDR5 양산 위한 초고속·초절전 솔루션 확보 - 기존 2세대(1y나노) D램 대비 생산성 20% 이상 향상 <input type="checkbox"/> 프리미엄 D램 라인업 지속 확대에 사업 역량 강화 - 팅택 라인에서 차세대 D램 라인업 생산 비중 확대
		PC용 6세대(1xx단) 256Gb V낸드기반 SSD양산 (2019.7월)	<input type="checkbox"/> 세계 최고 속도 6세대 V낸드기반 PC SSD 양산 - 100단 이상 셀 단일 공정 적층 V낸드 유일 양산 - 기존 대비 속도 1.2배, 생산성 20% 이상 향상 <input type="checkbox"/> 초고속/초절전 특성우위로 스토리지 시장 성장 주도 - 서버/모바일 시장 선점에 이어 자동차 시장 본격 공략
		서버용 5세대(9x단) V낸드기반 30.72TB NVMe SSD양산 (2019.9월)	<input type="checkbox"/> 세계 최고 속도/최대 용량 서버용 30.72TB NVMe SSD 양산 - 속도, 용량, 경제성 동시 강화 차세대 SSD 솔루션 확보 - 기존 대비 2.2배 속도 8GB/s 구현 PCIe Gen4 SSD 출시 <input type="checkbox"/> 프리미엄 SSD 시장 확대 주도로 사업 위상 강화 - 3대 SW(Never Die SSD, FIP, ML) 솔루션 업계 유일 제공
이미지 센서		모바일 이미지센서 (S5K2X7) (2017.10월)	<input type="checkbox"/> 초소형 고품질 이미지센서 ISOCELL Fast 2L9 - 자동초점, 듀얼픽셀 기술 적용 - 미세 공정 기술로 픽셀 크기 1.4 μ m에서 1.2 μ m로 줄여 사이즈 경쟁력 확보 - 이미지센서 1개로 아웃포커스 기능 구현 가능
		모바일 이미지센서 (S5K2L9SX) (2017.10월)	<input type="checkbox"/> 초소형 고품질 이미지센서 ISOCELL Slim 2X7 - 화소수를 자동 조절하여 밝고 선명한 촬영이 가능한 TetraCell(테트라셀) 기술 적용 - 업계 최초 픽셀 크기 1.0 μ m 미만의 (0.9 μ m) 초소형 이미지 센서 - 픽셀 사이 물리적 벽을 형성하는 DTI 공법 적용
		모바일 이미지센서 (S5K2L3) (2018.2월)	<input type="checkbox"/> D램 내장 3단 적층 구조 적용 ISOCELL Fast 2L3 - 빠르게 대량의 이미지 저장 가능 - 초당 960 프레임의 슈퍼 슬로우 모션 촬영 지원 <input type="checkbox"/> 듀얼픽셀 기반 위상 검출 자동 초점 기술 적용 - 환경 제약 없는 빠르고 정확한 오토포커스 제공 - 3D 노이즈 감소, HDR 등 첨단 기술 집약
		이미지센서	<input type="checkbox"/> 이미지센서 + S/W 알고리즘 동시 제공 토탈 솔루션

	솔루션 (2018.2월)	- S/W 구매 비용 및 센서/AP 최적화 시간 단축 - 리포커싱/저조도 촬영 등 듀얼카메라 기능 지원
	모바일 이미지센서 (S5K3P9) (2018.5월)	<input type="checkbox"/> 스몰 픽셀 고감도 이미지센서 ISOCELL Slim 3P9 - 칩 사이즈 감소 및 픽셀 성능/노이즈 개선 향상 - 오토포커스 손떨림 방지 등 기능 강화 <input type="checkbox"/> 턴키 솔루션 '플러그 앤 플레이' 제공 - AP, 카메라 모듈, 액추에이터 등 모듈 기선정후 S/W 이미지 튜닝까지 완료하여 제공 - VCX 평가 셋팅값 제공 및 개발 기간 단축
	이미지센서 기술 (2018.6월)	<input type="checkbox"/> 이미지 센서 개선 기술 ISOCELL Plus - 컬러 필터간 격벽 소재 변경 및 높이 상승으로 빛 반사/흡수로 인한 손실 최소화 - 전세대 대비 저조도 감도 향상
	모바일 이미지센서 (S5KGM1) (2018.10월)	<input type="checkbox"/> 0.8um 초소형 픽셀 ISOCELL Bright GM1 - 4,800만 초고화소 이미지 센서 - 테트라셀 기술로 저조도에서 고감도 효과 구현 <input type="checkbox"/> 고화소, 멀티카메라 채용 수요 대응 용이 - 초소형 픽셀사이즈와 테트라셀 기능으로 고화질 및 작은면적 동시 구현하여 설계의 유연성 제공
	모바일 이미지센서 (S5KGD1) (2018.10월)	<input type="checkbox"/> 0.8um 초소형 픽셀 ISOCELL Bright GD1 - 3,200만 고화소 이미지 센서 - 테트라셀 기술로 저조도에서 고감도 효과 구현 - 밝고 어두운 부분이 함께 있는 촬영 환경에서도 적절한 밝기와 풍부한 색감의 영상 촬영 가능한 실시간 HDR 지원 <input type="checkbox"/> 고화소, 멀티카메라 채용 수요 대응 용이 - 초소형 픽셀사이즈와 테트라셀 기능으로 고화질 및 작은 면적 동시 구현하여 설계의 유연성 제공
	모바일 이미지센서 (S5K3T2) (2019.1월)	<input type="checkbox"/> 초소형 픽셀 이미지센서 ISOCELL Slim 3T2 - 베젤리스 디스플레이에 최적화된 고화소 구현 - 1/3.4" 센서 중 최고화소 (20Mp) - 전면 테트라셀 기술 적용으로 저조도 촬영 우수, 후면 고배율 사용시 모듈 사이즈 감소, 화질개선
	모바일 이미지센서 (S5KGW1) (2019.5월)	<input type="checkbox"/> 초고화소 이미지센서 ISOCELL Bright GW1 - 모바일 이미지 센서 중 최고화소 (6,400만 화소) - DCG 구조 적용으로 Dynamic Range 증가 - 슈퍼 PD 기술로 Auto Focus 성능 극대화 및 초당 480 프레임 Full-HD 슬로우 모션 기능 제공 - 실시간 HDR 기능 지원으로 풍부한 색감 구현
	모바일 이미지센서 (S5KGM2) (2019.5월)	<input type="checkbox"/> ISOCELL Bright GM2 - 0.8um 3,200만화소 초소형 고화소 이미지센서 - 슈퍼 PD 기술로 Auto Focus 성능 극대화 및 초당 240 프레임 Full-HD 슬로우 모션 기능 제공
	모바일 이미지센서 (S5KHMX) (2019.8월)	<input type="checkbox"/> ISOCELL Bright HMX - 세계최초 1억8백만화소 모바일 이미지센서 - AI-ISO 적용하여 S/W로 광량조절, 색재현력 향상 - 최대 6K 해상도의 영상 초당 30 프레임 촬영 가능 - 아이소셀 플러스, 테트라셀 기술로 감도 개선
	모바일 이미지센서 (S5KGH1) (2019.9월)	<input type="checkbox"/> ISOCELL Slim GH1 - 모바일 이미지 센서 중 최소 픽셀 크기 (0.7um) - 모듈의 크기와 두께 소형화 가능하여 Full-Screen Display 세트 탑재 용이 - 고해상도 녹화 지원 및 화각 손실 최소화 가능 - 아이소셀 플러스, 테트라셀 기술로 감도 개선
엑시노스	엑시노스9	<input type="checkbox"/> 10나노 핀펫 공정 기반 Premium AP

	(2017.2월)	<ul style="list-style-type: none"> - 최첨단 10나노 공정 적용, 저전력 고성능 구현 - 기가비트급 LTE 통신 지원 모뎀 통합칩 - 2세대 커스텀 CPU 및 차세대 GPU등 최고수준 성능 제공
	엑시노스 9 (9810) (2018.1월)	<input type="checkbox"/> SC59810 <input type="checkbox"/> 독자 개발 3세대 CPU 및 Cat.18 6CA 지원 초고속 모뎀 탑재 AP <ul style="list-style-type: none"> - 싱글코어 성능 약 2배, 멀티코어 성능 40% 향상 - 업계최초 6CA LTE모뎀 탑재, 다운로드 속도 1.2Gbps 구현 <input type="checkbox"/> 딥러닝 알고리즘 구현, 지능형 이미지 처리 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 정확한 이미지 분석, 향상된 안면인식 기능 지원 - 저조도, 흔들리는 환경에서도 고화질의 이미지와 영상 촬영
	엑시노스 i (S111) (2018.8월)	<input type="checkbox"/> S5JS100 <input type="checkbox"/> 최신 NB-IoT 표준 지원, 저전력/보안강화 칩 <ul style="list-style-type: none"> - 저전력으로 표준 제정된 전송범위(10km) 상회 달성 - 데이터 보안강화를 위한 암호화/복호화 및 물리적 복제방지 기능 탑재 - 모뎀/CPU/RF/PMIC/GNSS 기능 원칩 통합
	엑시노스 9 (9820) (2018.11월)	<input type="checkbox"/> SC59820 <input type="checkbox"/> NPU, AP 구조개선 및 8CA 탑재로 성능 향상 <ul style="list-style-type: none"> - NPU: 이전제품 대비 AI 연산속도 7배 향상 - AP: 빅-리틀 (4+4) → 빅-미들-리틀 (2+2+4), 사용환경에 따라 유기적 동작, 전력효율 상승 - Modem: 업계 최초 8CA 기술 적용, DL 최대 2Gbps
	엑시노스 오토V9 (2019.1월)	<input type="checkbox"/> S5AHR80 <input type="checkbox"/> 차량용 인포테인먼트용 Exynos Auto V9 <ul style="list-style-type: none"> - 옥타코어 CPU활용하여 디스플레이 6대 및 카메라 12개 동시 제어 가능 - GPU 3개 탑재로 계기판/CID/HUD 개별 지원 - NPU 탑재로 디지털 음성/얼굴/동작 인식 - ASIL-B 안전등급 지원으로 안정성 강화
	엑시노스 i (T100) (2019.5월)	<input type="checkbox"/> S5JT100 <input type="checkbox"/> 저전력/보안강화 단거리 IoT 전용 SoC <ul style="list-style-type: none"> - 블루투스 5.0, 지그비 3.0 등 최신 단거리 무선통신 지원 - 데이터 보안강화를 위한 암호화/복호화 및 물리적 복제방지 기능 탑재 - 동작 온도 범위 확대 (최대 125℃ 고온 정상작동) - 28나노 공정 적용으로 전력효율 상승 - 프로세서/메모리/통신기능 패키지화
	엑시노스 980 (2019.9월)	<input type="checkbox"/> 엑시노스 980 <input type="checkbox"/> 5G 모뎀 통합 원칩 SoC <ul style="list-style-type: none"> - Sub-6GHz 대역 지원 5G 모뎀 + AP원칩 - EN-DC, Wi-Fi 6 등 최신 통신 기능 지원 - 전세대 및 프리미엄 제품 대비 NPU 성능 향상
	디스플레이 구동 반도체 (2019.1월)	<input type="checkbox"/> 디스플레이 구동 반도체 'S6CT93P' <ul style="list-style-type: none"> - 8K TV 초고화질 영상 구현 최적화 및 전송 효율 향상 - 이퀄라이저 S/W化로 신호품질 향상 및 개발효율 증대
	5G 모뎀 토털솔루션 (2019.4월)	<input type="checkbox"/> SA55100, S5M5500, S5M5800 <input type="checkbox"/> 세계최초 5G 스마트폰용 모뎀 솔루션 상용화 <ul style="list-style-type: none"> - 엑시노스 모뎀 5100, RF 5500, SM 5800 - 데이터 통신속도 1.7배 증가 (LTE대비) - 신규 RF/SM 탑재, 송수신 전력 효율 개선
	PDIC	<input type="checkbox"/> S2MM101

	(2019.5월)	<input type="checkbox"/> USB PD 규격 지원 고속충전 TA용 PDIC - USB-PD 3.0 표준 및 고속충전 프로토콜 지원 - 수분감지, 전압 보호기능 탑재
	PDSE (2019.5월)	<input type="checkbox"/> S3SSE8A <input type="checkbox"/> 세계최초 PDIC + SE 통합 원칩 - Type-C 인증 지원으로 비인증 제품 차단 - 보안키/인증서 저장, 암호화/복호화 지원 등 고성능 보안기능 탑재
파운드리	8인치 파운드리 공정 (RF/지문인식) (2018.3월)	<input type="checkbox"/> RF, 지문인식 센서 제품군에 특화된 8" 공정 개발 - 8인치 파운드리 서비스 제품군 확대 · 임베디드 플래시 메모리, 전력반도체, 디스플레이 드라이버, CMOS 이미지센서 외 RF, 지문인식 센서용 솔루션 추가 - 파운드리 고객의 제품 완성도 및 편의성 향상
	EUV기술 적용 7나노 공정 (2018.9월 개발)	<input type="checkbox"/> EUV 노광 기술 적용한 7LPP(Low Power Plus) 공정 - 노광 광원으로 EUV(Extreme Ultraviolet) 사용 · 파장의 길이가 기존 불화아르곤(ArF)의 1/14 미만에 불과해 세밀한 회로 패턴 구현 가능 · 멀티패터닝 공정 감소로 고성능/생산성 확보 - 10나노 공정 대비 성능 약 20% 향상, 면적 40% 및 소비전력 50% 가량 감소 기대
	eMRAM 솔루션 제품 출하 (28나노 FD-SOI 공 정기반) (2019.3월)	<input type="checkbox"/> 저전력 특성 공정과 차세대 내장 메모리 기술 접목 - 낮은 동작 전압을 사용하며, 대기전력이 없으며, 데이터 삭제과정이 불필요해 전력효율 극대화 - 기존 eFlash 대비 약 1000배 빠른 기록속도 지원 <input type="checkbox"/> 최소한의 레이어를 추가해 시스템 반도체에 내장 - 설계 구조 단순해 생산비용 절감 가능 <input type="checkbox"/> 저전력, 소형화 특성으로 MCU/IoT/AI 등에 최적화
	EUV 기술 적용 5나노 공정 (2019.4월)	<input type="checkbox"/> EUV 노광기술 적용한 5나노 공정 개발 - 셀 설계를 최적화해 7나노 공정 대비 로직면적 25% 감소, 전력효율 20% 및 성능 10% 향상 기대 - 7나노에 적용된 설계자산(IP)을 활용 가능해 기존 7나노 고객들의 설계 부담 경감
DP 사업	갤럭시 S10용 홀 디스플레이 AMOLED (2019.3월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 Flexible Hole in Display 상품화로 화면공간 극대화 - S10 6.1" 3K QHD+(3,040×1,440) Hole 1개, S10+ 6.4" Hole 2개 <input type="checkbox"/> 블루라이트의 획기적인 감소로 눈이 편안한 디스플레이 제공 - S9 대비 블루라이트 42% 감소(TUV 라인란드 아이컴포트 인증)
	NPC용 15.6" UHD AMOLED (2019.5월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 NPC용 4K OLED 디스플레이 개발 - 15.6" UHD(3,840 x 2,160), 16:9 - Blue Light 저감, 빠른 응답속도, 넓은 시야각으로 선명한 화질 제공
	스마트폰용 4K 고해상도 AMOLED (2019.6월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 4K 모바일 OLED 디스플레이 개발 - 6.5" UHD(1,644×3,840), 643ppi, 16M Color - 21:9 화면비로 영화의 원본 비율 그대로 감상 가능
	Gaming 모니터용 27" FHD 240Hz Curved LCD (2019.6월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 240Hz Curved LCD 디스플레이 개발 - 27" FHD(1920×1080), 16:9 - 240Hz 고속주사율과 G-sync 지원으로 부드럽고 끊김없는 게임환경 제공 - 곡률 1500R, 광시야각 기술로 몰입감 극대화
	갤럭시 폴드용 폴더블 AMOLED (2019.9월)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 폴더블 디스플레이 개발로 디스플레이 혁신 - In-Foldable AM OLED (곡률반경 1.5R) - 7.3" QXGA+(1,536×2,152), 4:3 - 복합 폴리머 소재 개발로 기존 디스플레이 대비 약 50% 두께 감소

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국 특허를 등록시킨 이래 현재 세계적으로 총 135,433건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 누적 건수 기준으로 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수(2019년 3분기말 기준, 누적)]

(단위 : 건)

국가	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가
건수	24,148	53,142	28,506	12,208	7,212	10,217

2019년 3분기까지 15.3조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 2,446건, 미국 특허 4,821건을 취득하였습니다.

[연도별 특허등록 건수]

(단위 : 건)

특허등록	'19.3Q	'18년	'17년	'16년	'15년	'14년	'13년
한국	2,446	2,055	2,703	3,462	3,002	3,985	2,775
미국	4,821	6,062	6,072	5,683	5,220	5,085	4,802

이들은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라, 유사기술/특허의 난립과 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통해 향후 신규사업 진출 시 사업보호의 역할이 기대되고 있습니다.

당사는 Google('14.1월 체결, 영구), Nokia('18.10월), Western Digital('16.12월, 2024년까지 공유), Qualcomm('18.1월, 2023년까지 공유), Huawei('19.2월) 등과의 상호 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, LED TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을 보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여 2019년 3분기에 미국에서 354건의 디자인 특허를 취득하였습니다.

나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저히 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자들에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

☞ 녹색기술 인증 관련 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '10. 녹색경영' 부분을 참조하시기 바랍니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향 최소화 활동을 하고 있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수·재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기전자 제품 관련 국내외 환경법규를 준수할뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수·재활용법 (예: EU WEEE Directive)
2. 유해물질사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생하는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지시설, 수질 오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다.

이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증 (ISO14001, OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제: 「물환경보전법」 「대기환경보전법」 「폐기물관리법」 「소음·진동관리법」 「환경영향평가법」 등
2. 온실가스 배출 관리: 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 「저탄소 녹색성장 기본법」 등
3. 기타 사업장환경관리법: 「화학물질관리법」 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 「악취방지법」 「토양환경보전법」 등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2018년	2017년	2016년
온실가스(단위 : tCO ₂ e)	10,775,372	8,589,071	6,885,300
에너지(단위 : TJ)	153,681	130,834	107,740

- ※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
- ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
- ※ 삼성디스플레이 분사(2012년)로 인해 DP사업이 제외된 기준입니다.
- ※ 배출량 및 사용량은 외부 검증기관 검증 결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제51기 3분기	제50기	제49기
	2019년 9월말	2018년 12월말	2017년 12월말
[유동자산]	186,042,134	174,697,424	146,982,464
· 현금및현금성자산	26,604,994	30,340,505	30,545,130
· 단기금융상품	69,476,971	65,893,797	49,447,696
· 기타유동금융자산	5,864,512	4,705,641	3,191,375
· 매출채권	40,367,204	33,867,733	27,695,995
· 재고자산	30,908,762	28,984,704	24,983,355
· 기타	12,819,691	10,905,044	11,118,913
[비유동자산]	167,343,851	164,659,820	154,769,626
· 기타비유동금융자산	9,825,568	8,315,087	7,858,931
· 관계기업 및 공동기업 투자	7,536,935	7,313,206	6,802,351
· 유형자산	116,855,571	115,416,724	111,665,648
· 무형자산	15,705,674	14,891,598	14,760,483
· 기타	17,420,103	18,723,205	13,682,213
자산총계	353,385,985	339,357,244	301,752,090
[유동부채]	63,303,192	69,081,510	67,175,114
[비유동부채]	26,640,549	22,522,557	20,085,548
부채총계	89,943,741	91,604,067	87,260,662
[지배기업 소유주지분]	255,403,450	240,068,993	207,213,416
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	251,761,348	242,698,956	215,811,200
· 기타	△1,659,305	△7,931,370	△13,899,191
[비지배지분]	8,038,794	7,684,184	7,278,012
자본총계	263,442,244	247,753,177	214,491,428
	2019년 1월~9월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월
매출액	170,516,121	243,771,415	239,575,376
영업이익	20,608,239	58,886,669	53,645,038
연결총당기순이익	16,511,825	44,344,857	42,186,747
지배기업 소유주지분	16,277,059	43,890,877	41,344,569
비지배지분	234,766	453,980	842,178

기본주당순이익(단위 : 원)	2,396	6,461	5,997
희석주당순이익(단위 : 원)	2,396	6,461	5,997
연결에 포함된 회사수	247개	253개	271개

- ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]
- ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제49기~제50기 연결감사보고서 및 제51기 분기 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제51기 3분기	제50기	제49기
	2019년 9월말	2018년 12월말	2017년 12월말
[유동자산]	76,848,738	80,039,455	70,155,189
· 현금및현금성자산	2,135,881	2,607,957	2,763,768
· 단기금융상품	24,403,587	34,113,871	25,510,064
· 매출채권	31,554,688	24,933,267	27,881,777
· 재고자산	12,646,133	12,440,951	7,837,144
· 기타	6,108,449	5,943,409	6,162,436
[비유동자산]	140,398,633	138,981,902	128,086,171
· 기타비유동금융자산	1,240,008	1,105,978	973,353
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	56,694,380	55,959,745	55,671,759
· 유형자산	71,544,177	70,602,493	62,816,961
· 무형자산	3,439,350	2,901,476	2,827,035
· 기타	7,480,718	8,412,210	5,797,063
자산총계	217,247,371	219,021,357	198,241,360
[유동부채]	37,245,240	43,145,053	44,495,084
[비유동부채]	2,451,483	2,888,179	2,176,501
부채총계	39,696,723	46,033,232	46,671,585
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	171,078,582	166,555,532	150,928,724
[기타]	1,170,659	1,131,186	△4,660,356
자본총계	177,550,648	172,988,125	151,569,775
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2019년 1월~9월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월
매출액	117,392,980	170,381,870	161,915,007
영업이익	9,360,048	43,699,451	34,857,091
당기순이익	11,737,687	32,815,127	28,800,837
기본주당순이익(단위 : 원)	1,728	4,830	4,178
희석주당순이익(단위 : 원)	1,728	4,830	4,178

* 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

* 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제49기~제50기 감사보고서 및 제51기 분기 검토보고서 주석사항을 참조하십시오.

* 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 51 기 3분기말 2019.09.30 현재

제 50 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 51 기 3분기말	제 50 기말
자산		
유동자산	186,042,134	174,697,424
현금및현금성자산	26,604,994	30,340,505
단기금융상품	69,476,971	65,893,797
단기상각후원가금융자산	4,021,901	2,703,693
단기당기손익-공정가치금융자산	1,842,611	2,001,948
매출채권	40,367,204	33,867,733
미수금	3,510,901	3,080,733
선급금	1,665,164	1,361,807
선급비용	4,845,137	4,136,167
재고자산	30,908,762	28,984,704
기타유동자산	2,798,489	2,326,337
비유동자산	167,343,851	164,659,820
상각후원가금융자산	134,641	238,309
기타포괄손익-공정가치금융자산	8,728,038	7,301,351
당기손익-공정가치금융자산	962,889	775,427
관계기업 및 공동기업 투자	7,536,935	7,313,206
유형자산	116,855,571	115,416,724
무형자산	15,705,674	14,891,598
장기선급비용	4,178,381	5,009,679
순확정급여자산	29,506	562,356
이연법인세자산	5,461,996	5,468,002
기타비유동자산	7,750,220	7,683,168
자산총계	353,385,985	339,357,244
부채		
유동부채	63,303,192	69,081,510
매입채무	11,422,269	8,479,916
단기차입금	12,330,248	13,586,660
미지급금	10,017,386	10,711,536
선수금	844,237	820,265
예수금	937,500	951,254
미지급비용	17,179,210	20,339,687

미지급법인세	2,318,190	8,720,050
유동성장기부채	792,467	33,386
총당부채	6,206,070	4,384,038
기타유동부채	1,255,615	1,054,718
비유동부채	26,640,549	22,522,557
사채	1,008,058	961,972
장기차입금	2,002,565	85,085
장기미지급금	2,408,246	3,194,043
순확정급여부채	724,085	504,064
이연법인세부채	17,185,000	15,162,523
장기총당부채	1,054,683	663,619
기타비유동부채	2,257,912	1,951,251
부채총계	89,943,741	91,604,067
자본		
지배기업 소유주지분	255,403,450	240,068,993
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	251,761,348	242,698,956
기타자본항목	(1,659,305)	(7,931,370)
비지배지분	8,038,794	7,684,184
자본총계	263,442,244	247,753,177
자본과부채총계	353,385,985	339,357,244

연결 손익계산서

제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 51 기 3분기		제 50 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	62,003,471	170,516,121	65,459,993	184,506,365
매출원가	39,993,890	108,685,026	35,194,358	98,378,427
매출총이익	22,009,581	61,831,095	30,265,635	86,127,938
판매비와관리비	14,231,689	41,222,856	12,690,770	38,041,868
영업이익(손실)	7,777,892	20,608,239	17,574,865	48,086,070
기타수익	496,993	1,178,934	176,612	915,176
기타비용	305,145	875,159	152,354	620,026
지분법이익	110,499	252,672	118,455	289,126
금융수익	2,796,372	7,864,491	2,501,153	7,903,413
금융비용	2,255,883	6,316,107	2,249,387	7,021,672
법인세비용차감전순이익(손실)	8,620,728	22,713,070	17,969,344	49,552,087
법인세비용	2,333,064	6,201,245	4,818,629	13,669,416
계속영업이익(손실)	6,287,664	16,511,825	13,150,715	35,882,671
당기순이익(손실)	6,287,664	16,511,825	13,150,715	35,882,671
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,105,039	16,277,059	12,967,428	35,560,808
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	182,625	234,766	183,287	321,863
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	899	2,396	1,909	5,234
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	899	2,396	1,909	5,234

연결 포괄손익계산서

제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 51 기 3분기		제 50 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기손이익(손실)	6,287,664	16,511,825	13,150,715	35,882,671
기타포괄손익	1,823,973	6,405,617	(1,762,131)	386,961
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	172,057	905,737	327,458	175,847
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	188,193	978,090	329,267	231,382
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(905)	(2,662)	15,595	16,919
순확정급여부채 재측정요소	(15,231)	(69,691)	(17,404)	(72,454)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,651,916	5,499,880	(2,089,589)	211,114
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	36,397	101,816	(23,665)	14,860
해외사업장환산외환차이	1,609,488	5,386,506	(2,060,896)	164,035
현금흐름위험회피파생상품평가손익	6,031	11,558	(5,028)	32,219
총포괄손익	8,111,637	22,917,442	11,388,584	36,269,632
포괄손익의 귀속				
지배기업 소유주지분	7,917,242	22,550,166	11,209,717	35,915,129
비지배지분	194,395	367,276	178,867	354,503

연결 자본변동표

제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본						
	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초 과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주 지분 합계		
2018.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	215,811,200	(13,899,191)	207,213,416	7,278,012	214,491,428
회계정책변경누적효과			220,176	(261,734)	(41,558)		(41,558)
수정후 기초자본	897,514	4,403,893	216,031,376	(14,160,925)	207,171,858	7,278,012	214,449,870
당기순이익(손실)			35,560,808		35,560,808	321,863	35,882,671
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			3,013	196,170	199,183	32,199	231,382
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				31,657	31,657	122	31,779
해외사업장환산외환차이				163,647	163,647	388	164,035
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(72,385)	(72,385)	(69)	(72,454)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				32,219	32,219		32,219
배당			(7,738,740)		(7,738,740)	(7,935)	(7,746,675)
연결실체내 자본거래 등				1,719	1,719	1,254	2,973
연결실체의 변동						(39)	(39)
자기주식의 취득				(875,111)	(875,111)		(875,111)
자기주식의 소각			(2,228,135)	2,228,135			
기타				1,525	1,525	985	2,510
2018.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	241,628,322	(12,453,349)	234,476,380	7,626,780	242,103,160
2019.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	242,698,956	(7,931,370)	240,068,993	7,684,184	247,753,177
회계정책변경누적효과							
수정후 기초자본	897,514	4,403,893	242,698,956	(7,931,370)	240,068,993	7,684,184	247,753,177
당기순이익(손실)			16,277,059		16,277,059	234,766	16,511,825
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			(30)	934,454	934,424	43,666	978,090
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				98,707	98,707	447	99,154
해외사업장환산외환차이				5,298,249	5,298,249	88,257	5,386,506
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(69,831)	(69,831)	140	(69,691)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				11,558	11,558		11,558
배당			(7,214,637)		(7,214,637)	(14,530)	(7,229,167)
연결실체내 자본거래 등				185	185	391	576
연결실체의 변동						(27)	(27)
자기주식의 취득							
자기주식의 소각							
기타				(1,257)	(1,257)	1,500	243
2019.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	251,761,348	(1,659,305)	255,403,450	8,038,794	263,442,244

연결 현금흐름표

제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 51 기 3분기	제 50 기 3분기
영업활동 현금흐름	25,665,775	44,603,783
영업에서 창출된 현금흐름	35,438,488	53,748,492
당기순이익	16,511,825	35,882,671
조정	26,398,410	34,137,314
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,471,747)	(16,271,493)
이자의 수취	1,686,007	1,273,834
이자의 지급	(439,802)	(367,706)
배당금 수입	203,469	187,765
법인세 납부액	(11,222,387)	(10,238,602)
투자활동 현금흐름	(21,462,218)	(36,477,265)
단기금융상품의 순감소(증가)	3,834,827	(9,026,701)
단기상각후원가금융자산의 순감소(증가)	(492,304)	(337,625)
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	286,474	
장기금융상품의 처분	2,500,701	254,855
장기금융상품의 취득	(8,004,950)	(2,782,949)
상각후원가금융자산의 처분	195,809	
상각후원가금융자산의 취득	(825,027)	(158,716)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	1,000	9,789
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(52,762)	(417,447)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	52,462	49,283
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(112,056)	(124,002)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	12,149	148
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(9,778)	(17,564)
유형자산의 처분	372,561	392,768
유형자산의 취득	(17,482,933)	(23,715,834)
무형자산의 처분	3,992	10,004
무형자산의 취득	(829,061)	(676,612)
사업결합으로 인한 현금유출액	(971,911)	(30,463)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	58,589	93,801
재무활동 현금흐름	(9,079,433)	(5,689,077)
단기차입금의 순증가(감소)	(1,340,893)	3,198,153
자기주식의 취득		(875,111)
장기차입금의 차입		3,474
장기차입금의 상환	(513,914)	(270,317)

배당금의 지급	(7,225,202)	(7,748,461)
비지배지분의 증감	576	3,185
외화환산으로 인한 현금의 변동	1,140,365	105,522
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,735,511)	2,542,963
기초의 현금및현금성자산	30,340,505	30,545,130
기말의 현금및현금성자산	26,604,994	33,088,093

3. 연결재무제표 주석

제 51 기 분기: 2019년 9월 30일 현재

제 50 기 : 2018년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항:

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 CE부문, IM부문, DS부문과 Harman부문으로 구성되어 있습니다. CE(Consumer Electronics) 부문은 디지털 TV, 모니터, 에어컨 및 냉장고 등의 사업으로 구성되어 있고, IM(Information technology & Mobile communications) 부문은 휴대폰, 통신시스템, 컴퓨터 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리 반도체, Foundry, System LSI 등의 반도체 사업과 OLED 및 LCD 패널 등의 디스플레이(DP) 사업으로 구성되어 있습니다. Harman부문은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이(주) 및 Samsung Electronics America, Inc.(SEA) 등 246개의 종속기업(주석 1. 나 참조)을 연결대상으로 하고, 삼성전기(주) 등 43개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc.(SEA)	전자제품 판매	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Dacor Holdings, Inc.	Holding Company	100.0
	Dacor, Inc.	가전제품 생산 및 판매	100.0
	Dacor Canada Co.	가전제품 판매	100.0
	EverythingDacor.com, Inc.	가전제품 판매	100.0
	Distinctive Appliances of California, Inc.	가전제품 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈기기 판매	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc.(SHI)	Holding Company	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	Stellus Technologies, Inc.	반도체 시스템 생산 및 판매	100.0
	Prismview, LLC	LED 디스플레이 생산 및 판매	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc.(SSI)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc.(SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0
	Viv Labs, Inc.	인공지능 서비스	100.0
	SigMast Communications Inc.	문자메시지 개발	100.0
	RT SV CO-INVEST, LP	벤처기업 투자	99.9
	Samsung Research America, Inc(SRA)	R&D	100.0
	Samsung Next LLC(SNX)	Holding Company	100.0
	Samsung Next Fund LLC(SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	Samsung International, Inc.(SII)	CTV/모니터 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V.(SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC.(SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.(SEM)	전자제품 판매	100.0
SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.(SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.(SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A.(SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A.(SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A.(SEPA)	컨설팅	100.0
	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.(SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A.(SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada(SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C.(SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services South America S.R.L.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group LLC	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Industries, Inc.	Holding Company	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Investment Group, LLC	Financing Company	100.0
	Harman KG Holding, LLC	Holding Company	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Red Bend Software Inc.	소프트웨어 디자인	100.0	
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4	
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0	
Zhilabs Inc.	네트워크Solution 판매	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd.(SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics(London) Ltd.(SEL)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH(SEHG)	Holding Company	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A.(SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S(SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.(SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.(SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A.(SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.(SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V.(SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Slovakia s.r.o.(SDSK)	DP 임가공	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC(SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o(SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa S.A.(SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag(SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited(SSEL)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH(SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH(SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o(SESK)	CTV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Baltics SIA(SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A(SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.(SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS(SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited(SCSC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Overseas B.V.(SEO)	전자제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	AMX UK Limited	오디오제품 판매	100.0
	Arcam Limited	Holding Company	100.0
	A&R Cambridge Limited	오디오제품 판매	100.0
	Duran Audio B.V.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive UK Limited	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Limited	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	Holding Company	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	Holding Company	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매 등	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Finance International, SCA	Financing Company	100.0
	Harman International s.r.o	오디오제품 생산	100.0
	Harman International SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Management GmbH	Holding Company	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Martin Manufacturing (UK) Ltd	오디오제품 생산	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Professional France SAS	오디오제품 판매	100.0	
Red Bend Software Ltd.	소프트웨어 디자인	100.0	
Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0	
Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC(SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC(SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC(SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP(SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd(SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC(SERK)	CTV 생산	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0
중동 및 아프리카	Samsung Electronics West Africa Ltd.(SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd.(SEEA)	마케팅	100.0
	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.(SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E(SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd.(SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L(SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.(SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.(SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	CTV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Turkey(SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.(SIRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.(SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab(SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Holding Company	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Holding Company	100.0
	iOnRoad Technologies Ltd	R&D	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Towersec Ltd.	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국제외)	Samsung Japan Corporation(SJC)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.(SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.(SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.(SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Medison India Private Ltd.(SMIN)	의료기기 판매	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.(SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.(SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Asia Private Ltd.(SAPL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd.(SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd(SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited(SDN)	DP 생산	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.(SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited(SENZ)	전자제품 판매	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia(STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.(TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd(LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation(SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.(SDV)	DP 생산	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.(SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited(SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.(SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	AMX Products And Solutions Private Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	Holding Company	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0	
Martin Professional Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.(SDD)	DP 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.(SDT)	DP 생산	95.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.(SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.(SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.(SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.(SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung Tianjin Mobile Development Center(SRC-Tianjin)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen(SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.(SESS)	반도체 임가공	100.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.(SEHZ)	전자제품 생산	99.8
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.(TSEC)	CTV/모니터 생산	91.2
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.(SET)	전자제품 판매	100.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center(SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.(TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.(SSS)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.(SESC)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Suzhou Module Co., Ltd.(SSM)	DP 임가공	100.0
	Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.(SSL)	DP 생산	60.0
	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd. (SSET)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.(SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center(SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.(SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.(SSCX)	반도체/DP 판매	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.(TSLED)	LED 생산	100.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0	
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이(주)	DP 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스(주)	DP 부품 생산	50.0
	스테코(주)	반도체 부품 생산	70.0
	세메스(주)	반도체/FPD 장비 생산 및 판매	91.5
	삼성전자서비스(주)	전자제품 수리서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스(주)	서비스 콜센터	100.0
	삼성전자판매(주)	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍(주)	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨(주)	의료기기 생산 및 판매	68.5
	(주)미래로시스템	반도체 S/W	99.9
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 27호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
(주)하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급 등	100.0	
레드벤드소프트웨어코리아(주)	소프트웨어 개발 및 공급	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당분기와 전기의 주요 연결대상 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	당분기말		당분기			
	자산	부채	3 개 월		누 적	
			매출액	분기순이익 (손실)	매출액	분기순이익 (손실)
삼성디스플레이(주)	47,875,269	7,344,995	8,035,292	625,778	19,879,267	564,934
Samsung Electronics America, Inc.(SEA)	36,319,821	15,278,213	9,033,718	452,372	24,665,042	692,979
Harman과 그 종속기업(*2)	16,292,151	6,174,757	2,630,955	123,952	7,337,371	142,830
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.(SCIC)	15,987,555	13,077,459	717,732	336,017	2,431,375	507,143
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.(SEVT)	14,514,163	2,782,728	8,817,188	649,599	26,351,382	1,830,421
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.(SEV)	13,612,377	2,509,191	6,857,328	536,470	17,143,228	1,270,154
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.(SCS)	12,151,097	2,412,706	1,520,006	51,636	4,172,863	422,674
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.(SEEH)	9,742,712	6,889,425	-	895	-	14,842
Samsung Semiconductor, Inc.(SSI)	9,423,475	3,897,118	4,571,950	73,691	11,507,995	137,632
Samsung Asia Private Ltd.(SAPL)	9,289,841	730,763	444,810	65,467	1,221,165	960,304
Samsung Display Vietnam Co., Ltd.(SDV)	9,056,469	6,484,352	5,645,477	431,780	11,811,374	396,993
Samsung India Electronics Private Ltd.(SIEL)	8,888,264	5,302,695	3,754,418	140,075	10,307,015	407,839
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.(SSS)	7,054,017	5,691,794	7,213,053	75,157	19,096,581	163,898
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.(SEDA)	6,814,002	1,618,805	1,814,033	239,304	5,389,017	608,258
Samsung Austin Semiconductor LLC.(SAS)	6,457,580	531,021	977,526	121,406	2,870,091	399,433
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.(TSE)	2,969,872	540,148	930,623	4,080	3,069,113	77,358
Samsung Electronics (UK) Ltd.(SEUK)	2,549,553	1,820,363	3,385,886	103,512	3,385,886	103,512
Samsung Electronics Europe Logistics B.V.(SELS)	2,422,020	1,970,778	3,069,567	177,402	9,056,624	317,114
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.(SEHC)	2,313,311	880,063	1,457,736	193,904	3,938,218	486,448
Samsung Electronics GmbH(SEG)	2,210,992	2,119,585	1,354,564	75,180	3,995,303	36,538
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.(SEH)	2,167,777	459,276	721,195	56,499	1,990,272	121,789
Samsung International, Inc.(SII)	2,113,479	718,074	1,896,101	189,832	4,541,760	525,811
Samsung Electronics Benelux B.V.(SEBN)	2,087,508	853,341	548,505	15,935	1,700,219	34,264
Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.(SSL)	1,864,458	636,411	362,015	1,351	1,090,728	20,822
Samsung Display Dongguan Co., Ltd.(SDD)	1,840,420	411,172	1,037,163	45,586	2,846,484	141,960

(*1) 상기 요약재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	전기말		전분기			
	자산	부채	3 개 월		누 적	
			매출액	분기순이익 (손실)	매출액	분기순이익 (손실)
삼성디스플레이(주)	47,162,963	7,509,766	9,098,839	658,230	20,327,834	599,393
Samsung Electronics America, Inc.(SEA)	30,681,097	11,862,223	8,396,872	329,386	22,482,760	652,532
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.(SCIC)	16,090,629	13,858,532	659,265	12,355	2,670,800	(80,145)
Harman과 그 종속기업(*2)	15,059,925	5,550,558	2,200,810	23,858	6,270,564	(65,258)
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.(SEV)	11,501,682	1,607,991	5,536,378	416,665	17,068,217	1,857,700
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.(SEVT)	11,360,811	2,209,962	7,368,469	473,234	21,189,837	1,915,919
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.(SCS)	10,254,900	1,920,000	1,242,756	465,184	3,589,827	1,177,387
Samsung Semiconductor, Inc.(SSI)	9,306,621	4,288,544	9,068,095	(185,412)	23,518,964	(141,523)
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.(SEEH)	8,586,022	6,388,302	-	1,582	-	12,861
Samsung Display Vietnam Co., Ltd.(SDV)	8,222,472	6,195,635	6,493,238	440,095	13,554,784	853,309
Samsung Asia Private Ltd.(SAPL)	7,630,154	592,916	476,069	37,000	1,289,422	859,239
Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.(SEHZ)	6,539,392	586,349	1,924,159	55,596	7,798,046	308,563
Samsung India Electronics Private Ltd.(SIEL)	6,410,825	3,438,807	3,098,604	59,725	8,675,215	359,617
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.(SEDA)	6,207,458	1,610,607	1,620,386	292,199	5,236,863	620,118
Samsung Austin Semiconductor LLC.(SAS)	5,642,117	511,596	968,094	90,888	2,763,353	253,598
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.(SSS)	5,400,549	4,227,922	9,249,477	71,887	23,421,996	205,341
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.(TSE)	2,465,999	397,248	839,828	(7,659)	3,039,146	121,483
Samsung Electronics (UK) Ltd.(SEUK)	2,203,583	1,588,007	1,162,011	(8,650)	3,520,229	111,436
Samsung Electronics GmbH(SEG)	2,202,610	2,144,728	1,256,428	(176,407)	4,500,725	(214,988)
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.(SEHC)	2,042,669	1,174,936	1,350,121	186,857	3,317,338	421,991
Samsung Electronics Europe Logistics B.V.(SELS)	1,904,358	1,778,710	2,803,147	14,643	9,554,260	341,289
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.(SEH)	1,894,922	280,245	554,611	7,904	1,750,068	90,328
Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.(SSL)	1,845,330	679,207	423,540	18,789	1,215,251	12,107
Samsung Electronics France S.A.S(SEF)	1,761,117	1,412,971	958,871	(3,872)	2,808,631	20,259
Samsung Electronics Benelux B.V.(SEBN)	1,673,470	552,994	486,101	(10,566)	1,628,708	9,509

(*1) 상기 요약재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

라. 연결대상범위의 변동

(1) 당분기 중 연결채무제표 작성대상 범위에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

지역	기업명	변동내역
유럽	Samsung France Research Center SARL(SFRC)	청산
	Innoetics E.P.E.	합병(*1)
중동	Broadsense Ltd.	청산
	iOnRoad Ltd	청산
아시아	Harman Connected Services Japan Co., Ltd.	합병(*2)
	Harman International Singapore Pte. Ltd.	합병(*3)
	Red Bend Software Japan Co., Ltd.	합병(*4)
	Studer Japan Ltd.	합병(*5)
중국	Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited(SBSC)	합병(*6)
	Harman Connected Services Solutions (Beijing) Co., Ltd.	청산

(*1) 연결회사의 종속기업 Samsung Electronics Greece S.M.S.A(SEGR)는 당분기 중 종속기업 Innoetics E.P.E.를 흡수합병하였습니다.

(*2) 연결회사의 종속기업 Harman International Japan Co., Ltd.는 당분기 중 종속기업 Harman Connected Services Japan Co., Ltd.를 흡수합병하였습니다.

(*3) 연결회사의 종속기업 Harman Singapore Pte. Ltd.는 당분기 중 종속기업 Harman International Singapore Pte. Ltd.를 흡수합병하였습니다.

(*4) 연결회사의 종속기업 Harman International Japan Co., Ltd.는 당분기 중 종속기업 Red Bend Software Japan Co., Ltd.를 흡수합병하였습니다.

(*5) 연결회사의 종속기업 Harman International Japan Co., Ltd.는 당분기 중 종속기업 Studer Japan Ltd.를 흡수합병하였습니다.

(*6) 연결회사의 종속기업 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd(SCIC)는 당분기 중 종속기업 Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited(SBSC)를 흡수합병하였습니다.

(2) 당분기 중 연결채무제표 작성대상 범위에 포함된 종속기업은 다음과 같습니다.

지역	기업명	변동내역
유럽	FOODIENT LTD.	인수
중동	Corephotonics Ltd.	인수
아시아	Samsung Display Noida Private Limited(SDN)	설립
국내	SVIC 45호 신기술투자조합	설립

2. 중요한 회계처리방침:

2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2019년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2019년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제·개정 기준서

연결회사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

연결회사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1116호 '리스'를 적용하였습니다. 기준서 제1116호의 경과규정에 따라 비교표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기준서 제1109호의 적용대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정

제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리가 과세당국에 의해 인정될지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리 불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표되었으나 2019년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않아, 연결회사가 조기적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 없습니다.

2.2. 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

가. 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

나. 리스

리스는 리스제공자가 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 동안 리스이용자에게 이전하는 계약입니다.

연결회사는 계약의 약정시점에, 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. 다만, 연결회사는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 실무적 간편법을 적용하여 모든 계약에 대해 다시 판단하지 않았습니다.

리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하 '비리스요소'라고 함)와 분리하여 리스로 회계처리합니다. 다만, 연결회사는 리스이용자로서의 회계처리에서 실무적 간편법을 적용하여 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리합니다.

(1) 리스이용자로서의 회계처리

연결회사는 리스개시일에 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다.

사용권자산은 최초 인식 시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상 차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 또한 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다. 사용권자산은 재무상태표에 '유형자산'으로 분류합니다.

리스부채는 리스개시일에 그날 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재 가치 측정시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 회사의 증분차입이자율로 리스료를 할인하고 있습니다. 리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보중에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다. 리스부채는 재무상태표에 '유동성장기부채' 또는 '장기차입금'으로 분류합니다.

단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산(예: 기초자산 US\$5,000 이하) 리스의 경우 예외규정을 선택하여 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.

(2) 리스제공자로서의 회계처리

리스제공자의 회계처리는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책과 유의적으로 변동되지 않았습니다.

연결회사는 리스약정일에 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하고, 금융리스 이외의 모든 리스는 운용리스로 분류합니다. 운용리스로부터 발생하는 리스료 수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식하고, 운용리스의 협상 및 계약단계에서 발생한 리스개설 직접원가는 리스자산의 장부금액에 가산한 후 리스료 수익에 대응하여 리스기간 동안 비용으로 인식합니다.

2.3. 회계정책의 변경

가. 기준서 제1116호 '리스' 의 적용

연결회사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1116호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

최초적용일인 2019년 1월 1일 현재 사용권자산 및 리스부채는 각각 2,774,982백만원, 2,344,756백만원 증가하였으며, 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	금 액
1. 2018년 12월 31일의 금융리스부채	61,189
2. 2019년 1월 1일의 운용리스 약정 조정내역	2,344,756
- 2018년 12월 31일의 운용리스 약정	2,785,140
- 2019년 1월 1일의 운용리스 약정 할인금액	2,528,731
(조정) 단기리스 및 소액자산리스 예외규정 적용	(183,975)
3. 2019년 1월 1일의 리스부채	2,405,945

2.4. 중요한 회계추정 및 가정

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 기준서 제1116호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품:

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	26,604,994	-	-	-	26,604,994
단기금융상품	69,476,971	-	-	-	69,476,971
매출채권	40,367,204	-	-	-	40,367,204
상각후원가금융자산	4,156,542	-	-	-	4,156,542
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	8,728,038	-	-	8,728,038
당기손익-공정가치금융자산	-	-	2,805,500	-	2,805,500
기타	9,716,944	-	214,594	35,178	9,966,716
계	150,322,655	8,728,038	3,020,094	35,178	162,105,965

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	11,422,269	-	-	11,422,269
단기차입금	2,208,002	-	10,122,246	12,330,248
미지급금	8,630,882	-	-	8,630,882
유동성장기부채	40,667	-	751,800	792,467
사채	1,008,058	-	-	1,008,058
장기차입금	-	-	2,002,565	2,002,565
장기미지급금	2,057,513	2,403	-	2,059,916
기타	8,818,522	176,073	7,204	9,001,799
계	34,185,913	178,476	12,883,815	47,248,204

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	30,340,505	-	-	-	30,340,505
단기금융상품	65,893,797	-	-	-	65,893,797
매출채권	33,867,733	-	-	-	33,867,733
상각후원가금융자산	2,942,002	-	-	-	2,942,002
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	7,301,351	-	-	7,301,351
당기손익-공정가치금융자산	-	-	2,777,375	-	2,777,375
기타	9,229,044	-	58,127	25,962	9,313,133
계	142,273,081	7,301,351	2,835,502	25,962	152,435,896

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	8,479,916	-	-	8,479,916
단기차입금	1,456,201	-	12,130,459	13,586,660
미지급금	9,779,287	-	-	9,779,287
유동성장기부채	33,386	-	-	33,386
사채	961,972	-	-	961,972
장기차입금	85,085	-	-	85,085
장기미지급금	2,846,585	13,417	-	2,860,002
기타	8,789,800	32,284	10,439	8,832,523
계	32,432,232	45,701	12,140,898	44,618,831

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
비유동항목		
지분상품	8,728,038	7,301,351

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
유동항목		
채무상품	1,842,611	2,001,948
비유동항목		
지분상품	668,198	453,642
채무상품	294,691	321,785
소 계	962,889	775,427
합 계	2,805,500	2,777,375

나. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

기업명	당분기말			전기말	
	보유주식수(주)	지분율(%)(*)	취득원가	장부금액 (시장가치)	장부금액 (시장가치)
삼성중공업(주)	100,693,398	16.0	735,488	793,464	746,138
(주)호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	172,807	153,361
(주)아이마켓코리아	647,320	1.8	324	6,732	4,479
(주)에스에프에이	3,644,000	10.2	38,262	153,777	126,082
(주)원익홀딩스	3,518,342	4.6	30,821	14,883	12,349
(주)원익아이피에스	3,701,872	7.5	32,428	106,984	74,408
ASML	6,297,787	1.5	363,012	1,881,476	1,104,944
Wacom	8,398,400	5.0	62,013	32,827	38,795
BYD	52,264,808	1.9	528,665	429,638	433,838
기타			296,744	384,377	200,363
계			2,101,714	3,976,965	2,894,757

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가총당금	장부금액	평가전금액	평가총당금	장부금액
제품 및 상품	9,861,373	(582,082)	9,279,291	9,206,754	(370,656)	8,836,098
반제품 및 재공품	11,812,131	(574,944)	11,237,187	11,862,033	(795,522)	11,066,511
원재료 및 저장품	9,558,883	(519,477)	9,039,406	8,658,212	(610,073)	8,048,139
미착품	1,352,878	-	1,352,878	1,033,956	-	1,033,956
계	32,585,265	(1,676,503)	30,908,762	30,760,955	(1,776,251)	28,984,704

6. 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	7,313,206	6,802,351
취득	9,822	17,564
처분	(1,437)	(148)
이익 중 지분해당액	252,672	289,126
기타(*)	(37,328)	(103,549)
분기말장부금액	7,536,935	7,005,344

(*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 및 회계변경누적효과 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스(주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합/관리업 등 IT서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스(주)	신사업 투자	31.5	한국	12월
삼성SDI(주)(*2)	2차전지 등 전자제품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

기업명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성전기(주)	359,237	1,255,573	1,166,990	359,237	1,127,805	1,126,043
삼성에스디에스(주)	147,963	1,440,776	1,466,321	147,963	1,350,838	1,376,321
삼성바이오로직스(주)	443,193	1,306,208	1,309,744	443,193	1,308,650	1,308,546
삼성SDI(주)	1,242,605	2,502,035	2,242,342	1,242,605	2,402,697	2,197,335
(주)제일기획	506,162	264,433	563,215	506,162	253,062	549,165
기타	598,143	354,189	540,864	625,922	310,909	525,259
계	3,297,303	7,123,214	7,289,476	3,325,082	6,753,961	7,082,669

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위 : 백만원)

기업명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성코닝어드밴스드글라스	215,000	176,444	176,440	215,000	173,503	173,499
기타	259,994	67,139	71,019	259,994	65,443	57,038
계	474,994	243,583	247,459	474,994	238,946	230,537

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당분기와 전분기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	1,126,043	38,783	19,857	(17,693)	1,166,990
삼성에스디에스(주)	1,376,321	109,365	15,579	(34,944)	1,466,321
삼성바이오로직스(주)	1,308,546	(2,949)	4,147	-	1,309,744
삼성SDI(주)	2,197,335	45,703	12,767	(13,463)	2,242,342
(주)제일기획	549,165	31,628	4,781	(22,359)	563,215
삼성코닝어드밴스드글라스	173,499	2,941	-	-	176,440
기타	582,297	27,201	42,604	(40,219)	611,883
계	7,313,206	252,672	99,735	(128,678)	7,536,935

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	991,579	112,816	4,749	(13,988)	1,095,156
삼성에스디에스(주)	1,282,205	103,254	(1,637)	(34,945)	1,348,877
삼성바이오로직스(주)	1,254,937	(29,566)	390	(43,839)	1,181,922
삼성SDI(주)	2,126,244	48,443	17,073	(13,463)	2,178,297
(주)제일기획	540,114	27,657	1,846	(22,068)	547,549
삼성코닝어드밴스드글라스	170,425	1,290	-	-	171,715
기타	436,847	25,232	9,363	10,386	481,828
계	6,802,351	289,126	31,784	(117,917)	7,005,344

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 및 회계변경누적효과 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보

(1) 주요 관계기업의 요약 재무정보 및 관계기업으로부터 수령한 배당금은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위 : 백만원)

구 분	삼성전기(주)	삼성에스디에스(주)	삼성바이오로직스(주)	삼성SDI(주)	(주)제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(당분기말):					
유동자산	3,947,615	6,361,969	1,338,602	5,142,641	1,810,733
비유동자산	5,135,761	2,625,255	4,446,455	14,594,355	514,312
유동부채	2,205,323	1,775,399	716,316	3,388,138	1,169,128
비유동부채	1,365,032	656,014	921,371	3,593,237	224,113
비지배지분	145,803	175,049	-	328,190	9,515
요약 포괄손익계산서(당분기):					
매출	6,354,143	7,936,935	388,265	7,276,507	2,518,194
계속영업손익(*)	338,039	484,014	(7,718)	435,469	101,685
중단영업손익(*)	198,880	-	-	-	-
기타포괄손익(*)	85,820	69,509	(380)	196,917	14,724
총포괄손익(*)	622,739	553,523	(8,098)	632,386	116,409
II. 배당(당분기)					
배당	17,693	34,944	-	13,463	22,359

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

2) 전기

(단위 : 백만원)

구 분	삼성전기(주)	삼성에스디에스(주)	삼성바이오로직스(주)	삼성SDI(주)	주제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(전기말):					
유동자산	3,525,293	5,881,776	1,577,684	5,519,342	1,889,015
비유동자산	5,119,621	2,132,073	4,402,725	13,830,379	378,586
유동부채	2,509,584	1,574,797	710,530	4,012,822	1,251,332
비유동부채	1,188,833	290,501	1,114,410	3,111,680	123,476
비지배지분	125,450	166,097	-	291,196	10,164
요약 포괄손익계산서(전분기):					
매출	6,194,843	7,252,142	357,532	6,679,626	2,591,403
계속영업손익(*)	470,854	456,676	(96,945)	446,864	96,072
기타포괄손익(*)	930	1,331	1,082	121,490	(5,463)
총포괄손익(*)	471,784	458,007	(95,863)	568,354	90,609
II. 배당(전분기)					
배당	13,270	34,944	-	13,463	22,069

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업의 요약 재무정보 및 공동기업으로부터 수령한 배당금은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스	
	당분기	전기
I. 요약 재무정보		
요약 재무상태표:		
유동자산	170,205	145,733
- 현금및현금성자산	8,963	19,047
비유동자산	225,099	234,666
유동부채	38,463	33,393
- 금융부채(*1)	19,891	17,710
비유동부채	3,954	-
요약 포괄손익계산서(*2):		
매출	189,245	177,017
감가상각비 및 무형자산상각비	442	981
이자수익	452	311
법인세비용	767	135
계속영업손익	5,882	2,558
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	5,882	2,558
II. 배당		
배당	-	-

(*1) 매입채무, 기타채무 및 총당부채가 제외된 금액입니다.

(*2) 분기 9개월 기준 금액입니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
분기순손익	26,298	903	24,197	1,035
기타포괄손익	30,378	12,226	6,668	2,695
총포괄손익	56,676	13,129	30,865	3,730

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당분기말		전기말
	주식수	시장가치	시장가치
삼성전기(주)	17,693,084	1,822,388	1,831,234
삼성에스디에스(주)	17,472,110	3,328,437	3,564,310
삼성바이오로직스(주)	20,836,832	6,407,326	8,053,436
삼성SDI(주)	13,462,673	3,002,176	2,948,325
(주)제일기획	29,038,075	720,144	653,357

사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스(주)가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스(주) 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주식 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치(1차처분)를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(2차처분)를 2018년 11월 14일 의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스(주)는 위 처분의 취소를 구하는 소송을 서울행정법원에 제기하며 처분의 효력정지를 신청하였고, 법원은 2019년 1월 22일(2차처분)과 2019년 2월 19일(1차처분)에 본안 소송의 판결 시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시항고 하였으며, 법원은 2019년 5월 13일(2차처분), 2019년 5월 24일(1차처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차처분), 2019년 6월 10일(1차처분)에 대해 재항고하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차처분), 2019년 10월 11일(1차처분) 재항고를 기각하였습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스(주)가 삼성바이오에피스(주) 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년과 그 이후 기간 지분법평가손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스(주)와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 당사의 당기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

7. 유형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초순장부금액	115,416,724	111,665,648
일반취득 및 자본적지출	17,675,362	22,294,169
사업결합으로 인한 취득	399,324	-
감가상각	(20,026,883)	(18,569,050)
처분/폐기/손상/환입	(643,153)	(364,172)
기타(*)	4,034,197	(23,447)
분기말순장부금액	116,855,571	115,003,148

(*) 기타는 회계변경누적효과, 환율변동에 의한 증감액 및 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	17,830,935	16,910,212
판매비와관리비 등	2,195,948	1,658,838
계	20,026,883	18,569,050

다. 당분기말 현재 사용권자산은 3,087,494백만원(당기초: 2,774,982백만원)입니다. 또한 당분기 중 신규 발생한 사용권자산은 866,567백만원이며, 사용권자산의 감가상각비는 541,379백만원입니다.

8. 무형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	14,891,598	14,760,483
내부개발에 의한 취득	285,699	229,153
개별 취득	543,362	447,459
사업결합으로 인한 취득	574,186	-
상각	(826,921)	(1,020,676)
처분/폐기/손상/환입	(39,137)	(29,131)
기타(*)	276,887	412,808
분기말장부금액	15,705,674	14,800,096

(*) 기타는 회계변경누적효과, 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	307,968	519,921
판매비와관리비 등	518,953	500,755
계	826,921	1,020,676

9. 차입금:

보고기간종료일 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당분기말	당분기말	전기말(*3)
(1) 단기차입금				
담보부차입금(*1)	우리은행 외	0.0 ~ 9.2	10,122,246	12,130,459
무담보차입금	씨티은행 외	0.0 ~ 6.2	2,208,002	1,456,201
계			12,330,248	13,586,660
(2) 유동성장기차입금				
은행차입금	신한은행 외	3.2 ~ 3.5	34,800	16,880
리스부채(*2)	CSSD 외	4.0	751,800	11,067
계			786,600	27,947
(3) 장기차입금				
은행차입금	신한은행 외	-	-	34,963
리스부채(*2)	CSSD 외	4.0	2,002,565	50,122
계			2,002,565	85,085

(*1) 담보부차입금에 대해서는 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다.

(*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균 증분차입이자율이며 당분기 중 발생한 이자비용은 76,891백만원입니다. 또한 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

(*3) 전기말 리스부채는 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채입니다(주석2 참조).

10. 사채:

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds(*1)	1997.10.02	2027.10.01	7.7	54,059 (US\$45,000천)	50,315 (US\$45,000천)
US\$ denominated Debenture Bonds(*2)	2015.05.06	2025.05.15	4.2	480,520 (US\$400,000천)	447,240 (US\$400,000천)
EURO€ denominated Debenture Bonds(*3)	2015.05.20	2022.05.27	2.0	460,127 (EUR€350,000천)	447,352 (EUR€350,000천)
1년 이내 만기도래분(유동성사채)				(6,007)	(5,591)
사채할인발행차금				(1,113)	(1,208)
사채할증발행차금				20,472	23,864
계				1,008,058	961,972

(*1) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(*2) 종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며, 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(*3) 종속기업 Harman Finance International, SCA에서 발행하였고, 7년 만기 일시상환되며, 이자는 1년마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)와 관련하여 연결재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	9,144,210	8,443,465
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	280,703	250,577
소계	9,424,913	8,694,042
사외적립자산의 공정가치	(8,730,334)	(8,752,334)
순확정급여부채(자산) 계	694,579	(58,292)

나. 당분기 및 전분기 중 연결손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	690,078	613,729
순이자원가(수익)	(1,698)	(16,385)
과거근무원가	937	-
기타	1,580	8,914
계	690,897	606,258

다. 당분기 및 전분기 중 연결손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	312,894	250,413
판매비와관리비 등	378,003	355,845
계	690,897	606,258

12. 총당부채:

당분기 중 총당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	상여총당부채 (라)	기타총당부채 (마),(바)	계
기초	1,873,869	1,134,379	777,073	-	1,262,336	5,047,657
순전입액	1,019,793	222,263	213,257	2,871,367	500,293	4,826,973
사용액	(1,133,957)	(518,499)	(270,580)	(514,002)	(588,014)	(3,025,052)
기타(*)	70,932	40,762	10,195	292,154	(2,868)	411,175
당분기말	1,830,637	878,905	729,945	2,649,519	1,171,747	7,260,753

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 임직원을 대상으로 당 회계연도의 경영실적에 따라 상여를 지급하고 있는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분은 총당부채로 계상하고 있습니다.

마. 연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.

바. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 당분기말 현재 무상할당 배출권 및 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤)

구 분	당분기말
무상할당 배출권	1,442
배출량 추정치	1,698

(2) 당분기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기
기초	31,647
증가	2,652
당분기말	34,299

(3) 당분기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기
기초	99,960
순전입(환입)액	(86,173)
사용액	-
당분기말	13,787

13. 우발부채와 약정사항:

가. 지급보증한 내역

보고기간종료일 현재 연결회사가 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

내역	당분기말	전기말
임대주택 관련 채무보증	-	32,511

나. 소송 등

(1) 보고기간종료일 현재 TFT-LCD 판매에 대한 가격담합과 관련된 일부 해외구매자들로부터의 민사상 손해배상청구 등을 포함하여, 연결회사의 사업과 관련하여 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(2) 이외에도 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

14. 계약부채:

연결회사가 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
계약부채(*)	8,595,591	9,021,400

(*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 25,000,000,000주 (1주의 금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(소각 주식수 제외)는 각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원 및 우선주 82,289백만원)으로 납입자본금(897,514백만원)과 상이합니다.

16. 연결이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
임의적립금 등	167,791,608	151,519,651
연결미처분이익잉여금	83,969,740	91,179,305
계	251,761,348	242,698,956

나. 회사는 2019년 4월 30일, 7월 31일, 10월 31일 이사회결의에 의거 2019년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일을 배당기준일로 하여 분기배당을 지급하기로 하였으며, 당분기와 전분기의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		당분기	전분기	
1분기	배당받을 주식(*)	보통주	5,969,782,550주	119,395,651주
		우선주	822,886,700주	16,457,734주
	배당률(액면가 기준)	354%	354%	
	배당금액	보통주	2,113,303	2,113,303
		우선주	291,302	291,302
		계	2,404,605	2,404,605
2분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	354%	354%	
	배당금액	보통주	2,113,303	2,113,303
		우선주	291,302	291,302
		계	2,404,605	2,404,605
3분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	354%	354%	
	배당금액	보통주	2,113,303	2,113,303
		우선주	291,302	291,302
		계	2,404,605	2,404,605

(*) 전기 중 주식분할로 인해 주식수가 변경되었습니다.

17. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	2,396,720	1,462,266
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	54,495	(44,212)
해외사업장환산외환차이	(3,314,493)	(8,612,742)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(866,394)	(796,563)
기타	70,367	59,881
계	(1,659,305)	(7,931,370)

18. 비용의 성격별 분류:

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
제품 및 재공품 등의 변동	606,907	(613,869)	(739,625)	(3,632,439)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	23,816,523	62,750,710	20,440,504	58,245,296
급여	5,639,703	17,568,331	5,500,229	16,459,120
퇴직급여	274,643	828,596	237,477	705,644
감가상각비	6,545,815	20,026,883	6,481,244	18,569,050
무형자산상각비	321,745	826,921	342,615	1,020,676
복리후생비	1,059,511	3,406,159	988,504	3,098,028
유틸리티비	1,163,615	3,332,694	1,144,868	3,223,873
외주용역비	1,378,003	3,805,121	1,187,553	3,607,953
광고선전비	1,111,059	3,189,703	880,905	2,816,358
판매촉진비	1,786,359	5,221,738	1,806,935	5,265,512
기타비용	10,521,696	29,564,895	9,613,919	27,041,224
계(*)	54,225,579	149,907,882	47,885,128	136,420,295

(*) 연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비:

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 판매비와관리비				
급여	1,544,149	4,724,247	1,503,110	4,590,355
퇴직급여	67,649	202,859	68,139	196,520
지급수수료	1,498,492	4,099,730	1,501,583	4,150,720
감가상각비	397,765	1,172,150	256,003	754,808
무형자산상각비	111,781	325,532	112,888	327,550
광고선전비	1,111,059	3,189,703	880,905	2,816,358
판매촉진비	1,786,359	5,221,738	1,806,935	5,265,512
운반비	508,596	1,541,367	618,347	1,800,729
서비스비	698,379	2,086,205	522,088	2,000,507
기타판매비와관리비	1,374,446	3,671,311	900,773	3,025,200
소계	9,098,675	26,234,842	8,170,771	24,928,259
(2) 경상연구개발비				
연구개발 총지출액	5,158,670	15,273,713	4,559,674	13,342,762
개발비 자산화	(25,656)	(285,699)	(39,675)	(229,153)
소계	5,133,014	14,988,014	4,519,999	13,113,609
계	14,231,689	41,222,856	12,690,770	38,041,868

20. 기타수익 및 기타비용:

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 기타수익				
배당금수익	31,448	116,091	27,655	102,619
임대료수익	40,171	115,560	34,468	106,358
투자자산처분이익	14,331	39,387	5,886	16,623
유형자산처분이익	55,256	223,067	25,312	272,452
기타	355,787	684,829	83,291	417,124
계	496,993	1,178,934	176,612	915,176
(2) 기타비용				
유형자산처분손실	25,332	103,079	11,409	59,334
기부금	87,035	287,221	81,428	219,626
기타	192,778	484,859	59,517	341,066
계	305,145	875,159	152,354	620,026

21. 금융수익 및 금융비용:

가. 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 금융수익				
이자수익	682,799	2,017,109	616,374	1,627,133
- 상각후원가 측정 금융자산	682,781	2,016,852	616,294	1,626,915
- 당기손익-공정가치 측정 금융자산	18	257	80	218
외환차이	1,855,968	5,233,810	1,748,308	5,475,023
파생상품관련이익	257,605	613,572	136,471	801,257
계	2,796,372	7,864,491	2,501,153	7,903,413
(2) 금융비용				
이자비용	172,293	526,973	189,639	482,245
- 상각후원가 측정 금융부채	66,203	204,118	69,850	207,214
- 기타금융부채	106,090	322,855	119,789	275,031
외환차이	1,923,416	5,261,960	1,866,097	5,930,362
파생상품관련손실	160,174	527,174	193,651	609,065
계	2,255,883	6,316,107	2,249,387	7,021,672

나. 연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용:

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 27.3%입니다.

23. 주당이익:

가. 기본주당이익

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	6,105,039	16,277,059	12,967,428	35,560,808
분기순이익 중 보통주 해당분	5,365,454	14,305,202	11,396,510	31,252,853
÷가중평균유통보통주식수	5,969,783	5,969,783	5,969,783	5,970,672
기본 보통주 주당이익(단위 : 원)	899	2,396	1,909	5,234

(2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	6,105,039	16,277,059	12,967,428	35,560,808
분기순이익 중 우선주 해당분	739,585	1,971,857	1,570,918	4,307,955
÷가중평균유통우선주식수	822,887	822,887	822,887	823,094
기본 우선주 주당이익(단위 : 원)	899	2,396	1,909	5,234

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표:

가. 당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정내역

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용	6,201,245	13,669,416
금융수익	(3,150,812)	(2,922,912)
금융비용	1,773,458	1,995,250
퇴직급여	828,596	705,644
감가상각비	20,026,883	18,569,050
무형자산상각비	826,921	1,020,676
대손상각비(환입)	(205,711)	46,742
배당금수익	(116,091)	(102,619)
지분법이익	(252,672)	(289,126)
유형자산처분이익	(223,067)	(272,452)
유형자산처분손실	103,079	59,334
재고자산평가손실 등	708,114	1,569,403
투자자산처분이익	(39,387)	(16,623)
기타	(82,146)	105,531
계	26,398,410	34,137,314

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 감소(증가)	(2,435,271)	(5,409,393)
미수금의 감소(증가)	(52,847)	858,372
선급금의 감소(증가)	(179,428)	47,854
장단기선급비용의 감소(증가)	307,985	(221,570)
재고자산의 감소(증가)	(1,542,096)	(4,960,503)
매입채무의 증가(감소)	869,972	1,189,019
장단기미지급금의 증가(감소)	(1,298,315)	(3,350,738)
선수금의 증가(감소)	201,201	(126,106)
예수금의 증가(감소)	(136,253)	33,325
미지급비용의 증가(감소)	(3,756,007)	(3,989,982)
총당부채의 증가(감소)	1,801,921	2,161,806
퇴직금의 지급	(265,132)	(271,804)
기타	(987,477)	(2,231,773)
계	(7,471,747)	(16,271,493)

나. 당분기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 494,828백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 76,891백만원입니다.

25. 재무위험관리:

연결회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 특정 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

해외 주요 권역 별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)를 운영하여 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

연결회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 각 개별회사의 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다.

연결회사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래 발생시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.

연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 헷지 목적 이외의 외환거래는 금지하고 있습니다.

(2) 추가변동위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당분기 및 전기 포괄손익(법인세효과 반영 전)의 변동금액은 각각 39,770백만원 및 28,947백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

연결회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 변동위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 연결회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 이상징후 발견 시 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요 시 지역 금융센터 및 연결회사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 연결회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한 유동성위험에 대비하여 연결회사는 무역금융 등의 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 연결회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 연결재무제표 상 금액을 기준으로 계산합니다.

연결회사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고 있습니다.

보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	89,943,741	91,604,067
자 본	263,442,244	247,753,177
부채비율	34.1%	37.0%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	26,604,994	(*1)	30,340,505	(*1)
단기금융상품	69,476,971	(*1)	65,893,797	(*1)
단기상각후원가금융자산	4,021,901	(*1)	2,703,693	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	1,842,611	1,842,611	2,001,948	2,001,948
매출채권	40,367,204	(*1)	33,867,733	(*1)
상각후원가금융자산	134,641	(*1)	238,309	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	8,728,038	8,728,038	7,301,351	7,301,351
당기손익-공정가치금융자산	962,889	962,889	775,427	775,427
기타(*2)	9,966,716	249,772	9,313,133	84,089
소 계	162,105,965		152,435,896	
금융부채				
매입채무	11,422,269	(*1)	8,479,916	(*1)
단기차입금	12,330,248	(*1)	13,586,660	(*1)
미지급금	8,630,882	(*1)	9,779,287	(*1)
유동성장기부채(*3)	792,467	(*1)	33,386	(*1)
사채	1,008,058	1,059,938	961,972	964,182
장기차입금(*3)	2,002,565	(*1)	85,085	(*1)
장기미지급금(*2)	2,059,916	2,403	2,860,002	13,417
기타(*2)	9,001,799	183,277	8,832,523	42,723
소 계	47,248,204		44,618,831	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 9,716,944백만원(전기: 9,229,044 백만원)

및 금융부채 10,876,035백만원(전기: 11,636,385백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다

(*3) 유동성장기부채와 장기차입금 중 리스부채는 기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외 하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	3,829,183	-	4,898,855	8,728,038
당기손익-공정가치금융자산	147,782	25,954	2,631,764	2,805,500
기타	-	249,772	-	249,772
금융부채				
사채	-	1,059,938	-	1,059,938
장기미지급금	-	-	2,403	2,403
기타	-	183,277	-	183,277

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,884,633	-	4,416,718	7,301,351
당기손익-공정가치금융자산	10,124	18,503	2,748,747	2,777,375
기타	-	84,089	-	84,089
금융부채				
사채	-	964,182	-	964,182
장기미지급금	-	-	13,417	13,417
기타	-	41,639	1,085	42,723

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- 수준 2: 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)
- 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

연결회사는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 수준 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 수준 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열 체계에서 수준 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	수준 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산				
(주)말타니	10,923	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0%)
			가중평균자본비용	8.8%~10.8%(9.8%)
삼성벤처투자(주)	7,720	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0%)
			가중평균자본비용	17.5%~19.5%(18.5%)
Corning Incorporated 전환우선주	4,058,926	삼항모형	위험 할인율	4.3%~6.3%(5.3%)
			가격 변동성	22.3%~28.3%(25.3%)
장기미지급금				
조건부금융부채	2,403	확률가중모형	확률적용률	50.0%

(4) 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	7,165,466	3,652,574
매입	3,142,151	247,848
매도	(3,277,968)	(59,039)
평가(당기손익)	25,104	14,064
평가(기타포괄손익)	384,555	335,396
기타(*)	91,311	1,176,132
분기말	7,530,619	5,366,975

(*) 기타는 회계변경누적효과 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	당분기	전분기
기초	14,502	351,918
결제	(1,127)	(322,920)
평가(당기손익)	(11,617)	5,992
기타	644	862
분기말	2,403	35,852

(5) 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*)	-	167,762	-	(126,446)

(*) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0% ~ 1.0%)과 변동성(22.3% ~ 28.3%) 및 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

26. 부문별 보고:

가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 영업이익의 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 CE, IM, 반도체, DP, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

구 분	CE	IM	DS			Harman	계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP				
매출액	73,747,318	172,577,905	140,717,615	90,372,358	48,464,722	8,601,962	397,685,677	(227,169,556)	170,516,121
내부매출액	(41,703,689)	(90,263,064)	(69,935,003)	(42,225,147)	(25,456,470)	(1,258,090)	(227,169,556)	227,169,556	-
순매출액(*2)	32,043,629	82,314,841	70,782,612	48,147,211	23,008,252	7,343,872	170,516,121	-	170,516,121
감가상각비	399,274	923,822	17,790,165	12,842,033	4,922,067	249,594	20,026,883	-	20,026,883
무형자산상각비	25,044	76,592	415,722	332,651	77,747	171,518	826,921	-	826,921
영업이익	1,801,278	6,752,053	11,925,026	10,569,544	1,361,650	199,127	20,608,239	-	20,608,239

(*1) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

(2) 당3분기

(단위 : 백만원)

구 분	CE	IM	DS			Harman	합계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP				
매출액	26,043,844	60,460,589	54,079,039	33,508,048	19,920,646	3,051,745	144,311,780	(82,308,309)	62,003,471
내부매출액	(15,109,080)	(31,206,495)	(27,443,094)	(15,920,936)	(10,658,383)	(420,512)	(82,308,309)	82,308,309	-
순매출액(*2)	10,934,764	29,254,094	26,635,945	17,587,112	9,262,263	2,631,233	62,003,471	-	62,003,471
감가상각비	132,025	305,284	5,773,945	4,138,141	1,627,925	88,150	6,545,815	-	6,545,815
무형자산상각비	8,325	25,633	184,491	157,554	25,172	58,956	321,745	-	321,745
영업이익	547,926	2,916,796	4,241,916	3,048,905	1,174,205	98,756	7,777,892	-	7,777,892

(*1) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

(3) 전분기

(단위 : 백만원)

구 분	CE	IM	DS			Harman	합계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP				
매출액	69,020,638	165,178,323	183,721,916	130,205,866	49,961,288	7,912,289	427,436,384	(242,930,019)	184,506,365
내부매출액	(38,699,109)	(87,820,191)	(92,916,865)	(62,662,375)	(26,670,515)	(1,620,241)	(242,930,019)	242,930,019	-
순매출액(*2)	30,321,529	77,358,132	90,805,051	67,543,491	23,290,773	6,292,048	184,506,365	-	184,506,365
감가상각비	407,032	871,145	16,846,472	11,926,478	4,831,653	171,811	18,569,050	-	18,569,050
무형자산상각비	28,716	97,003	574,783	477,175	87,269	166,860	1,020,676	-	1,020,676
영업이익	1,347,200	8,660,035	38,018,029	36,806,613	1,644,879	89,203	48,086,070	-	48,086,070

(*1) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

(4) 전3분기

(단위 : 백만원)

구 분	CE	IM	DS			Harman	합계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP				
매출액	24,653,460	54,437,539	70,658,901	47,900,414	21,769,702	2,686,602	153,076,001	(87,616,008)	65,459,993
내부매출액	(14,474,699)	(29,524,922)	(35,897,414)	(23,132,303)	(11,681,500)	(469,892)	(87,616,008)	87,616,008	-
순매출액(*2)	10,178,761	24,912,617	34,761,487	24,768,111	10,088,202	2,216,710	65,459,993	-	65,459,993
감가상각비	134,773	295,022	5,903,203	4,294,502	1,584,411	57,107	6,481,244	-	6,481,244
무형자산상각비	9,213	30,713	192,551	161,671	27,431	58,184	342,615	-	342,615
영업이익	558,986	2,221,241	14,564,055	13,650,341	1,101,089	80,978	17,574,865	-	17,574,865

(*1) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

나. 지역별 정보

당분기와 전분기의 지역별 영업현황(소재지 기준)은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	26,636,899	53,407,531	30,810,616	32,434,060	27,227,015	-	170,516,121
비유동자산(*)	92,909,605	10,766,839	6,609,862	11,833,968	10,785,955	(344,984)	132,561,245

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(2) 당3분기

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	10,422,240	19,689,111	10,766,389	11,084,404	10,041,327	-	62,003,471
비유동자산(*)	92,909,605	10,766,839	6,609,862	11,833,968	10,785,955	(344,984)	132,561,245

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(3) 전분기

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	24,737,974	61,234,078	31,721,437	32,836,589	33,976,287	-	184,506,365
비유동자산(*)	93,699,847	10,055,368	6,070,517	11,846,848	8,784,903	(654,239)	129,803,244

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(4) 전3분기

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	9,950,388	22,471,989	10,188,062	10,438,224	12,411,330	-	65,459,993
비유동자산(*)	93,699,847	10,055,368	6,070,517	11,846,848	8,784,903	(654,239)	129,803,244

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

27. 특수관계자와의 거래:

가. 매출·매입 등 거래 내역

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	63,288	-	1,581,365	301,686
	삼성전기(주)	44,358	-	1,767,700	16
	삼성SDI(주)	78,506	16,106	465,086	67,407
	(주)제일기획	24,801	-	622,250	958
	기타	720,805	2	7,904,289	192,211
	관계기업 및 공동기업 계	931,758	16,108	12,340,690	562,278
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	104,184	-	287,592	3,192,970
	기타	149,012	-	828,046	480,637
	그 밖의 특수관계자 계	253,196	-	1,115,638	3,673,607
기타(*2)	삼성엔지니어링(주)	3,784	-	43,689	1,203,663
	(주)에스원	14,465	-	300,832	11,777
	기타	95,319	38	309,888	267,265
	기타 계	113,568	38	654,409	1,482,705

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	59,533	-	1,562,247	272,066
	삼성전기(주)	47,651	-	1,631,481	-
	삼성SDI(주)	51,195	-	610,839	77,358
	(주)제일기획	24,768	-	649,160	3,258
	기타	734,731	-	7,180,346	146,075
	관계기업 및 공동기업 계	917,878	-	11,634,073	498,757
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	82,924	183	240,816	2,670,286
	기타	123,339	-	759,604	629,321
	그 밖의 특수관계자 계	206,263	183	1,000,420	3,299,607
기타(*2)	삼성엔지니어링(주)	2,753	-	17,180	981,671
	(주)에스원	27,761	258	294,703	25,651
	기타	119,609	-	288,532	190,119
	기타 계	150,123	258	600,415	1,197,441

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

나. 채권·채무잔액

당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	3,517	548,717
	삼성전기(주)	1,854	381,885
	삼성SDI(주)	105,192	129,349
	(주)제일기획	151	353,288
	기타	229,174	1,099,288
	관계기업 및 공동기업 계	339,888	2,512,527
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	270,178	1,270,683
	기타	34,839	186,568
	그 밖의 특수관계자 계	305,017	1,457,251
기타(*2)	삼성엔지니어링(주)	2,191	206,430
	(주)에스원	1,752	28,208
	기타	10,328	48,735
	기타 계	14,271	283,373

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	5,294	490,611
	삼성전기(주)	3,518	163,668
	삼성SDI(주)	102,641	73,398
	(주)제일기획	241	465,517
	기타	282,849	1,067,439
	관계기업 및 공동기업 계	394,543	2,260,633
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	225,606	1,725,547
	기타(*2)	19,676	183,395
	그 밖의 특수관계자 계	245,282	1,908,942
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	1,078	581,153
	(주)에스원	3,149	37,785
	기타	4,696	47,502
	기타 계	8,923	666,440

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등 금액에 포함된 전기말 현재 삼성카드(주)와의 구매카드 미결제금액은 없습니다.

삼성카드(주)와의 연간 구매카드 약정금액은 2,543,000백만원이며, 전기 중 사용 및 상환한 금액은 각각 3,724,851백만원 및 4,846,182백만원입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 연결회사는 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에 9,822백만원 및 17,564백만원을 추가로 출자하였으며, 관계기업 및 공동기업으로부터 출자원금 1,437백만원 및 148백만원을 회수하였습니다. 또한 연결회사는 당분기 중 관계기업인 삼성전기(주)의 PLP 사업을 785,000백만원에 양수하였으며, 전분기 중 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사인 삼성중공업(주)에 대하여 204,055백만원을 추가로 출자하였습니다.

라. 연결회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 1,246,411백만원 및 1,357,898백만원입니다. 또한, 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당분기 및 전분기 중 지급결의한 배당금은 94,308백만원 및 104,206백만원입니다. 당분기말과 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

마. 연결회사가 당분기 중 특수관계자와 체결한 리스 이용 계약은 없으며, 특수관계자에게 지급한 리스료는 42,577백만원입니다.

바. 당분기 및 전분기 중 연결회사가 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당분기	전분기
단기급여	5,021	7,100
퇴직급여	1,054	1,083
기타 장기급여	4,837	6,142

28. 사업결합:

당분기 중 발생한 주요한 사업결합 거래는 다음과 같습니다.

가. Corephotonics 지분 인수

연결회사의 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V.(SEBN)는 CIS 광학기술 및 우수 인력 확보를 위해 2019년 1월 28일자로 Corephotonics Ltd.의 지분 83.9%를, 2019년 3월 4일자로 8.5%를 인수하였습니다.

(1) 피인수회사의 개요

구 분	내 용
피인수회사명	Corephotonics Ltd.
본점소재지	Tel Aviv, Israel
대표이사	David Mendlovic
업종	카메라 솔루션 개발

(2) 인수회계처리

(단위 : 백만원)

구 분	금 액
I. 이전대가	
사업결합 이전에 보유한 지분의 공정가치(*1)	13,236
추가 이전대가의 공정가치	160,214
총 이전대가	173,450
II. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액	
현금및현금성자산	6,069
단기금융상품 등	19,354
매출채권 및 기타채권	1,199
유형자산	339
무형자산	100,598
기타자산	82
기타채무	236
이연법인세부채	23,138
기타부채	3,475
총 식별가능한 순자산	100,792
III. 식별가능한 비지배지분으로 인식된 금액(*2)	77
IV. 영업권 (I - II + III)	72,735

(*1) 사업결합 전에 연결회사의 종속기업인 SVIC 28호 신기술투자조합이 보유하고 있던 Corephotonics Ltd.의 지분 7.6%에 대하여 2019년 1월 28일 기준으로 공정가치를 재측정함으로써 기타비용 500백만원을 인식하였습니다.

(*2) 사업결합 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적지분으로 측정되었습니다.

Corephotonics가 2019년 1월 1일부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출 및 연결분기순손실은 845백만원 및 17,182백만원입니다. 또한 연결대상 편입 이후 Corephotonics로부터 발생한 매출 및 연결분기순손실은 526백만원 12,572백만원입니다.

나. PLP 사업 양수

연결회사는 2019년 4월 30일자 이사회 결의에 의거 2019년 6월 1일자로 차세대 패키지 기술 확보를 통한 반도체 경쟁력을 강화하기 위하여 관계기업인 삼성전기(주)의 PLP 사업을 785,000백만원에 양수하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	금 액
I. 이전대가의 공정가치	785,000
II. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액	
재고자산	10,906
유형자산	398,984
무형자산	182,171
기타자산	1,561
기타부채	15,363
총 식별가능한 순자산	578,259
III. 영업권 (I - II)	206,741

PLP 사업이 2019년 1월 1일부터 사업양수되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 없으며 연결 분기순손실은 115,098백만원입니다. 또한 사업양수 이후 PLP사업으로부터 발생한 매출은 없으며 연결분기순손실은 45,286백만원입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 51 기 3분기말 2019.09.30 현재

제 50 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 51 기 3분기말	제 50 기말
자산		
유동자산	76,848,738	80,039,455
현금및현금성자산	2,135,881	2,607,957
단기금융상품	24,403,587	34,113,871
매출채권	31,554,688	24,933,267
미수금	1,012,224	1,515,079
선급금	993,896	807,262
선급비용	2,668,049	2,230,628
재고자산	12,646,133	12,440,951
기타유동자산	1,434,280	1,390,440
비유동자산	140,398,633	138,981,902
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,233,737	1,098,565
당기손익-공정가치금융자산	6,271	7,413
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	56,694,380	55,959,745
유형자산	71,544,177	70,602,493
무형자산	3,439,350	2,901,476
장기선급비용	3,305,683	4,108,410
순확정급여자산	29,506	562,356
이연법인세자산	1,012,733	654,456
기타비유동자산	3,132,796	3,086,988
자산총계	217,247,371	219,021,357
부채		
유동부채	37,245,240	43,145,053
매입채무	11,163,808	7,315,631
단기차입금	8,838,207	10,353,873
미지급금	6,973,953	8,385,752
선수금	227,644	214,615
예수금	432,337	572,702
미지급비용	3,753,696	6,129,837
미지급법인세	1,587,139	7,925,887
유동성장기부채	125,902	5,440
총당부채	3,725,432	2,135,314

기타유동부채	417,122	106,002
비유동부채	2,451,483	2,888,179
사채	46,939	43,516
장기차입금	133,190	
장기미지급금	1,751,497	2,472,416
장기충당부채	517,282	372,217
기타비유동부채	2,575	30
부채총계	39,696,723	46,033,232
자본		
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	171,078,582	166,555,532
기타자본항목	1,170,659	1,131,186
자본총계	177,550,648	172,988,125
자본과부채총계	217,247,371	219,021,357

손익계산서

제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 51 기 3분기		제 50 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	42,204,911	117,392,980	47,645,339	131,567,040
매출원가	32,735,989	87,878,933	27,578,197	77,380,630
매출총이익	9,468,922	29,514,047	20,067,142	54,186,410
판매비와관리비	6,802,955	20,153,999	6,154,425	18,023,191
영업이익(손실)	2,665,967	9,360,048	13,912,717	36,163,219
기타수익	3,095,131	4,938,635	155,099	574,553
기타비용	101,796	440,249	86,117	228,997
금융수익	1,104,785	3,313,159	739,900	2,829,759
금융비용	977,630	2,925,982	834,436	2,787,804
법인세비용차감전순이익(손실)	5,786,457	14,245,611	13,887,163	36,550,730
법인세비용	1,200,567	2,507,924	3,675,615	9,808,739
계속영업이익(손실)	4,585,890	11,737,687	10,211,548	26,741,991
당기순이익(손실)	4,585,890	11,737,687	10,211,548	26,741,991
주당이익				
기분주당이익(손실) (단위 : 원)	675	1,728	1,503	3,936
회석주당이익(손실) (단위 : 원)	675	1,728	1,503	3,936

포괄손익계산서

제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 51 기 3분기		제 50 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익(손실)	4,585,890	11,737,687	10,211,548	26,741,991
기타포괄손익	(19,415)	39,473	12,234	(39,101)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(19,415)	39,473	12,234	(39,101)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(5,749)	93,878	31,718	35,609
순확정급여자산 재측정요소	(13,666)	(54,405)	(19,484)	(74,710)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				
총포괄손익	4,566,475	11,777,160	10,223,782	26,702,890

자본변동표

제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본				
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2018.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	150,928,724	(4,660,356)	151,569,775
회계정책변경누적효과			61,021	(61,021)	
수정후 기초자본	897,514	4,403,893	150,989,745	(4,721,377)	151,569,775
당기순이익(손실)			26,741,991		26,741,991
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			2,701	32,908	35,609
순확정급여자산 재측정요소				(74,710)	(74,710)
배당			(7,738,740)		(7,738,740)
자기주식의 취득				(875,111)	(875,111)
자기주식의 소각			(2,228,135)	2,228,135	
2018.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	167,767,562	(3,410,155)	169,658,814
2019.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	166,555,532	1,131,186	172,988,125
회계정책변경누적효과					
수정후 기초자본	897,514	4,403,893	166,555,532	1,131,186	172,988,125
당기순이익(손실)			11,737,687		11,737,687
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				93,878	93,878
순확정급여자산 재측정요소				(54,405)	(54,405)
배당			(7,214,637)		(7,214,637)
자기주식의 취득					
자기주식의 소각					
2019.09.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	171,078,582	1,170,659	177,550,648

현금흐름표

제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 50 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 51 기 3분기	제 50 기 3분기
영업활동 현금흐름	12,895,344	29,342,891
영업에서 창출된 현금흐름	17,444,767	37,007,574
당기순이익	11,737,687	26,741,991
조정	10,225,453	21,355,836
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,518,373)	(11,090,253)
이자의 수취	470,687	360,840
이자의 지급	(230,733)	(242,658)
배당금 수입	4,586,880	714,616
법인세 납부액	(9,376,257)	(8,497,481)
투자활동 현금흐름	(4,537,058)	(22,250,426)
단기금융상품의 순감소(증가)	9,410,284	(3,651,554)
장기금융상품의 처분	300,000	
장기금융상품의 취득		(300,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	688	7,345
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(6,701)	(204,055)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,889	6,906
당기손익-공정가치금융자산의 취득		(1,261)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	58,677	25,624
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(920,228)	(122,738)
유형자산의 처분	378,687	282,945
유형자산의 취득	(12,185,018)	(17,692,885)
무형자산의 처분	91	463
무형자산의 취득	(779,437)	(604,961)
사업결합으로 인한 현금유출액	(785,000)	
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(10,990)	3,745
재무활동 현금흐름	(8,830,958)	(5,936,201)
단기차입금의 순증가(감소)	(1,527,098)	2,676,493
자기주식의 취득		(875,111)
장기차입금의 상환	(89,918)	
배당금의 지급	(7,213,942)	(7,737,583)
외화환산으로 인한 현금의 변동	596	
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(472,076)	1,156,264
기초의 현금및현금성자산	2,607,957	2,763,768
기말의 현금및현금성자산	2,135,881	3,920,032

이익잉여금처분계산서

제 50 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목	제 50 기		제 49 기		제 48 기	
I. 미처분이익잉여금		18,556,368		14,031,533		38,248
1. 전기이월이익잉여금	30		31		30	
2. 회계정책변경누적효과 등	58,324		-		-	
3. 분기배당액 제50기 - 주당배당금(률): 1,062원 (1062%) 제49기 - 주당배당금(률): 21,000원 (420%) 제48기 - 주당배당금(률): 1,000원(20%)	(7,213,815)		(2,896,772)		(141,540)	
4. 자기주식 소각	(7,103,298)		(11,872,563)		(11,399,991)	
5. 당기순이익	32,815,127		28,800,837		11,579,749	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-		3,812,135
1. 기업합리화적립금	-		-		3,812,135	
III. 이익잉여금처분액		18,556,338		14,031,503		3,850,352
1. 기업합리화적립금	5,000,000		3,000,000		-	
2. 배당금 주당배당금(률) 제50기 - 보통주: 354원(354%) 우선주: 355원(355%) 제49기 - 보통주: 21,500원(430%) 우선주: 21,550원(431%) 제48기 - 보통주: 27,500원(550%) 우선주: 27,550원(551%)	2,405,428		2,929,530		3,850,352	
3. 연구및인력개발준비금	10,000,000		8,000,000		-	
4. 시설적립금	1,150,910		101,973		-	
III. 차기이월미처분이익잉여금		30		30		31

※ 제49기 및 제48기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

5. 재무제표 주석

제 51 기 분기: 2019년 9월 30일 현재

제 50 기 : 2018년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사

1. 일반적 사항:

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 CE부문, IM부문, DS부문으로 구성되어 있습니다. CE(Consumer Electronics) 부문은 디지털 TV, 모니터, 에어컨 및 냉장고 등의 사업으로 구성되어 있고, IM(Information technology & Mobile communications) 부문은 휴대폰, 통신시스템, 컴퓨터 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리 반도체, Foundry, System LSI 등의 반도체 사업으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

이 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침:

2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2019년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2019년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 회사가 채택한 제·개정 기준서

회사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

회사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1116호 '리스'를 적용하였습니다. 기준서 제1116호의 경과규정에 따라 비교표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자율 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기준서 제1109호의 적용대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정

제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리가 과세당국에 의해 인정될지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리 불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표되었으나 2019년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않아, 회사가 조기적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 없습니다.

2.2. 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

가. 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

나. 리스

리스는 리스제공자가 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 동안 리스이용자에게 이전하는 계약입니다.

회사는 계약의 약정시점에, 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. 다만, 회사는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 실무적 간편법을 적용하여 모든 계약에 대해 다시 판단하지 않았습니다.

리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하 '비리스요소'라고 함)와 분리하여 리스로 회계처리합니다. 다만, 회사는 리스이용자로서의 회계처리에서 실무적 간편법을 적용하여 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리합니다.

(1) 리스이용자로서의 회계처리

회사는 리스개시일에 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다.

사용권자산은 최초 인식 시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 또한 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다. 사용권자산은 재무상태표에 '유형자산'으로 분류합니다.

리스부채는 리스개시일에 그날 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재 가치 측정시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 회사의 증분차입이자율로 리스료를 할인하고 있습니다. 리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다. 리스부채는 재무상태표에 '유동성장기부채' 또는 '장기차입금'으로 분류합니다.

단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산(예: 기초자산 US\$5,000 이하) 리스의 경우 예외규정을 선택하여 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.

(2) 리스제공자로서의 회계처리

리스제공자의 회계처리는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책과 유의적으로 변동되지 않았습니다.

회사는 리스약정일에 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하고, 금융리스 이외의 모든 리스는 운용리스로 분류합니다. 운용리스로부터 발생하는 리스료 수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식하고, 운용리스의 협상 및 계약 단계에서 발생한 리스개설 직접원가는 리스자산의 장부금액에 가산한 후 리스료 수익에 대응하여 리스기간 동안 비용으로 인식합니다.

2.3. 회계정책의 변경

가. 기준서 제1116호 '리스' 의 적용

회사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1116호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

최초적용일인 2019년 1월 1일 현재 사용권자산 및 리스부채는 각각 438,923백만원, 249,034백만원 증가하였으며, 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	금 액
1. 2018년 12월 31일의 금융리스부채	-
2. 2019년 1월 1일의 운용리스 약정 조정내역	249,034
- 2018년 12월 31일의 운용리스 약정	285,567
- 2019년 1월 1일의 운용리스 약정 할인금액	269,032
(조정) 단기리스 및 소액자산리스 예외규정 적용	(19,998)
3. 2019년 1월 1일의 리스부채	249,034

2.4. 중요한 회계추정 및 가정

분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 기준서 제1116호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품:

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
현금및현금성자산	2,135,881	-	-	2,135,881
단기금융상품	24,403,587	-	-	24,403,587
매출채권	31,554,688	-	-	31,554,688
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	1,233,737	-	1,233,737
당기손익-공정가치금융자산	-	-	6,271	6,271
기타	4,071,613	-	-	4,071,613
계	62,165,769	1,233,737	6,271	63,405,777

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	11,163,808	-	11,163,808
단기차입금	-	8,838,207	8,838,207
미지급금	6,763,134	-	6,763,134
유동성장기부채	5,873	120,029	125,902
사채	46,939	-	46,939
장기차입금	-	133,190	133,190
장기미지급금	1,501,640	-	1,501,640
기타	2,778,100	-	2,778,100
계	22,259,494	9,091,426	31,350,920

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
현금및현금성자산	2,607,957	-	-	2,607,957
단기금융상품	34,113,871	-	-	34,113,871
매출채권	24,933,267	-	-	24,933,267
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	1,098,565	-	1,098,565
당기손익-공정가치금융자산	-	-	7,413	7,413
기타	4,630,073	-	-	4,630,073
계	66,285,168	1,098,565	7,413	67,391,146

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	7,315,631	-	7,315,631
단기차입금	-	10,353,873	10,353,873
미지급금	8,255,775	-	8,255,775
유동성장기부채	5,440	-	5,440
사채	43,516	-	43,516
장기미지급금	2,231,836	-	2,231,836
기타	2,355,676	-	2,355,676
계	20,207,874	10,353,873	30,561,747

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 구성내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분상품	1,233,737	1,098,565

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
채무상품	6,271	7,413

나. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

기 업 명	당분기말			전기말	
	보유주식수 (주)	지분율 (%)(*)	취득원가	장부금액 (시장가치)	장부금액 (시장가치)
삼성중공업(주)	100,693,398	16.0	735,488	793,464	746,138
(주)호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	172,807	153,361
(주)아이마켓코리아	647,320	1.8	324	6,732	4,479
(주)에이테크솔루션	1,592,000	15.9	26,348	12,545	12,418
(주)원익홀딩스	1,759,171	2.3	15,410	7,441	6,175
(주)원익아이피에스	1,850,936	3.8	16,214	53,492	37,204
(주)케이티스카이라이프	240,000	0.5	3,344	2,172	2,760
(주)동진세미캠	2,467,894	4.8	48,277	41,214	18,040
솔브레인(주)	835,110	4.8	55,618	60,963	39,709
(주)용평리조트	400,000	0.8	1,869	3,000	2,436
계			916,849	1,153,830	1,022,720

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가총당금	장부금액	평가전금액	평가총당금	장부금액
제품 및 상품	2,476,075	(384,349)	2,091,726	3,045,263	(300,008)	2,745,255
반제품 및 재공품	8,963,290	(394,039)	8,569,251	8,328,324	(403,623)	7,924,701
원재료 및 저장품	1,918,734	(336,744)	1,581,990	1,523,979	(263,632)	1,260,347
미착품	403,166	-	403,166	510,648	-	510,648
계	13,761,265	(1,115,132)	12,646,133	13,408,214	(967,263)	12,440,951

6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당분기 및 전분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	55,959,746	55,671,759
취득	920,228	122,738
처분	(58,677)	(25,095)
손상	(126,917)	-
분기말장부금액	56,694,380	55,769,402

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다
(종속기업 현황은 주식 26 참조).

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스(주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합/관리업 등 IT서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스(주)	신사업 투자	31.5	한국	12월
삼성SDI(주)(*2)	2차전지 등 전자제품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당분기말			전기말	
	주식수	시장가치	장부금액	시장가치	장부금액
삼성전기(주)	17,693,084	1,822,388	445,244	1,831,234	445,244
삼성에스디에스(주)	17,472,110	3,328,437	560,827	3,564,310	560,827
삼성바이오로직스(주)	20,836,832	6,407,326	443,193	8,053,436	443,193
삼성SDI(주)	13,462,673	3,002,176	1,242,605	2,948,325	1,242,605
(주)제일기획	29,038,075	720,144	491,599	653,357	491,599

7. 유형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초순장부금액	70,602,493	62,816,961
일반취득 및 자본적지출	11,765,778	16,982,040
사업결합으로 인한 취득	398,984	-
감가상각	(11,382,296)	(10,078,076)
처분/폐기/손상/환입	(182,591)	(83,634)
기타(*)	341,809	(111,827)
분기말순장부금액	71,544,177	69,525,464

(*) 기타는 회계변경누적효과 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	10,375,471	9,160,497
판매비와관리비 등	1,006,825	917,579
계	11,382,296	10,078,076

다. 당분기말 현재 사용권자산은 438,245백만원(당기초: 438,923백만원)입니다. 또한 당분기 중 신규 발생한 사용권자산은 110,334백만원이며, 사용권자산의 감가상각비는 96,374백만원입니다.

8. 무형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,901,476	2,827,035
내부개발에 의한 취득	285,699	229,153
개별 취득	493,738	375,808
사업결합으로 인한 취득	388,912	-
상각	(490,588)	(676,252)
처분/폐기/손상/환입	(28,742)	(19,252)
기타(*)	(111,145)	78,505
분기말장부금액	3,439,350	2,814,997

(*) 기타는 회계변경누적효과 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	261,290	464,280
판매비와관리비 등	229,298	211,972
계	490,588	676,252

9. 차입금:

보고기간종료일 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당분기말	당분기말	전기말
(1) 단기차입금				
담보부차입금(*1)	우리은행 외	0.0 ~ 9.2	8,838,207	10,353,873
(2) 유동성장기차입금				
리스부채(*2)	-	2.4	120,035	-
(3) 장기차입금				
리스부채(*2)	-	2.4	133,190	-

(*1) 담보부차입금에 대해서는 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다.

(*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균 증분차입이자율이며 당분기 중 발생한 이자비용은 4,940백만원입니다. 또한 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스 제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

10. 사채:

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds(*)	1997.10.2	2027.10.1	7.7	54,059 (US\$45,000천)	50,315 (US\$45,000천)
1년 이내 만기도래분(유동성사채)				(6,007)	(5,591)
사채할인발행차금				(1,113)	(1,208)
계				46,939	43,516

(*) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여자산:

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여자산과 관련하여 재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	6,918,086	6,416,966
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	16,888	15,664
소 계	6,934,974	6,432,630
사외적립자산의 공정가치	(6,964,480)	(6,994,986)
순확정급여(자산) 계	(29,506)	(562,356)

나. 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	485,886	452,927
순이자원가(수익)	(14,771)	(24,719)
계	471,115	428,208

다. 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	187,565	167,175
판매비와관리비 등	283,550	261,033
계	471,115	428,208

12. 총당부채:

당분기 중 총당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	상여총당부채 (라)	기타총당부채 (마), (바)	계
기초	190,995	1,134,379	580,816	-	601,341	2,507,531
순전입액	233,696	193,716	149,201	2,568,837	270,835	3,416,285
사용액	(199,868)	(518,499)	(214,525)	(341,391)	(425,335)	(1,699,618)
기타	-	40,761	1,790	3,389	(27,424)	18,516
당분기말	224,823	850,357	517,282	2,230,835	419,417	4,242,714

가. 회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.

나. 회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.

라. 회사는 임직원을 대상으로 당 회계연도의 경영실적에 따라 상여를 지급하고 있는바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분은 총당부채로 계상하고 있습니다.

마. 회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.

바. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 당분기말 현재 무상할당 배출권 및 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤)

구 분	당분기말
무상할당 배출권	781
배출량 추정치	1,121

(2) 당분기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기
기초	31,647
증가	2,652
당분기말	34,299

(3) 당분기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기
기초	99,832
순전입(환입)액	(86,296)
사용액	-
당분기말	13,536

13. 우발부채와 약정사항:

가. 지급보증한 내역

(1) 보고기간종료일 현재 회사가 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 백만US\$)

내역	당분기말	전기말
임대주택 관련 채무보증	-	5,235
해외중속기업에 대한 채무보증 (한도 기준)	US\$ 8,289 (원화환산액: ₩9,957,928)	US\$ 8,281 (원화환산액: ₩9,259,529)
해외중속기업에 대한 채무보증 (실차입금 기준)	US\$ 137 (원화환산액: ₩164,706)	US\$ 217 (원화환산액: ₩240,989)

보고기간종료일 현재 회사가 해외중속기업의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

(단위 : 백만원)

해외중속기업	보증처	보증기간	금액	
			실차입금	지급보증금액
SAMCOL	Citibank 외	2020-06-13	80,841	201,818
SEPR	BBVA 외	2020-06-13	83,865	216,234
기타			-	9,539,876
계			164,706	9,957,928

(2) 보고기간종료일 현재 회사가 해외중속기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증 한도액은 18,222백만원입니다.

나. 소송 등

보고기간종료일 현재 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 분할과 관련된 연대책무

회사와 삼성디스플레이(주) 등은 분할된 삼성디스플레이(주) 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

14. 계약부채:

회사가 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
계약부채(*)	1,143,582	701,851

(*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 25,000,000,000주(1주의 금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(소각 주식수 제외)는 각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면 총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원 및 우선주 82,289백만원)으로 납입자본금(897,514백만원)과 상이합니다.

16. 이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금	450,789	450,789
임의적립금 등	170,627,793	166,104,743
계	171,078,582	166,555,532

나. 회사는 2019년 4월 30일, 7월 31일, 10월 31일 이사회결의에 의거 2019년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일을 배당기준일로 하여 분기배당을 지급하기로 하였으며, 당분기와 전분기의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		당분기	전분기	
1분기	배당받을 주식(*)	보통주	5,969,782,550주	119,395,651주
		우선주	822,886,700주	16,457,734주
	배당률(액면가 기준)	354%	354%	
	배당금액	보통주	2,113,303	2,113,303
		우선주	291,302	291,302
		계	2,404,605	2,404,605
2분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	354%	354%	
	배당금액	보통주	2,113,303	2,113,303
		우선주	291,302	291,302
		계	2,404,605	2,404,605
3분기	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
		우선주	822,886,700주	822,886,700주
	배당률(액면가 기준)	354%	354%	
	배당금액	보통주	2,113,303	2,113,303
		우선주	291,302	291,302
		계	2,404,605	2,404,605

(*) 전기 중 주식분할로 인해 주식수가 변경되었습니다.

17. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	116,637	22,759
순확정급여자산 재측정요소	(706,386)	(651,981)
기타	1,760,408	1,760,408
계	1,170,659	1,131,186

18. 비용의 성격별 분류:

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
제품 및 재공품 등의 변동	1,317,095	8,979	(783,840)	(2,659,694)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	22,590,594	61,500,377	18,941,110	55,418,130
급여	2,532,209	8,328,606	2,688,566	7,985,777
퇴직급여	158,406	474,392	143,416	430,007
감가상각비	3,781,967	11,382,296	3,696,229	10,078,076
무형자산상각비	209,268	490,588	227,147	676,252
복리후생비	473,416	1,578,483	440,964	1,372,257
유틸리티비	609,329	1,740,618	590,653	1,634,242
외주용역비	774,525	2,103,452	635,533	1,975,009
광고선전비	323,451	779,422	54,249	401,510
판매촉진비	286,186	893,924	308,518	1,032,530
기타비용	6,482,498	18,751,795	6,790,077	17,059,725
계(*)	39,538,944	108,032,932	33,732,622	95,403,821

(*) 손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비:

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 판매비와관리비				
급여	430,991	1,401,828	465,040	1,389,631
퇴직급여	28,684	85,834	27,643	82,720
지급수수료	678,782	1,753,866	718,286	1,807,744
감가상각비	109,703	329,293	96,565	276,584
무형자산상각비	38,049	109,037	35,490	101,746
광고선전비	323,451	779,422	54,249	401,510
판매촉진비	286,186	893,924	308,518	1,032,530
운반비	173,450	486,669	130,185	378,599
서비스비	175,838	531,086	9,973	299,161
기타판매비와관리비	257,657	1,188,670	509,832	1,383,312
소계	2,502,791	7,559,629	2,355,781	7,153,537
(2) 경상연구개발비				
연구개발 총지출액	4,325,820	12,880,069	3,838,319	11,098,807
개발비 자산화	(25,656)	(285,699)	(39,675)	(229,153)
소계	4,300,164	12,594,370	3,798,644	10,869,654
계	6,802,955	20,153,999	6,154,425	18,023,191

20. 기타수익 및 기타비용:

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 기타수익				
배당금수익	2,885,566	4,416,397	-	99,635
임대료수익	42,563	127,510	42,637	123,548
투자자산처분이익	-	4,723	-	5,805
유형자산처분이익	122,008	229,326	72,046	217,764
기타	44,994	160,679	40,416	127,801
계	3,095,131	4,938,635	155,099	574,553
(2) 기타비용				
유형자산처분손실	2,907	18,256	1,348	18,436
기부금	72,232	230,568	66,544	182,760
기타	26,657	191,425	18,225	27,801
계	101,796	440,249	86,117	228,997

21. 금융수익 및 금융비용:

가. 당분기 및 전분기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 금융수익				
이자수익	189,654	599,850	192,716	502,267
- 상각후원가 측정 금융자산	189,654	599,850	192,716	502,267
외환차이	915,131	2,713,309	547,184	2,263,181
파생상품관련이익	-	-	-	64,311
계	1,104,785	3,313,159	739,900	2,829,759
(2) 금융비용				
이자비용	91,779	289,772	118,949	286,822
- 상각후원가 측정 금융부채	20,933	63,443	13,863	47,521
- 기타금융부채	70,846	226,329	105,086	239,301
외환차이	885,851	2,636,210	715,487	2,494,378
파생상품관련손실	-	-	-	6,604
계	977,630	2,925,982	834,436	2,787,804

나. 회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용:

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 17.6%입니다.

23. 주당이익:

가. 기본주당이익

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
분기순이익	4,585,890	11,737,687	10,211,548	26,741,991
분기순이익 중 보통주 해당분	4,030,340	10,315,744	8,974,487	23,502,377
÷ 가중평균유통보통주식수	5,969,783	5,969,783	5,969,783	5,970,672
기본 보통주 주당이익(단위 : 원)	675	1,728	1,503	3,936

(2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
분기순이익	4,585,890	11,737,687	10,211,548	26,741,991
분기순이익 중 우선주 해당분	555,550	1,421,943	1,237,061	3,239,614
÷ 가중평균유통우선주식수	822,887	822,887	822,887	823,094
기본 우선주 주당이익(단위 : 원)	675	1,728	1,503	3,936

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표:

가. 당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름의 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정내역

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용	2,507,924	9,808,739
금융수익	(900,188)	(705,821)
금융비용	706,831	811,843
퇴직급여	474,392	430,007
감가상각비	11,382,296	10,078,076
무형자산상각비	490,588	676,252
대손상각비(환입)	(201,152)	32,591
배당금수익	(4,416,397)	(99,635)
유형자산처분이익	(229,326)	(217,764)
유형자산처분손실	18,256	18,436
재고자산평가손실 등	292,749	484,625
투자자산처분이익	(4,723)	(5,805)
기타	104,203	44,292
계	10,225,453	21,355,836

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 감소(증가)	(5,371,953)	(4,553,958)
미수금의 감소(증가)	510,916	672,565
선급금의 감소(증가)	(83,207)	(17,673)
장단기선급비용의 감소(증가)	365,318	413,661
재고자산의 감소(증가)	(432,877)	(3,093,455)
매입채무의 증가(감소)	3,846,727	2,056,950
장단기미지급금의 증가(감소)	(1,754,624)	(3,065,658)
선수금의 증가(감소)	13,169	(6,577)
예수금의 증가(감소)	(140,365)	(59,354)
미지급비용의 증가(감소)	(2,444,558)	(2,906,074)
총당부채의 증가(감소)	1,716,667	1,850,444
퇴직금의 지급	(171,052)	(149,483)
기타	(572,534)	(2,231,641)
계	(4,518,373)	(11,090,253)

나. 당분기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 89,918 백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 4,940백만원입니다.

25. 재무위험관리:

회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 특정 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

해외 주요 권역 별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)를 운영하여 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다.

회사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래 발생시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.

회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며, 헷지 목적 이외의 외환거래는 금지하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당분기 및 전기 포괄손익(법인세효과 반영 전)의 변동금액은 각각 11,538백만원 및 10,227백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재정팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전 관리하고 있습니다. 이상 징후 발견 시 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 회사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성 위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한 유동성위험에 대비하여 회사는 무역금융 등의 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 재무제표 상 금액을 기준으로 계산합니다.

회사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고 있습니다.

보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	39,696,723	46,033,232
자 본	177,550,648	172,988,125
부채비율	22.4%	26.6%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 회사 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	2,135,881	(*1)	2,607,957	(*1)
단기금융상품	24,403,587	(*1)	34,113,871	(*1)
매출채권	31,554,688	(*1)	24,933,267	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,233,737	1,233,737	1,098,565	1,098,565
당기손익-공정가치금융자산	6,271	6,271	7,413	7,413
기타	4,071,613	(*1)	4,630,073	(*1)
소계	63,405,777		67,391,146	
금융부채				
매입채무	11,163,808	(*1)	7,315,631	(*1)
단기차입금	8,838,207	(*1)	10,353,873	(*1)
미지급금	6,763,134	(*1)	8,255,775	(*1)
유동성장기부채	125,902	(*1)(*2)	5,440	(*1)
사채	46,939	64,468	43,516	57,733
장기차입금	133,190	(*2)	-	-
장기미지급금	1,501,640	(*1)	2,231,836	(*1)
기타	2,778,100	(*1)	2,355,676	(*1)
소계	31,350,920		30,561,747	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 유동성장기부채와 장기차입금 중 리스부채는 기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,153,830	-	79,907	1,233,737
당기손익-공정가치금융자산	-	-	6,271	6,271
금융부채				
사채	-	64,468	-	64,468

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,022,720	-	75,845	1,098,565
당기손익-공정가치금융자산	-	-	7,413	7,413
금융부채				
사채	-	57,733	-	57,733

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- 수준 2: 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)
- 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

회사는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 수준 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 수준 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열 체계에서 수준 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래 현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	수준 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산				
(주)말타니	10,923	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0%)
			가중평균자본비용	8.8%~10.8%(9.8%)
삼성벤처투자(주)	7,720	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0%)
			가중평균자본비용	17.5%~19.5%(18.5%)

(4) 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	83,258	22,921
매입	6,701	-
매도	(2,159)	(7,345)
평가(당기손익)	-	(930)
평가(기타포괄손익)	(1,622)	2,257
기타(*)	-	76,207
분기말	86,178	93,110

(*) 기타는 회계변경누적효과 등을 포함하고 있습니다.

(5) 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*)	-	4,055	-	(2,794)

(*) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0% ~ 1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

26. 특수관계자와의 거래:

가. 지배, 종속관계

보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc.(SEA)	전자제품 판매	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Dacor Holdings, Inc.	Holding Company	100.0
	Dacor, Inc.	가전제품 생산 및 판매	100.0
	Dacor Canada Co.	가전제품 판매	100.0
	EverythingDacor.com, Inc.	가전제품 판매	100.0
	Distinctive Appliances of California, Inc.	가전제품 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈기기 판매	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc.(SHI)	Holding Company	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	Stellus Technologies, Inc.	반도체 시스템 생산 및 판매	100.0
	Prismview, LLC	LED 디스플레이 생산 및 판매	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc.(SSI)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc.(SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0
	Viv Labs, Inc.	인공지능 서비스	100.0
	SigMast Communications Inc.	문자메시지 개발	100.0
	RT SV CO-INVEST, LP	벤처기업 투자	99.9
	Samsung Research America, Inc(SRA)	R&D	100.0
	Samsung Next LLC(SNX)	Holding Company	100.0
	Samsung Next Fund LLC(SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	Samsung International, Inc.(SII)	CTV/모니터 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V(SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC.(SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.(SEM)	전자제품 판매	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.(SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.(SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A.(SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A.(SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A.(SEPA)	컨설팅	100.0
	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.(SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A.(SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada(SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C.(SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services South America S.R.L.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group LLC	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Industries, Inc.	Holding Company	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Investment Group, LLC	Financing Company	100.0
	Harman KG Holding, LLC	Holding Company	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Red Bend Software Inc.	소프트웨어 디자인	100.0	
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4	
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0	
Zhilabs Inc.	네트워크Solution 판매	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd.(SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics(London) Ltd.(SEL)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH(SEHG)	Holding Company	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A.(SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S(SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.(SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.(SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A.(SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.(SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V.(SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Slovakia s.r.o.(SDSK)	DP 임가공	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC(SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o(SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa S.A.(SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag(SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited(SSEL)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH(SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH(ESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o(SESK)	CTV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Baltics SIA(SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A(SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.(SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS(SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited(SCSC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Overseas B.V.(SEO)	전자제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	AMX UK Limited	오디오제품 판매	100.0
	Arcam Limited	Holding Company	100.0
	A&R Cambridge Limited	오디오제품 판매	100.0
	Duran Audio B.V.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive UK Limited	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Limited	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	Holding Company	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	Holding Company	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매 등	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Finance International, SCA	Financing Company	100.0
	Harman International s.r.o	오디오제품 생산	100.0
	Harman International SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Management GmbH	Holding Company	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Martin Manufacturing (UK) Ltd	오디오제품 생산	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Professional France SAS	오디오제품 판매	100.0	
Red Bend Software Ltd.	소프트웨어 디자인	100.0	
Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0	
Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC(SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC(SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC(SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP(SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd(SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC(SERK)	CTV 생산	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0
중동 및 아프리카	Samsung Electronics West Africa Ltd.(SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd.(SEEA)	마케팅	100.0
	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.(SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E(SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd.(SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L(SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.(SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.(SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	CTV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Turkey(SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.(SIRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.(SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab(SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Holding Company	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Holding Company	100.0
	iOnRoad Technologies Ltd	R&D	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Towersec Ltd.	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국제외)	Samsung Japan Corporation(SJC)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.(SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.(SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.(SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Medison India Private Ltd.(SMIN)	의료기기 판매	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.(SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.(SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Asia Private Ltd.(SAPL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd.(SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd(SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited(SDN)	DP 생산	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.(SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited(SENZ)	전자제품 판매	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia(STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.(TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd(LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation(SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.(SDV)	DP 생산	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.(SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited(SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.(SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	AMX Products And Solutions Private Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	Holding Company	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0	
Martin Professional Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.(SDD)	DP 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.(SDT)	DP 생산	95.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.(SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.(SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.(SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.(SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung Tianjin Mobile Development Center(SRC-Tianjin)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen(SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.(SESS)	반도체 임가공	100.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.(SEHZ)	전자제품 생산	99.8
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.(TSEC)	CTV/모니터 생산	91.2
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.(SET)	전자제품 판매	100.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center(SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.(TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.(SSS)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.(SESC)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Suzhou Module Co., Ltd.(SSM)	DP 임가공	100.0
	Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.(SSL)	DP 생산	60.0
	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd. (SSET)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.(SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center(SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.(SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.(SSCX)	반도체/DP 판매	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.(TSLED)	LED 생산	100.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이(주)	DP 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스(주)	DP 부품 생산	50.0
	스테코(주)	반도체 부품 생산	70.0
	세메스(주)	반도체/FPD 장비 생산 및 판매	91.5
	삼성전자서비스(주)	전자제품 수리서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스(주)	서비스 콜센터	100.0
	삼성전자판매(주)	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍(주)	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨(주)	의료기기 생산 및 판매	68.5
	(주)미래로시스템	반도체 S/W	99.9
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 27호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	(주)하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급 등	100.0
레드벤드소프트웨어코리아(주)	소프트웨어 개발 및 공급	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

나. 매출·매입 등 거래 내역

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 등 처분	매입 등	비유동자산 등 매입
종속기업	삼성디스플레이(주)	250,212	-	891,991	-
	SEA	19,531,071	-	126,347	-
	Harman과 그 종속기업(*2)	-	-	111,063	-
	SCIC	340,304	-	5,033	-
	SEVT	5,491,680	324	15,298,062	419
	SEV	3,340,383	529	10,918,025	392
	SCS	352,604	193,058	4,172,789	30,676
	SSI	9,254,718	-	326,591	-
	SAPL	1,201,671	-	27,068	-
	SDV	622,240	-	-	-
	SIEL	4,060,646	107	1,978,062	-
	SSS	14,191,865	-	-	-
	SEDA	1,071,918	-	332	-
	SAS	29	4,299	2,870,091	-
	TSE	1,164,898	-	1,433,159	-
	SEUK	181,884	-	84,237	-
	SELS	2,082,650	-	16,079	-
	SEHC	565,928	513	2,907,709	-
	SEG	2,233,481	-	16,478	-
	SEH	488,211	-	1,529	-
	SII	1,063,892	-	4,439,393	-
	SEBN	17,440	-	1,848	-
	SSL	25,392	-	-	-
	SDD	102,172	-	-	-
기타	36,138,879	5,449	12,048,405	7,999	
	종속기업 계	103,774,168	204,279	57,674,291	39,486

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 등 처분	매입 등	비유동자산 등 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	61,995	-	1,445,035	284,595
	삼성전기㈜	31,500	-	1,027,376	16
	삼성SDI㈜	45,967	16,106	203,169	65,141
	㈜제일기획	24,110	-	600,752	958
	기타	359,033	-	491,490	1,188
	관계기업 및 공동기업 계	522,604	16,106	3,767,822	351,898
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	100,859	-	159,799	3,058,288
	기타	127,652	-	343,208	40,380
	그 밖의 특수관계자 계	228,511	-	503,007	3,098,668
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	3,638	-	43,021	1,097,904
	㈜에스원	8,209	-	244,926	8,254
	기타	80,009	38	176,319	213
	기타 계	91,856	38	464,266	1,106,371

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 등 처분	매입 등	비유동자산 등 매입
종속기업	삼성디스플레이㈜	124,952	-	1,028,757	1,660
	SEA	17,380,774	-	129,370	-
	SCIC	218,201	-	4,613	-
	Harman과 그 종속기업(*2)	-	-	72,764	-
	SEVT	4,600,692	1,433	10,536,150	-
	SEV	3,357,689	937	9,549,145	-
	SSI	22,453,271	-	285,006	-
	SCS	432,096	138,973	3,589,609	24,695
	SDV	678,090	-	-	-
	SSS	18,509,631	-	-	-
	SAPL	1,276,250	-	25,640	-
	SIEL	4,050,280	-	290,955	-
	SEHZ	1,293,916	-	5,986,255	273
	SEDA	881,581	-	4,048	-
	SAS	3,973	-	2,763,353	-
	TSE	1,241,551	-	1,386,372	-
	SEUK	117,043	-	60,570	-
	SELS	1,904,087	-	10,679	-
	SEG	2,733,780	-	21,161	-
	SEHC	461,277	562	2,037,985	45
	SEH	230,881	-	874	12
	SEF	1,721,313	-	3,219	-
	SSL	26,318	-	-	-
	SEBN	69,488	-	1,225	-
	기타	32,781,345	10,150	15,165,717	23,830
		종속기업 계	116,548,479	152,055	52,953,467

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 등 처분	매입 등	비유동자산 등 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	58,536	-	1,423,425	227,157
	삼성전기(주)	25,412	-	720,042	-
	삼성SDI(주)	34,933	-	244,016	49,363
	(주)제일기획	24,057	-	637,395	3,258
	기타	409,487	-	430,367	4,407
	관계기업 및 공동기업 계	552,425	-	3,455,245	284,185
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	75,869	183	137,021	1,982,734
	기타	102,651	-	321,614	50,058
	그 밖의 특수관계자 계	178,520	183	458,635	2,032,792
기타(*2)	삼성엔지니어링(주)	2,609	-	16,128	589,207
	(주)에스원	20,462	258	221,722	12,694
	기타	105,700	-	161,938	182
	기타 계	128,771	258	399,788	602,083

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 채권·채무잔액

당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
종속기업	삼성디스플레이(주)	8,441	159,203
	SEA	6,119,111	113,708
	Harman과 그 종속기업(*2)	-	11,196
	SCIC	95,305	580
	SEVT	784,682	3,556,262
	SEV	629,567	3,535,076
	SCS	84,295	477,258
	SEEH	142	-
	SSI	2,736,402	118,214
	SAPL	142,783	13,704
	SDV	126,330	-
	SIEL	2,973,941	239,860
	SSS	4,101,348	-
	SEDA	402,036	3,279
	SAS	2,300	300,678
	TSE	152,171	139,943
	SEUK	63,251	16,473
	SELS	686,543	2,591
	SEHC	79,541	377,558
	SEG	732,361	3,969
	SEH	61,787	86
	SII	104,313	401,012
	SEBN	2,123	6,551
	SSL	4,348	-
	SDD	8,337	-
	기타	7,589,288	1,508,864
	종속기업 계(*3)	27,690,746	10,986,065

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(*3) 당분기말 현재 상기의 종속기업 채권금액에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	3,383	517,337
	삼성전기(주)	1,810	280,928
	삼성SDI(주)	102,584	100,230
	(주)제일기획	13	348,019
	기타	85,082	83,405
	관계기업 및 공동기업 계	192,872	1,329,919
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	241,455	1,204,624
	기타	23,235	115,209
	그 밖의 특수관계자 계	264,690	1,319,833
기타(*2)	삼성엔지니어링(주)	2,145	193,326
	(주)에스원	1,118	19,766
	기타	437	34,783
	기타 계	3,700	247,875

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
종속기업	삼성디스플레이(주)	15,338	182,541
	SEA	4,932,605	72,147
	SCIC	36,616	5,215
	Harman과 그 종속기업(*2)	5,343	8,493
	SEV	518,366	1,225,669
	SEVT	673,277	2,406,151
	SCS	69,891	331,097
	SSI	3,375,191	81,359
	SEEH	517	-
	SDV	118,248	134
	SAPL	105,781	13,251
	SEHZ	92,360	782,167
	SIEL	2,026,325	169,499
	SEDA	427,141	1,398
	SAS	7,130	259,818
	SSS	3,304,263	63
	TSE	124,502	171,847
	SEUK	48,993	20,224
	SEG	492,312	2,473
	SEHC	252,661	235,795
	SELS	697,276	1,567
	SEH	61,756	30
	SSL	4,499	-
	SEF	551,773	333
	SEBN	24,733	2,402
기타	6,573,262	2,243,236	
	종속기업 계(*3)	24,540,159	8,216,909

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(*3) 상기의 종속기업 채권금액에 대하여 손실충당금 245,402백만원을 계상하고 있으며, 전기에 인식된 손실충당금환입액은 26,206백만원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	5,192	467,438
	삼성전기(주)	2,989	112,336
	삼성SDI(주)	102,532	52,825
	(주)제일기획	129	461,326
	기타	94,057	104,942
	관계기업 및 공동기업 계	204,899	1,198,867
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	196,829	1,678,553
	기타(*2)	14,849	119,154
	그 밖의 특수관계자 계	211,678	1,797,707
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	1,029	428,191
	(주)에스원	2,454	29,113
	기타	1,133	29,107
	기타 계	4,616	486,411

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등 금액에 포함된 전기말 현재 삼성카드(주)와의 구매카드 미결제금액은 없습니다. 삼성카드(주)와의 연간 구매카드 약정금액은 2,000,000백만원이며, 전기 중 사용 및 상환한 금액은 각각 3,096,204백만원 및 4,207,333백만원입니다.

(*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

라. 회사는 당분기와 전분기 중 종속기업에 920,228백만원 및 122,738백만원을 추가로 출자하였으며, 종속기업으로부터 출자원금 58,370백만원 및 24,947백만원을 회수하였습니다. 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에 추가 출자한 내역은 없으며, 관계기업 및 공동기업으로부터 출자원금 306백만원 및 148백만원을 회수하였습니다. 또한, 회사는 당분기 중 관계기업인 삼성전기(주)의 PLP 사업을 785,000백만원에 양수하였으며, 전분기 중 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사인 삼성중공업(주)에 대하여 204,055백만원을 추가로 출자하였습니다.

마. 회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 1,246,411백만원 및 1,357,898백만원입니다. 또한, 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당분기 중 지급 결의한 배당금은 94,308백만원 및 104,206백만원입니다. 당분기말과 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

바. 회사가 당분기 중 특수관계자와 체결한 리스 이용 계약은 67,898백만원이며, 특수관계자에게 지급한 리스료는 48,429백만원입니다.

사. 회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 13 참조).

아. 당분기 및 전분기 중 회사가 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위하여 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당분기	전분기
단기급여	5,021	7,100
퇴직급여	1,054	1,083
기타 장기급여	4,837	6,142

27. 사업결합:

회사는 2019년 4월 30일자 이사회 결의에 의거 2019년 6월 1일자로 차세대 패키지 기술 확보를 통한 반도체 경쟁력을 강화하기 위하여 관계기업인 삼성전기(주)의 PLP 사업을 785,000백만원에 양수하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	금 액
I. 이전대가의 공정가치	785,000
II. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액	
재고자산	10,906
유형자산	398,984
무형자산	182,171
기타자산	1,561
기타부채	15,363
총 식별가능한 순자산	578,259
III. 영업권 (I - II)	206,741

PLP 사업이 2019년 1월 1일부터 사업양수되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 없으며 분기순손실은 136,417백만원입니다. 또한 사업양수 이후 PLP 사업으로부터 발생한 매출은 없으며 분기순손실은 45,286백만원입니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

해당사항 없음

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

최근 3사업연도내 본사 기준(별도재무제표 기준) 주요한 분할, 영업양수 등에 대한 내역은 다음과 같으며, 종속기업의 주요한 사업결합 등의 내용은 연결재무제표의 사업결합 주석 등을 참조하시기 바랍니다.

[프린팅솔루션 사업]

- 분할 내역

- 회사명: 에스프린팅솔루션(주)
- 소재지: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129
- 대표이사: 김기호
- 분할방법: 물적분할(분할후 에스프린팅솔루션(주) 신설)
- 분할목적: 프린팅솔루션 사업의 경쟁력 강화
- 분할승인: 2016년 10월 27일(임시주주총회 결의)
- 분할기일: 2016년 11월 1일

- 양도 내역

당사는 2016년 9월 12일 HP Inc.(대표자: Dion Weisler, 소재지: 미국 Palo Alto)에게 에스프린팅솔루션(주) 지분을 포함한 프린팅솔루션 사업 부문을 미화 10억 5천만불에 포괄적으로 양도하는 기본양수도 계약을 체결하였으며, 양도 거래가 2017년 11월 1일 종결되었습니다.

- 상기 분할 및 양도 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트 (<http://dart.fss.or.kr/>) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

[PLP 사업]

- 양수 내역

당사는 2019년 4월 30일자 이사회 결의에 의거 2019년 6월 1일자로 차세대 패키지 기술 확보를 통한 반도체 경쟁력을 강화하기 위하여 관계기업인 삼성전기(주)(대표자: 이윤태, 소재지: 국내)의 PLP(Panel Level Package) 사업을 785,000백만원에 양수하였습니다.

- 상기 양수 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트 (<http://dart.fss.or.kr/>) 상 공시한 '특수관계인으로부터 영업양수'에서 확인할 수 있습니다.

(단위 : 억원)

구분	계정과목	예측		실적				비고
		1차연도	2차연도	1차연도		2차연도		
				실적	과리율	실적	과리율	
PLP 영업양수	매출액	101	219	-	-	-	-	
	영업이익	△1,273	△2,155	-	-	-	-	
	당기순이익	△1,273	△2,155	-	-	-	-	

※ 1차연도 예측은 영업양수일인 2019년 6월부터 12월까지 7개월분이며, 1차연도 실적과 과리율은 2019년 사업보고서에 기재할 예정입니다.

[△는 부(-)의 값임]

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

(중요한 소송사건)

1) TFT-LCD 판매 관련

① Iiyama사 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2014년 12월 19일
소송 당사자	원고: Mouse Computer사, 유럽 내 Iiyama 5개사 피고: 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	수정 소장 접수
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

② 이스라엘 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2013년 11월 26일
소송 당사자	원고: Hatzlacha 피고: 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	소장 송달 대기 중
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

③ Puerto Rico 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2018년 08월 13일
소송 당사자	원고: Puerto Rico 검사 피고: 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	소장 송달 대기 중
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

2) 이외에도 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(채무보증 내역)

1) 국내채무보증

해당사항 없음

2) 해외채무보증

(단위 : 천US\$)

성명(법인명)	관계	채권자	채무내용	목적	보증기간	거래내역 (잔액)				채무보증 한도	이자율 (%)	보증시작일
						기초	증가	감소	기말			
SEA (미주총괄법인)	계열회사	BOA 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	1,398,000		2018.11.09
SEM (멕시코판매법인)	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2020.08.19	0	0	0	0	546,000		2018.11.09
SAMCOL (콜롬비아판매법인)	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	85,662	0	18,368	67,294	168,000	6.2%	2018.12.17
SEDA (브라질생판법인)	계열회사	BRADESCO 외	지급보증	운영자금	2019.12.17	0	0	0	0	654,000		2018.10.08
SECH (칠레판매법인)	계열회사	Santander 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	178,000		2018.11.09
SEPR (페루판매법인)	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	58,710	11,102	0	69,812	180,000	2.8%	2018.11.09
SSA (남아공판매법인)	계열회사	SCB 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	323,000		2018.11.09
SEMAG (모로코판매법인)	계열회사	SocGen 외	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	110,000		2018.11.09
SETK (터키판매법인)	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	64,519	0	64,519	0	822,000		2018.11.09
SECE (카자흐스탄판매법인)	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2020.07.19	0	0	0	0	75,463		2018.12.17
SEEG (이집트생판법인)	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	50,000		2019.06.14
SEIN (인도네시아생판법인)	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	186,000		2018.11.09
SJC (일본판매법인)	계열회사	Mizuho Bank 외	지급보증	운영자금	2020.05.31	0	0	0	0	900,828		2018.11.09
SEUC (우크라이나판매법인)	계열회사	Credit Agricole 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	150,000		2018.11.09
SEDAM (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	341,000		2018.11.09
SELA (파나마판매법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	50,000		2018.12.17
SEEH (네덜란드지주사)	계열회사	HSBC 외	지급보증	운영자금	2020.09.05	0	0	0	0	705,000		2018.11.01
SERK (러시아생산법인)	계열회사	SOCGEN 외	지급보증	운영자금	2020.07.12	0	0	0	0	245,000		2018.11.09
SELV (요르단판매법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	10,000		2018.12.17

SAPL (싱가포르법인)	계열회사	BOA 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	411,000		2018.11.09
SEV (베트남생산법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	15,000		2018.11.09
SAVINA (베트남판매법인)	계열회사	HSBC 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	71,000		2018.11.09
SET (대만판매법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	30,000		2018.11.09
SCIC (중국법인)	계열회사	HSBC 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	350,000		2018.11.09
SME (말레이시아판매법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	110,000		2018.11.09
SAMEX (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	5,000		2018.12.17
SEASA (아르헨티나판매법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	1,000		2018.12.17
SSAP (남아공생산법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	30,000		2018.11.09
SEHK (홍콩판매법인)	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0		2,000		2019.06.14
SEPM (폴란드생산법인)	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2019.06.13	7,712	0	7,712	0	0		2018.06.14
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	2,000		2018.11.09
Harman Finance International, SCA	계열회사	JP Morgan 외	지급보증	운영자금	2022.05.27	400,101	0	17,077	383,024	383,024	2.0%	2015.05.27
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	25,000		2019.06.01
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SOCGEN	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	15,000		2019.06.01
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	100,000		2019.06.14
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	30,000		2019.06.14
합 계						616,703	11,102	107,675	520,130	8,672,315		

※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결후 집행되며, 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 그 결정을

경영위원회에 위임하고 있습니다.

※ 상기 채무보증 중 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여

수수료를 수취하고 있습니다. 2018년 중 US\$464천의 수수료를 청구하여 2019년 중 전액 수취하였습니다.

☞ 추가적인 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

해당사항 없음

나. 대손충당금 설정 현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구분	계정과목	채권 금액	대손충당금	대손충당금 설정률
제51기 3분기	매출채권	40,740,369	373,165	0.9%
	단기대여금	9,041	87	1.0%
	미수금	3,542,418	31,517	0.9%
	선급금	1,668,296	3,132	0.2%
	장기성매출채권	1,186,767	81	0.0%
	장기성미수금	324,011	2,919	0.9%
	장기성선급금	836,803	7,942	0.9%
	장기대여금	128,211	616	0.5%
	합 계	48,435,916	419,459	0.9%
제50기	매출채권	34,433,876	566,143	1.6%
	단기대여금	10,177	54	0.5%
	미수금	3,111,442	30,708	1.0%
	선급금	1,364,111	2,304	0.2%
	장기성매출채권	1,046,252	5,421	0.5%
	장기성미수금	223,986	337	0.2%
	장기성선급금	960,392	9,366	1.0%
	장기대여금	125,700	549	0.4%
	합 계	41,275,936	614,882	1.5%
제49기	매출채권	28,333,822	635,815	2.2%
	단기대여금	7,258	81	1.1%
	미수금	4,135,935	26,975	0.7%
	선급금	1,758,547	4,874	0.3%
	장기성매출채권	1,983,136	1,397	0.1%
	장기성미수금	139,472	330	0.2%
	장기성선급금	134,192	836	0.6%
	장기대여금	130,550	467	0.4%
	합 계	36,622,912	670,775	1.8%

※ 채권금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.(연결기준)

(2) 대손충당금 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제51기 3분기	제50기	제49기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	614,882	670,775	457,957
2. 순대손처리액(① - ② + ③)	△7,707	18,697	3,685
① 대손처리액(상각채권액) 등	1,774	24,721	38,584
② 상각채권회수액	7,079	6,024	559
③ 기타증감액	△2,402	-	△34,340
3. 대손상각비 계상(환입)액	△203,130	△37,196	216,503
4. 기말 대손충당금 잔액합계	419,459	614,882	670,775

※ 연결기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정 방침

1) 대손충당금 설정방침

보고기간종료일 현재 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금 설정

2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거

- 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정

[대손 설정기준]

상 황	설정률
분 정	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

- 3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생시 실대손처리
- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
 - 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
 - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
 - 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
 - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	41,671,703	67,398	148,696	39,339	41,927,136
구성비율	99.3%	0.2%	0.4%	0.1%	100.0%

※ 매출채권잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.(연결기준)

다. 재고자산 현황

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

부문	사업	계정과목	제51기 3분기말	제50기말	제49기말	비고
CE		제품 및 상품	2,341,397	1,606,820	1,827,162	
		반제품 및 재공품	252,201	112,043	110,179	
		원재료 및 저장품	2,910,077	2,445,758	2,505,575	
		미착품	2,111,812	1,916,504	1,684,923	
		소 계	7,615,487	6,081,125	6,127,839	
IM		제품 및 상품	2,837,445	2,525,787	2,327,139	
		반제품 및 재공품	526,639	624,129	721,194	
		원재료 및 저장품	3,491,651	3,305,566	4,541,940	
		미착품	595,043	715,361	867,103	
		소 계	7,450,778	7,170,843	8,457,376	
DS	반도체	제품 및 상품	1,566,749	2,498,132	1,094,967	
		반제품 및 재공품	9,710,896	9,378,528	5,179,312	
		원재료 및 저장품	1,270,094	863,607	659,223	
		미착품	72,151	22,697	39,312	
		소 계	12,619,890	12,762,964	6,972,814	
	DP	제품 및 상품	526,024	549,432	746,856	
		반제품 및 재공품	660,580	559,960	638,268	
		원재료 및 저장품	841,781	720,622	849,786	
		미착품	33,870	82,677	133,038	
		소 계	2,062,255	1,912,691	2,367,948	
	DS 계	제품 및 상품	2,126,899	3,107,878	1,872,648	
		반제품 및 재공품	10,412,880	10,297,065	6,256,420	
		원재료 및 저장품	2,140,233	1,741,613	1,708,632	
		미착품	106,353	48,306	64,934	
		소 계	14,786,365	15,194,862	9,902,634	
Harman		제품 및 상품	809,278	558,014	432,184	
		반제품 및 재공품	103,546	87,751	77,696	
		원재료 및 저장품	382,791	363,432	322,649	
		미착품	273,386	141,524	140,939	
		소 계	1,569,001	1,150,721	973,468	
총 계		제품 및 상품	9,279,291	8,836,098	7,304,437	
		반제품 및 재공품	11,237,187	11,066,511	7,113,901	
		원재료 및 저장품	9,039,406	8,048,139	9,413,217	
		미착품	1,352,878	1,033,956	1,151,800	
		소 계	30,908,762	28,984,704	24,983,355	

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]	8.7%	8.5%	8.3%	
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고 + 기말재고)÷2}]	4.8회	4.9회	6.0회	

(2) 재고자산의 실사내역 등

1) 실사내역

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

2) 실사방법

- 사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시
 - ※ 반도체 및 DP 라인재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
 - 사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고에 대해선 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
 - 외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인
- ※ 최근 재고실사는 본사(별도)의 경우 2019년 5월 31일, 6월 1일, 6월 3일에 진행하였으며, 종속법인의 경우 동일 시기에 재고실사를 진행하였습니다.

(3) 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법 등을 사용하여 재고자산의 재무상
태표가액을 결정하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	당분기말잔액
제품 및 상품	9,861,373	9,861,373	△582,082	9,279,291
반제품 및 재공품	11,812,131	11,812,131	△574,944	11,237,187
원재료 및 저장품	9,558,883	9,558,883	△519,477	9,039,406
미착품	1,352,878	1,352,878	-	1,352,878
합 계	32,585,265	32,585,265	△1,676,503	30,908,762

※ 연결기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

라. 공정가치평가 방법 및 내역

(1) 평가방법

[금융자산]

(분류)

2018년 1월 1일부터 당사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

- 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)
- 상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산

계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금 흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

(금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

[금융부채]

(분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

- 당기손익-공정가치 측정 금융부채. 파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
- 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채. 이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
- 금융보증계약. 최초 인식시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정. 최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가. 이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

(제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

[과생상품]

당사는 과생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 과생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 금융수익 또는 금융비용으로 인식하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	26,604,994	-	-	-	26,604,994
단기금융상품	69,476,971	-	-	-	69,476,971
매출채권	40,367,204	-	-	-	40,367,204
상각후원가금융자산	4,156,542	-	-	-	4,156,542
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	8,728,038	-	-	8,728,038
당기손익-공정가치금융자산	-	-	2,805,500	-	2,805,500
기타	9,716,944	-	214,594	35,178	9,966,716
계	150,322,655	8,728,038	3,020,094	35,178	162,105,965

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	11,422,269	-	-	11,422,269
단기차입금	2,208,002	-	10,122,246	12,330,248
미지급금	8,630,882	-	-	8,630,882
유동성장기부채	40,667	-	751,800	792,467
사채	1,008,058	-	-	1,008,058
장기차입금	-	-	2,002,565	2,002,565
장기미지급금	2,057,513	2,403	-	2,059,916
기타	8,818,522	176,073	7,204	9,001,799
계	34,185,913	178,476	12,883,815	47,248,204

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	30,340,505	-	-	-	30,340,505
단기금융상품	65,893,797	-	-	-	65,893,797
매출채권	33,867,733	-	-	-	33,867,733
상각후원가금융자산	2,942,002	-	-	-	2,942,002
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	7,301,351	-	-	7,301,351
당기손익-공정가치금융자산	-	-	2,777,375	-	2,777,375
기타	9,229,044	-	58,127	25,962	9,313,133
계	142,273,081	7,301,351	2,835,502	25,962	152,435,896

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	8,479,916	-	-	8,479,916
단기차입금	1,456,201	-	12,130,459	13,586,660
미지급금	9,779,287	-	-	9,779,287
유동성장기부채	33,386	-	-	33,386
사채	961,972	-	-	961,972
장기차입금	85,085	-	-	85,085
장기미지급금	2,846,585	13,417	-	2,860,002
기타	8,789,800	32,284	10,439	8,832,523
계	32,432,232	45,701	12,140,898	44,618,831

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(3) 공정가치 측정

보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	26,604,994	(*1)	30,340,505	(*1)
단기금융상품	69,476,971	(*1)	65,893,797	(*1)
단기상각후원가금융자산	4,021,901	(*1)	2,703,693	(*1)
단기당기손익-공정가치금융자산	1,842,611	1,842,611	2,001,948	2,001,948
매출채권	40,367,204	(*1)	33,867,733	(*1)
상각후원가금융자산	134,641	(*1)	238,309	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	8,728,038	8,728,038	7,301,351	7,301,351
당기손익-공정가치금융자산	962,889	962,889	775,427	775,427
기타(*2)	9,966,716	249,772	9,313,133	84,089
소 계	162,105,965		152,435,896	
금융부채				
매입채무	11,422,269	(*1)	8,479,916	(*1)
단기차입금	12,330,248	(*1)	13,586,660	(*1)
미지급금	8,630,882	(*1)	9,779,287	(*1)
유동성장기부채(*3)	792,467	(*1)	33,386	(*1)
사채	1,008,058	1,059,938	961,972	964,182
장기차입금(*3)	2,002,565	(*1)	85,085	(*1)
장기미지급금(*2)	2,059,916	2,403	2,860,002	13,417
기타(*2)	9,001,799	183,277	8,832,523	42,723
소 계	47,248,204		44,618,831	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 9,716,944백만원(전기: 9,229,044 백만원)

및 금융부채 10,876,035백만원(전기: 11,636,385백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다

(*3) 유동성장기부채와 장기차입금 중 리스부채는 기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외 하였습니다.

보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	3,829,183	-	4,898,855	8,728,038
당기손익-공정가치금융자산	147,782	25,954	2,631,764	2,805,500
기타	-	249,772	-	249,772
금융부채				
사채	-	1,059,938	-	1,059,938
장기미지급금	-	-	2,403	2,403
기타	-	183,277	-	183,277

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,884,633	-	4,416,718	7,301,351
당기손익-공정가치금융자산	10,124	18,503	2,748,747	2,777,375
기타	-	84,089	-	84,089
금융부채				
사채	-	964,182	-	964,182
장기미지급금	-	-	13,417	13,417
기타	-	41,639	1,085	42,723

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- 수준 2: 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)
- 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

당사는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 수준 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 수준 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래 현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	수준 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산				
(주)말타니	10,923	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0% ~ 1.0%(0%)
			가중평균자본비용	8.8% ~ 10.8%(9.8%)
삼성벤처투자(주)	7,720	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0% ~ 1.0%(0%)
			가중평균자본비용	17.5% ~ 19.5%(18.5%)
Corning Incorporated 전환우선주	4,058,926	삼항모형	위험 할인율	4.3% ~ 6.3%(5.3%)
			가격 변동성	22.3% ~ 28.3%(25.3%)
장기미지급금				
조건부금융부채	2,403	확률가중모형	확률적용률	50.0%

(수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위 : 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	7,165,466	3,652,574
매입	3,142,151	247,848
매도	△3,277,968	△59,039
평가(당기손익)	25,104	14,064
평가(기타포괄손익)	384,555	335,396
기타(*)	91,311	1,176,132
분기말	7,530,619	5,366,975

(*) 기타는 회계변경누적효과 등을 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	당분기	전분기
기초	14,502	351,918
결제	△1,127	△322,920
평가(당기손익)	△11,617	5,992
기타	644	862
분기말	2,403	35,852

[△는 부(-)의 값임]

(수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*)	-	167,762	-	△126,446

(*) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0% ~ 1.0%)과 변동성(22.3% ~ 28.3%) 및 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

(4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다.

마. 채무증권 발행실적 등

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자(주)	회사채	공모	1997.10.02	120,130	7.7%	AA-(S&P), Aa3(Moody's)	2027.10.01	일부상환	골드만삭스 외
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015.05.06	480,520	4.2%	Baa1 (Moody's), A (S&P)	2025.05.15	미상환	J.P.모건 외
Harman Finance International, SCA	회사채	공모	2015.05.20	460,127	2.0%	Baa1 (Moody's), A (S&P)	2022.05.27	미상환	HSBC 외
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.01.08	20,000	2.7%	A1	2019.04.05	상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.01.23	25,000	2.7%	A1	2019.04.19	상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.01.30	40,000	2.7%	A1	2019.04.26	상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.02.01	10,000	2.7%	A1	2019.04.29	상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.03.06	10,000	2.7%	A1	2019.06.04	상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.04.04	10,000	2.7%	A1	2019.07.02	상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.04.11	25,000	2.7%	A1	2019.07.09	상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.06.25	50,000	2.2%	A1	2019.09.23	상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.07.09	30,000	2.2%	A1	2019.10.07	미상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.07.11	20,000	2.2%	A1	2019.10.08	미상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.08.13	15,000	1.9%	A1	2019.11.11	미상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.08.27	30,000	1.9%	A1	2019.11.25	미상환	-
세메스(주)	기업어음증권	사모	2019.09.11	25,000	2.0%	A1	2019.12.09	미상환	-
합 계	-	-	-	1,370,777	-	-	-	-	-

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

※ 상기 기업어음증권의 평가기관은 나이스신용평가(주), 한국기업평가(주)입니다.

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족 여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US\$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	120,130	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2019년 09월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	해당 없음
	이행현황	해당 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 중 (해당자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중 ('19년 중 처분 자산은 전체의 0.1%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당 없음
	이행현황	해당 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당 없음

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.는

Fiscal Agent의 지위에 있습니다.

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의 작성기준일입니다.

※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	50,000	-	70,000	-	-	-	-	-	120,000
	합계	50,000	-	70,000	-	-	-	-	-	120,000

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없음

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	6,006	6,007	466,134	6,007	6,007	504,545	-	994,706
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	6,006	6,007	466,134	6,007	6,007	504,545	-	994,706

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(삼성전자)

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	6,006	6,007	6,007	6,007	6,007	24,025	-	54,059
	합계	6,006	6,007	6,007	6,007	6,007	24,025	-	54,059

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(Harman)

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	460,127	-	-	480,520	-	940,647
	합계	-	-	460,127	-	-	480,520	-	940,647

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

해당사항 없음

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

해당사항 없음

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

삼일회계법인은 당사의 제49기, 제50기 감사 및 제51기 3분기 검토를 수행하였고, 감사 관련하여 제49기, 제50기 감사의견은 모두 적정이며, 제51기 3분기 검토 결과 재무제표에 한 국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 당사의 종속기업은 제51기 3분기말 현재 246개이며, 당분기 중 인수한 FOODIENT LTD.는 PwC, Corephotonics Ltd.는 E&Y를 외부감사인으로 선임하였습니다. 또한 당분기 중 신규 설립된 종속기업 Samsung Display Noida Private Limited(SDN)는 PwC를 외부감사인으로 선임하였습니다. 회계감사인의 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제51기 3분기	삼일회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음
제50기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음
제49기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 상기 감사의견은 별도·연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

[제51기 일정]

구 분		일 정
제51기 1분기	사전검토	2019.03.04 ~ 2019.03.22
	본검토	2019.04.05 ~ 2019.05.13
제51기 반기	사전검토	2019.06.03 ~ 2019.06.21
	본검토	2019.07.05 ~ 2019.08.13
제51기 3분기	사전검토	2019.09.02 ~ 2019.09.20
	본검토	2019.10.07 ~ 2019.11.12

※ 상기 일정은 별도·연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내용	보수	총소요시간
제51기 3분기	삼일회계법인	별도 및 연결 분·반기 재무제표 검토	2,195	23,600
제50기(전기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	4,400	50,401
제49기(전전기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	4,030	46,576

당사의 감사인인 삼일회계법인은 회계감사 용역 외에 하기 내용의 비감사용역을 수행하였으며, 당사는 용역의 대가로 제51기 3분기에 258백만원을 지급하였습니다.

[비감사용역 계약체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수
제51기 3분기	2019년 2월	기타 업무	2019.02~2019.09	258
제50기(전기)	2017년 11월	세무자문업무	2018.01~2018.03	194
	2018년 12월	세무자문업무	2018.12~2018.12	149
	2016년 12월	관세 등 관련 자문업무	2018.01~2018.12	253
	소 계			596
제49기(전전기)	2017년 1월	세무자문업무	2017.01~2017.12	196
	2016년 12월	관세 등 관련 자문업무	2017.01~2017.12	810
	소 계			1,006

2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항
제51기 3분기	삼일회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음
제50기(전기)	삼일회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부 회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
제49기(전전기)	삼일회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부 회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일(2019년 9월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(이상훈, 이재용, 김기남, 김현석, 고동진)과 사외이사 6인(박재완, 김선욱, 박병국, 김종훈, 안규리, 김한조), 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 CFO를 역임하여 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이상훈 이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회는 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 거버넌스위원회 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할
이사회	사내이사 5명, 사외이사 6명	이상훈, 이재용, 김기남, 김현석, 고동진, 박재완, 김선욱, 박병국, 김종훈, 안규리, 김한조	이상훈 (사내이사)	· 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 · 경영진의 업무집행 감독
경영위원회	사내이사 3명	김기남, 김현석, 고동진	김기남 (사내이사)	· 경영 일반, 재무 관련사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의·결의
감사위원회	사외이사 3명	박재완, 김선욱, 김한조	박재완 (사외이사)	· 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사
사외이사후보 추천위원회	사외이사 3명	김종훈, 박병국, 안규리	김종훈 (사외이사)	· 사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천
내부거래위원회	사외이사 3명	김선욱, 박재완, 김한조	김선욱 (사외이사)	· 자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고
보상위원회	사외이사 3명	박재완, 박병국, 김종훈	-	· 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보
거버넌스위원회	사외이사 6명	박재완, 김선욱, 박병국, 김종훈, 안규리, 김한조	박재완 (사외이사)	· 사회적 책임을 다하고 주주 가치를 제고하기 위한 역할 수행

※ 2019년 3분기말 기준입니다.

※ 2019년 3월 20일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴임하고 주주총회를 통해 박재완 사외이사가 재선임되고 김한조, 안규리 사외이사가 신규 선임되었습니다.

※ 2019년 10월 26일 이재용 사내이사가 임기만료 퇴임하였습니다.

※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이상훈, 김기남, 김현석, 고동진), 사외이사 6인(박재완, 김선욱, 박병국, 김종훈, 안규리, 김한조), 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다.

※ 보상위원회 위원장은 차기 위원회 개최시 선임 예정입니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사					사외이사					
			이상훈	이재용	김기남	김현석	고동진	이인호	송광수	김선욱	박재완	박병국	김중훈
'19.01.31 (1차)	① 2018년(제50기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	② 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	③ 2019년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	④ 삼성디스플레이와 임대차계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	⑤ 삼성SDI주와 연구설비 매매 및 임대차계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	⑥ 2019년 사회공헌 매칭기금 운영계획 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	⑦ 삼성공정학재단 기부금 출연의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건													
'19.02.26 (2차)	① 제50기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	② 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 - 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	- 제1호: 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건												
	- 제2호: 이사 선임의 건 · 제2-1호: 사외이사 선임의 건 · 제2-2호: 감사위원회 위원 선임의 건												
	- 제3호: 이사 보수한도 승인의 건												
	③ 생산물 배상책임보험 가입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
④ 국제기능올림픽 후원의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
⑤ 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	

※ 2019년 3월 20일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴임하고 주주총회를 통해 박재완 사외이사가 재선임되었습니다.

※ 2019년 2차 이사회 안건 중 '⑤ 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건'은 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되므로,

안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사인 김기남 대표이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다.

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사					사외이사					
			이상훈	이재용	김기남	김현석	고동진	박재완	김선욱	박병국	김중훈	안규리	김한조
'19.03.20 (3차)	① 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	② 이사 보수 책정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'19.04.30 (4차)	① 2019년 1분기 보고서 및 분기배당 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	② 신기술사업투자조합 가입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	③ PLP사업 영업양수의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	④ 사원 단체보험 가입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	⑤ 사회공헌 기부금 출연의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	⑥ 산업안전보건 발전기금 출연의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	⑦ DS부문 우수협력사 인센티브 기금 출연의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
'19.07.31 (5차)	① 2019년 반기보고서 및 2분기 배당 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	② 감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	③ 사업장 패키지보험 가입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	④ 대구·경북창조경제혁신센터 창업지원사업의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2019년 3월 20일 주주총회를 통해 박재완 사외이사가 재선임되고 김한조, 안규리 사외이사가 신규 선임되었습니다.

※ 2019년 10월 26일 이재용 사내이사가 임기만료 퇴임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	사내이사 3명	김기남(위원장), 김현석, 고동진	하단 기재내용 참조	-
내부거래위원회	사외이사 3명	김선욱(위원장), 박재완, 김한조	하단 기재내용 참조	-
보상위원회	사외이사 3명	박재완, 박병국, 김종훈	하단 기재내용 참조	-
거버넌스위원회	사외이사 6명	박재완(위원장), 김선욱, 박병국, 김종훈, 안규리, 김한조	하단 기재내용 참조	-

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2019년 3분기말 기준입니다.

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

※ 보상위원회 위원장은 차기 위원회 개최시 선임 예정입니다.

□ 경영위원회

- 설치목적: 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.
경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.
- 권한사항: 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함

1. 경영일반에 관한 사항

- 1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
- 2) 주요 경영전략
- 3) 사업계획·사업구조 조정 추진
- 4) 해외 지점·법인의 설치, 이전 및 철수
- 5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
- 6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)
- 7) 기타 주요 경영현황
- 8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
- 9) 지배인의 선임 또는 해임
- 10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
- 11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
- 12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
- 13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 과기
- 14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
- 15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는 공급계약 체결 또는 해지
- 16) 조직의 운영에 관한 기본원칙
- 17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
- 18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
- 19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
- 20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항

- 1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분
- 2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자
- 3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는 신규 채무보증(기간 연장은 제외함)
 - 담보: 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함
 - 채무보증: 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외.
- 4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)
- 5) 내부거래의 승인
내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 50억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)
- 6) 사채발행
- 7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로 인한 경우에 한함
- 8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회가 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

□ 내부거래위원회

- 설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항
 - 내부거래 보고 청취권: 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음
 - ※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억원 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
 - 내부거래 직권조사 명령권
 - 내부거래 시정조치 건의권

□ 보상위원회

- 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함
- 권한사항
 - 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
 - 등기이사에 대한 보상체계
 - 기타 이사회에서 위임한 사항

□ 거버넌스위원회

- 설치목적: 기업의 사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위함
- 권한사항
 - 회사의 사회적 책임과 관련된 사항
 - 주주가치 제고와 관련된 사항
 - 주주환원 정책 사전심의
 - 주주권익 개선을 위한 각종 활동 검토
 - 기타 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항 검토
 - 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항
 - 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명		
				김기남 (출석률:100%)	김현석 (출석률:100%)	고동진 (출석률:67%)
				찬 반 여 부		
경영위원회	'19.02.15	① 라이선스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		② 해외법인 합병의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	'19.03.08	① 해외법인 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		② 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	'19.04.05	① 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		② 팅택 단지 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		③ 파운드리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성
④ 해외법인 청산의 건		가결	찬성	찬성	찬성	
'19.06.07	① 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	불참	
'19.07.05	① 파운드리 투자의 건	가결	찬성	찬성	불참	
'19.08.30	① 해외법인 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	
	② 파운드리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명					
				이인호 (출석률: 100%)	송광수 (출석률: 100%)	김선욱 (출석률: 100%)	박재완 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: 100%)	
				찬 반 여부					
내부거래 위원회	'19.01.30	① 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 삼성디스플레이㈜와 임대차계약 체결의 건 2) 삼성SDI㈜와 연구설비 매매 및 임대차계약 체결의 건 ② '18년 4/4분기 내부거래 현황 보고	-	-	-	-	-	해당 사항 없음 (신규 선임)	해당 사항 없음 (신규 선임)
	'19.02.26	① 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 생산물 배상책임보험 가입의 건	-	-	-	-	-	-	
	'19.04.29	① 내부거래위원회 위원장 선임의 건 ② 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 신기술사업투자조합 가입의 건 2) PLP사업 영업양수의 건 3) 사원 단체보험 가입의 건 4) 사회공헌 기부금 출연의 건 ③ '19.1/4분기 내부거래 현황 보고	가결 -	해당 사항 없음 (임기 만료)	해당 사항 없음 (임기 만료)	찬성 -	찬성 -	찬성 -	
	'19.07.30	① 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 사업장 패키지보험 가입의 건 ② '19.2/4분기 내부거래 현황 보고	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

※ 2019년 3월 20일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴임하고 박재완, 김한조 사외이사가 위원으로 선임되었습니다.

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명				
				송광수 (출석률:100%)	이인호 (출석률:100%)	김중훈 (출석률:100%)	박재완 (출석률: -)	박병국 (출석률: -)
				찬반여부				
보상 위원회	'19.02.25	① 2019년 이사보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)

※ 2019년 3월 20일 송광수, 이인호 사외이사가 임기만료 퇴임하고 박재완, 박병국 사외이사가 위원으로 선임되었습니다.

□ 거버넌스위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명							
				이인호 (출석률: -)	송광수 (출석률: -)	박재완 (출석률: 100%)	김선욱 (출석률: 100%)	박병국 (출석률: 100%)	김중훈 (출석률: 100%)	안규리 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: 100%)
				찬반여부							
거버넌스 위원회	'19.04.30	① 위원장 선임의 건	가결	해당사항	해당사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'19.07.31	※ 보고사항 ① IR동향 보고의 건	-	없음 (임기만료)	없음 (임기만료)	-	-	-	-	-	-

※ 2019년 3월 20일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴임하고 안규리, 김한조 사외이사가 위원으로 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융, ESG 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령·정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

각 이사의 주요경력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기 (연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관 계
사내이사	이상훈	'18.03~'21.03 (해당없음)	2013년부터 2017년까지 최고재무책임자(CFO)를 역임한 재무 및 경영지원 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단	이사회	이사회 의장	해당없음	특수관계인
사내이사	이재용	'16.10~'19.10 (해당없음)	최고운영책임자(COO)로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 사업재편 등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	이사회	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인
사내이사 (대표이사)	김기남	'18.03~'21.03 (해당없음)	종합기술원장, 메모리 사업부장, 반도체 총괄 등을 역임한 반도체 분야 최고 권위자로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 미래의 불확실한 시장 상황에서도 당사 부품사업이 선두 위치를 공고히 하는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	DS부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인
사내이사 (대표이사)	김현석	'18.03~'21.03 (해당없음)	디스플레이 제품 분야의 최고 개발 전문가로서 당사가 글로벌 TV 1위를 달성하는데 주도적인 역할을 한 경험을 바탕으로 성공 DNA를 생활가전 등 타 사업 부문으로 전파하여 CE부문 사업의 시너지 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	CE부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인
사내이사 (대표이사)	고동진	'18.03~'21.03 (해당없음)	모바일사업 분야의 개발 전문가로서 갤럭시 신화를 일구며 모바일 사업 일류화를 선도하는데 기여하였으며 스마트폰 시장의 성장 둔화, 경쟁 심화 등 어려운 경영 여건에서도 당사가 First mover로 거듭나는 데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	IM부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인
사외이사	박재완	'16.03~'22.03 (1회)	국정운영 및 정책기획과 관련한 풍부한 경험을 보유한 재무 및 공공부문 전문가로서 행정과 재무에 대한 전문성을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	김선욱	'18.03~'21.03 (해당없음)	법학전문대학원 교수와 법제처장을 역임한 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	박병국	'18.03~'21.03 (해당없음)	전기·정보공학부 교수이자 반도체 플래시 메모리 분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김종훈	'18.03~'21.03 (해당없음)	IT분야의 통신 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량과 함께 IT산업에 대한 통찰력과 광범위한 네트워크를 통한 글로벌 경영 감각으로 이사회에 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	안규리	'19.03~'22.03 (해당없음)	소외계층과 공익을 위해 활동해 온 의료 전문가로서 최근기업 경영의 핵심이슈가 되고 있는 환경안전, 보건, 사회공헌 등 ESG 분야에서 이사회에 도움을 주고 회사가 사회와 더욱 소통하고 지속가능경영을 실현하는데 기여할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
사외이사	김한조	'19.03~'22.03 (해당없음)	은행장을 역임한 재무전문가이자 전문 경영인이며 현재 사회공헌 재단을 맡고 있어 경영 전반에 대한 조연 외에 재무 전문성 및 상생·나눔경영 역량을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2019년 3분기말 기준입니다.

※ 2019년 10월 26일 이재용 사내이사가 임기만료 퇴임하였습니다.

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 「상법」 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

(2) 사외이사후보 추천위원회

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2019년 9월 30일) 현재 위원회는 사외이사 3인(김종훈, 박병국, 안규리)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.(「상법」 제542조의8 제4항의 규정 충족)

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명			
			김종훈 (출석률:100%)	박재완 (출석률:100%)	박병국 (출석률:100%)	안규리 (출석률: -)
			찬 반 여부			
'19.01.31	① 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항
	② 사외이사후보 추천일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	없음
'19.02.25	① 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	(신규선임)

※ 2019년 3월 20일 박재완 사외이사의 위원 임기가 만료되었으며 안규리 사외이사가 위원으로 선임되었습니다.

※ 2019년 2차 위원회에서 박재완 사외이사는 본인을 후보로 추천하는 결의에 의결권을 행사하지 않았습니다.

(3) 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무 담당기간)	주요 활동내역
인사팀	6	부사장 1명(33년 7개월 / 4년 2개월), 전무 1명(28년 10개월 / 9개월), 상무 1명(26년 7개월 / 9개월), 직원(Senior Professional) 3명 (평균 13년 5개월 / 평균 2년 7개월)	<ul style="list-style-type: none"> • 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원 • 사외이사 교육 및 직무수행 지원 • 이사후보에 대한 데이터베이스 구축 • 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공 • 회의 진행을 위한 실무 지원 • 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

※ 2019년 3분기말 기준입니다.

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실시 현황

① 국내외 경영현장 점검

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
'17.5월	인사팀 및 해당 경영현장 경영진	이인호, 김한중, 송광수, 이병기, 박재완	해당사항 없음	경영활동 현황파악을 위한 현장 시찰
'18.1월	인사팀 및 해당 경영현장 경영진	이인호, 김한중, 송광수, 이병기, 박재완	해당사항 없음	경영활동 현황파악을 위한 현장 시찰
'18.8월	인사팀 및 해당 경영현장 경영진	이인호, 송광수, 김선욱, 박재완, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	경영활동 현황파악을 위한 현장 시찰
'19.8월	인사팀 및 해당 경영현장 경영진	박재완, 김선욱, 박병국, 김종훈, 안규리, 김한조	해당사항 없음	경영활동 현황파악을 위한 현장 시찰

② 신입 사외이사 오리엔테이션

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
'18.3월	인사팀	김선욱, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
'18.4월	인사팀 및 유관부서 경영진	김선욱, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
'19.3월	인사팀	안규리, 김한조	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
'19.4월	인사팀 및 유관부서 경영진	안규리, 김한조	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
'19.7월	인사팀 및 유관부서 경영진	안규리, 김한조	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

※ 교육 참석 대상은 신입 사외이사입니다.

③ 사외이사 공통 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
'19.1월	지원팀	이인호, 송광수, 박재완, 김선욱, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	2019년 경영계획
'19.1월	네트워크 사업부	이인호, 송광수, 박재완, 김선욱, 박병국, 김종훈	해당사항 없음	5G 기술동향 설명 및 라인투어

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2019년 3분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 박재완 위원장과 김한조 위원이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다. 박재완 위원장은 재무행정 분야 박사학위 소지자(1992년)로서 성균관대 행정학과 교수(1996~현재)로 근무하고 있고 감사원 부감사관(1983~1992년), 재무부/재정경제원 행정사무관(1992~1994년), 기획재정부 장관(2011~2013) 등을 역임하였습니다. 김한조 위원은 한국외환은행 입행(1982년) 이후 홍제역지점장(1999~2000년), 여의도종합금융지점장(2001~2002년), 강남역지점장(2004~2005년) 및 기업사업그룹장(2012~2013년), 외환캐피탈 사장(2013~2014년), 한국외환은행 은행장(2014~2015년), 하나금융지주 부회장(2015~2016년) 등을 역임하였습니다.

성 명	주 요 경 력	선 임 배 경	사외이사 여부	타회사 겸직 현황
박재완 (위원장)	<ul style="list-style-type: none"> 성균관대 행정학과, 국정전문대학원 교수(1996~현재) 기획재정부 장관(2011~2013) 고용노동부 장관(2010~2011) 제17대 국회의원(2004~2008) 	국정운영 및 정책기획과 관련한 풍부한 경험을 보유한 재무 및 공공부문 전문가로서 행정과 재무에 대한 전문성을 두루 갖추고 있어 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사	롯데쇼핑(주) 사외이사 (2016년~현재)
김선욱	<ul style="list-style-type: none"> 이화여대 법학전문대학원 명예교수(2018~현재) 이화여대 법학과(법학전문대학원) 교수(1995~2018) 이화여대 총장 (2010~2014) 법제처 처장 (2005~2007) 	법률전문가로서 전문성과 행정, 재무, 대외협력 등 조직 운영에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사	-
김한조	<ul style="list-style-type: none"> 하나금융공익재단 이사장(2019~현재) 하나금융나눔재단 이사장(2015~2019) 하나금융지주 부회장(2015~2016) 한국외환은행 은행장(2014~2015) 외환캐피탈 사장(2013~2014) 	재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	사외이사	-

※ 2019년 3월 20일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴임하고 박재완, 김한조 사외이사가 위원으로 선임되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 이사회가 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있으며, 재무전문가(박재완 위원장, 김한조 위원)와 법률전문가(김선욱 위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등
3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」 제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조
사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(2명, 박재완, 김한조)	「상법」 제542조의11 제2항, 당사 감사위원회 규정 제3조
감사위원회의 대표는 사외이사	충족	
그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」 제542조의11 제3항

감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사회부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명				
				이인호 (출석률: 100%)	송광수 (출석률: 100%)	박재완 (출석률: 100%)	김선욱 (출석률: 100%)	김한조 (출석률: 100%)
				찬 반 여부				
감사 위원회	'19.01.30	- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 2018년 내부회계관리규정 개정 승인 - 제50기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2018년 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 - 2018년 4/4분기 대외 후원금 현황 보고 - 2018년 감사팀 감사실적 보고	- 가결 - - - -	- 찬성 - - - -	- 찬성 - - - -	- 해당 사항 없음 (신규 선임)	- 찬성 - - - -	- 해당 사항 없음 (신규 선임)
	'19.02.26	- 제50기 정기주주총회 목적사항 심의 - 2018년 내부감시장치 가동현황 보고	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	'19.04.29	- 감사위원회 위원장 선임 - 제51기 1/4분기 분기보고서 보고 - 2019년 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 - 2019년 1/4분기 대외 후원금 현황 보고 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고 - 2019년 외부감사인 감사계획 및 1/4분기 검토	- 가결 - - - - - -	- - - - - - - 해당 사항 없음 (임기 만료)	- - - - - - - 해당 사항 없음 (임기 만료)	- 찬성 - - - - - -	- 찬성 - - - - - -	- 찬성 - - - - - -
	'19.07.30	- 2019년 반기보고서 보고 - 2019년 2/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 - 2019년 2/4분기 내부회계관리제도 운영실태 점검 보고 - 2019년 2/4분기 대외 후원금 현황 보고 - 감사위원회 규정 개정(안) 보고 - 외부감사인 선임규정 승인 - 2019년 상반기 감사실적 보고 - 2019년 2/4분기 외부감사인 검토 보고	- - - - - 가결 - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -

※ 2019년 3월 20일 이인호, 송광수 사외이사가 임기만료 퇴임하고 박재완, 김한조 사외이사가 위원으로 선임되었습니다.

라. 감사위원회 교육 실시 계획

당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 연 1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, 재경팀 및 감사팀이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다.

마. 감사위원회 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2019.04.29	감사팀 재경팀 인사팀 외부전문가	박재완 김선욱 김한조	해당사항 없음	입문교육
2019.07.30	외부전문가	박재완 김선욱 김한조	해당사항 없음	내부회계관리제도

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
감사팀	4	전무 1명(5년 5개월), 직원(Senior Professional) 3명(평균 1년 2개월)	감사위원회 지원
내부회계 평가지원그룹	3	상무 1명(9개월), 변호사 1명(9개월), 직원(Senior Professional) 1명(9개월)	내부회계관리제도 운영실태 평가 지원

※ 2019년 3분기말 기준입니다.

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

사. 준법지원인에 관한 사항

구 분		내 용
1. 준법지원인	성명	김영수
	나이	만51세
	최종학력	서울대 법대 학사
	현직	삼성전자 법무실 Compliance팀장 ('18년 3월~현재)
	주요경력	'00~'12: 서울지방법원, 수원지방법원 등 판사 '13.03: 삼성전자 준법경영실 상무대우 '15.12: 삼성전자 법무팀 상무대우 '18.03: 삼성전자 Compliance팀 팀장 상무대우 (겸)개인정보보호사무국장 '18.12: 삼성전자 Compliance팀 팀장 전무대우 (겸)개인정보보호사무국장
2. 이사회 결의일		2018.03.23
3. 결격요건		해당사항 없음
4. 기타		해당사항 없음

※ 2019년 3분기말 기준입니다.

아. 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과

당사는 국내외 사업장에서 정기·비정기적으로 준법 점검 활동을 수행하고 있으며, 점검 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사안은 경영 활동에 반영하여 회사 및 임직원이 제반 법규를 준수할 수 있도록 효과적인 준법 지원 활동을 하고 있습니다.

구분	점검 내용	점검 분야	점검 및 처리 결과
'19.1월	마케팅 조직 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	전반적으로 양호하며, 일부 개선 필요사항은 사내 정책 등에 따라 보완함
	해외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
	특허 출원 프로세스 점검	기술유용, 영업비밀 등	
	고객영업비밀 침해 리스크 점검	영업비밀	
'19.3월	자회사 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	
'19.4월	해외법인 자율 준법 점검	컴플라이언스 프로그램 운영 현황	
	특허 출원 프로세스 점검	기술유용, 영업비밀 등	
'19.5월	자회사 준법 점검	영업비밀, 개인정보보호 등	
	국내 사업장 정기 준법 점검	영업비밀, 지식재산 등 업무상 잠재 리스크	
'19.6월	해외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
'19.7월	해외 연구조직 자율 준법 점검	컴플라이언스 프로그램 운영 현황 등	
'19.8월	소프트웨어 불법사용 점검	비인가 소프트웨어 사용	
'19.9월	특허 출원 프로세스 점검	기술유용, 영업비밀 등	
	고객영업비밀 침해 리스크 점검	영업비밀	
	해외 생산조직 준법 점검	기술유용	
	해외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	

※ 점검시기는 각 분기별 종료월 기준입니다.

※ 각 점검은 일부 점검대상 조직을 선정하여 실시하였습니다.

자. 준법지원인 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
Compliance팀 등	53	상무 2명(평균 5년 2개월), 직원(Principal Professional) 10명(평균 6년 6개월), 변호사 14명(평균 3년 4개월), 직원(Senior Professional) 21명(평균 5년 5개월), 직원(Professional) 6명(평균 2년 7개월)	준법지원인 주요 활동 지원

※ 2019년 3분기말 기준입니다.

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
이건희	최대주주 본인	보통주	249,273,200	4.18	249,273,200	4.18	-
이건희	최대주주 본인	우선주	619,900	0.08	619,900	0.08	-
삼성물산(주)	계열회사	보통주	298,818,100	5.01	298,818,100	5.01	-
삼성복지재단	출연 재단	보통주	4,484,150	0.08	4,484,150	0.08	-
삼성문화재단	출연 재단	보통주	1,880,750	0.03	1,880,750	0.03	-
홍라희	최대주주의 배우자	보통주	54,153,600	0.91	54,153,600	0.91	-
이재용	최대주주의 자	보통주	42,020,150	0.70	42,020,150	0.70	-
삼성생명보험(주)	계열회사	보통주	508,157,148	8.51	508,157,148	8.51	-
삼성생명보험(주)	계열회사	우선주	43,950	0.01	43,950	0.01	-
삼성생명보험(주)(특별계정)	계열회사	보통주	19,048,733	0.32	19,329,524	0.32	장내매매
삼성생명보험(주)(특별계정)	계열회사	우선주	1,268,546	0.15	885,463	0.11	장내매매
삼성화재해상보험(주)	계열회사	보통주	88,802,052	1.49	88,802,052	1.49	-
이상훈	발행회사 임원	보통주	28,500	0.00	28,500	0.00	-
김기남	발행회사 임원	보통주	175,000	0.00	200,000	0.00	장내매매
김현석	발행회사 임원	보통주	99,750	0.00	99,750	0.00	-
고동진	발행회사 임원	보통주	50,000	0.00	75,000	0.00	장내매매
안규리	발행회사 임원	보통주	0	0.00	500	0.00	장내매매
김한조	발행회사 임원	보통주	0	0.00	2,175	0.00	장내매매
계		보통주	1,266,991,133	21.22	1,267,324,599	21.23	-
		우선주	1,932,396	0.23	1,549,313	0.19	-

※ 보통주 중 일부와 우선주는 의결권이 없습니다. 자세한 의결권 현황은 'I. 회사의 개요'의 '5. 의결권 현황'을 참고하시기 바랍니다.

※ 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

(최대주주 관련 사항)

- 1) 최대주주: 이건희
- 2) 경력(최근 5년간): 삼성전자 회장 (2010.3월 ~)
국제올림픽위원회 명예위원 (2017년 ~)
국제올림픽위원회 위원 (1996 ~ 2017년)
- 3) 최대주주 변동현황: 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

2. 주식의 분포현황

최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	국민연금공단	626,094,383	10.49%	-
	삼성생명보험(주)	527,486,672	8.84%	-
	BlackRock Fund Advisors	300,391,061	5.03%	주식등의 대량보유상황보고서 기준 (2019년 2월 7일 공시)
	삼성물산(주)	298,818,100	5.01%	-
우리사주조합		-	-	-

※ 2019년 9월 30일 기준입니다.(BlackRock Fund Advisors는 2019년 1월 28일 기준)

※ 삼성생명보험(주) 소유주식수 및 지분율은 특별계정 포함 기준입니다. 자세한 현황은 'I. 회사의 개요'의 '5. 의결권 현황'을 참고하시기 바랍니다.

3. 소액주주현황

보통주 기준 소액주주현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 주)

구분	주 주		보유주식		비고
	주주수	비율	주식수	비율	
소액주주	606,447	99.98%	3,640,957,839	60.99%	-
전체	606,575	100.00%	5,969,782,550	100.00%	-

※ 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주입니다.

4. 주식사무

구 분	내 용
-----	-----

정관상
신주인수권의
내용

1. 이 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 제8조 6항에서 정하는 바에 따라 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생 하였을 경우에는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 이를 처리한다.
 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 - ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
 - ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
 - ③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 - ④ 제11조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
 - ⑤ 제11조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
 - ⑥ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입 등을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우
다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.
- ☞(주) 제8조 6항
- 이 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다.
- 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.
- ☞ (주) 제11조의 3 (일반공모증자)
1. 이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제1항 제3호의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행할 수 있다.
 2. 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.
다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.
- ☞ (주) 제11조의 4 (주식매수선택권)
1. 이 회사는 임·직원(상법 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 상법이 허용하는 한도내에서 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 관련 법령이 정하는 한도까지 임·직원(이 회사의 이사를 제외한다)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
 2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는

	<p>기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임·직원으로 하되 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임·직원은 제외한다.</p> <p>3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다.</p> <p>4. 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관련 법령에서 허용하는 한도까지로 한다.</p> <p>5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년 이내에 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다. 단, 이 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 관련 법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다.</p> <p>6. 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관련 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되, 관련 법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다.</p> <p>7. 다음 각호에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <p>1. 임·직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우</p>		
결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내
주주명부폐쇄기간		1월 1일부터 1개월 간	
주권의 종류	-		
명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23		
주주의 특전	없음	공고게재신문	중앙일보

※ 2019년 9월 16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

5. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류		'19.4월	5월	6월	7월	8월	9월	
보통주	주가	최 고	47,250	45,900	47,000	47,300	45,200	49,500
		최 저	44,650	41,200	43,450	44,400	42,650	43,250
		평 균	46,061	43,024	44,866	46,215	43,840	47,295
	거래량	최고(일)	13,697,399	24,506,881	16,906,541	12,872,916	16,926,881	18,297,430
		최저(일)	5,513,658	6,562,916	6,085,066	4,717,226	5,017,381	7,006,280
		월 간	209,113	271,585	194,668	183,772	205,260	207,963
우선주	주가	최 고	38,000	37,200	38,250	38,850	37,050	40,950
		최 저	36,000	33,000	35,650	36,750	35,400	36,200
		평 균	37,152	34,786	36,847	38,041	36,124	39,145
	거래량	최고(일)	1,440,697	4,397,225	2,893,202	1,729,492	2,139,235	2,815,902
		최저(일)	417,733	558,669	741,107	292,829	425,875	395,516
		월 간	19,301	29,240	27,629	18,706	26,639	24,165

※ 월간 거래량은 천주 단위입니다.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 런던 증권거래소(보통주)]

(단위 : \$, 원, DR)

종 류		'19.4월	5월	6월	7월	8월	9월	
보통주	주가	최 고	1,042.00	991.00	1,017.00	1,007.00	963.00	1,033.00
		(W환산)	1,181,524	1,147,776	1,176,466	1,185,843	1,138,170	1,232,472
		최 저	959.50	870.50	918.00	936.00	885.00	895.00
		(W환산)	1,100,451	1,035,721	1,086,912	1,095,494	1,078,727	1,084,651
		평 균	1,009.20	910.60	953.95	979.48	904.36	991.50
	거래량	최고(일)	20,231	45,669	20,353	32,458	26,986	25,316
		최저(일)	5,319	3,195	4,994	4,992	6,589	6,186
		월 간	233	393	264	332	334	299

※ 월간 거래량은 천DR 단위입니다.

※ 원화 환산 주가는 거래일 종가 원/달러 환율 기준, 원주 1주당 1/25DR

[증권거래소명 : 룩셈부르크 증권거래소(우선주)]

(단위 : \$, 원, DR)

종 류		'19.4월	5월	6월	7월	8월	9월	
우선주	주가	최 고	835.00	796.00	832.00	825.00	778.00	854.00
		(W환산)	951,232	921,927	962,458	954,030	919,518	1,020,615
		최 저	767.00	696.00	753.00	777.00	720.00	738.00
		(W환산)	879,672	828,101	890,799	909,401	877,608	894,382
		평 균	809.70	736.14	784.00	806.43	741.38	816.52
	거래량	최고(일)	17,766	6,915	2,574	3,178	3,023	4,316
		최저(일)	605	115	159	204	176	620
		월 간	61	40	23	28	24	31

※ 월간 거래량은 천DR 단위입니다.

※ 원화 환산 주가는 거래일 종가 원/달러 환율 기준, 원주 1주당 1/25DR

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주 와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
이상훈	남	1955.06	사내이사	등기임원	상근	이사회 의장	· 경북대 경제학 학사 · (전)삼성전자 경영지원실장	28,500	-	발행회사 임원	75개월	2021.03.22
이재용	남	1968.06	사내이사	등기임원	상근	경영전반 총괄	· Harvard대 경영학 박사 수료 · 삼성전자 부회장	42,020,150	-	최대주주 의 자	36개월	2019.10.26
김기남	남	1958.04	대표이사	등기임원	상근	DS부문 경영전반 총괄	· UCLA 전자공학 박사 · 삼성전자 DS부문장	200,000	-	발행회사 임원	19개월	2021.03.22
김현석	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	CE부문 경영전반 총괄	· Portland주립대 전기 및 전자공학 석사 · 삼성전자 CE부문장	99,750	-	발행회사 임원	19개월	2021.03.22
고동진	남	1961.03	대표이사	등기임원	상근	IM부문 경영전반 총괄	· Sussex대 기술정책학 석사 · 삼성전자 IM부문장	75,000	-	발행회사 임원	19개월	2021.03.22
박재완	남	1955.01	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	· Harvard대 정책학 박사 · 성균관대 행정학과 교수	-	-	발행회사 임원	43개월	2022.03.10
김선욱	여	1952.12	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	· Konstanz대 법학 박사 · 이화여대 명예교수	-	-	발행회사 임원	19개월	2021.03.22
박병국	남	1959.04	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	· Stanford대 전기공학 박사 · 서울대 전기·정보공학부 교수	-	-	발행회사 임원	19개월	2021.03.22
김종훈	남	1960.08	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	· Maryland대 신뢰성공학 박사 · Kiswe Mobile 회장	-	-	발행회사 임원	19개월	2021.03.22
안규리	여	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	· 서울대 내과학 박사 · 서울대 의과대학 신장내과 교수	500	-	발행회사 임원	7개월	2022.03.19
김한조	남	1956.07	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	· 연세대 불어불문학 학사 · 하나금융나눔재단 이사장	2,175	-	발행회사 임원	7개월	2022.03.19

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재 하였습니다.

※ 2019년 10월 26일 이재용 사내이사가 임기만료 퇴임하였습니다.

나. 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일)

겸 직 자		겸 직 회 사		
성 명	직 위	회사명	직 위	재임 기간
박재완	사외이사	롯데쇼핑(주)	사외이사	2016년 ~ 현재

김종훈	사외이사	Kiswe Mobile	회장	2013년 ~ 현재
-----	------	--------------	----	------------

다. 미등기임원

(기준일 : 2019년 09월 30일)

성명	직위	출생 연월	성별	담당업무	약력	학력	최대주주 와의 관계	재직기 간 (개월)	상근 여부
이건희	회장	1942.01	남	회장	대표이사 회장	서울대(博士)	본인		비상근
권오현	회장	1952.10	남	종합기술원 회장	대표이사 부회장	Stanford Univ.(博士)	해당없음		상근
신중균	부회장	1956.01	남	인재개발담당	대표이사 사장	광운대	해당없음		상근
윤부근	부회장	1953.02	남	Corporate Relations담당	대표이사 사장	한양대	해당없음		상근
김상균	사장	1958.07	남	법무실장	준법경영실장	서울대	해당없음		상근
전동수	사장	1958.08	남	의료기기사업부장	삼성에스디에스 대표이사	경북대(碩士)	계열회사 임원		상근
성인희	사장	1957.01	남	의료사업일류화추진단장	정밀화학 대표이사	경희대	해당없음		상근
정현호	사장	1960.03	남	사업지원T/F장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(碩士)	해당없음		상근
강인엽	사장	1963.07	남	System LSI사업부장	System LSI SOC개발실장	Univ. of California, LA(博士)	해당없음		상근
노희찬	사장	1961.10	남	경영지원실장	삼성디스플레이 경영지원실장	연세대	해당없음		상근
정은승	사장	1960.08	남	Foundry사업부장	반도체연구소장	Univ. of Texas, Arlington(博士)	해당없음		상근
진교영	사장	1962.08	남	메모리사업부장	메모리 DRAM개발실장	서울대(博士)	해당없음		상근
한중희	사장	1962.03	남	영상디스플레이사업부장	영상디스플레이 개발팀장	인하대	해당없음		상근
노태문	사장	1968.09	남	무선 개발실장	무선 개발2실장	포항공대(博士)	해당없음		상근
조준형	부사장대우	1960.08	남	법무실 법무팀장	CEO 보좌역	동아대	해당없음		상근
강경훈	부사장	1964.08	남	제도개선T/F	인사팀 담당임원	경찰대	해당없음		상근
엄영훈	부사장	1960.03	남	복미총괄	복미副总괄	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
이상철	부사장	1960.06	남	동남아총괄	무선 전략마케팅실장	인하대	해당없음		상근
이영희	부사장	1964.11	여	글로벌마케팅센터장	무선 마케팅팀장	Northwestern Univ. (碩士)	해당없음		상근
박병대	부사장	1959.02	남	한국총괄	생활가전 전략마케팅팀장	한국외국어대	해당없음		상근
박중환	부사장	1961.12	남	전장사업팀장	생활가전 C&M사업팀장	연세대(碩士)	해당없음		상근
배영창	부사장	1961.09	남	Foundry 전략마케팅팀장	System LSI 전략마케팅팀장	명지대	해당없음		상근
안중현	부사장	1963.03	남	사업지원T/F 담당임원	기획팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
엄대현	부사장대우	1966.03	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	한양대	해당없음		상근
왕통	부사장	1962.06	남	중국전략협력실 담당임원	SCIC 담당임원	北京郵電大	해당없음		상근
김문수	부사장	1963.01	남	구주총괄	영상전략마케팅팀장	고려대	해당없음		상근
김용관	부사장	1963.12	남	의료기기 전략지원담당	지원팀 담당임원	Thunderbird(碩士)	해당없음		상근
남공범	부사장	1964.01	남	재경팀장	경영지원팀 담당임원	고려대	해당없음		상근
데이빗스틸	부사장	1966.09	남	복미총괄 대외협력팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	MIT(博士)	해당없음		상근
정태경	부사장	1963.10	남	LED사업팀장	Test&Package센터장	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
주은기	부사장	1962.01	남	상생협력센터장	상생협력센터 대외협력팀장	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
최경식	부사장	1962.03	남	무선 전략마케팅실장	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대(碩士)	해당없음		상근
최윤호	부사장	1963.01	남	사업지원T/F 담당임원	무선 지원팀장	성균관대	해당없음		상근
최주선	부사장	1963.05	남	DS부문 미주총괄	메모리 전략마케팅팀장	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
계승교	부사장	1963.12	남	SSIC 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(碩士)	해당없음	39	상근
권계현	부사장	1964.07	남	중국총괄	SCIC Mobile Div.장	Univ. of Edinburgh (碩士)	해당없음		상근
박용기	부사장	1963.04	남	인사팀장	무선 인사팀장	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
신명훈	부사장대우	1965.01	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)	해당없음		상근
장시호	부사장	1961.07	남	글로벌품질혁신실장	글로벌기술센터장	한양대	해당없음		상근

최철	부사장	1962.05	남	메모리 전략마케팅팀장	DS부문 중국총괄	清華大(碩士)	해당없음		상근
김석기	부사장	1962.11	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Global운영센터장	한양대	해당없음		상근
김정환	부사장	1958.01	남	중남미총괄	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	한국외국어대	해당없음		상근
이상훈	부사장	1959.07	남	생활가전 Global운영센터장	생활가전 메카솔루션팀장	동아대	해당없음		상근
장성진	부사장	1965.07	남	메모리 품질보증실장	메모리 DRAM개발실장	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
최시영	부사장	1964.01	남	메모리제조기술센터장	Foundry제조기술센터장	The Ohio State Univ. (博士)	해당없음		상근
한재수	부사장	1962.06	남	System LSI 전략마케팅팀장	메모리 전략마케팅팀장	성균관대	해당없음		상근
홍현철	부사장	1961.01	남	서남아총괄	SELA법인장	한국외국어대	해당없음		상근
황정욱	부사장	1965.04	남	무선 제품기술팀장	무선 개발실 담당임원	인하대	해당없음		상근
강봉구	부사장	1962.02	남	생활가전 전략마케팅팀장	생활가전 전략마케팅 담당임원	홍익대	해당없음		상근
강봉용	부사장	1964.01	남	DS부문 경영지원실장	DS부문 지원팀장	고려대	해당없음		상근
김경준	부사장	1965.02	남	무선 Global CS팀장	무선 개발2실 담당임원	한양대(碩士)	해당없음		상근
김원경	부사장	1967.08	남	Global Public Affairs팀장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(碩士)	해당없음		상근
김재윤	부사장	1963.03	남	기획팀장	삼성경제연구소 산업전략1실장	서울대(博士)	해당없음	45	상근
김중성	부사장	1964.02	남	영상디스플레이 지원팀장	삼성디스플레이 경영지원팀장	서울대	해당없음		상근
명성완	부사장	1962.03	남	중동총괄	SEG법인장	한국외국어대	해당없음		상근
박경군	부사장	1962.10	남	무선 구매팀장	무선 구매팀 담당임원	동아대	해당없음		상근
박찬춘	부사장	1962.04	남	기흥/화성/평택단지장	SAS법인장	電氣通信大學(博士)	해당없음		상근
백수현	부사장	1963.01	남	커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대	해당없음		상근
백홍주	부사장	1961.12	남	Test & System Package총괄	메모리제조기술센터장	인하대	해당없음		상근
안덕호	부사장대우	1968.07	남	DS부문 법무지원팀장	법무실 담당임원	서울대	해당없음		상근
양걸	부사장	1962.10	남	DS부문 중국총괄	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서강대(碩士)	해당없음		상근
윤철운	부사장	1962.11	남	영상디스플레이 Global운영팀장	영상디스플레이 Global CS팀장	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
이돈태	부사장	1968.09	남	디자인경영센터장	디자인경영센터副主任장	연세대(博士)	해당없음	57	상근
이명진	부사장	1958.08	남	IR팀장	IR그룹장	State Univ. of New York, Buffalo	해당없음		상근
이봉주	부사장	1963.03	남	DS부문 인사팀장	System LSI 인사팀장	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
이왕익	부사장	1963.07	남	재경팀 담당임원	삼성생명 지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
전준영	부사장	1962.05	남	DS부문 구매팀장	System LSI 기획팀장	성균관대	해당없음		상근
최진원	부사장	1966.09	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대	해당없음		상근
김동욱	부사장	1963.09	남	TSE-P법인장	SEVT법인장	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
김홍경	부사장	1965.11	남	사업지원T/F 담당임원	삼성SDI 경영지원실장	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
박문호	부사장	1965.01	남	인사팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대	해당없음		상근
이승욱	부사장	1967.02	남	사업지원T/F 담당임원	기획팀 담당임원	Univ. of Akron(博士)	해당없음	59	상근
이인정	부사장대우	1961.10	남	법무실 IP센터장	법무실 IP센터 라이선싱팀장	Franklin Pierce Law Center(碩士)	해당없음		상근
전세원	부사장	1964.12	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	SSI법인 담당부장	홍익대	해당없음		상근
최정준	부사장	1965.08	남	지원팀장	지원팀 담당임원	성균관대	해당없음		상근
최주호	부사장	1963.03	남	베트남복합단지장	무선 인사팀장	아주대(碩士)	해당없음		상근
추중석	부사장	1962.09	남	영상디스플레이 영상전략마케팅팀장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(碩士)	해당없음		상근
이태협	전무	1960.05	남	성균관대(파견)	커뮤니케이션팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)	해당없음		상근
서병훈	전무	1963.07	남	IR팀 담당임원	삼성물산 IR/해외홍보팀장	Carnegie Mellon Univ.(博士)	해당없음		상근
이상주	전무대우	1970.09	남	법무실 담당임원	법무실 Compliance팀장	Harvard Univ.(碩士)	해당없음		상근

이원식	전우	1962.08	남	전장사업팀 담당임원	무선 UX혁신팀장	Texas A&M Univ. (碩士)	해당없음	상근
이종철	전우대우	1968.01	남	북미총괄 법무지원팀장	법무실 준법지원팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(碩士)	해당없음	상근
강윤제	전우대우	1968.08	남	무선 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀장	청주대	해당없음	상근
김연수	전우	1963.02	남	LED사업팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	고려대	해당없음	상근
박윤상	전우	1963.06	남	네트워크 안식년	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(博 士)	해당없음	상근
서기용	전우	1960.11	남	네트워크 전략마케팅팀장	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	상근
안정태	전우	1964.02	남	감사팀장	영상디스플레이 지원팀장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(碩士)	해당없음	상근
오수열	전우	1960.07	남	네트워크 Global운영팀장	네트워크 Global제조팀장	아주대	해당없음	상근
장호식	전우대우	1963.10	남	법무실 IP센터 IP전략팀장	IP센터 IP전략팀 담당임원	Franklin Pierce Law Center(碩士)	해당없음	상근
강원석	전우	1964.11	남	SVCC장	무선 개발실 담당임원	한양대	해당없음	상근
김정호	전우	1964.04	남	재경팀 담당임원	경영지원팀 담당임원	Emory Univ.(碩士)	해당없음	상근
이흥모	전우대우	1962.10	남	무선 개발실 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Franklin Pierce Law Center(碩士)	해당없음	상근
하혜승	전우	1967.11	여	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	Wellesley College	해당없음	상근
고승환	전우	1962.09	남	영상디스플레이 구매팀장	생활가전 구매팀장	인하대	해당없음	상근
김사필	전우	1965.04	남	상생협력센터 대외협력팀장	인사팀 담당임원	경찰대	해당없음	상근
김성진	전우	1965.03	남	생활가전 지원팀장	지원팀 담당임원	고려대	해당없음	상근
김진해	전우	1963.12	남	한국총괄 IM영업팀장	한국총괄 모바일영업팀장	광운대	해당없음	상근
목장균	전우	1964.03	남	구미지원센터장	인사팀 담당임원	고려대	해당없음	상근
성일경	전우	1964.01	남	CIS총괄	SEG법인장	연세대	해당없음	상근
심상필	전우	1965.05	남	Foundry제조기술센터장	SAS법인장	한국과학기술원(博士)	해당없음	상근
삼의경	전우	1964.10	남	무선 인사팀장	Foundry 인사팀장	한국과학기술원(碩士)	해당없음	상근
윤성희	전우	1964.12	남	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	영남대	해당없음	상근
이강협	전우	1962.12	남	한국총괄 CE영업팀장	SEA 담당임원	고려대	해당없음	상근
이민혁	전우대우	1972.02	남	디자인경영센터 디자인혁신팀장	무선 디자인팀장	경희대	해당없음	상근
이성수	전우	1964.11	남	DS부문 감사팀장	메모리 품질보증실 담당임원	경희대	해당없음	상근
최방섭	전우	1963.04	남	SEA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대	해당없음	상근
최승범	전우	1964.12	남	Samsung Research 기술전략팀장	소프트웨어센터 S/W전략팀장	한국과학기술원(碩士)	해당없음	상근
최원진	전우	1964.01	남	한국총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	상근
홍두희	전우	1964.02	남	무선 지원팀장	무선 지원팀 담당임원	Wake Forest Univ. (碩士)	해당없음	상근
김경진	전우	1963.11	남	SAMEX법인장	SESK법인장	송실대	해당없음	상근
김원수	전우	1961.08	남	SEM-P법인장	SIEL-P(N)공장장	삼성전자기술대학 (碩士)	해당없음	상근
김우준	전우	1968.05	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	차세대사업팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음	상근
나기홍	전우	1966.03	남	인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	고려대	해당없음	상근
부성중	전우	1964.10	남	경영혁신센터 담당임원	지원팀 담당임원	성균관대	해당없음	상근
스틴지아노	전우	1966.02	남	SEA 담당임원	SEA CB Div. SVP	Rutgers Univ.	해당없음	상근
이병철	전우	1965.10	남	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	淸華大(碩士)	해당없음	상근
이현식	전우	1964.12	남	한국총괄 B2B영업팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	상근
임백균	전우	1963.02	남	SCS법인장	메모리제조센터 담당임원	삼성전자기술대학 (碩士)	해당없음	상근

장의영	전우	1962.08	남	생활가전 Global CS팀장	생활가전 개발팀 담당임원	경희대	해당없음		상근
채원철	전우	1966.05	남	무선 상품전략팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	광운대	해당없음		상근
강민호	전우	1964.05	남	네트워크 지원팀장	무선 지원팀 담당임원	경북대	해당없음		상근
김기원	전우	1963.04	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	상생협력센터 담당임원	고려대(碩士)	해당없음		상근
김남용	전우	1965.06	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	연세대	해당없음		상근
김동욱	전우	1968.10	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	연세대(碩士)	해당없음		상근
김명욱	전우	1961.01	남	생활가전 Global운영센터 담당임원	SSEC법인장	인하대	해당없음		상근
김상규	전우	1968.01	남	DS부문 재경팀장	재경팀 담당임원	서울대(碩士)	해당없음		상근
김선식	전우	1964.06	남	메모리 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	성균관대(碩士)	해당없음		상근
김성환	전우	1964.07	남	TSE-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	고려대(碩士)	해당없음		상근
김영도	전우	1962.12	남	상생협력센터 구매전략팀장	상생협력센터 구매전략팀 담당부장	경북대	해당없음		상근
김이태	전우	1966.02	남	커뮤니케이션팀 담당임원	기획팀 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(博士)	해당없음	41	상근
김재훈	전우대우	1972.08	남	법무실 담당임원	법무실 Compliance팀 담당임원	Georgetown Univ. (碩士)	해당없음		상근
김현도	전우	1966.04	남	생활가전 인사팀장	영상디스플레이 인사팀장	연세대(碩士)	해당없음		상근
김철주	전우	1965.06	남	SEJ법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	광운대	해당없음		상근
더뫼라이언	전우	1962.09	남	DS부문 구주총괄	DS부문 구주총괄 담당임원	Limerick Regional Technical College	해당없음		상근
류문형	전우	1965.07	남	복미총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	서울대	해당없음		상근
문성우	전우	1971.12	남	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
바우만	전우	1966.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	Univ. of Bath(碩士)	해당없음		상근
박봉출	전우	1964.01	남	생활가전 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	숭실대	해당없음		상근
박영우	전우	1962.11	남	SESS법인장	메모리 Solution개발실 담당임원	인천대	해당없음		상근
송기찬	전우	1963.05	남	지원팀 담당임원	구주총괄 지원팀장	성균관대	해당없음		상근
송봉섭	전우	1965.04	남	인사팀 담당임원	생활가전 인사팀장	경북대	해당없음		상근
송원득	전우대우	1964.01	남	법무실 IP센터 DS IP팀장	법무실 IP센터 기술분석팀장	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
안정수	전우	1964.01	남	기흥/화성/평택단지 평택사업장	메모리제조기술센터 담당임원	고려대	해당없음		상근
오세용	전우	1962.06	남	지원팀 담당임원	동남아총괄 지원팀장	중앙대	해당없음		상근
윤성혁	전우	1962.09	남	아프리카총괄	SSA법인장	Univ of Illinois, Urbana- Champaign(碩士)	해당없음		상근
윤태양	전우	1968.12	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	고려대(碩士)	계열회사 임원		상근
이규열	전우	1966.05	남	Test&Package센터장	메모리제조기술센터 담당임원	항공대	해당없음		상근
이병국	전우	1965.11	남	SEVT법인장	SVCC장	부산대	해당없음		상근
이상배	전우	1963.03	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI TD팀 담당임원	광운대(博士)	해당없음		상근
임성택	전우	1966.06	남	SEI법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	연세대	해당없음		상근
장성대	전우	1964.08	남	기흥/화성/평택단지 환경안전센터장	기흥/화성/평택단지 건설팀장	동국대	해당없음		상근
장성재	전우	1965.06	남	사업지원T/F 담당임원	지원팀 담당임원	서강대	해당없음		상근
장재혁	전우	1967.10	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	중앙대	해당없음		상근
정해린	전우	1964.11	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당임원	고려대	해당없음		상근
조상호	전우	1965.02	남	SEG법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	경희대	해당없음		상근
주창훈	전우	1970.10	남	사업지원T/F 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(碩士)	해당없음		상근
짐엘리엇	전우	1970.11	남	DS부문 미주총괄 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.	해당없음		상근
최수영	전우	1965.11	남	중남미총괄 지원팀장	생활가전 지원팀 담당임원	고려대	해당없음		상근
최중열	전우대우	1967.06	남	생활가전 디자인팀장	생활가전 디자인 담당임원	서울대(碩士)	해당없음		상근
한승훈	전우	1965.07	남	DS부문 미주총괄 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Iowa State Univ. (博士)	해당없음		상근
권재훈	전우	1964.04	남	SEIN-S법인장	SEAU법인장	한국외국어대	해당없음		상근

권태훈	전우	1968.02	남	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	North Carolina, Chapel Hill(碩士)	해당없음	상근
김대현	전우	1964.08	남	SETK법인장	SEI법인장	한국과학기술원(碩士)	해당없음	상근
김영수	전우대우	1968.07	남	법무실 Compliance팀장	법무실 담당임원	서울대	해당없음	상근
김영호	전우	1964.12	남	감사팀 담당임원	재경팀 담당임원	Tulane Univ.(碩士)	해당없음	상근
김은중	전우	1965.06	남	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당부장	성균관대	해당없음	상근
김재준	전우	1968.01	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)	해당없음	상근
김중현	전우	1966.08	남	Foundry 인사팀장	생활가전 인사팀장	육사	해당없음	상근
김창한	전우	1963.01	남	DS부문 상생협력센터장	DS부문 기획팀 담당임원	성균관대	해당없음	상근
김철기	전우	1968.03	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SAVINA-S법인장	경북대	해당없음	상근
노형훈	전우	1964.11	남	SEV법인장	TSE-P법인장	고려대	해당없음	상근
서양석	전우	1966.10	남	경영혁신센터 담당임원	서남아총괄 지원팀장	Thunderbird(碩士)	해당없음	상근
서형석	전우	1968.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	상근
신동호	전우	1963.10	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	System LSI Global운영팀장	State Univ. of New York, Stony Brook(碩 士)	해당없음	상근
이기수	전우	1964.07	남	생활가전 상품전략팀장	생활가전 개발팀 담당임원	한양대(碩士)	해당없음	상근
이승구	전우	1969.08	남	인사팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대	해당없음	상근
이우섭	전우	1966.05	남	무선 구매팀 담당임원	무선 Global운영실 담당임원	성균관대	해당없음	상근
전경빈	전우	1966.12	남	Global CS센터장	생활가전 Global CS팀장	한국과학기술원(博士)	해당없음	상근
정광열	전우	1965.09	남	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	상근
정상섭	전우	1966.11	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI제조센터 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	상근
정원영	전우	1965.05	남	DS부문 중국총괄 담당임원	중국상생전략협력실 담당임원	고려대	해당없음	상근
정윤	전우	1967.05	남	SEDA-S판매부문장	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대(博士)	해당없음	상근
최승식	전우	1966.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SERC 담당임원	고려대	해당없음	상근
최완우	전우	1965.02	남	DS부문 인사팀 담당임원	메모리 인사팀장	서강대	해당없음	상근
허국	전우	1965.08	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	서강대	해당없음	상근
허길영	전우	1965.08	남	DS부문 재경팀 담당임원	Test&Package센터 담당임원	아주대(碩士)	해당없음	상근
김병욱	상우	1963.08	남	기흥/화성/평택단지 지원팀 담당임원	재경팀 담당임원	고려대	해당없음	상근
김종신	상우	1963.10	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	상근
양준호	상우대우	1971.02	남	무선 디자인팀 담당임원	디자인경영센터 차세대디자인팀 담당임원	세종대	해당없음	상근
이계성	상우대우	1967.11	남	구주총괄 대외협력팀장	법무실 담당임원	St. Louis Univ.(碩士)	해당없음	상근
전승준	상우	1962.06	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	한양대(碩士)	해당없음	상근
최윤범	상우	1963.02	남	SEHZ법인장	SEVT 담당임원	경원대	해당없음	상근
강동훈	상우대우	1970.12	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	Georgetown Univ. (碩士)	해당없음	상근
김도현	상우대우	1975.03	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	서울대	해당없음	상근
김동환	상우	1964.06	남	상생협력센터 베트남구매센터장	베트남복합단지 담당임원	항공대	해당없음	상근
김민섭	상우	1966.02	남	Test & System Package총괄 지원팀 장	DS부문 지원팀 담당임원	성균관대	해당없음	상근
김영수	상우	1966.08	남	한국총괄 IMC팀장	SESA법인장	서강대	해당없음	상근
김영태	상우	1963.10	남	생활가전 담당임원	생활가전 C&M사업팀장	서울대	해당없음	상근
김유석	상우대우	1965.04	남	법무실 IP센터 라이선싱팀장	법무실 IP센터 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(博士)	해당없음	상근
김정렬	상우	1963.03	남	LED사업팀 담당임원	SSW 담당임원	경희대	해당없음	상근
김태관	상우	1965.01	남	구주총괄 지원팀장	생활가전 지원팀 담당임원	고려대	해당없음	상근
박성호	상우	1968.09	남	무선 Global제조센터 담당임원	SEHZ법인장	경북대(碩士)	해당없음	상근
배학범	상우	1963.08	남	SEHC 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	경희대	해당없음	상근
안민용	상우	1963.06	남	Test & System Package총괄 품질팀 장	Test&Package센터 담당임원	경북대	해당없음	상근

안용일	상무대우	1971.02	남	디자인경영센터 UX센터장	디자인경영센터 디자인전략팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
양석환	상무	1962.05	남	생활가전 지원팀 담당임원	SEA 담당임원	Purdue Univ.(碩士)	해당없음		상근
엄재춘	상무	1966.06	남	SCIC 담당임원	중국총괄 Retail Management팀장	서강대(碩士)	해당없음		상근
이동근	상무	1963.01	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	고려대(博士)	해당없음		상근
이상우	상무대우	1972.11	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	연세대	해당없음	52	상근
이태관	상무대우	1971.12	남	법무실 담당임원	삼성물산 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(碩士)	해당없음		상근
정기수	상무	1965.02	남	의료기기 인사팀장	글로벌기술센터 담당임원	연세대	해당없음		상근
정상인	상무대우	1969.06	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(碩士)	해당없음		상근
최윤준	상무	1967.09	남	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 개발팀장	MIT(博士)	해당없음		상근
홍승오	상무	1968.10	남	기획팀 담당임원	경영지원실 사업전략 담당부장	London Business Sch.(LBS)(碩士)	해당없음		상근
가네코	상무	1958.12	남	DS부문 일본총괄	DS부문 일본총괄 VP	Musashi Univ.	해당없음		상근
강윤석	상무	1964.05	남	기흥/화성/평택단지 인사팀장	LED사업팀 담당임원	성균관대(碩士)	해당없음		상근
강인규	상무대우	1968.05	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	서울대	해당없음	46	상근
강현석	상무	1963.08	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SIEL-S 담당임원	서강대	해당없음		상근
김경춘	상무대우	1974.01	남	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	중앙대	해당없음		상근
김도현	상무	1965.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SECH법인장	항공대	해당없음		상근
김동관	상무	1969.10	남	인사팀 담당임원	삼성에스디에스 보안선진화T/F장	한양대	해당없음		상근
김요정	상무	1965.04	남	System LSI 품질팀장	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	포항공대(碩士)	해당없음		상근
김윤수	상무	1967.12	남	SME법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Thunderbird(碩士)	해당없음		상근
김정식	상무	1970.08	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	한양대(碩士)	해당없음		상근
김종근	상무	1967.06	남	SEDA-P(M)공장장	무선 Global제조센터 Global제조지원팀장	경북대(碩士)	해당없음		상근
김종민	상무	1968.03	남	전장사업팀 담당임원	IRO	Univ. of Pennsylvania(碩士)	해당없음		상근
김형남	상무	1965.06	남	영상디스플레이 Global CS팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
김호진	상무	1966.08	남	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	성균관대	해당없음		상근
나운천	상무	1967.02	남	네트워크 지원팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)	해당없음		상근
남길준	상무	1963.08	남	무선 안식년	SECA법인장	서강대	해당없음		상근
마틴	상무	1970.02	남	SEG 담당임원	SEG 법인장	Staatl. Berufsakademie Mannheim	해당없음		상근
맹경우	상무	1970.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(博士)	해당없음		상근
박동수	상무	1966.12	남	중남미총괄 CS팀장	Global CS센터 Global서비스팀장	광주대	해당없음		상근
박석민	상무	1970.12	남	경영혁신센터 담당임원	경영혁신팀 담당부장	Univ. of Texas, Austin(博士)	해당없음		상근
박찬우	상무	1973.05	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 상품혁신팀 담당임원	Stanford Univ.(博士)	해당없음		상근
방현우	상무	1967.07	남	안식년	베트남복합단지 대외협력팀장	고려대(碩士)	해당없음		상근
백일섭	상무	1968.08	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 개발2실 담당임원	광운대	해당없음		상근
서응교	상무	1964.11	남	서남아총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	서울대	해당없음		상근
신성우	상무	1965.12	남	Foundry 지원팀장	SAS법인 담당임원	연세대	계열회사 임원		상근
안준연	상무	1965.07	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	경운대	해당없음		상근
안진	상무	1966.02	남	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	인하대	해당없음	57	상근
양동성	상무	1967.12	남	DS부문 구주총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	성균관대	해당없음		상근
오시연	상무	1971.02	여	경영혁신센터 담당임원	중국총괄 지원팀 담당임원	고려대(碩士)	해당없음	57	상근

오창민	상무	1965.02	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEJ 담당임원	서울대(碩士)	해당없음		상근
오치오	상무	1967.01	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	종합기술원 인사팀 담당부장	건국대(碩士)	해당없음		상근
이기호	상무	1964.06	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEPCO법인장	성균관대	해당없음		상근
이상재	상무	1965.06	남	상생협력센터 담당임원	파트너지원센터 상생협력아카데미장	중앙대	해당없음		상근
이성민	상무	1964.09	남	DS부문 동남아총괄	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	성균관대	해당없음		상근
이정주	상무	1964.06	남	SCIC 담당임원	SET법인장	고려대	해당없음		상근
이철희	상무	1963.04	남	SEVT 담당임원	SEV 담당임원	성균관대	해당없음		상근
이현	상무	1969.02	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEAU법인장	Syracuse Univ.(碩士)	해당없음		상근
이홍빈	상무	1964.04	남	SSEC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임원	명지대	해당없음		상근
장문석	상무	1969.03	남	SIEL-P(N)공장장	무선 Global운영팀장	항공대	해당없음		상근
전용병	상무	1966.08	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	北京大(碩士)	해당없음		상근
정광명	상무	1964.04	남	생활가전 광주지원팀장	무선 인사팀 담당부장	전남대	해당없음		상근
정재신	상무	1964.08	남	SEA 담당임원	중남미총괄 물류혁신팀장	서강대	해당없음	57	상근
제현중	상무	1968.03	남	SSC 담당임원	SSC 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음	34	상근
조용취	상무	1968.06	남	SEF법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대	해당없음		상근
조인하	상무	1974.02	여	SENA법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	서강대(碩士)	해당없음		상근
지천기	상무	1968.01	남	SCS 담당임원	메모리 기획팀장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(碩士)	해당없음		상근
최경록	상무	1971.04	남	무선 제품기술팀 담당임원	SRC-Tianjin연구소장	경북대(碩士)	해당없음		상근
케빈리	상무	1962.07	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin	해당없음		상근
홍유진	상무대우	1972.05	여	무선 Mobile UX센터 담당임원	무선 UX혁신팀장	Univ. of California, LA(碩士)	해당없음		상근
홍종서	상무	1966.11	남	반도체연구소 기술기획팀장	반도체연구소 수석	고려대	해당없음		상근
가르시아	상무	1972.08	남	SESA 담당임원	SESA 담당임원	ESADE(碩士)	해당없음		상근
고상범	상무대우	1965.10	남	무선 메카솔루션팀장	무선 메카솔루션팀 담당임원	부산대	해당없음		상근
김기건	상무	1964.02	남	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 담당부장	광운대	해당없음		상근
김기훈	상무	1968.05	남	중동총괄 지원팀장	무선 지원팀 담당임원	Univ. of Baltimore (碩士)	해당없음		상근
김대원	상무	1965.11	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEF법인장	성균관대(碩士)	해당없음		상근
김병도	상무	1967.03	남	무선 GDC센터 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서강대(碩士)	해당없음		상근
김상용	상무	1970.11	남	네트워크 인사팀장	인사팀 담당임원	연세대	해당없음		상근
김상우	상무대우	1971.01	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	서울대	해당없음	18	상근
김세호	상무	1967.10	남	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담 당임원	SENA법인장	동국대	해당없음		상근
김수진	상무	1969.08	여	Global Public Affairs팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(博士)	해당없음	46	상근
김연성	상무	1966.05	남	생활가전 지원팀 담당임원	중남미총괄 지원팀장	MIT(碩士)	해당없음		상근
김재록	상무	1965.05	남	상생협력센터 구매전략팀 담당임원	상생협력센터 상생협력팀 담당임원	국민대	해당없음		상근
김정우	상무	1965.04	남	SEPOL법인장	SEROM법인장	고려대	해당없음		상근
김진수	상무대우	1971.10	남	디자인경영센터 차세대디자인팀장	디자인경영센터 차세대디자인팀 담당 임원	국민대	해당없음		상근
김형준	상무	1966.11	남	SAMEX 담당임원	무선 지원팀 담당임원	Emory Univ.(碩士)	해당없음		상근
김희선	상무	1969.10	여	글로벌마케팅센터 담당임원	무선 마케팅팀 담당임원	Duke Univ.(碩士)	해당없음		상근
노원일	상무	1967.08	남	네트워크 상품전략팀장	네트워크 기획팀 담당임원	Stanford Univ.(博士)	해당없음		상근
데니맥클린	상무	1966.11	남	SEA 담당임원	SEA SVP	Villanova Univ.(碩士)	해당없음		상근
메노	상무	1968.06	남	SEBN법인장	SEBN 담당임원	Haarlem Business School	해당없음		상근
문국열	상무	1969.01	남	SVCC 담당임원	SEV 담당임원	구미1대	해당없음		상근
박순철	상무	1966.07	남	무선 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	연세대	해당없음		상근
박정현	상무	1964.09	남	아프리카총괄 담당임원	SEEA법인장	서강대	해당없음		상근

박효상	상무	1967.08	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	한양대	해당없음		상근
백상현	상무	1965.08	남	사업지원T/F 담당임원	삼성바이오에피스 Commercial본부 담당임원	연세대	해당없음	16	상근
백중수	상무	1971.01	남	전장사업팀 담당임원	기획팀 담당임원	서울대(碩士)	해당없음		상근
서경욱	상무	1966.10	남	SAVINA-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Michigan State Univ. (碩士)	해당없음		상근
석중욱	상무	1969.06	남	TSLED법인장	기흥/화성단지총괄 LED제조팀장	광운대	해당없음		상근
손성원	상무	1969.02	남	지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당임원	연세대(碩士)	계열회사 임원		상근
송명주	상무	1970.02	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	동남아총괄 마케팅팀 담당부장	서강대(碩士)	해당없음		상근
신용인	상무	1969.11	남	무선 Global운영팀장	SEVT 담당임원	서강대	해당없음		상근
심재덕	상무	1973.07	남	중국전략협력실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)	해당없음		상근
안재우	상무	1969.12	남	한국총괄 인사팀장	중국총괄 인사팀장	고려대	해당없음		상근
여명구	상무	1970.10	남	제도개선T/F	DS부문 인사팀 담당임원	충북대	해당없음		상근
오병민	상무	1967.02	남	기흥/화성/평택단지 환경안전센터 담당임원	기흥/화성/평택단지 보건관리팀장	광운대	해당없음		상근
오중훈	상무	1969.10	남	DS부문 미주총괄 담당임원	System LSI 지원팀장	Purdue Univ.(碩士)	해당없음		상근
원중현	상무	1967.05	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SAMEX 담당임원	성균관대	해당없음		상근
윤준오	상무	1967.06	남	네트워크 기획팀장	사업지원T/F 담당임원	건국대	해당없음		상근
윤창훈	상무	1965.06	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEDA-S판매부문장	경희대	해당없음		상근
이경우	상무	1965.10	남	SRJ 담당임원	IRO	도시사대(博士)	해당없음		상근
이규호	상무	1969.06	남	영상디스플레이 인사팀장	인사팀 담당임원	서강대	해당없음		상근
이동우	상무	1967.06	남	메모리 지원팀장	감사팀 담당임원	경북대	계열회사 임원		상근
이성현	상무	1966.07	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SELA법인장	홍익대	해당없음		상근
이영순	상무	1966.10	여	인재개발원 副원장	인사팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
이영호	상무	1967.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SCIC 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(碩士)	해당없음		상근
이원준	상무	1970.02	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	연세대	계열회사 임원		상근
이재용	상무	1969.04	남	무선 GDC센터 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	London Sch. of Economics(博士)	해당없음		상근
이창용	상무	1968.12	남	SGE법인장	글로벌마케팅센터 담당임원	MIT(碩士)	해당없음		상근
이충순	상무	1967.09	남	SERC 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대	해당없음		상근
이환구	상무	1964.03	남	기흥/화성/평택단지 평택사업장 담당 임원	DS부문 지원팀 담당임원	성균관대	해당없음		상근
임성욱	상무	1964.02	남	SEDA-P(C)공정장	SEDA-P(M) 담당임원	영남대	해당없음		상근
장호영	상무	1968.01	남	네트워크 구매팀장	네트워크 Global운영팀 담당임원	경북대	해당없음		상근
전필규	상무	1968.11	남	Samsung Research 인사팀장	무선 인사팀 담당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(碩士)	해당없음		상근
정훈	상무	1969.01	남	SESA법인장	SEBN법인장	홍익대	해당없음		상근
조강용	상무	1964.02	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	삼성전자기술대학 (碩士)	해당없음		상근
조기재	상무	1967.01	남	DS부문 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	Babson College(碩士)	계열회사 임원		상근
조성혁	상무	1970.05	남	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of California, Berkeley(碩士)	해당없음		상근
조시정	상무	1969.11	남	인사팀 담당임원	SEJ 담당부장	경희대	해당없음		상근
조홍상	상무	1966.06	남	SEM-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대	해당없음		상근

진문구	상무	1965.10	남	SIEL-S 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
최승걸	상무	1968.12	남	기흥/화성/평택단지 Facility팀장	SCS법인 담당임원	서울시립대	해당없음		상근
최익수	상무	1967.05	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당부장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(碩士)	해당없음		상근
피재걸	상무	1964.04	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)	해당없음		상근
하영욱	상무	1964.01	남	SSIC 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(碩士)	해당없음		상근
한장수	상무	1970.02	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 책임번호사	State Univ. of New York, Buffalo(博士)	해당없음		상근
홍경현	상무	1963.01	남	글로벌기술센터 제조혁신팀장	글로벌기술센터 제조기술팀장	영남대	해당없음		상근
홍범석	상무	1968.06	남	Iran지점장	SELV법인장	중앙대	해당없음		상근
홍성희	상무	1966.02	남	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 구매팀 담당임원	서강대	해당없음		상근
고대곤	상무	1965.03	남	SEPM법인장	SIEL-P(C)법인장	아주대	해당없음	58	상근
곽연봉	상무대우	1967.03	남	기흥/화성/평택단지 전기기술팀장	기흥/화성/평택단지 전기기술팀 담당 임원	광운대	해당없음	58	상근
김기삼	상무	1965.11	남	DS부문 지원팀 담당임원	SCS 담당임원	아주대(碩士)	해당없음	58	상근
김대주	상무	1969.10	남	지원팀 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(碩士)	해당없음	58	상근
김병성	상무	1969.12	남	의료기기 지원팀장	SEHZ 담당임원	인하대	계열회사 임원	58	상근
김보경	상무	1966.08	남	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음	58	상근
김상효	상무	1967.10	남	네트워크 지원팀 담당임원	IR그룹 담당임원	Duke Univ.(碩士)	해당없음	58	상근
김성기	상무	1968.11	남	북미총괄 CS팀장	CIS총괄 CS팀장	연세대(碩士)	해당없음	58	상근
김성욱	상무	1968.06	남	한국총괄 온라인영업팀장	인사팀 담당임원	고려대(碩士)	해당없음	58	상근
김의석	상무대우	1973.12	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	영상디스플레이 디자인팀 수석	홍익대	해당없음	58	상근
김인식	상무	1967.09	남	재경팀 담당임원	삼성에스디에스 전략기획담당 담당임 원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)	해당없음	16	상근
김재원	상무	1969.08	남	안식년	지원팀 담당임원	Univ. of Notre Dame (碩士)	해당없음	58	상근
김창업	상무	1969.08	남	SELA법인장	SEM-S 담당임원	한양대	해당없음	58	상근
김한석	상무	1968.07	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	인하대	해당없음	58	상근
데이브다스	상무	1975.06	남	SEA 담당임원	SEA VP	Northwestern Univ. (碩士)	해당없음	58	상근
명호석	상무	1967.04	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	중앙대	해당없음	58	상근
박기원	상무	1966.06	남	글로벌마케팅센터 담당임원	Saudi Arabia지점장	서울대	해당없음	58	상근
박상교	상무대우	1972.03	남	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	성균관대	해당없음	58	상근
박성근	상무	1966.01	남	베트남복합단지 담당임원	SEV 담당임원	동국대	해당없음	58	상근
박성민	상무	1965.04	남	생활가전 Global CS팀 담당임원	Global CS센터 품질혁신팀장	인하대	해당없음	58	상근
박정선	상무	1972.12	여	무선 서비스사업실 담당임원	SRA 담당임원	Duke Univ.(碩士)	해당없음	58	상근
박정호	상무대우	1971.09	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Michigan State Univ. (碩士)	해당없음	58	상근
박진영	상무	1971.11	여	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	서울대	해당없음	58	상근
박태호	상무	1969.03	남	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담 당임원	영상디스플레이 AV사업팀 담당임원	Univ. of Pittsburgh (碩士)	해당없음	58	상근
박해진	상무	1965.10	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 동남아총괄	한국외국어대	해당없음	58	상근
백승엽	상무	1967.01	남	경영혁신센터 담당임원	Samsung Research 지원팀장	California State Univ.. Hayward(碩士)	해당없음	58	상근

부민혁	상무대우	1973.06	남	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전사업부 수석	제주대	해당없음	58	상근
서한석	상무	1968.02	남	SEA 담당임원	STA 담당부장	George Washington Univ.(碩士)	해당없음	58	상근
손영호	상무	1965.07	남	SEA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대	해당없음	58	상근
송승엽	상무	1968.08	남	Test&Package센터 담당임원	SCS 담당임원	성균관대	해당없음	58	상근
신동수	상무	1968.06	남	네트워크 기획팀 담당임원	네트워크 지원팀 담당임원	서울대(碩士)	해당없음	58	상근
신승철	상무	1973.04	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	연세대	해당없음	58	상근
신현진	상무	1971.01	남	인사팀 담당임원	동남아총괄 인사팀장	경북대	해당없음	58	상근
안정혁	상무	1967.12	남	무선 지원팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	육사	해당없음	58	상근
엄재원	상무	1968.04	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	연세대	해당없음	58	상근
오창환	상무	1969.01	남	종합기술원 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	George Washington Univ.(碩士)	해당없음	45	상근
우영돈	상무대우	1974.01	남	법무실 담당임원	무선 지원팀 담당임원	한양대	해당없음	58	상근
유병길	상무	1970.09	남	감사팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Virginia(碩士)	해당없음	58	상근
윤병관	상무	1970.11	남	무선 Global제조센터 담당임원	SIEL-P(N)공장장	구미1대	해당없음	58	상근
윤인수	상무대우	1974.11	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	Georgetown Univ.(碩士)	해당없음	58	상근
이광철	상무	1969.02	남	Global CS센터 Global서비스팀장	Global CS센터 Global서비스팀 담당 임원	한양대	해당없음	58	상근
이상윤	상무	1968.09	남	CIS총괄 지원팀장	재경팀 담당임원	경희대	해당없음	58	상근
이창섭	상무	1965.11	남	SELV법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대	해당없음	58	상근
이학민	상무	1972.04	남	사업지원T/F 담당임원	지원팀 담당임원	서울대(碩士)	해당없음	58	상근
이호영	상무	1965.02	남	DS부문 상생협력센터 담당임원	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	경희대	해당없음	58	상근
이황균	상무	1965.05	남	SEHC 담당임원	SERK법인장	성균관대	해당없음	58	상근
장단단	상무	1964.06	여	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	HOSEI UNIV.	해당없음	58	상근
전병준	상무	1966.02	남	SEUK법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	성균관대	해당없음	58	상근
전우성	상무	1964.03	남	SEHA법인장	SEMA법인장	조선대	해당없음	58	상근
정순찬	상무	1965.02	남	기흥/화성/평택단지 평택사업장 담당 임원	기흥/화성/평택단지 평택인프라기술팀 장	건국대	해당없음	58	상근
정재중	상무	1969.02	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	국민대(碩士)	해당없음	58	상근
조명호	상무	1969.05	남	감사팀 담당임원	감사팀 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	58	상근
조필주	상무	1971.07	남	종합기술원 기획지원팀장	DS부문 감사팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음	58	상근
주재원	상무	1968.02	남	중국총괄 CS팀장	CS환경센터 Global서비스팀 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	58	상근
지우정	상무	1967.11	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국총괄 인사팀장	고려대(碩士)	해당없음	58	상근
트레비스	상무	1966.09	남	SEA 담당임원	SEA VP	Arizona State Univ.	해당없음	58	상근
한규한	상무	1966.02	남	DS부문 부품플랫폼사업팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)	해당없음	58	상근
한상숙	상무	1966.07	여	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	Northwestern Univ.(碩士)	해당없음	58	상근
허석	상무	1973.10	남	DS부문 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	Stanford Univ.(博士)	해당없음	58	상근
현경호	상무	1966.05	남	DS부문 감사팀 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	한양대	해당없음	58	상근
고재윤	상무	1973.01	남	지원팀 담당임원	경영혁신팀 담당임원	고려대(碩士)	해당없음	46	상근
고재필	상무	1970.03	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 인사팀 담당임원	Purdue Univ.(碩士)	해당없음	46	상근
권오수	상무	1968.04	남	SEA 담당임원	TSTC 담당임원	성균관대	해당없음	46	상근
김강수	상무	1966.09	남	기흥/화성/평택단지 인프라QA팀장	메모리제조기술센터 담당임원	성균관대	해당없음	46	상근
김경조	상무	1965.12	남	Test&Package센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	성균관대	해당없음	46	상근
김군한	상무	1968.06	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	성균관대	해당없음	46	상근
김민정	상무	1971.07	여	메모리 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음	46	상근
김병우	상무	1968.03	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SIEL-S 담당임원	경북대	해당없음	46	상근
김성은	상무	1971.09	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	고려대(碩士)	해당없음	46	상근

김재훈	상무	1967.01	남	SEDA-S 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)	해당없음	46	상근
마이클레이 포드	상무	1962.02	남	SAS 담당임원	SAS VP	Univ. of Texas, Dallas(碩士)	해당없음	46	상근
문중승	상무	1971.08	남	SVCC 담당임원	글로벌기술센터 제조전략팀장	Georgia Inst. of Tech.(博士)	해당없음	46	상근
문희동	상무	1971.07	남	사업지원T/F 담당임원	종합기술원 인사팀장	한양대	해당없음	46	상근
박정미	상무	1968.07	여	무선 GDC센터 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음	46	상근
박정진	상무	1968.07	남	중국총괄 지원팀장	SEG 담당임원	Univ. of Minnesota, Twin Cities(碩士)	해당없음	46	상근
박중범	상무	1969.02	남	SIEL-S 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	46	상근
박준호	상무	1972.05	남	무선 상품전략팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대	해당없음	46	상근
박철범	상무	1966.03	남	상생협력센터 구매전략팀 담당임원	상생협력센터 시너지구매팀 담당임원	고려대	해당없음	46	상근
배상우	상무	1970.10	남	Foundry 품질팀장	System LSI 품질팀장	Purdue Univ.(博士)	해당없음	46	상근
복정수	상무	1970.06	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SESG법인장	고려대	해당없음	46	상근
서보철	상무	1972.01	남	보안선진화T/F	감사팀 담당임원	동국대	해당없음	46	상근
손종을	상무	1967.03	남	무선 전략마케팅실 담당임원	삼성화재 자동차보험본부 담당임원	건국대	해당없음	22	상근
손호성	상무	1968.04	남	무선 구매팀 담당임원	무선 개발실 담당임원	경북대	해당없음	46	상근
송철섭	상무	1967.12	남	DS부문 중국총괄 담당임원	System LSI 전략마케팅팀 담당부장	인하대	해당없음	46	상근
안재용	상무	1968.08	남	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 감사팀 담당임원	성균관대	해당없음	39	상근
유승호	상무	1968.06	남	생활가전 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	연세대	해당없음	46	상근
윤종덕	상무	1969.04	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	고려대(碩士)	해당없음	46	상근
이계원	상무	1968.05	남	인재개발원 담당임원	인재개발원 담당부장	서울대(碩士)	해당없음	46	상근
이광현	상무	1971.06	남	복미총괄 인사팀장	무선 인사팀 담당임원	연세대	해당없음	46	상근
이규영	상무	1968.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	고려대(碩士)	해당없음	46	상근
이상도	상무	1969.03	남	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담 당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	City Univ. of New York(碩士)	해당없음	46	상근
이상원	상무	1971.07	남	SEF 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Georgetown Univ. (碩士)	해당없음	46	상근
이상직	상무	1970.06	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEASA법인장	한국외국어대	해당없음	46	상근
이승원	상무	1968.06	남	Foundry 기획팀장	삼성SDI 사업운영그룹장	서강대(碩士)	계열회사 임원	22	상근
이재범	상무	1970.10	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	홍익대	해당없음	46	상근
이재환	상무	1967.08	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEPAK법인장	성균관대	해당없음	46	상근
이정길	상무	1971.02	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	Keio Univ.(碩士)	해당없음	46	상근
이정삼	상무	1967.06	남	Test & System Package총괄 GPO팀장	Test&Package센터 담당임원	인하대	해당없음	46	상근
이제현	상무	1970.04	남	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 경영지원실 담당임원	광운대	해당없음	22	상근
이창수	상무	1971.07	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	경희대	해당없음	46	상근
이형우	상무	1970.03	남	Global Public Affairs팀 담당임원	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(碩士)	해당없음	18	상근
정윤찬	상무	1968.09	남	상생협력센터 상생협력팀 담당임원	감사팀 담당부장	성균관대	해당없음	46	상근
정지호	상무	1967.01	남	SEPCO법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	아주대	해당없음	46	상근
정호진	상무	1971.05	남	한국총괄 CE영업팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Rutgers Univ.(碩士)	해당없음	46	상근
제이디라우	상무	1966.10	남	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	Univ. of Houston (碩士)	해당없음	46	상근
조영준	상무	1971.05	남	무선 인사팀 담당임원	인사팀 담당임원	성균관대	해당없음	46	상근
지송하	상무	1973.01	여	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담 당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	이화여대	해당없음	46	상근
지용준	상무	1968.01	남	DS부문 인사팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	연세대(博士)	해당없음	46	상근

최광보	상무	1971.03	남	사업지원T/F 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	부산대	해당없음	46	상근
최현복	상무	1969.02	남	사업지원T/F 담당임원	사업지원T/F 담당임원	上海交通大(碩士)	해당없음	45	상근
케빈모어튼	상무	1963.03	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 미주총괄 VP	Loyola Marymount Univ.	해당없음	46	상근
피터리	상무	1970.05	남	서남아총괄 대외협력팀장	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Chicago (碩士)	해당없음	46	상근
한우섭	상무	1967.01	남	의료기기 IVD사업팀장	의료기기 Global CS팀장	한국과학기술원(博士)	해당없음	46	상근
허태영	상무	1970.11	남	영상디스플레이 상품전략팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. of California, LA	해당없음	46	상근
홍성범	상무	1967.03	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S 담당부장	Institute Teknologi Bandung(碩士)	해당없음	46	상근
황대환	상무	1969.06	남	TSTC법인장	무선 Global제조센터 담당임원	수도전기공고	해당없음	46	상근
황보용	상무	1970.10	남	기획팀 담당임원	메모리 기획팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음	46	상근
황대환	상무	1968.04	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEAG 담당임원	경희대	해당없음	46	상근
강재원	상무	1967.07	남	경영혁신센터 담당임원	경영혁신팀 담당부장	인하대	해당없음	29	상근
김동준	상무	1973.05	남	LED기술센터 담당임원	LED사업팀 담당임원	광주과학기술원(博士)	해당없음	29	상근
김성은	상무	1968.11	남	무선 구매팀 담당임원	무선 기술전략팀 담당임원	항공대	해당없음	29	상근
김성환	상무	1970.05	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)	해당없음	29	상근
김세윤	상무	1973.06	남	지원팀 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	고려대(碩士)	해당없음	29	상근
김육한	상무	1967.12	남	SEG 담당임원	SESG법인장	한국과학기술원(碩士)	해당없음	29	상근
김이수	상무	1973.03	남	SVCC 담당임원	SEVT 담당임원	아주대	해당없음	29	상근
김호균	상무	1968.12	남	중남미총괄 대외협력팀장	Samsung Research 인사팀장	연세대(碩士)	해당없음	29	상근
박건태	상무	1969.09	남	무선 구매팀 담당임원	감사팀 담당부장	Univ. of Colorado, Boulder(碩士)	해당없음	29	상근
박춘중	상무	1967.08	남	한국총괄 IM영역팀 담당임원	한국총괄 모바일영역팀 담당임원	인하대	해당없음	29	상근
서영진	상무	1969.05	남	Global CS센터 제품환경팀장	Global CS센터 제품환경팀장	Insa De Lyon (博士)	해당없음	29	상근
송두근	상무	1968.07	남	기흥/화성/평택단지 환경안전센터 담당임원	기흥/화성/평택단지 환경안전팀장	아주대(碩士)	해당없음	29	상근
엄종국	상무	1968.03	남	SEDA-P(M) 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	인하대	해당없음	29	상근
여형민	상무	1971.06	남	사업지원T/F 담당임원	사업지원T/F 담당임원	성균관대(碩士)	해당없음	27	상근
오정석	상무	1970.03	남	System LSI 지원팀장	DS부문 중국총괄 담당부장	淸華大(碩士)	해당없음	29	상근
윤주환	상무	1970.05	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(碩士)	해당없음	29	상근
이관수	상무	1969.11	남	SEHZ 담당임원	네트워크 지원팀 담당임원	영남대	해당없음	29	상근
이동현	상무대우	1972.09	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	고려대	해당없음	29	상근
이영직	상무	1967.08	남	SERK법인장	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	아주대	해당없음	29	상근
이재욱	상무	1968.07	남	Test&Package센터 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	성균관대(碩士)	해당없음	29	상근
이재환	상무	1970.09	남	SEEG-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	중앙대(碩士)	해당없음	29	상근
이종민	상무	1971.09	남	무선 기획팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Illinois Inst. of Tech. (碩士)	해당없음	29	상근
이현	상무	1971.01	남	SEROM법인장	SECZ법인장	Duke Univ.(碩士)	해당없음	29	상근
임성윤	상무	1971.01	남	SEPR법인장	SEPR법인장	고려대	해당없음	29	상근
정상태	상무	1972.01	남	SEA 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	중앙대	해당없음	29	상근
정의욱	상무	1968.07	남	Foundry Global운영팀장	Foundry Global운영팀장	인하대	해당없음	29	상근
존헤링턴	상무	1962.02	남	SEA 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison	해당없음	29	상근
최기화	상무	1969.03	남	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	네트워크 개발1팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(博士)	해당없음	29	상근
최병갑	상무	1969.08	남	Test&Package센터 담당임원	Test&Package센터 담당부장	서울대(博士)	해당없음	29	상근
최성욱	상무	1969.02	남	글로벌기술센터 금형기술팀 담당임원	글로벌기술센터 수석	삼성전자공과대학	해당없음	29	상근

홍성민	상무	1969.06	남	System LSI 인사팀장	System LSI 인사팀 담당부장	Univ. of Texas, Austin(碩士)	해당없음	29	상근
홍정호	상무	1969.02	남	전자사업팀 담당임원	SESA 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(碩士)	해당없음	29	상근
강석채	상무	1971.06	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	Foundry 전략마케팅팀 담당부장	Georgia Inst. of Tech.(博士)	해당없음	22	상근
강정대	상무	1970.09	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	상생협력센터 담당부장	한국방송통신대	해당없음	22	상근
강태규	상무	1972.01	남	IR팀 담당임원	IR그룹 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(碩士)	해당없음	22	상근
권형석	상무	1973.02	남	DS부문 동남아총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서강대(碩士)	해당없음	22	상근
김기수	상무	1970.02	남	Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry제조기술센터 담당부장	성균관대	해당없음	22	상근
김보현	상무	1973.02	남	Test & System Package총괄 인사팀장	Test&Package센터 담당임원	서강대(碩士)	해당없음	22	상근
김상훈	상무	1968.02	남	SENA 담당임원	무선 전략마케팅팀 담당부장	건국대	해당없음	22	상근
김승리	상무	1972.09	여	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Stanford Univ.(碩士)	해당없음	22	상근
김승일	상무	1970.07	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	단국대	해당없음	22	상근
김연정	상무	1975.12	남	무선 상품전략팀 담당임원	무선 개발실 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	22	상근
김윤호	상무대우	1974.11	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	연세대	해당없음	18	상근
김장경	상무	1973.05	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	홍익대	해당없음	22	상근
김정현	상무	1975.06	남	무선 기획팀 담당임원	무선 상품혁신팀 담당임원	고려대	해당없음	22	상근
김준엽	상무	1969.10	남	SESK 담당임원	SEI 담당임원	경기대	해당없음	22	상근
김창영	상무	1973.03	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	중앙대	해당없음	22	상근
김태균	상무	1969.01	남	SSIC Korea 담당임원	SSIC IoT사업화팀 담당임원	성균관대	해당없음	22	상근
김태중	상무대우	1971.05	남	무선 디자인팀 담당임원	무선 디자인팀 수석	한양대	해당없음	22	상근
김태진	상무	1969.01	남	재경팀 담당임원	삼성경제연구소 사회인프라개발실 담당부장	George Washington Univ.(碩士)	해당없음	22	상근
김평진	상무대우	1973.12	남	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대	해당없음	22	상근
김현	상무	1968.07	남	구미지원센터 인사팀장	인사팀 담당부장	서강대(碩士)	해당없음	22	상근
김형재	상무	1970.12	남	영상디스플레이 상품전략팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	해당없음	22	상근
남정만	상무	1967.06	남	생활가전 Global운영센터 담당임원	생활가전 Global제조팀 담당임원	전남기계공고	해당없음	22	상근
노태현	상무	1969.09	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	George Washington Univ.(碩士)	해당없음	22	상근
류일곤	상무	1968.07	남	무선 인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당부장	경북대	해당없음	22	상근
류재준	상무	1969.09	남	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 감사팀 담당부장	성균관대	해당없음	22	상근
문형준	상무	1968.07	남	System LSI 기획팀장	DS부문 지원팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	해당없음	22	상근
박장록	상무	1967.02	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	계명대	해당없음	22	상근
배광운	상무	1968.03	남	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	경희대	해당없음	22	상근
배일환	상무	1970.07	남	SEVT 담당임원	인사팀 담당부장	고려대(碩士)	해당없음	22	상근
설훈	상무	1970.03	남	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	고려대	해당없음	22	상근
손용우	상무	1968.09	남	TSTC 담당임원	무선 지원팀 담당부장	경희대	해당없음	22	상근
손중곤	상무	1970.09	남	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)	해당없음	22	상근
송우창	상무	1968.01	남	한국총괄 온라인영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	해당없음	22	상근
송원준	상무	1969.04	남	SEAU법인장	SENZ법인장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)	해당없음	22	상근
셰인확비	상무	1972.05	남	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(碩士)	해당없음	22	상근

스테판코테	상무	1972.04	남	SEF 담당임원	SEF VP	INSEEC Paris(碩士)	해당없음	22	상근
심재현	상무	1972.01	남	동남아총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	Georgetown Univ. (碩士)	해당없음	22	상근
아심와르시	상무	1972.06	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S SVP	SIBM, Pune(碩士)	해당없음	22	상근
안정희	상무	1970.09	남	SEMAG법인장	Lebanon지점장	경북대(碩士)	해당없음	22	상근
양익준	상무	1969.11	남	아프리카총괄 지원팀장	경영혁신센터 담당임원	성균관대	해당없음	22	상근
양혜순	상무	1968.02	여	생활가전 상품전략팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	Michigan State Univ. (博士)	해당없음	22	상근
여태정	상무	1970.06	남	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(博士)	해당없음	22	상근
오재균	상무	1972.02	남	SAS 담당임원	DS부문 지원팀 담당부장	Univ. of Iowa(碩士)	해당없음	22	상근
오형석	상무	1970.09	남	Test & System Package총괄 구매팀장	Test&Package센터 담당임원	고려대	해당없음	22	상근
이민철	상무	1970.04	남	무선 PC사업팀 담당임원	무선 PC사업팀 담당부장	서강대(碩士)	해당없음	22	상근
이상욱	상무	1972.08	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발2실 수석	금오공대	해당없음	22	상근
이상욱	상무	1971.01	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당부장	경북대	해당없음	22	상근
이상천	상무	1970.09	남	기흥/화성/평택단지 지원팀장	생산기술연구소 담당임원	인하대	해당없음	22	상근
이승엽	상무	1968.08	남	SECH법인장	SAMCOL법인장	서울대	해당없음	22	상근
이정자	상무	1969.04	여	기흥/화성/평택단지 Facility팀 담당임 원	기흥/화성/평택단지 Facility팀 담당부 장	인하대	해당없음	22	상근
이한관	상무	1971.09	남	DS부문 인사팀 담당임원	SCS 담당임원	성균관대(碩士)	해당없음	22	상근
이한형	상무	1968.09	남	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	경희대	해당없음	22	상근
이희윤	상무	1968.08	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	부산수산대	해당없음	22	상근
장상익	상무	1968.07	남	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	경북대	해당없음	22	상근
장형택	상무	1970.05	남	SEA 담당임원	SEA 담당부장	Washington Univ. in St. Louis(碩士)	해당없음	22	상근
정지은	상무	1974.05	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Northwestern Univ.(碩 士)	해당없음	22	상근
조성훈	상무	1970.11	남	SELS법인장	감사팀 담당부장	건국대(博士)	해당없음	22	상근
조철호	상무	1971.07	남	SECA법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Southern California(碩士)	해당없음	22	상근
주명취	상무	1963.08	남	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	上海大(碩士)	해당없음	22	상근
지혜령	상무	1972.04	여	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)	해당없음	22	상근
차경환	상무	1972.04	남	SEAU 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(碩士)	해당없음	22	상근
최동준	상무	1972.05	남	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당부장	Univ. of Southern California(碩士)	해당없음	22	상근
최순	상무	1970.10	남	SEA 담당임원	SIEL-S 담당임원	Duke Univ.(碩士)	해당없음	22	상근
최유중	상무	1971.12	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	연세대(碩士)	해당없음	22	상근
최찬식	상무	1966.02	남	기흥/화성/평택단지 건설팀장	기흥/화성/평택단지 건설팀 담당임원	서울대(碩士)	해당없음	22	상근
편정우	상무	1970.10	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Univ. of Texas, Austin(博士)	해당없음	22	상근
한경환	상무	1971.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	해당없음	22	상근
한준수	상무	1969.04	남	Test&Package센터 담당임원	Test&Package센터 담당부장	중앙대	해당없음	22	상근
허지영	상무	1970.09	남	기흥/화성/평택단지 환경안전센터 담 당임원	메모리제조기술센터 담당임원	부산대	해당없음	22	상근
황근하	상무	1970.05	남	SEH-P법인장	SEH-P 담당임원	아주대	해당없음	22	상근
황호준	상무	1972.03	남	TSE-S 담당임원	SEAG 담당임원	인하대	해당없음	22	상근
강도희	상무	1974.12	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발실 담당부장	경북대(碩士)	해당없음	10	상근
강상용	상무	1972.09	남	SEG 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Pennsylvania(碩士)	해당없음	10	상근

강태우	상무	1973.10	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	고려대	해당없음	10	상근
고형석	상무	1972.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEG 담당부장	Case Western Reserve Univ.(碩士)	해당없음	10	상근
권석원	상무	1970.05	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 담당부장	아주대	해당없음	10	상근
권진현	상무	1968.07	남	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당부장	Thunderbird(碩士)	해당없음	10	상근
김경준	상무	1969.01	남	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	광운대	해당없음	10	상근
김구희	상무	1969.12	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조기술센터 담당부장	서울대(博士)	해당없음	10	상근
김범진	상무	1975.02	남	SERC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	Southern Illinois Univ.(碩士)	해당없음	10	상근
김성권	상무	1971.02	남	디자인경영센터 디자인전략팀 담당임원	디자인경영센터 디자인전략팀 담당부장	홍익대	해당없음	10	상근
김성한	상무	1974.09	남	SEAG법인장	SEAG법인장	광운대	해당없음	10	상근
김원희	상무	1971.04	남	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	Mcgill Univ.(碩士)	해당없음	10	상근
김윤철	상무	1967.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대	해당없음	10	상근
김재윤	상무	1970.07	남	전장사업팀 담당임원	재경팀 담당부장	Georgetown Univ.(碩士)	해당없음	10	상근
김정우	상무	1970.01	남	의료기기 DR사업팀장	의료기기 DR사업팀 담당부장	아주대(碩士)	해당없음	10	상근
김정호	상무	1972.01	남	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	Georgetown Univ.(碩士)	해당없음	10	상근
김지윤	상무	1975.02	여	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	Cornell Univ.(碩士)	해당없음	10	상근
김태우	상무	1971.05	남	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	해당없음	10	상근
김태훈	상무	1970.10	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조기술센터 담당부장	인하대	해당없음	10	상근
김현중	상무	1969.05	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	Thunderbird(碩士)	해당없음	10	상근
남경인	상무	1973.03	남	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 담당부장	한국과학기술원(碩士)	해당없음	10	상근
노경래	상무	1976.12	남	SEM-S 담당임원	SEM-S 담당부장	서강대	해당없음	10	상근
박재성	상무	1971.02	남	Test&Package센터 담당임원	Test&Package센터 담당부장	인하대	해당없음	10	상근
박진수	상무	1969.07	남	기흥/화성/평택단지 평택사업장 담당임원	기흥/화성/평택단지 담당부장	인하대	해당없음	10	상근
박현아	상무	1973.01	여	네트워크 상품전략팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(碩士)	해당없음	10	상근
송명숙	상무	1972.11	여	SIEL-S 담당임원	SIEL-S 담당부장	성균관대	해당없음	10	상근
송방영	상무	1974.10	남	지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)	계열회사 임원	10	상근
안승환	상무	1970.10	남	SEA 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	연세대	해당없음	10	상근
양택진	상무	1971.08	남	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	Samsung Research 기술전략팀 담당부장	연세대	해당없음	10	상근
육근성	상무	1968.08	남	SESA 담당임원	북미총괄 지원팀 담당부장	Indiana Univ., Bloomington(碩士)	해당없음	10	상근
윤남호	상무	1968.12	남	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당부장	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(碩士)	해당없음	10	상근
윤찬현	상무	1971.10	남	무선 구매팀 담당임원	무선 구매팀 담당부장	영남대	해당없음	10	상근
윤철웅	상무	1970.07	남	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SECE법인장	인하대	해당없음	10	상근
이근수	상무	1970.12	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	상생협력센터 대외협력팀 담당부장	세종대	해당없음	10	상근
이달래	상무	1970.04	여	생활가전 상품전략팀 담당임원	EDAO 담당부장	한국외국어대	해당없음	10	상근
이승목	상무	1973.09	남	동남아총괄 인사팀장	인사팀 담당임원	고려대	해당없음	10	상근
이창엽	상무	1970.04	남	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	영남대	해당없음	10	상근

임전식	상무	1969.08	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조기술센터 담당부장	전북대	해당없음	10	상근
장소연	상무	1971.06	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	이화여대	해당없음	10	상근
정광희	상무	1971.08	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	광운대	해당없음	10	상근
정승욱	상무	1969.05	남	중국전략협력실 담당임원	중국전략협력실 담당부장	Thunderbird(碩士)	해당없음	10	상근
정유진	상무	1970.06	여	생활가전 담당임원	생활가전 상품전략팀 담당부장	서강대(碩士)	해당없음	10	상근
존테일러	상무	1968.04	남	SAS 담당임원	SAS VP	Univ. of New Hampshire	해당없음	10	상근
최영	상무	1969.07	남	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 인사팀 담당부장	항공대	해당없음	10	상근
최창훈	상무	1972.02	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당부장	서울시립대(博士)	해당없음	10	상근
코너피어스	상무	1970.04	남	SEUK 담당임원	SEUK VP	Univ. of Dublin(碩士)	해당없음	10	상근
함선규	상무	1970.01	남	SRA 담당임원	지원팀 담당부장	Washington Univ. in St. Louis(碩士)	해당없음	10	상근
홍경선	상무	1970.08	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	해당없음	10	상근
홍주선	상무	1971.10	남	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당부장	경희대(碩士)	해당없음	10	상근
황성훈	상무	1969.07	남	Global CS센터 품질혁신팀 담당임원	Global CS센터 품질혁신팀 담당부장	한양대(碩士)	해당없음	10	상근
조승환	연구위원	1962.10	남	Samsung Research 펌소장	소프트웨어센터 펌센터장	한양대(碩士)	해당없음		상근
박길재	연구위원	1966.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 제품기술팀장	연세대(碩士)	해당없음		상근
이효건	연구위원	1962.01	남	영상디스플레이 개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
김용제	연구위원	1962.04	남	무선 서비스사업실장	SRA연구소장	아주대(碩士)	해당없음		상근
윤종식	연구위원	1961.09	남	Foundry 기술개발실장	System LSI Foundry사업팀장	Univ. of California, LA(博士)	해당없음		상근
장덕현	연구위원	1964.02	남	System LSI SOC개발실장	System LSI LSI개발실장	Univ. of Florida(博士)	해당없음		상근
전경춘	연구위원	1962.12	남	네트워크사업부장	네트워크 개발팀장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)	해당없음		상근
강호규	연구위원	1961.09	남	반도체연구소장	반도체연구소 공정개발실장	Stanford Univ.(博士)	해당없음		상근
경계현	연구위원	1963.03	남	메모리 Solution개발실장	메모리 Flash개발실장	서울대(博士)	해당없음		상근
정재현	연구위원	1962.09	남	메모리 Flash개발실장	메모리 Solution개발실장	Univ. of Southern California(博士)	해당없음		상근
천강욱	연구위원	1966.01	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 상품전략팀장	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
이재승	연구위원	1960.07	남	생활가전 개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	고려대(碩士)	해당없음		상근
이정배	연구위원	1967.02	남	메모리 DRAM개발실장	메모리 품질보증실장	서울대(博士)	해당없음		상근
황성우	연구위원	1962.08	남	종합기술원 부원장	종합기술원 Device연구소 담당임원	Princeton Univ.(博士)	해당없음		상근
남석우	연구위원	1966.03	남	반도체연구소 공정개발실장	반도체연구소 공정개발팀 담당임원	연세대(博士)	해당없음		상근
박용민	연구위원	1964.04	남	System LSI Sensor사업팀장	System LSI 개발실장	연세대(碩士)	해당없음		상근
이규필	연구위원	1961.05	남	반도체연구소 메모리TD실장	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of Florida(博士)	해당없음		상근
전재호	연구위원	1963.04	남	네트워크 개발팀장	네트워크 Global Technology Service팀장	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
정순문	연구위원	1961.11	남	반도체연구소 Logic TD팀장	반도체연구소 담당임원	Univ. of Florida(博士)	해당없음		상근
김형섭	연구위원	1966.01	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(博士)	해당없음		상근
박재홍	연구위원	1965.01	남	Foundry Design Platform개발실장	Foundry 기술개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(博士)	해당없음		상근
송두현	연구위원	1964.01	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
조병학	연구위원	1967.03	남	System LSI 기반설계실장	System LSI Modem개발실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(博士)	해당없음		상근
김학상	연구위원	1966.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell(博士)	해당없음		상근
박현호	연구위원	1962.05	남	네트워크 개발팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	계명대	해당없음		상근
신민철	연구위원	1966.02	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 신사업T/F장	서울대(碩士)	해당없음		상근

신유균	연구위원	1965.02	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
김학래	연구위원	1962.02	남	글로벌기술센터 자동화기술팀장	생산기술연구소 수석	한양대	해당없음		상근
이준천	연구위원	1965.05	남	SRA연구소장	DMC연구소 차세대모바일팀장	Univ. of Cincinnati (博士)	해당없음		상근
강석립	연구위원	1964.10	남	기흥/화성/평택단지 스마트IT팀장	메모리 제조센터 담당임원	경북대	해당없음		상근
강임수	연구위원	1963.07	남	System LSI 개발실장	System LSI 개발실 담당임원	성균관대(碩士)	해당없음		상근
김민구	연구위원	1964.08	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
송재혁	연구위원	1967.08	남	메모리 Flash개발실 담당임원	SCS법인 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
정기태	연구위원	1965.09	남	Foundry 기술개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
최진혁	연구위원	1967.02	남	메모리 Design Platform개발실장	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
한진만	연구위원	1966.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대	해당없음		상근
구자흥	연구위원	1968.01	남	Foundry 제조기술센터 담당임원	System LSI 제조센터 담당임원	North Carolina State Univ.(博士)	해당없음		상근
권상덕	연구위원	1967.03	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
김주년	연구위원	1969.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	성균관대(碩士)	해당없음		상근
김진성	연구위원	1963.02	남	Foundry 제조기술센터 담당임원	메모리 제조센터 담당임원	아주대	해당없음		상근
디페쉬	연구위원	1969.06	남	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Indian Inst. of Management, Bangalore(碩士)	해당없음		상근
박광일	연구위원	1971.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
박두식	연구위원	1965.08	남	종합기술원 Device & System연구센터장	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	포항공대(碩士)	해당없음		상근
박성선	연구위원	1965.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	충남대	해당없음		상근
박호진	연구위원	1962.09	남	System LSI 개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	한양대	해당없음		상근
심은수	연구위원	1966.10	남	종합기술원 AI&SW연구센터장	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	Columbia Univ.(博士)	해당없음		상근
윤장현	연구위원	1968.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)	해당없음		상근
이동기	연구위원	1969.05	남	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	Univ. of California, San Diego(博士)	해당없음		상근
이석준	연구위원	1965.07	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
전영식	연구위원	1967.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	한양대(碩士)	해당없음		상근
정현준	연구위원	1964.06	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	SEH-P법인장	한양대	해당없음		상근
주창남	연구위원	1965.04	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	성균관대	해당없음		상근
최길현	연구위원	1966.10	남	SAS법인장	System LSI 제조센터 담당임원	한양대(碩士)	해당없음		상근
한인택	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Material연구센터장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
홍형선	연구위원	1963.08	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	인하대(碩士)	해당없음		상근
김태연	연구위원	1965.04	남	네트워크 Global Technology Service팀장	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	서강대(碩士)	해당없음		상근
서장석	연구위원	1967.08	남	네트워크 개발팀 담당임원	무선 개발실 담당임원	연세대(碩士)	해당없음		상근
신재광	연구위원	1964.09	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 기반기술Lab장	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
이종열	연구위원	1970.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
이주영	연구위원	1966.07	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	Univ. of California, LA(博士)	해당없음		상근
이준희	연구위원	1969.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	MIT(博士)	해당없음		상근
전충상	연구위원	1965.08	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	메모리 제조센터 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
조태제	연구위원	1964.06	남	Test & System Package개발실 담당임원	삼성전기 PLP솔루션사업팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	4	상근
최용훈	연구위원	1969.07	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	고려대	해당없음		상근

황기현	연구위원	1967.06	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(博士)	해당없음		상근
신영민	연구위원	1965.12	남	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI 기반설계실 Master	연세대	해당없음	10	상근
권재욱	연구위원	1966.07	남	LED기술센터장	LED사업팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
김태진	연구위원	1964.09	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	연세대	해당없음		상근
류제형	연구위원	1974.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
문승도	연구위원	1968.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Southern California(博士)	해당없음		상근
박성용	연구위원	1969.02	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발1팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
박종애	연구위원	1965.08	여	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	이화여대(博士)	해당없음		상근
선경일	연구위원	1968.01	남	System LSI A-Project팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
신현석	연구위원	1969.05	남	Samsung Research Smart Device팀장	Samsung Research Intelligent Machine센터장	서강대(碩士)	해당없음		상근
유미영	연구위원	1968.07	여	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	포항공대(碩士)	해당없음		상근
유준영	연구위원	1967.09	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	성균관대	해당없음		상근
유호선	연구위원	1967.08	남	생산기술연구소 담당임원	영상디스플레이 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
이준화	연구위원	1972.03	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
임준서	연구위원	1968.08	남	System LSI Sensor사업팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
강대철	연구위원	1965.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	인하대	해당없음		상근
강상범	연구위원	1969.02	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(博士)	해당없음		상근
문창록	연구위원	1971.01	남	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
박기철	연구위원	1971.05	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
박기태	연구위원	1971.01	남	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	Tohoku Univ.(博士)	해당없음		상근
박성준	연구위원	1971.01	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	Stanford Univ.(博士)	해당없음		상근
박정훈	연구위원	1969.10	남	Samsung Research Visual Technology팀장	Samsung Research Media Research팀장	한양대(碩士)	해당없음		상근
안상호	연구위원	1965.03	남	Test&Package센터 담당임원	Test&Package센터 담당부장	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
안수진	연구위원	1969.12	여	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	포항공대(博士)	해당없음		상근
안원익	연구위원	1970.07	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
안정착	연구위원	1970.12	남	반도체연구소 CIS TD팀장	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	포항공대(博士)	해당없음		상근
이시영	연구위원	1972.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	경북대(碩士)	해당없음		상근
이영민	연구위원	1964.03	남	SRPOL연구소장	SRR연구소장	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
이은철	연구위원	1965.07	남	Foundry 제품기술팀장	System LSI 제품기술팀장	광운대	해당없음		상근
이진욱	연구위원	1970.02	남	SRR연구소장	소프트웨어센터 Applied Platform팀장	Arizona State Univ.(博士)	해당없음		상근
임채환	연구위원	1971.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	경북대(博士)	해당없음		상근
장경훈	연구위원	1970.02	남	Samsung Research Robot센터 담당임원	Samsung Research Intelligent Machine센터 담당임원	고려대(博士)	해당없음		상근
장세영	연구위원	1974.09	여	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
전찬욱	연구위원	1966.05	남	반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 수석	연세대	해당없음		상근
조상연	연구위원	1971.12	남	System LSI A-Project팀장	반도체연구소 S/W센터장	Univ. of Minnesota, Twin Cities(博士)	해당없음		상근
조장호	연구위원	1969.04	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
최경세	연구위원	1969.04	남	Test & System Package개발실 담당임원	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
최기환	연구위원	1970.01	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	Univ. of Southern California(博士)	해당없음		상근
최상진	연구위원	1967.03	남	메모리제조기술센터 담당임원	생산기술연구소 담당임원	포항공대(碩士)	해당없음		상근
최승현	연구위원	1967.10	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	중앙대(碩士)	해당없음		상근
최용원	연구위원	1968.05	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	고려대(碩士)	해당없음		상근

최윤희	연구위원	1968.07	여	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	포항공대(碩士)	해당없음		상근
허성희	연구위원	1969.01	남	SCS 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
허운행	연구위원	1969.08	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)	해당없음		상근
황하섭	연구위원	1964.03	남	SCS 담당임원	메모리제조센터 담당임원	인하대	해당없음		상근
고영관	연구위원	1972.06	남	Test & System Package개발실 담당임원	삼성전기 총양연구소 담당임원	서울대(博士)	해당없음	4	상근
김광연	연구위원	1965.07	남	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	58	상근
김두일	연구위원	1971.07	남	Samsung Research Platform팀장	소프트웨어센터 S/W Platform팀장	경북대	해당없음	58	상근
김명철	연구위원	1968.09	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	한국과학기술원(博士)	해당없음	58	상근
김세녕	연구위원	1964.01	남	Test&Package센터 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	삼성전자기술대학(碩士)	해당없음	58	상근
김영집	연구위원	1971.03	남	SRA 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음	58	상근
문용운	연구위원	1969.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	서강대(碩士)	해당없음	58	상근
문준	연구위원	1974.06	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음	58	상근
민중술	연구위원	1968.03	남	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	고려대(碩士)	해당없음	58	상근
박병률	연구위원	1968.09	남	Test&Package센터 담당임원	삼성전기 PLP솔루션사업팀 담당임원	고려대(碩士)	해당없음	4	상근
박찬익	연구위원	1972.04	남	메모리 기획팀장	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음	58	상근
변준호	연구위원	1972.07	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(博士)	해당없음	58	상근
송호건	연구위원	1966.01	남	Test & System Package개발실 담당임원	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	Univ. of California, Berkeley(博士)	해당없음	58	상근
신경섭	연구위원	1968.09	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	Univ. of California, Berkeley(博士)	해당없음	58	상근
알록나스데	연구위원	1962.11	남	SRI-Bangalore 담당임원	SRI-Bangalore SVP	Mcgill Univ.(博士)	해당없음	58	상근
원성근	연구위원	1968.05	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI제조센터 담당임원	경북대	해당없음	58	상근
이근호	연구위원	1970.02	남	기흥/화성/평택단지 스마트IT팀 담당임원	반도체연구소 수석	한국과학기술원(博士)	해당없음	58	상근
이상재	연구위원	1965.12	남	Test&Package센터 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	홍익대	해당없음	58	상근
이재열	연구위원	1970.01	남	System LSI 개발실 담당임원	System LSI 개발실 Master	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
이제석	연구위원	1969.01	남	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	58	상근
임종형	연구위원	1969.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대	해당없음	58	상근
장세연	연구위원	1967.01	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	광운대	계열회사 임원	58	상근
장재훈	연구위원	1969.07	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한국과학기술원(博士)	해당없음	58	상근
조혜정	연구위원	1967.11	여	생활가전 개발팀 담당임원	Samsung Research Frontier Research팀 담당임원	포항공대(博士)	해당없음	58	상근
최창규	연구위원	1970.03	남	종합기술원 AI&SW연구소 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	58	상근
프라나브	연구위원	1981.05	남	SRA 담당임원	무선 상품혁신팀 담당임원	MIT(碩士)	해당없음	58	상근
황상준	연구위원	1972.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	고려대(博士)	해당없음	58	상근
고형중	연구위원	1970.11	남	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Florida(博士)	해당없음	46	상근
구본영	연구위원	1967.05	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI제조센터 담당임원	서울대(碩士)	해당없음	46	상근
김강태	연구위원	1972.10	남	Samsung Research SE팀장	Samsung Research DX팀장	중앙대(博士)	해당없음	46	상근
김경남	연구위원	1965.11	남	System LSI 개발실 담당임원	System LSI 개발실 수석	성균관대	해당없음	46	상근
김기호	연구위원	1966.03	남	SRI-Delhi연구소장	SRC-Nanjing연구소장	George Washington Univ.(碩士)	해당없음	46	상근
김수련	연구위원	1967.04	여	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	한국과학기술원(博士)	해당없음	46	상근
김태훈	연구위원	1969.04	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(博士)	해당없음	46	상근
김현우	연구위원	1970.02	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	한국과학기술원(博士)	해당없음	46	상근

김홍식	연구위원	1969.09	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	인하대	해당없음	46	상근
김후성	연구위원	1972.01	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	고려대(碩士)	해당없음	46	상근
박형원	연구위원	1966.09	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	한양대(碩士)	해당없음	46	상근
반효동	연구위원	1967.06	남	메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	서울대(碩士)	해당없음	46	상근
배광진	연구위원	1968.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대	해당없음	46	상근
배용철	연구위원	1970.05	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	서울대(碩士)	해당없음	46	상근
서행룡	연구위원	1967.09	남	기흥/화성/평택단지 스마트IT팀 담당 임원	기흥/화성단지총괄 시스템기술팀 수석	부산대	해당없음	46	상근
손동현	연구위원	1969.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	고려대(碩士)	해당없음	46	상근
신영주	연구위원	1969.09	남	메모리제조기술센터 담당임원	SCS법인 담당임원	Purdue Univ.(博士)	해당없음	46	상근
용석우	연구위원	1970.09	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(碩士)	해당없음	46	상근
원순재	연구위원	1972.01	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	고려대(碩士)	해당없음	46	상근
윤석호	연구위원	1972.07	남	LED기술센터 담당임원	LED사업팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음	46	상근
이우형	연구위원	1970.02	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	Purdue Univ.(博士)	해당없음	46	상근
이영수	연구위원	1972.01	남	글로벌기술센터 요소기술팀장	글로벌기술센터 요소기술팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음	46	상근
이종명	연구위원	1970.03	남	메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(博士)	해당없음	46	상근
이중호	연구위원	1968.01	남	반도체연구소 Logic TD팀 담당임원	반도체연구소 수석	연세대(碩士)	해당없음	46	상근
이진엽	연구위원	1970.02	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서강대(碩士)	해당없음	46	상근
정용준	연구위원	1969.10	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서강대(碩士)	해당없음	46	상근
조기호	연구위원	1971.03	남	네트워크 상품전략팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	46	상근
박준수	연구위원	1967.08	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	연세대(碩士)	해당없음	29	상근
박진환	연구위원	1970.07	남	DS부문 안식년 담당임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	29	상근
박철홍	연구위원	1968.05	남	반도체연구소 Logic TD팀 담당임원	반도체연구소 수석	Univ. of California, San Diego(博士)	해당없음	29	상근
박헌정	연구위원	1969.12	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	고려대	해당없음	29	상근
방원철	연구위원	1969.04	남	의료기기 담당임원	의료기기 선행개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	29	상근
손영수	연구위원	1974.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	DS부문 미주총괄 수석	포항공대(博士)	해당없음	29	상근
송기환	연구위원	1970.07	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash설계팀 수석	서울대(博士)	해당없음	29	상근
오승훈	연구위원	1968.03	남	SRI-Noida연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Aachen Univ. of Tech.(博士)	해당없음	29	상근
오화석	연구위원	1972.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서강대(碩士)	해당없음	29	상근
위훈	연구위원	1970.04	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	서울대(博士)	해당없음	29	상근
이석원	연구위원	1970.07	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(博士)	해당없음	29	상근
이애영	연구위원	1968.12	여	무선 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	포항공대(碩士)	해당없음	29	상근
이재일	연구위원	1967.09	남	종합기술원 담당임원	종합기술원 담당임원	서울대(博士)	해당없음	8	상근
이치훈	연구위원	1969.08	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	서울대(博士)	해당없음	29	상근
이해정	연구위원	1970.10	여	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서강대(碩士)	해당없음	29	상근
임용식	연구위원	1971.01	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	29	상근
정상일	연구위원	1967.09	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	중앙대	해당없음	29	상근
정진민	연구위원	1972.12	남	Samsung Research Platform팀 담당임원	소프트웨어센터 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	29	상근
조성대	연구위원	1969.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(博士)	해당없음	29	상근
조학주	연구위원	1969.03	남	반도체연구소 Logic TD팀 담당임원	System LSI 수석	Univ. of Texas, Austin(博士)	해당없음	29	상근
최철민	연구위원	1973.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	서울대(博士)	해당없음	29	상근
홍영기	연구위원	1970.03	남	Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry제조기술센터 수석	Imperial College(博士)	해당없음	29	상근
강희성	연구위원	1970.08	남	Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry제조기술센터 수석	포항공대(博士)	해당없음	22	상근
고경민	연구위원	1975.03	남	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	22	상근

권상욱	연구위원	1968.08	남	SRUK연구소장	SRK연구소장	Univ. of Southern California(博士)	해당없음	22	상근
권순철	연구위원	1968.02	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	건국대	해당없음	22	상근
김수홍	연구위원	1972.11	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	Stanford Univ.(博士)	해당없음	22	상근
김영대	연구위원	1968.10	남	Foundry 제품기술팀 담당임원	Foundry 제품기술팀 수석	동국대(碩士)	해당없음	22	상근
김재영	연구위원	1971.11	남	SiEL-S 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 수석	포항공대(博士)	해당없음	22	상근
김정주	연구위원	1969.01	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	광운대	해당없음	22	상근
김중환	연구위원	1971.05	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Virginia Tech(博士)	해당없음	22	상근
김중훈	연구위원	1969.12	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	중앙대	해당없음	22	상근
김준석	연구위원	1972.10	남	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	연세대(博士)	해당없음	22	상근
김중정	연구위원	1973.11	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	Tohoku Univ.(博士)	해당없음	22	상근
김지영	연구위원	1970.04	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Univ. of California, LA(博士)	해당없음	22	상근
김진주	연구위원	1969.05	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	고려대(碩士)	해당없음	22	상근
김창태	연구위원	1972.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	금오공대	해당없음	22	상근
목진호	연구위원	1968.09	남	글로벌기술센터 요소기술팀 담당임원	글로벌기술센터 요소기술팀 수석	연세대(博士)	해당없음	22	상근
박기철	연구위원	1968.10	남	의료기기 담당임원	의료기기 선행개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	22	상근
박재영	연구위원	1969.09	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	연세대(碩士)	해당없음	22	상근
박종규	연구위원	1969.07	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	경북대	해당없음	22	상근
박종욱	연구위원	1968.11	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 AV사업팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음	22	상근
성낙희	연구위원	1973.03	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Georgia Inst. of Tech.(博士)	해당없음	22	상근
성덕용	연구위원	1973.09	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	Carnegie Mellon Univ.(博士)	해당없음	22	상근
손태용	연구위원	1972.08	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대(碩士)	해당없음	22	상근
송태중	연구위원	1971.04	남	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)	해당없음	22	상근
신종신	연구위원	1973.12	남	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(博士)	해당없음	22	상근
오문욱	연구위원	1974.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(碩士)	해당없음	22	상근
오태영	연구위원	1974.10	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Stanford Univ.(博士)	해당없음	22	상근
우경구	연구위원	1973.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	22	상근
윤하룡	연구위원	1971.12	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 수석	서울대(碩士)	해당없음	22	상근
이경우	연구위원	1969.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 수석	한양대(博士)	해당없음	22	상근
이금주	연구위원	1971.09	여	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	중앙대(碩士)	해당없음	22	상근
이기욱	연구위원	1970.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 수석	동아대	해당없음	22	상근
이승재	연구위원	1974.08	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash설계팀 수석	서울대(碩士)	해당없음	22	상근
이정봉	연구위원	1970.03	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	경북대(碩士)	해당없음	22	상근
이종규	연구위원	1970.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	한양대(碩士)	해당없음	22	상근
이진구	연구위원	1973.02	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 수석	성균관대(碩士)	해당없음	22	상근
이효석	연구위원	1969.02	남	종합기술원 AI&SW연구센터 담당임원	종합기술원 기반기술Lab 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	22	상근
정상규	연구위원	1970.03	남	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	조선대	해당없음	22	상근
정승필	연구위원	1968.06	남	Foundry제조기술센터 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	George Washington Univ.(碩士)	해당없음	22	상근
정혜순	연구위원	1975.12	여	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	부산대	해당없음	22	상근
조용호	연구위원	1970.03	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한국과학기술원(博士)	해당없음	22	상근
최영상	연구위원	1975.01	남	종합기술원 AI&SW연구센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)	해당없음	22	상근
한상연	연구위원	1969.01	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	22	상근

한승훈	연구위원	1974.04	남	생활가전 선행개발팀 담당임원	Samsung Research Frontier Research팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	22	상근
홍기준	연구위원	1971.05	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Columbia Univ.(碩士)	해당없음	22	상근
홍승환	연구위원	1971.06	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(碩士)	해당없음	22	상근
강동구	연구위원	1976.12	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash설계팀 담당임원	Purdue Univ.(博士)	해당없음	10	상근
고승범	연구위원	1971.07	남	메모리 Design Platform개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	아주대	해당없음	10	상근
구원본	연구위원	1970.02	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조기술센터 담당부장	한양대	해당없음	10	상근
권기덕	연구위원	1972.07	남	SCS 담당임원	메모리제조기술센터 담당부장	경북대(碩士)	해당없음	10	상근
김대신	연구위원	1970.03	남	반도체연구소 CAE팀장	반도체연구소 담당부장	Georgia Inst. of Tech.(博士)	해당없음	10	상근
김용찬	연구위원	1969.03	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조기술센터 담당부장	경희대	해당없음	10	상근
김은경	연구위원	1974.04	여	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	단국대	해당없음	10	상근
김이태	연구위원	1971.01	남	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당부장	포항공대(碩士)	해당없음	10	상근
김인형	연구위원	1973.12	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당부장	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
김일룡	연구위원	1974.02	남	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당부장	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
문성훈	연구위원	1974.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	경북대(博士)	해당없음	10	상근
박민철	연구위원	1972.09	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	반도체연구소 담당부장	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
박성욱	연구위원	1972.04	남	기흥/화성/평택단지 평택사업장 담당임원	기흥/화성/평택단지 평택사업장 담당부장	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
박정대	연구위원	1976.12	남	기흥/화성/평택단지 분석기술팀장 담당임원	기흥/화성/평택단지 분석기술팀 담당임원	포항공대(博士)	해당없음	10	상근
박제민	연구위원	1971.12	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(博士)	해당없음	10	상근
박지선	연구위원	1974.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	Univ. of Texas, Austin(博士)	해당없음	10	상근
박진표	연구위원	1972.11	남	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당부장	서울대(博士)	해당없음	10	상근
박태상	연구위원	1975.01	남	글로벌기술센터 담당임원	글로벌기술센터 담당부장	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
발라지	연구위원	1969.09	남	SSIR연구소장	SSIR VP	Birla Institute of Technology and Science, Pilani(碩士)	해당없음	10	상근
배승준	연구위원	1976.03	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당부장	포항공대(博士)	해당없음	10	상근
손한구	연구위원	1969.06	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	State Univ. of New York, Stony Brook(碩 士)	해당없음	10	상근
안성준	연구위원	1975.01	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당부장	서울대(博士)	해당없음	10	상근
양진기	연구위원	1971.05	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	연세대(碩士)	해당없음	10	상근
오준영	연구위원	1969.02	남	Test & System Package개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	The Ohio State Univ. (博士)	해당없음	10	상근
우형동	연구위원	1970.09	남	기흥/화성/평택단지 평택사업장 담당임원	기흥/화성/평택단지 평택사업장 담당부장	경북대	해당없음	10	상근
윤인철	연구위원	1971.03	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	한양대(碩士)	해당없음	10	상근
이동근	연구위원	1971.08	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당부장	한양대(博士)	해당없음	10	상근
이병시	연구위원	1969.01	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(碩士)	해당없음	10	상근
이신재	연구위원	1972.11	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	인하대	해당없음	10	상근
이정노	연구위원	1971.02	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 담당부장	한양대(碩士)	해당없음	10	상근
이종우	연구위원	1978.04	남	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)	해당없음	10	상근

이화성	연구위원	1970.09	남	Foundry 품질팀 담당임원	Foundry 품질팀 담당부장	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
임성택	연구위원	1970.10	남	생활가전 C&M사업팀 담당임원	생활가전 C&M사업팀 담당부장	서울대(博士)	해당없음	10	상근
정실완	연구위원	1973.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당부장	서울대	해당없음	10	상근
장훈	연구위원	1972.09	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당부장	Columbia Univ.(博士)	해당없음	10	상근
전승훈	연구위원	1971.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
정병기	연구위원	1972.03	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당부장	건국대	해당없음	10	상근
정일규	연구위원	1968.05	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	광운대	해당없음	10	상근
정진국	연구위원	1975.10	남	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Samsung Research 담당임원	서강대(博士)	해당없음	10	상근
조민정	연구위원	1974.07	여	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 부품플랫폼사업팀 담당임원	서울대(碩士)	해당없음	10	상근
조성일	연구위원	1973.12	남	Test & System Package개발실 담당임원	Test&Package센터 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
최정연	연구위원	1974.11	남	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당부장	포항공대(博士)	해당없음	10	상근
한정남	연구위원	1973.01	남	Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry제조기술센터 담당부장	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
현상진	연구위원	1972.02	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당부장	서울대(博士)	해당없음	10	상근
황인철	연구위원	1977.11	남	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당부장	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
강문수	연구위원	1969.08	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(博士)	해당없음	3	상근
강성철	연구위원	1967.08	남	Samsung Research Robot센터장	무선 개발실 담당임원	서울대(博士)	해당없음	6	상근
계종욱	연구위원	1966.10	남	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(碩士)	해당없음	25	상근
고광현	연구위원	1968.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(博士)	해당없음	15	상근
곽성웅	연구위원	1965.05	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(博士)	해당없음	10	상근
권오상	연구위원	1967.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(博士)	해당없음	57	상근
길태호	연구위원	1977.11	남	Samsung Research Security팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)	해당없음	9	상근
김기남	연구위원	1964.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	DMC연구소 ECO Solution팀 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(博士)	해당없음	54	상근
김남승	연구위원	1974.05	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM설계팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)	해당없음	17	상근
김대우	연구위원	1970.03	남	Test & System Package개발실 담당임원	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	연세대(博士)	해당없음	23	상근
김대현	연구위원	1974.06	남	Samsung Research Platform팀 담당임원	Samsung Research Media Research팀 담당임원	Cornell Univ.(博士)	해당없음	28	상근
김도균	연구위원	1969.06	남	Samsung Research Smart Device팀 담당임원	Samsung Research Intelligent Machine센터 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	46	상근
김동욱	연구위원	1969.06	남	Test&Package센터 담당임원	Test&Package센터 담당임원	Univ. of California, Irvine(博士)	해당없음	18	상근
김민경	연구위원	1973.07	여	Samsung Research AI센터 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)	해당없음	39	상근
김석원	연구위원	1970.11	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	MIT(博士)	해당없음	31	상근
김성덕	연구위원	1966.09	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Lehigh Univ.(博士)	해당없음	28	상근
김성우	연구위원	1967.11	남	System LSI A-Project팀 담당임원	System LSI 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	8	상근

김성한	연구위원	1967.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
김용재	연구위원	1972.03	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	서강대(碩士)	해당없음	53	상근
김우년	연구위원	1970.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	포항공대(博士)	해당없음	9	상근
김우섭	연구위원	1964.10	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	고려대(博士)	해당없음		상근
김우중	연구위원	1965.02	남	TSEC법인장	TSEC 담당임원	국민대	해당없음	58	상근
김이환	연구위원	1968.12	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	Univ. of California, Berkeley(博士)	해당없음		상근
김준석	연구위원	1969.04	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Stanford Univ.(博士)	해당없음	34	상근
김찬우	연구위원	1976.04	남	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(博士)	해당없음	20	상근
김형석	연구위원	1968.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	연세대(碩士)	해당없음		상근
김희덕	연구위원	1963.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	광운대(碩士)	해당없음		상근
나가노타카 시	연구위원	1968.09	남	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	동경농공대	해당없음	22	상근
다니엘리	연구위원	1969.12	남	SRA 담당임원	Samsung Research 담당임원	MIT(博士)	해당없음	16	비상근
박수남	연구위원	1970.10	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	Univ. of Minnesota, Minneapolis(博士)	해당없음	9	상근
박인택	연구위원	1976.04	남	Samsung Research 차세대통신연구 센터 담당임원	Samsung Research 차세대통신연구 센터 담당임원	Stanford Univ.(博士)	해당없음	5	상근
박종천	연구위원	1973.11	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	연세대	해당없음	15	상근
박창진	연구위원	1967.01	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	경북대	해당없음	22	상근
방지훈	연구위원	1973.11	남	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(碩士)	해당없음	20	상근
배홍상	연구위원	1972.01	남	System LSI A-Project팀 담당임원	종합기술원 Device & System연구센 터 담당임원	Stanford Univ.(博士)	해당없음	19	상근
성학경	연구위원	1960.11	남	영상디스플레이 담당임원	글로벌기술센터 요소기술팀장	Tokyo Institute of Tech(博士)	해당없음		상근
손재철	연구위원	1965.11	남	SSIT 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
송병무	연구위원	1973.08	남	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Cornell Univ.(博士)	해당없음	27	상근
송용호	연구위원	1967.04	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(博士)	해당없음	6	상근
송윤중	연구위원	1971.10	남	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Virginia Tech(博士)	해당없음	10	상근
승현준	연구위원	1966.06	남	Samsung Research 담당임원	Samsung Research 담당임원	Harvard Univ.(博士)	해당없음	16	비상근
신승혁	연구위원	1968.01	남	Samsung Research IP출원팀장	무선 개발실 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(博士)	해당없음		상근
안길준	연구위원	1969.01	남	Samsung Research Security팀장	소프트웨어센터 Security팀장	George Mason Univ. (博士)	해당없음	29	상근
양병덕	연구위원	1971.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	연세대(博士)	해당없음	21	상근
양세영	연구위원	1975.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	22	상근
양장규	연구위원	1963.09	남	생산기술연구소장	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음		상근
오경석	연구위원	1965.06	남	Test & System Package개발실장	Test & System Package개발실 담당 임원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(博士)	해당없음	37	상근
오부근	연구위원	1967.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	한양대(博士)	해당없음	40	상근
윤종문	연구위원	1971.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Boston Univ.(碩士)	해당없음	30	상근
윤종필	연구위원	1963.05	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대	해당없음	57	상근
이경운	연구위원	1964.12	남	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research Cloud & IoT팀장	서울대	해당없음		상근
이근배	연구위원	1961.03	남	Samsung Research AI센터장	소프트웨어센터 Artificial Intelligence팀장	Univ. of California, LA(博士)	해당없음	48	상근
이기선	연구위원	1974.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Virginia Tech(博士)	해당없음		상근

이원석	연구위원	1967.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)	해당없음		상근
이종배	연구위원	1966.02	남	기흥/화성/평택단지 스마트IT팀 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대(碩士)	해당없음	58	상근
이종현	연구위원	1966.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Cambridge Univ.(博士)	해당없음	52	상근
이주형	연구위원	1972.08	남	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(博士)	해당없음	1	상근
임근취	연구위원	1973.05	남	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	16	상근
임백준	연구위원	1968.07	남	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(碩士)	해당없음	25	상근
임석환	연구위원	1974.11	남	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Stanford Univ.(博士)	해당없음	9	상근
정동섭	연구위원	1962.11	남	글로벌기술센터 요소기술팀 담당임원	생산기술연구소 금형기술센터 수석	The Ohio State Univ.(博士)	해당없음		상근
장수백	연구위원	1975.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Southern Connecticut State Univ.(碩士)	해당없음	39	상근
장우승	연구위원	1970.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(博士)	해당없음	6	상근
잭안	연구위원	1966.02	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Stanford Univ.(碩士)	해당없음	44	상근
정서형	연구위원	1967.05	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(碩士)	해당없음	46	상근
정의석	연구위원	1960.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	스웨덴 왕립과학대(碩士)	해당없음	22	상근
정재연	연구위원	1974.09	여	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	MIT(博士)	해당없음	36	상근
주혁	연구위원	1971.10	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(博士)	해당없음	16	상근
최성현	연구위원	1970.05	남	Samsung Research 차세대통신연구센터장	Samsung Research 차세대통신연구센터장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)	해당없음	1	상근
최성훈	연구위원	1973.02	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발실 담당임원	서울대(碩士)	해당없음	37	상근
최원준	연구위원	1970.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Stanford Univ.(博士)	해당없음	43	상근
최윤석	연구위원	1970.01	남	Samsung Research AI센터 담당임원	SRA 담당임원	Univ. of Texas, Austin(博士)	해당없음	27	상근
최형식	연구위원	1958.06	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	인하대	해당없음		상근
홍성훈	연구위원	1967.12	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	서울대(博士)	해당없음	40	상근
강윤경	전문위원	1968.12	여	Samsung Research 창의개발센터 담당임원	창의개발센터 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)	해당없음	22	상근
곽진환	전문위원	1968.01	남	SRIL연구소장	법무실 IP센터 담당임원	Santa Clara Univ.(碩士)	해당없음		상근
구성기	전문위원	1973.11	남	홈IoT사업화T/F장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	George Washington Univ.(博士)	해당없음	36	상근
구수연	전문위원	1973.07	여	무선 GDC센터 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Rutgers Univ.(碩士)	해당없음	20	상근
구윤모	전문위원	1962.07	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Texas A&M Univ.(碩士)	해당없음		상근
권금주	전문위원	1971.05	여	한국총괄 Retail마케팅팀장	한국총괄 Retail마케팅팀장	단국대	해당없음	3	상근
김경희	전문위원	1969.07	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Yale Univ.(碩士)	해당없음	13	상근
김광덕	전문위원	1962.08	남	생활가전 Global운영센터 담당임원	생활가전 Global제조팀 담당임원	전남과학대	해당없음		상근
김규태	전문위원	1970.12	남	생활가전 Global운영센터 담당임원	생활가전 담당임원	RPI(碩士)	해당없음	12	상근
김대길	전문위원	1970.11	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	Univ. of Southern California(碩士)	해당없음	27	상근

김도형	전문위원	1958.09	남	SEHC법인장	SEPM법인장	아주대	해당없음		상근
김민영	전문위원	1969.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.	해당없음	43	상근
김상우	전문위원	1961.10	남	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	Columbia Univ.(碩士)	해당없음		상근
김성운	전문위원	1966.10	남	법무실 IP센터 기술분석팀장	법무실 IP센터 담당임원	Harvard Univ.(碩士)	해당없음		상근
김수형	전문위원	1972.08	남	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 담당임원	MIT(博士)	해당없음	10	상근
김승민	전문위원	1967.03	남	SEA 담당임원	SEA 담당부장	성균관대	해당없음		상근
김원호	전문위원	1964.06	남	Test&Package센터 담당임원	삼성전기 PLP솔루션사업팀 담당임원	전남대	해당없음	4	상근
김윌리엄	전문위원	1972.08	남	무선 GDC센터장	무선 GDC센터장	Univ. of Colorado, Boulder	해당없음	8	상근
김인창	전문위원	1970.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Georgia State Univ. (碩士)	해당없음	22	상근
김재열	전문위원	1965.07	남	기흥/화성/평택단지 전기기술팀 담당 임원	기흥/화성/평택단지 전기기술팀 담당 임원	중앙대	해당없음	21	상근
김정봉	전문위원	1965.07	남	SSC 담당임원	인사팀 담당임원	부산대	해당없음	45	상근
김정호	전문위원	1969.05	남	경영혁신센터 담당임원	SEHC법인장	연세대	해당없음	58	상근
김중균	전문위원	1966.08	남	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대	해당없음		상근
김주완	전문위원	1968.09	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 상용혁신팀 담당임원	MIT(碩士)	해당없음	21	상근
김현수	전문위원	1970.09	남	Samsung Research 기술전략팀 담당 임원	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	성균관대(博士)	해당없음	58	상근
김홍민	전문위원	1971.10	남	무선 디자인팀 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	SAIC(碩士)	해당없음	1	상근
남정현	전문위원	1964.04	남	생활가전 Global운영센터 담당임원	글로벌기술센터 제조혁신팀장	천안공고	해당없음		상근
데이비드윤	전문위원	1971.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Northwestern Univ. (碩士)	해당없음	29	상근
데이빗은	전문위원	1967.01	남	Samsung NEXT장	Global Innovation센터장	Harvard Univ.(碩士)	해당없음		상근
도성대	전문위원	1966.12	남	서남아총괄 CS팀장	서남아총괄 CS팀장	부산대	해당없음	29	상근
리션	전문위원	1972.05	남	무선 GDC센터 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Alaska, Fairbanks	해당없음	13	상근
마츠오카	전문위원	1957.02	남	생활가전 담당임원	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	多摩美術大	해당없음		상근
민승재	전문위원	1971.07	남	디자인경영센터 디자인전략팀장	디자인경영센터 디자인전략팀장	Art Center College Of Design	해당없음	9	상근
박범주	전문위원	1966.04	남	Samsung Research 담당임원	인재개발원 담당임원	성균관대(博士)	해당없음		상근
박상훈	전문위원	1969.09	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	SYRACUSE UNIV.(碩士)	해당없음	29	상근
박성모	전문위원	1961.02	남	Global CS센터 품질혁신팀 담당임원	CS환경센터 품질혁신팀 담당임원	홍익대	해당없음		상근
박은주	전문위원	1964.07	남	SEV 담당임원	기흥/화성단지총괄 환경안전팀장	서울과학기술대	해당없음		상근
박제임스	전문위원	1973.06	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	California Polytechnic State Univ.	해당없음	22	상근
박철우	전문위원	1971.10	남	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Harvard Univ.(碩士)	해당없음	2	상근
서기호	전문위원	1964.03	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI제조센터 담당임원	항공대	해당없음		상근
서정아	전문위원	1971.05	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)	해당없음	30	상근
서준호	전문위원	1967.11	남	생활가전 C&M사업팀장	SEHA법인장	Duke Univ.(碩士)	해당없음	33	상근
송인강	전문위원	1971.07	남	무선 개발실 담당임원	무선 기술전략팀 담당부장	Vanderbilt Univ.(碩士)	해당없음	10	상근
송인숙	전문위원	1974.01	여	의료기기 전략마케팅팀장	의료기기 상용전략팀장	The Johns Hopkins Univ.(博士)	해당없음	53	상근
신민재	전문위원	1972.09	남	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 IP법무팀 담당임원	Harvard Univ.(碩士)	해당없음		상근
신종훈	전문위원	1964.09	남	기흥/화성/평택단지 소방방재팀장	기흥/화성/평택단지 소방방재팀장	수원대(碩士)	해당없음	9	상근
심동섭	전문위원	1969.07	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Univ. of Phoenix (博士)	해당없음	7	상근
안진우	전문위원	1969.11	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	동아대	해당없음	22	상근

유석영	전문위원	1963.04	남	DS부문 상생협력센터 담당임원	SCS법인 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)	해당없음		상근
윤승환	연구위원	1971.01	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Univ. of California, Irvine(博士)	해당없음	8	상근
윤준호	전문위원	1963.04	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	송실대	해당없음	45	상근
윤태식	전문위원	1969.04	남	한국총괄 IMC팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	연세대(碩士)	해당없음		상근
음두찬	전문위원	1965.12	남	종합기술원 미래기술육성센터장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	해당없음		상근
이경성	전문위원	1961.05	남	SEVT 담당임원	환경안전센터 Global환경안전팀장	Univ. of Sheffield (碩士)	해당없음	55	상근
이귀로	전문위원	1966.08	남	DS부문 인사팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	동국대	해당없음	58	상근
이기남	전문위원	1961.08	남	SESK법인장	SESK 담당임원	황공대	해당없음		상근
이상용	전문위원	1970.02	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음	3	상근
이상현	전문위원	1966.05	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대(博士)	해당없음		상근
이영춘	전문위원	1967.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)	해당없음	17	상근
이원기	전문위원	1965.07	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	연세대(碩士)	해당없음	57	상근
이원진	전문위원	1967.08	남	영상디스플레이 Service Business팀 장	영상디스플레이 서비스전략팀장	Purdue Univ.(碩士)	해당없음		상근
이은영	전문위원	1973.03	여	한국총괄 온라인영업팀 담당임원	한국총괄 온라인영업팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook	해당없음	35	상근
이재경	전문위원	1969.10	여	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀장	Univ. of Westminster (碩士)	해당없음	22	상근
이정숙	전문위원	1972.12	여	무선 Mobile UX센터 담당임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Berlin Art Univ.(碩士)	해당없음	1	상근
이준규	전문위원	1973.10	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(碩士)	해당없음	1	상근
이지선	전문위원	1971.08	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Northwestern Univ. (碩士)	해당없음	23	상근
이지수	전문위원	1976.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)	해당없음	52	상근
이진석	전문위원	1971.09	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Imperial College(博士)	해당없음	13	상근
이호신	전문위원	1970.12	남	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Georgetown Univ. (碩士)	해당없음	10	상근
이희만	전문위원	1970.05	남	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	37	상근
임영수	전문위원	1969.06	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	영남대	해당없음	26	상근
임휘용	전문위원	1965.02	남	인재개발원 담당임원	네트워크 인사팀장	서강대	해당없음		상근
장용	전문위원	1970.03	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	해당없음	10	상근
장호진	전문위원	1970.09	남	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 라이선싱팀 책임변호사	Duke Univ.(碩士)	해당없음		상근
전병권	전문위원	1967.02	남	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	SEEG-P법인장	전북대	해당없음	10	상근
전천훈	전문위원	1962.07	남	Global EHS센터장	Global EHS센터 수원환경안전팀장	오산대	해당없음	29	상근
정수연	전문위원	1961.06	남	무선 Global제조센터장	무선 Global제조센터 담당임원	금오공대	해당없음		상근
정진성	전문위원	1967.08	남	기흥/화성/평택단지 Facility팀 담당임원	Foundry제조기술센터 담당임원	부산대	해당없음	46	상근
조지현	전문위원	1961.06	남	상생협력센터 상생협력팀장	상생협력센터 상생협력팀 담당임원	아주대(博士)	해당없음		상근
최봉석	전문위원	1967.03	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 책임변호사	Georgetown Univ. (碩士)	해당없음	57	상근
최수호	전문위원	1963.02	남	LED사업팀 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	California State Univ., Sacramento(碩士)	해당없음		상근
최승은	전문위원	1969.07	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서강대(碩士)	해당없음	42	상근
최에드워드	전문위원	1966.12	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Maryland	해당없음	13	상근
최영규	전문위원	1961.03	남	무선 PC사업팀장	무선 개발실 담당임원	서울대(碩士)	해당없음		상근

최윤정	전문위원	1973.10	여	Samsung NEXT 담당임원	Samsung NEXT 담당부장	연세대(碩士)	해당없음	3	상근
토마스코	전문위원	1970.11	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Virginia	해당없음	53	상근
파트릭쇼메	전문위원	1964.05	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 상품혁신팀장	Institut d administration des entreprises(碩士)	해당없음	35	상근
피오승커	전문위원	1961.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 마케팅팀 담당임원	California State Univ., Northridge(碩士)	해당없음	54	상근
한상범	전문위원	1965.02	남	무선 Global CS팀 담당임원	SEA 담당임원	연세대	해당없음	45	상근
한석제	전문위원	1960.04	남	무선 Global Mobile B2B팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Northwestern Univ. (碩士)	해당없음	50	상근
한인국	전문위원	1964.11	남	Samsung Research 창의개발센터장	기획팀 담당임원	한양대	해당없음		상근
홍유석	전문위원	1972.12	남	법무실 담당임원	법무실 책임변호사	Univ. of Notre Dame (博士)	해당없음	10	상근
홍중필	전문위원	1973.08	남	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 담당임원	Boston College(碩士)	해당없음	22	상근
황득규	전문위원	1959.06	남	중국전략협력실장	기흥/화성단지장	Boston Univ.(碩士)	해당없음		상근
황우찬	전문위원	1962.10	남	제도개선T/F	신문화T/F 담당임원	한양대(碩士)	해당없음		상근
황제임스	전문위원	1971.07	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	West Point	해당없음	10	상근

※ 미등기임원의 보유 주식수는 보통주(의결권 있는 주식) 250,233,132주 및 우선주(의결권 없는 주식) 636,750주입니다.

(이건희 회장 보통주 249,273,200주, 우선주 619,900주 등)

※ 미등기임원 보유주식수는 2019년 9월 30일 기준이며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권 등 소유상황보고서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 재직기간 기재를 생략하였습니다.

라. 미등기임원의 변동

작성기준일 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	직위	출생연월	성별	담당업무	최대주주와의 관계	사유
신규선임	정태인	전문위원	1973.09	남	네트워크 상품전략팀 담당임원	해당없음	경력입사
	구자천	상무	1981.04	남	System LSI 기획팀 담당임원	해당없음	경력입사
	윤승욱	연구위원	1970.01	남	TSP총괄 PKG기술기획팀 담당임원	해당없음	경력입사
	김경환	전무대우	1970.06	남	법무실 법무팀 담당임원	해당없음	경력입사
	최강석	전문위원	1965.12	남	무선사업부 Global Mobile B2B팀 담당임원	해당없음	경력입사
퇴임	토마스고	전문위원	1970.11	남	무선 서비스사업실 담당임원	해당없음	의원면직

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

마. 직원의 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

사업부문	성별	직원 수				합 계	평균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자						
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)					
CE	남	10,079	-	69	-	10,148	15.2	-	-	-
CE	여	2,086	71	18	-	2,104	10.2	-	-	-
IM	남	20,196	-	175	-	20,371	13.1	-	-	-
IM	여	7,506	75	34	-	7,540	10.9	-	-	-
DS	남	38,970	-	139	2	39,109	10.7	-	-	-
DS	여	15,570	186	15	-	15,565	10.7	-	-	-
기타	남	8,435	-	145	-	8,580	14.3	-	-	-
기타	여	2,280	91	50	-	2,330	10.5	-	-	-
성별합계	남	77,680	-	528	2	78,208	12.3	5,470,136	72	-
성별합계	여	27,442	423	117	-	27,559	10.7	1,317,048	52	-
합 계		105,122	423	645	2	105,767	11.9	6,787,184	67	-

※ 상기 직원의 수는 본사(별도) 기준이며 등기임원(사내이사 5명, 사외이사 6명) 제외 기준입니다.(휴직자 포함)

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 「소득세법」 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의

근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.

※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 101,323명(남 75,944명, 여 25,379명) 기준으로 산출하였습니다.

바. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

구분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	879	352,499	401	-

※ 인원수와 급여액은 작성지침에 따라 작성일 기준 재임 중이며 「소득세법」 제20조에 의거 관할 세무서에 제출하는

근로소득지급명세서 상 근로소득 발생자에 한해 기재하였습니다.

※ '임원의 현황' 미등기임원 중 해외 주재원 등 국내에서 근로소득이 발생하지 않아 상기 현황에 포함되지 않은

임원은 169명입니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

<이사·감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	5	-	-
사외이사	3	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	11	46,500	-

2. 보수지급금액

2-1. 이사·감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
11	8,124	739	-

- ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
- ※ 보수총액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 「소득세법」 상의 소득 금액입니다. 단, 3분기 공시금액은 지급일(1월~9월) 기준으로 산정하였습니다.
- ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
- ※ 등기임원 공시금액은 미등기임원 재임분을 포함한 보수총액 기준으로 산정하였습니다.
- ※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	7,451	1,490	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	3	379	126	-
감사위원회 위원	3	294	98	-
감사	-	-	-	-

- ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
- ※ 보수총액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 「소득세법」 상의 소득 금액입니다. 단, 3분기 공시금액은 지급일(1월~9월) 기준으로 산정하였습니다.
- ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
- ※ 등기임원 공시금액은 미등기임원 재임분을 포함한 보수총액 기준으로 산정하였습니다.
- ※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

<이사·감사의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

나. 주식선택권의 부여 및 행사현황

1. 이사·감사에게 부여한 주식매수선택권

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	5	-	-
사외이사	3	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	11	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

2. 그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권

2019년 3분기말 현재 누적기준 미행사 주식매수선택권은 없습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

- 기업집단의 명칭: 삼성

당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 2019년 3분기말 현재 전년말 대비 1개 회사(㈜생보부동산신탁)가 감소하여 61개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 45개사입니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

구분	회사수	회사명	법인등록번호
상장사	16	삼성물산(주)	1101110015762
		삼성전자(주)	1301110006246
		삼성에스디아이(주)	1101110394174
		삼성전기(주)	1301110001626
		삼성화재해상보험(주)	1101110005078
		삼성중공업(주)	1101110168595
		삼성생명보험(주)	1101110005953
		㈜멀티캠퍼스	1101111960792
		삼성증권(주)	1101110335649
		삼성에스디에스(주)	1101110398556
		삼성카드(주)	1101110346901
		삼성엔지니어링(주)	1101110240509
		㈜에스원	1101110221939
		㈜제일기획	1101110139017
		㈜호텔신라	1101110145519
		삼성바이오로직스(주)	1201110566317
비상장사	45	㈜서울레이크사이드	1101110504070
		㈜삼우종합건축사사무소	1101115494151
		㈜씨브이네트	1101111931686
		삼성바이오에피스(주)	1201110601501
		삼성디스플레이(주)	1345110187812
		삼성코닝어드밴스드글라스(유)	1648140000991
		에스유머티리얼스(주)	1648110061337
		스테코(주)	1647110003490
		세메스(주)	1615110011795
		삼성전자서비스(주)	1301110049139
		삼성전자판매(주)	1801110210300

		삼성전자로지텍(주)	1301110046797
		수원삼성축구단(주)	1358110160126
		삼성메디슨(주)	1346110001036
		삼성화재애니카손해사정(주)	1101111595680
		삼성화재서비스손해사정(주)	1101111237703
		(주)삼성화재금융서비스보험대리점	1101116002424
		삼성전자서비스씨에스(주)	1358110352541
		삼성선물(주)	1101110894520
		삼성자산운용(주)	1701110139833
		삼성생명서비스손해사정(주)	1101111855414
		삼성에스알에이자산운용(주)	1101115004322
		(주)삼성생명금융서비스보험대리점	1101115714533
		에스디플렉스(주)	1760110039005
		제일패션리테일(주)	1101114736934
		네추럴나인(주)	1101114940171
		삼성웰스토리(주)	1101115282077
		(주)시큐아이	1101111912503
		에스티엠(주)	2301110176840
		에스코어(주)	1101113681031
		오픈핸즈(주)	1311110266146
		(주)미라콤아이앤씨	1101111617533
		삼성카드고객서비스(주)	1101115291656
		(주)휴먼티에스에스	1101114272706
		에스원씨알엠(주)	1358110190199
		신라스테이(주)	1101115433927
		에이치디씨신라면세점(주)	1101115722916
		(주)삼성경제연구소	1101110766670
		(주)삼성라이온즈	1701110015786
		삼성벤처투자(주)	1101111785538
		삼성액티브자산운용(주)	1101116277382
		삼성헤지자산운용(주)	1101116277390
		(주)하만인터내셔널코리아	1101113145673
		레드밴드소프트웨어코리아(주)	1101113613315
		에스비티엠(주)	1101116536556
계	61		

2. 관계기업 및 자회사의 지분현황

[국내]

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : %)

피출자회사 출자회사	삼성 물산	삼성 전자	삼성 SDI	삼성 전기	삼 성 중공업	호텔 신라	삼성 엔지니 어링	제일 기획	에스원	삼성 에스디 에스	삼성 라이온즈	삼성 경제 연구소	스테코
삼성물산주		5.0			0.1		7.0			17.1		1.0	
삼성전자주			19.6	23.7	16.0	5.1		25.2		22.6		29.8	70.0
삼성SDI주					0.4	0.1	11.7		11.0			29.6	
삼성전기주					2.2							23.8	
삼성중공업주												1.0	
㈜제일기획					0.1						67.5		
㈜호텔신라													
㈜에스원													
㈜삼성경제연구소													
삼성에스디에스주													
삼성생명보험주	0.1	8.8	0.2	0.3	3.3	7.7	0.1	0.2	5.4	0.1		14.8	
삼성화재해상보험주		1.5					0.2		1.0				
삼성증권주						3.1			1.3				
삼성카드주						1.3		3.0	1.9				
삼성디스플레이주													
삼성바이오로직스주													
삼성자산운용주													
㈜미라콤아이앤씨													
삼성전자서비스주													
Harman International Industries, Inc.													
Harman International Industries Limited													
계	0.1	15.3	19.7	24.0	22.1	17.3	19.0	28.5	20.7	39.8	67.5	100.0	70.0

※ 보통주 기준입니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : %)

출자회사	세메스	삼성 전자 서비스	삼성 전자 판매	수원 삼성 축구단	삼성 전자 로지텍	삼성 디스플레이	삼성 메디슨	삼성 바이오 로직스	삼성 바이오 에피스	삼성코닝 어드밴스 드글라스	에스유머 테리얼스	씨브이 넷	서울 레이크 사이드
삼성물산주								43.4				40.1	100.0
삼성전자주	91.5	99.3	100.0		100.0	84.8	68.5	31.5					
삼성SDI주						15.2							
삼성전기주													
삼성중공업주													
㈜제일기획				100.0									
㈜호텔신라													
㈜에스원													
㈜삼성경제연구소													
삼성에스디에스주												9.4	
삼성생명보험주								0.1					
삼성화재해상보험주													
삼성증권주													
삼성카드주													
삼성디스플레이주										50.0	50.0		
삼성바이오로직스주									50.0				
삼성자산운용주													
㈜미라콤아이앤씨													
삼성전자서비스주													
Harman International Industries, Inc.													
Harman International Industries Limited													
계	91.5	99.3	100.0	100.0	100.0	100.0	68.5	75.0	50.0	50.0	50.0	49.5	100.0

※ 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	삼우 종합건축 사사무소	에스디 플렉스	제일패션 리테일	네추럴 나인	삼성 웰스토리	삼성전자 서비스 씨에스	시큐 아이	휴먼티에 스에스	에스원씨 알앤	에스 티앤	멀티 캠퍼스	에스 코어	오픈 핸즈
삼성물산주	100.0		100.0	51.0	100.0		8.7						
삼성전자주													
삼성SDI주		50.0								100.0			
삼성전기주													
삼성중공업주													
㈜제일기획												5.2	
㈜호텔신라													
㈜에스원								100.0	100.0			0.6	
㈜삼성경제연구소											15.2		
삼성에스디에스주							56.5				47.2	81.8	100.0
삼성생명보험주													
삼성화재해상보험주													
삼성증권주													
삼성카드주													
삼성디스플레이주													
삼성바이오로직스주													
삼성자산운용주													
㈜미라콤아이앤씨												0.5	
삼성전자서비스주						100.0							
Harman International Industries, Inc.													
Harman International Industries Limited													
계	100.0	50.0	100.0	51.0	100.0	100.0	65.2	100.0	100.0	100.0	62.4	88.1	100.0

※ 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	미라콤 아이앤씨	신라 스태이	HDC 신라 면세점	에스비티 엠	삼성 생명 보험	삼성생명 서비스 손해사정	삼성 에스알에이 자산운용	삼성생명 금융서비스 보험대리점	삼성화재 해상보험	삼성화재 애니카 손해사정	삼성화재 서비스 손해사정	삼성화재 금융서비스 보험대리점
삼성물산주					19.3							
삼성전자주												
삼성SDI주												
삼성전기주												
삼성중공업주												
㈜제일기획	5.4											
㈜호텔신라		100.0	50.0	100.0								
㈜에스원	0.6											
㈜삼성경제연구소												
삼성에스디에스주	83.6											
삼성생명보험주						99.8	100.0	100.0	15.0			
삼성화재해상보험주										100.0	100.0	100.0
삼성증권주												
삼성카드주												
삼성디스플레이주												
삼성바이오로직스주												
삼성자산운용주												
㈜미라콤아이앤씨												
삼성전자서비스주												
Harman International Industries, Inc.												
Harman International Industries Limited												
계	89.6	100.0	50.0	100.0	19.3	99.8	100.0	100.0	15.0	100.0	100.0	100.0

※ 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	삼성 증권	삼성 카드	삼성카드 고객서비스	삼성 자산운용	삼성 선물	삼성벤처 투자	삼성액티브 자산운용	삼성헤지 자산운용	하만 인터내셔널 코리아	레드벤드 소프트웨어 코리아
삼성물산주						16.7				
삼성전자주						16.3				
삼성SDI주						16.3				
삼성전기주						17.0				
삼성중공업주						17.0				
㈜제일기획										
㈜호텔신라										
㈜에스원										
㈜삼성경제연구소										
삼성에스디에스주										
삼성생명보험주	29.5	71.9		100.0						
삼성화재해상보험주										
삼성증권주					100.0	16.7				
삼성카드주			100.0							
삼성디스플레이주										
삼성바이오로직스주										
삼성자산운용주							100.0	100.0		
㈜미래콤아이앤씨										
삼성전자서비스주										
Harman International Industries, Inc.									100.0	
Harman International Industries Limited										100.0
계	29.5	71.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 보통주 기준입니다.

[해외]

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : %)

출자회사명	피출자회사명	지분율
㈜삼우종합건축사사무소	SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited	100.0
㈜삼우종합건축사사무소	SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	100.0
㈜삼우종합건축사사무소	SAMOO (KL) SDN. BHD.	100.0
Samsung C&T America Inc.	Meadowland Distribution	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Green repower, LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Construction Inc.	100.0
Samsung C&T America Inc.	QSSC, S.A. de C.V.	20.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Energy LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	S-print Inc	24.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 LP H.LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Wind GP Holding Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Windsor Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Southgate Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE DEVELOPMENT GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE DEVELOPMENT LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	100.0

Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC GP Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction LP	100.0
Samsung Green repower, LLC	SOLAR PROJECTS SOLUTIONS,LLC	50.0
SP Armow Wind Ontario GP Inc	SP Armow Wind Ontario LP	0.0
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL Holdings LLC	83.6
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL E&P LLC	90.0
SRE GRW EPC GP Inc.	SRE GRW EPC LP	0.0
SRE SKW EPC GP Inc.	SRE SKW EPC LP	0.0
PLL Holdings LLC	Parallel Petroleum LLC	61.0
SRE GRW LP Holdings LP	Grand Renewable Wind LP Inc.	45.0
SRE SKW LP Holdings LP	South Kent Wind LP Inc.	50.0
SRE WIND PA GP INC.	SRE WIND PA LP	0.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	Grand Renewable Solar GP Inc.	50.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	SRE GRS Holdings LP	0.0
SRE K2 EPC GP Inc.	SRE K2 EPC LP	0.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	KINGSTON SOLAR GP INC.	50.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	SRE KS HOLDINGS LP	0.0
SRE Belle River LP Holdings LP	SP Belle River Wind LP	42.5
SP Belle River Wind GP Inc	SP Belle River Wind LP	0.0
SRE Armow EPC GP Inc.	SRE Armow EPC LP	0.0
SRE Armow LP Holdings LP	SP Armow Wind Ontario LP	50.0
SRE North Kent 1 LP H.LP	North Kent Wind 1 LP	35.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Armow Wind Ontario GP Inc	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE GRW LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE SKW LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE Armow LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	South Kent Wind GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	Grand Renewable Wind GP Inc.	50.0
South Kent Wind GP Inc.	South Kent Wind LP Inc.	0.0
Grand Renewable Wind GP Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	0.0
North Kent Wind 1 GP Inc	North Kent Wind 1 LP	0.0
SRE Solar Development GP Inc.	SRE Solar Development LP	0.0
SRE Solar Construction Management GP Inc.	SRE Solar Construction Management LP	0.0
SRE DEVELOPMENT GP INC.	SRE DEVELOPMENT LP	0.0
SRE BRW EPC GP INC.	SRE BRW EPC LP	0.0
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	SRE North Kent 1 LP H.LP	0.0
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	North Kent Wind 1 GP Inc	50.0
SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	0.0
SRE Belle River GP Holdings Inc	SRE Belle River LP Holdings LP	0.0
SRE Belle River GP Holdings Inc	SP Belle River Wind GP Inc	50.0
SRE NK1 EPC GP Inc	SRE NK1 EPC LP	0.0
SRE Summerside Construction GP Inc.	SRE Summerside Construction LP	0.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 1 LLC	100.0

Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 2 LLC	100.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 3, LLC	100.0
Samsung Solar Energy 1 LLC	CS SOLAR LLC	50.0
Samsung Solar Energy 3, LLC	SST SOLAR, LLC	50.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	SCNT Investment Atlantic SPRL	0.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	POSS-SLPC, s.r.o	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Romania 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	S.C. Otelinox S.A	94.3
Solluce Romania 1 B.V.	LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA S.R.L.	78.0
Cheil Holding Inc.	Samsung Const. Co. Phils.,Inc.	75.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung Chemtech Vina LLC	48.3
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S-print Inc	16.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	10.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	30.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S&G Biofuel PTE.LTD	12.6
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Gandaerah Hendana	95.0
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Inecda	95.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	13.2
Samsung C&T Hongkong Ltd.	천진국제무역공사	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	45.0
삼성전자주	Samsung Japan Corporation	100.0
삼성전자주	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics America, Inc.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Canada, Inc.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	63.6
삼성전자주	Samsung Electronics (UK) Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics(London) Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Holding GmbH	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Iberia, S.A.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics France S.A.S	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Italia S.P.A.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Benelux B.V.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Overseas B.V.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Portuguesa S.A.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Austria GmbH	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	55.7
삼성전자주	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	75.0
삼성전자주	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자주	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Asia Private Ltd.	100.0

삼성전자(주)	Samsung India Electronics Private Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	PT Samsung Electronics Indonesia	100.0
삼성전자(주)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	91.8
삼성전자(주)	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	69.1
삼성전자(주)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	89.6
삼성전자(주)	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	48.2
삼성전자(주)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	90.0
삼성전자(주)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	73.7
삼성전자(주)	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	87.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Argentina S.A.	98.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Chile Limitada	4.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Company LLC	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	100.0
삼성전자(주)	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	100.0
삼성바이오에피스	Samsung Bioepis NL B.V.	100.0
삼성바이오에피스	Samsung Bioepis CH GmbH	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	100.0
삼성디스플레이(주)	Intellectual Keystone Technology LLC	41.9
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Slovakia s.r.o.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Noida Private Limited	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Suzhou Module Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.	60.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	95.0
삼성디스플레이(주)	Novalcd GmbH	9.9

세메스주	SEMES America, Inc.	100.0
세메스주	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	100.0
삼성메디슨주	Samsung Medison India Private Ltd.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NeuroLogica Corp.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Dacor Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung HVAC America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	SmartThings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Oak Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Joyent, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Prismview, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Semiconductor, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Research America, Inc	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung International, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Harman International Industries, Inc.	100.0
Dacor Holdings, Inc.	Dacor, Inc.	100.0
Dacor Holdings, Inc.	EverythingDacor.com, Inc.	100.0
Dacor Holdings, Inc.	Distinctive Appliances of California, Inc.	100.0
Dacor, Inc.	Dacor Canada Co.	100.0
Samsung Oak Holdings, Inc.	Stellus Technologies, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Austin Semiconductor LLC.	100.0
Samsung Electronics Canada, Inc.	AdGear Technologies Inc.	100.0
Samsung Electronics Canada, Inc.	SigMast Communications Inc.	100.0
Samsung Research America, Inc	SAMSUNG NEXT LLC	100.0
Samsung Research America, Inc	Viv Labs, Inc.	100.0
SAMSUNG NEXT LLC	SAMSUNG NEXT FUND LLC	100.0
Samsung International, Inc.	Samsung Mexicana S.A. de C.V	100.0
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Japan Co., Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Industries Canada Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Professional, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Red Bend Software Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Connected Services, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Financial Group LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Belgium SA	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman France SNC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Inc. & Co. KG	66.0
Harman International Industries, Inc.	Harman KG Holding, LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Finance International, SCA	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Finance International GP S.a.r.l	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	99.9
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	Harman International Estonia OU	100.0
Harman Investment Group, LLC	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	5.0

Harman Investment Group, LLC	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	100.0
Harman Professional, Inc.	AMX UK Limited	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman Singapore Pte. Ltd.	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Professional, Inc.	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Red Bend Software Inc.	Red Bend Software SAS	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Engineering Corp.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services South America S.R.L.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services AB.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services UK Ltd.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	1.6
Harman Connected Services, Inc.	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	100.0
Harman Financial Group LLC	Harman International (India) Private Limited	0.0
Harman Financial Group LLC	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.1
Harman Financial Group LLC	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.0
Samsung Electronics (UK) Ltd.	Samsung Semiconductor Europe Limited	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Semiconductor Europe GmbH	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Electronics GmbH	100.0
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	31.4
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	44.3
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	36.4
Samsung Electronics Benelux B.V.	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics West Africa Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics East Africa Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	99.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Israel Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	99.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Turkey	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Semiconductor Israel R&D Center,Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Maghreb Arab	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	13.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Chile Limitada	95.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Peru S.A.C.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Central Eurasia LLP	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Corephotonics Ltd.	100.0
Zhilabs, S.L.	Zhilabs Inc.	100.0
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Samsung Nanoradio Design Center	100.0
AKG Acoustics GmbH	Harman Professional Denmark ApS	100.0
AKG Acoustics GmbH	Studer Professional Audio GmbH	100.0

Harman Professional Denmark ApS	Martin Professional Japan Ltd.	40.0
Harman Professional Denmark ApS	Harman International s.r.o	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Professional Pte. Ltd.	100.0
Harman France SNC	Harman International SNC	100.0
Harman France SNC	Harman Professional France SAS	100.0
Harman Becker Automotive Systems Gmbh	Harman International Romania SRL	0.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems Gmbh	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Deutschland Gmbh	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	95.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Duran Audio B.V.	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman RUS CIS LLC	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Holding Gmbh & Co. KG	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Management Gmbh	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Hungary Financing Ltd.	100.0
Harman Connected Services GmbH	Harman Connected Services OOO	100.0
Harman KG Holding, LLC	Harman Inc. & Co. KG	34.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Professional Kft	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Consumer Nederland B.V.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman International Romania SRL	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Red Bend Ltd.	100.0
Harman Hungary Financing Ltd.	Harman International Industries Limited	100.0
Harman Finance International GP S.a.r.l	Harman Finance International, SCA	0.0
Harman Consumer Nederland B.V.	AKG Acoustics Gmbh	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Holding Limited	100.0
Duran Audio B.V.	Harman Investment Group, LLC	100.0
Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	Harman France SNC	0.0
Harman Connected Services AB.	Harman Finland Oy	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services GmbH	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	100.0
Harman Automotive UK Limited	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman Automotive UK Limited	100.0
Harman International Industries Limited	Martin Manufacturing (UK) Ltd	100.0
Harman International Industries Limited	Harman Connected Services Limited	100.0
Harman International Industries Limited	Arcam Limited	100.0
Harman International Industries Limited	Harman International Industries PTY Ltd.	100.0
Harman International Industries Limited	AMX Products And Solutions Private Limited	1.0
Harman Connected Services UK Ltd.	Harman Connected Services Morocco	100.0
Arcam Limited	A&R Cambridge Limited	100.0
Samsung Electronics Austria GmbH	Samsung Electronics Switzerland GmbH	100.0

Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	68.6
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Romania LLC	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Zhilabs, S.L.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	49.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Greece S.M.S.A	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	FOODIENT LTD.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Denmark Research Center ApS	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Novalad GmbH	40.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics New Zealand Limited	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Philippines Corporation	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co. Ltd.,	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.4
Samsung India Electronics Private Ltd.	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	100.0
PT Samsung Electronics Indonesia	PT Samsung Telecommunications Indonesia	100.0
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	100.0
Harman International (India) Private Limited	AMX Products And Solutions Private Limited	99.0
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.3
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	19.2
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Tianjin Mobile Development Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung R&D Institute China-Shenzhen	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	10.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	43.1
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Beijing Samsung Telecom R&D Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	26.3

Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics China R&D Center	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	100.0
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
Samsung Electronics Maghreb Arab	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	1.0
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Harman International (India) Private Limited	100.0
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	98.4
Red Bend Ltd.	Red Bend Software Ltd.	100.0
Red Bend Ltd.	iOnRoad Technologies Ltd	100.0
Red Bend Ltd.	Towersec Ltd.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronica Colombia S.A.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronics Panama. S.A.	100.0
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	Samsung Electronics Argentina S.A.	2.0
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	100.0
Samsung Electronics Central Eurasia LLP	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	0.0
삼성SDI㈜	Intellectual Keystone Technology LLC	41.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Japan Co., Ltd.	89.2
삼성SDI㈜	Samsung SDI America, Inc.	91.7
삼성SDI㈜	Samsung SDI Hungary Rt.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Europe GmbH	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Battery Systems GmbH	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI India Private Limited	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	97.6
삼성SDI㈜	Samsung SDI China Co., Ltd.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	65.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd.	50.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	80.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI Brasil Ltda.	45.0
삼성SDI㈜	Novald GmbH	50.1
삼성SDI㈜	SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD.	100.0
삼성SDI㈜	Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd.	50.0
삼성SDI㈜	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung SDI America, Inc.	Samsung SDI Brasil Ltda.	40.4
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Samsung SDI India Private Limited	0.0
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Samsung SDI Brasil Ltda.	14.6
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics Japan Co., Ltd.	100.0
삼성전기㈜	Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	100.0

삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics GmbH	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd.	75.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	100.0
삼성전기(주)	Calamba Premier Realty Corporation	39.8
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	99.9
삼성전기(주)	Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	81.8
삼성전기(주)	Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	95.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Calamba Premier Realty Corporation	Batino Realty Corporation	100.0
Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	0.1
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Management Corporation	100.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD.	100.0
삼성화재해상보험(주)	PT. Asuransi Samsung Tugu	70.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	75.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	100.0
삼성화재해상보험(주)	삼성재산보험 (중국) 유한공사	100.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	100.0
삼성중공업(주)	Camellia Consulting Corporation	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영파)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영성)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	영성가야선업유한공사	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	100.0
삼성중공업(주)	SHI BRAZIL CONSTRUCTION	100.0
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	SHI - MCI FZE	70.0
삼성생명보험(주)	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	51.0
삼성생명보험(주)	THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD.	48.9
삼성생명보험(주)	Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd	90.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (New York), Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management(London) Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	100.0
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	Samsung Asset Management (Beijing) Ltd.	100.0
CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	COLOMBO VIA DELLA SPIGA S.R.L	100.0
Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	Eight Seconds(Shanghai)Co., Ltd.	100.0

삼성물산(주)	MYODO METAL CO., LTD.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Japan Corporation	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T America Inc.	100.0
삼성물산(주)	Samsung E&C America, INC.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Renewable Energy Inc.	100.0
삼성물산(주)	QSSC, S.A. de C.V.	60.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Canada Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Deutschland GmbH	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T U.K. Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T ECUK Limited	100.0
삼성물산(주)	Whesoe engineering Limited	100.0
삼성물산(주)	SCNT Investment Atlantic SPRL	100.0
삼성물산(주)	POSS-SLPC, s.r.o	50.0
삼성물산(주)	Solluce Romania 1 B.V.	80.0
삼성물산(주)	SAM investment Manzanillo.B.V	53.3
삼성물산(주)	Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	100.0
삼성물산(주)	Erdsam Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Chemtech Vina LLC	51.7
삼성물산(주)	S-print Inc	40.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	43.9
삼성물산(주)	Cheil Holding Inc.	40.0
삼성물산(주)	Samsung Const. Co. Phils.,Inc.	25.0
삼성물산(주)	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	90.0
삼성물산(주)	Samsung C&T India Pte., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation India Private Limited	100.0
삼성물산(주)	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	S&G Biofuel PTE.LTD	50.5
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	100.0
삼성물산(주)	S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Hongkong Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	55.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	100.0
삼성물산(주)	SAM Gulf Investment Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Chile Copper SpA	100.0
삼성물산(주)	SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation Rus LLC	100.0
삼성물산(주)	JSC BALKHASH THERMAL POWER PLANT	50.0
삼성물산(주)	Samsung SDI America, Inc.	8.3
삼성물산(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	2.4

삼성물산(주)	Beijing Samsung Real Estate Co., Ltd	10.0
삼성물산(주)	Cheil Industries Corp., USA	100.0
삼성물산(주)	CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	100.0
삼성물산(주)	Samsung Fashion Trading Co., Ltd	100.0
삼성물산(주)	CHEIL INDUSTRIES INC. VIETNAM COMPANY LIMITED	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	60.0
삼성물산(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	19.3
삼성웰스토리(주)	WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	90.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co., LTD	85.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Welstory Food Company Limited	70.0
(주)멀티캠퍼스	LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC	82.4
Eight Seconds(Shanghai)Co., Ltd.	Eight Seconds (Shanghai) Trading Co., Ltd.	100.0
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai China Co., Ltd.	100.0
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai Taiwan Co., Ltd.	100.0
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd.	100.0
PengTai China Co., Ltd.	PengTai e-Commerce Co.,Ltd.	100.0
PengTai China Co., Ltd.	PengTai Marketing Service Co., Ltd.	100.0
PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd.	MEDIALYTICS Inc.	51.0
PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd.	Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	51.0
iMarket Asia Co., Ltd.	iMarket China Co., Ltd.	80.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (America), Inc.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Europe) Limited.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Asia) Limited.	100.0
삼성에스디에스(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	40.6
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL America, Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS GSCL CANADA., LTD.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS America, Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	Neo EXpress Transportation (NEXT), Inc.	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Europe Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hungary Kft.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung GSCL Sweden AB	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL France SAS	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Baltics, SIA	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Austria GmbH	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS GSCL Romania SRL	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung Data Systems India Private Limited	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS India Private Limited	100.0
삼성에스디에스(주)	VASCO SUPPLY CHAIN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	51.0

삼성에스디에스㈜	Samsung SDS GSCL Vietnam Co Ltd	100.0
삼성에스디에스㈜	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD.	100.0
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL AUSTRALIA PTY., LTD.	100.0
삼성에스디에스㈜	SDS-ACUTECH CO., LTD	50.0
삼성에스디에스㈜	ALS SDS Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스㈜	SDS-MP LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY	51.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS China, Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung IT Services (Beijing) Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Ltd	100.0
삼성에스디에스㈜	SDS Kerry (Shanghai) Supply Chain Solutions Limited	50.0
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt Co. Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Transport and Logistics Joint Stock Company	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda	99.7
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTD	99.7
삼성에스디에스㈜	Inte-SDS Logistics, S.A de C.V.	51.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company	100.0
㈜미라콤아이앤씨	MIRACOM INC ASIA PACIFIC LTD	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda	0.3
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	99.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Panama S. A.	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C.	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S.	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTD	0.3
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL UK Ltd.	100.0
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS GSCL Romania SRL	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company	0.0
Samsung SDS China, Ltd.	Samsung SDS Global SCL Beijing Co., Ltd	100.0
Samsung IT Services (Beijing) Co., Ltd.	Samsung SDS Global Development Center Xi'an	100.0
MIRACOM INC ASIA PACIFIC LTD	MIRACOM INC CHINA LTD	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering America Inc.	100.0
삼성엔지니어링㈜	Samsung Engineering Hungary Ltd.	100.0

삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Italy S.R.L	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	100.0
삼성엔지니어링(주)	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	81.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering India Private Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Lt	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	64.8
삼성엔지니어링(주)	Muharraq STP Company B.S.C.	4.6
삼성엔지니어링(주)	Muharraq Holding Company 1 Ltd.	45.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Bolivia S.A	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Kazakhstan LLP	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Construction, LLC	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Louisiana Construction, L.L.C.	100.0
Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	0.3
Samsung Engineering India Private Ltd.	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	0.0
Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	Samsung EPC Co., Ltd	75.0
Muharraq Holding Company 1 Ltd.	Muharraq Holding Company 2 Ltd.	100.0
Muharraq Holding Company 2 Ltd.	Muharraq STP Company B.S.C.	89.9
(주)에스원	S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	100.0
(주)에스원	SOCM LLC	100.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
(주)에스원	Samsung Beijing Security Systems	100.0
(주)제일기획	Cheil USA Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Central America Inc.	100.0
(주)제일기획	IRIS Worldwide Holdings Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil Europe Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Germany GmbH	100.0
(주)제일기획	Cheil France SAS	100.0
(주)제일기획	Cheil Nordic AB	100.0
(주)제일기획	Cheil India Pvt. Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil (Thailand) Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Singapore Pte. Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Vietnam Co. Ltd.	99.0
(주)제일기획	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Malaysia SDN BHD	100.0
(주)제일기획	Cheil China	100.0

주제일기획	Cheil Hong Kong Ltd.	100.0
주제일기획	Cheil MEA FZ-LLC	100.0
주제일기획	Cheil South Africa Pty., Ltd.	100.0
주제일기획	CHEIL KENYA LIMITED	99.0
주제일기획	Cheil Communications Nigeria Ltd.	99.0
주제일기획	Cheil Jordan LLC	100.0
주제일기획	Cheil Ghana Limited	100.0
주제일기획	Cheil Brazil Communications Ltda.	100.0
주제일기획	Cheil Mexico S.A DE C.V.	98.0
주제일기획	Cheil Chile SpA.	100.0
주제일기획	Cheil Peru SAC	100.0
주제일기획	Cheil Argentina S.A.	98.0
주제일기획	Cheil Rus LLC	100.0
주제일기획	Cheil Ukraine LLC	100.0
주제일기획	Cheil Kazakhstan LLC	100.0
주호텔신라	Samsung Hospitality America Inc.	100.0
주호텔신라	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	100.0
주호텔신라	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	100.0
주호텔신라	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	100.0
주호텔신라	Shilla Travel Retail Taiwan Limited	64.0
에이치디씨신라면세점(주)	HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality U.K. Inc.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Europe GmbH	100.0
에스비티엠(주)	SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	99.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Philippines Inc.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality India Private Limited	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris USA, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Atlanta, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Experience, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Latin America, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Worldwide San Diego, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	89 Degrees, Inc.	75.0
Iris Latin America, Inc.	Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	0.0
Iris Latin America, Inc.	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	0.0
Iris Canada Holdings Ltd	Pricing Solutions Ltd	100.0
Cheil USA Inc.	The Barbarian Group LLC	100.0
Cheil USA Inc.	McKinney Ventures LLC	100.0
Cheil USA Inc.	Cheil India Pvt. Ltd.	0.0
Cheil USA Inc.	Cheil Mexico S.A DE C.V.	2.0
IRIS Worldwide Holdings Limited	Iris Nation Worldwide Limited	100.0
IRIS Worldwide Holdings Limited	Josh & James Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Americas, Inc.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Canada Holdings Ltd	100.0

Iris Nation Worldwide Limited	Iris London Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Promotional Marketing Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures 1 Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Founded Partners Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Products (Worldwide) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Korea Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris PR Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Concise Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Digital Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Amsterdam B.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Datalytics Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures (Worldwide) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Culture Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Concise Consultants Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Atom42 Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	WDMP Limited	49.0
Iris Nation Worldwide Limited	Pricing Solutions (UK) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Services Limited Dooel Skopje	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Singapore Pte Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide Integrated Marketing Pvt Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Sydney PTY Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide (Thailand) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris (Beijing) Advertising Company Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Hong Kong Limited	100.0
Iris London Limited	Iris Partners LLP	100.0
Iris Promotional Marketing Ltd	Holdings BR185 Limited	100.0
Iris Ventures 1 Limited	Iris Germany GmbH	100.0
Founded Partners Limited	Founded Partners, Inc.	100.0
Iris Ventures (Worldwide) Limited	THE ELEPHANT ROOM LIMITED	49.0
Iris Ventures (Worldwide) Limited	Fixers Group B.V.	49.0
Iris Germany GmbH	Pepper NA, Inc.	100.0
Iris Germany GmbH	Pepper Technologies Pte Limited	100.0
Cheil Europe Ltd.	BEATTIE MCGUINNESS BUNGAY LIMITED	100.0
Cheil Europe Ltd.	Cheil Italia S.r.l	100.0
Cheil Europe Ltd.	CHEIL SPAIN S.L	100.0
Cheil Europe Ltd.	CHEIL BENELUX B.V.	100.0
Cheil Germany GmbH	Cheil Austria GmbH	100.0
Cheil Germany GmbH	Centrade Integrated SRL	60.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil HU Kft.	100.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil Adriatic	100.0
Cheil India Pvt. Ltd.	Experience Commerce Software Pvt Ltd	100.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PengTai Greater China Co., Ltd.	95.7
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	100.0
Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Cheil Philippines Inc.	30.0
Cheil Hong Kong Ltd.	PengTai Greater China Co., Ltd.	3.1
Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	100.0

Cheil MEA FZ-LLC	One Agency FZ LLC	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	0.0
Cheil South Africa Pty., Ltd.	CHEIL KENYA LIMITED	1.0
Cheil South Africa Pty., Ltd.	Cheil Communications Nigeria Ltd.	1.0
One Agency FZ LLC	One RX India PVT. LTD	100.0
One Agency FZ LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	100.0
One Agency FZ LLC	One RX Interior Design LLC	100.0
One Agency FZ LLC	One RX Printing LLC	100.0
One Agency FZ LLC	One Agency South Africa Pty., Ltd.	100.0
One RX Interior Design LLC	One RX India PVT. LTD	0.0
Holdings BR185 Limited	Brazil 185 Participacoes Ltda	100.0
Brazil 185 Participacoes Ltda	Iris Router Marketing Ltda	100.0
Cheil Brazil Communications Ltda.	Cheil Argentina S.A.	2.0

※ 보통주 기준입니다.

3. 관련법령상의 규제내용 등

□ 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한기업집단 등

① 지정시기: 2019년 5월 15일

② 규제내용 요약

- 상호출자의 금지
- 계열사 채무보증 금지
- 금융·보험사의 계열사 의결권 제한
- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
- 비상장사 중요사항 공시
- 기업집단 현황 등에 관한 공시

4. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일 : 2019년 09월 30일)

성명	계열사 겸직현황		
	회사명	직위	상근여부
전동수	삼성메디슨(주)	대표이사	상근
최원진	삼성전자로지텍(주)	감사	비상근
	삼성전자판매(주)	감사	비상근
	삼성전자서비스(주)	감사	비상근
윤태양	세메스(주)	기타 비상무이사	비상근
신성우	스테코(주)	감사	비상근
손성원	삼성메디슨(주)	감사	비상근
이동우	세메스(주)	감사	비상근
이원준	(주)삼성경제연구소	감사	비상근
조기재	삼성디스플레이(주)	감사	비상근
김병성	삼성메디슨(주)	사내이사	상근
이승원	스테코(주)	기타 비상무이사	비상근
송방영	삼성벤처투자(주)	감사	비상근
장세연	세메스(주)	기타 비상무이사	비상근

5. 타법인출자 현황

2019년 3분기말 현재 당사 타법인출자 금액은 장부가액 기준 57조 9,344억원이며, 사업관련 등 목적으로 출자하였습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일)

(단위 : 천주, 백만원, %)

계정과목	법인명 또는 종목명	최초 취득 일자	출자 목적	최초 취득 금액	기초잔액			증가(감소) 내역			기말잔액			최근 사업연도 재무현황		비고
					수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가/ 손상	수량	지분율	장부가액	총자산	당기 순손익	
								수량	금액							
상장	삼성전기㈜	1977.01	사업관련	250	17,693	23.7	445,244				17,693	23.7	445,244	8,644,914	685,019	
비상장	스테코㈜	1995.06	경영참가 등	24,000	2,590	70.0	35,861				2,590	70.0	35,861	169,786	7,215	
비상장	세메스㈜	1992.12	경영참가 등	1,000	2,173	91.5	71,906				2,173	91.5	71,906	1,080,229	104,122	
비상장	㈜삼성경제연구소	1991.05	사업관련	320	3,576	29.8	24,942				3,576	29.8	24,942	136,967	194	
상장	삼성에스디에스㈜	1992.07	사업관련	6,160	17,472	22.6	560,827				17,472	22.6	560,827	8,013,849	638,792	
비상장	삼성전자서비스㈜	1998.01	경영참가 등	30,000	6,000	99.3	48,121				6,000	99.3	48,121	387,220	△25,696	
비상장	삼성전자판매㈜	2000.12	경영참가 등	3,100	1,767	100.0	247,523				1,767	100.0	247,523	652,337	2,368	
비상장	삼성전자로지텍㈜	1999.04	경영참가 등	76	1,011	100.0	46,669				1,011	100.0	46,669	173,309	10,214	
비상장	삼성디스플레이㈜	2012.04	경영참가 등	16,009.5 47	221,969	84.8	18,509,307				221,969	84.8	18,509,307	47,162,963	1,263,050	
비상장	SVIC 21호 투자조합	2011.11	경영참가 등	19,800	1	99.0	83,506	△0	△7,524		1	99.0	75,982	83,047	△160	회수
비상장	SVIC 22호 투자조합	2011.11	경영참가 등	19,800	1	99.0	129,066	△0	△14,850		1	99.0	114,216	132,618	16,820	회수
비상장	SVIC 26호 투자조합	2014.11	경영참가 등	19,800	2	99.0	167,181	△0	△2,970		2	99.0	164,211	200,834	13,397	회수
비상장	SVIC 27호 투자조합	2014.09	경영참가 등	5,940	0	99.0	31,739	0	4,673		0	99.0	36,412	32,638	3,145	회수 /출자
비상장	SVIC 28호 투자조합	2015.02	경영참가 등	7,425	2	99.0	169,831	△0	△11,839		2	99.0	157,992	226,667	34,254	회수 /출자
비상장	SVIC 32호 투자조합	2016.08	경영참가 등	19,800	1	99.0	140,080	0	41,615		1	99.0	181,695	137,250	1,946	회수 /출자
비상장	SVIC 33호 투자조합	2016.11	경영참가 등	4,950	1	99.0	133,497	0	21,802		0	99.0	155,299	140,123	9,663	회수 /출자
비상장	SVIC 42호 투자 조합	2018.11	경영참 가 등	4,950	0	99.0	4,950				0	99.0	4,950	5,007	△105	
비상장	SVIC 45호 투자조합	2019.05	경영참가 등	19,800	-	-	-	0	19,800		0	99.0	19,800	-	-	출자
비상장	삼성메디슨㈜	2011.02	경영참가 등	286,384	87,350	68.5	351,792				87,350	68.5	351,792	345,288	53,594	
상장	삼성바이오로직 스㈜	2011.04	사업관련	30,000	20,837	31.5	443,193				20,837	31.5	443,193	5,980,409	224,109	
비상장	인텔렉추얼디스	2011.05	사업관련	5,000	357	15.7	1,922				357	15.7	1,922	33,922	782	

	커버리주																
상장	삼성중공업주	1977.09	사업관련	125	100,693	16.0	746,138		47,326	100,693	16.0	793,464	14,282,892	△388,189	평가		
상장	㈜호텔신라	1979.12	사업관련	252	2,005	5.1	153,361		19,446	2,005	5.1	172,807	2,303,742	110,308	평가		
상장	㈜제일기획	1988.09	사업관련	185	29,038	25.2	491,599			29,038	25.2	491,599	2,172,078	131,869			
상장	에이테크솔루션주	2009.11	사업관련	26,348	1,592	15.9	12,418		127	1,592	15.9	12,545	176,521	652	평가		
상장	㈜아이마켓코리아	2000.12	사업관련	1,900	647	1.8	4,479		2,253	647	1.8	6,732	1,078,276	20,722	평가		
상장	㈜케이티스카이라이프	2001.12	사업관련	3,344	240	0.5	2,760		△588	240	0.5	2,172	816,001	52,010	평가		
상장	삼성SDI주	1977.01	사업관련	304	13,463	19.6	1,242,605			13,463	19.6	1,242,605	19,349,721	745,049			
상장	㈜원익아이피에스	2016.04	사업관련	16,214	1,851	4.5	37,204		16,288	1,851	3.8	53,492	512,346	86,860	평가		
상장	㈜원익홀딩스	2013.12	사업관련	15,411	1,759	2.3	6,175		1,266	1,759	2.3	7,441	1,209,057	96,370	평가		
상장	㈜동진세미켈	2017.11	사업관련	48,277	2,468	4.8	18,040		23,174	2,468	4.8	41,214	760,452	47,958	평가		
상장	솔브레인주	2017.11	사업관련	55,618	835	4.8	39,709		21,254	835	4.8	60,963	1,006,120	102,957	평가		
비상장	㈜한국비즈니스금융대부	1995.01	사업관련	5,000	1,000	17.2	5,231		△595	1,000	17.2	4,636	86,384	1,229	평가		
비상장	한국경제신문주	1987.05	사업관련	150	72	0.4	365			72	0.4	365	371,583	23,890			
비상장	삼성벤처투자주	1999.11	사업관련	4,900	980	16.3	7,313		407	980	16.3	7,720	120,484	9,820	평가		
비상장	㈜씨이비뱅크	2000.12	사업관련	8,000	1,083	7.5	0			1,083	7.5	0	0	0			
비상장	화인칩스주	2001.12	사업관련	10	2	3.8	10			2	3.8	10	6,718	498			
비상장	㈜인켈	2006.11	사업관련	130	0	0.0	0			0	0.0	0	83,438	5,567			
상장	㈜용광리조트	2007.05	사업관련	1,869	400	0.8	2,436		564	400	0.8	3,000	812,776	10,186	평가		
비상장	㈜삼보컴퓨터	2012.09	채권회수	0	0	0.0	0			0	0.0	0	45,040	3,322			
비상장	아이큐브투자조합1호	2009.12	사업관련	4,000	0	16.2	1,614			0	16.2	1,614	1,994	163			
비상장	㈜신성건설	2010.07	채권회수	1	0	0.0	0			0	0.0	0	182,249	△9,517			
비상장	㈜우방	2010.07	채권회수	0	1	0.0	0			1	0.0	0	540,484	15,992			
비상장	대우산업개발주	2012.12	채권회수	0	0	0.0	0			0	0.0	0	220,148	19,975			
비상장	대우송도개발주	2012.12	채권회수	0	9	0.0	0			9	0.0	0	19,367	△350			
비상장	지일자동차판매주	2012.12	채권회수	0	1	0.0	0			1	0.0	0	267,881	19,562			
비상장	성원건설주	2014.04	채권회수	0	1	0.0	0			1	0.0	0	27,744	△627			
비상장	㈜인회	2014.04	채권회수	0	2	0.2	0	△2		0	0.1	0	9,147	△241	주식병합		
비상장	풍림산업주	2014.05	채권회수	0	1	0.4	0			1	0.4	0	111,616	△452,889			
비상장	반도체성장펀드	2017.03	사업관련	500	50,000.00	66.7	50,000			50,000.00	66.7	50,000	75,263	105			
비상장	JNT(반도체펀드)	2011.02	사업관련	1,800	0	24.0	1,758			0	24.0	1,758	5,200	△112			
비상장	SV(반도체펀드)	2011.02	사업관련	1,850	0	14.9	0			-	-	-	-	-	청산		
비상장	서울투자파트너스주(벤처조합)	2011.10	사업관련	1,550	0	19.4	1,925	△0	△271	0	19.4	1,654	4,642	△2,985	회수		
비상장	대신아주B(반도체펀드)	2011.08	사업관련	258	0	3.0	681			0	3.0	681	13,933	△4,452			
비상장	TS(반도체펀드)	2011.11	사업관련	1,700	0	20.5	306	△0	△306	0	20.5	0	5,093	△872	회수		
비상장	L&S(반도체펀드)	2012.07	사업관련	848	0	7.5	1,681	△0	△939	0	7.5	742	16,063	△6,418	회수		
비상장	㈜말다니	2012.04	사업관련	16,544	45	15.0	12,358		△1,435	45	15.0	10,923	72,328	908	평가		
비상장	㈜팬택자산관리	2013.06	사업관련	53,000	53,000	10.0	0			53,000	10.0	0	59,122	△539			

비상장	KTCNP-GC (반도체펀드)	2013.12	사업관련	960	0	3.6	2,996	△0	△808	0	3.6	2,188	270,854	171,486	회수
비상장	포스코사회복지법인 드	2013.12	사업관련	600	0	10.0	440	△0	△140	0	10.0	300	4,088	△160	회수
비상장	㈜인공지능연구원	2016.07	사업관련	3,000	600	14.3	3,000			600	14.3	3,000	16,772	△1,201	
비상장	SECA	1992.08	해외거점 확보	3,823	0	100.0	90,922			0	100.0	90,922	1,070,163	62,851	
비상장	SEA	1978.07	해외거점 확보	59,362	492	100.0	17,053,807	0	112,750	492	100.0	17,166,557	30,681,097	870,814	증자
비상장	SELA	1989.04	해외거점 확보	319	40	100.0	86,962			40	100.0	86,962	430,737	37,194	
비상장	SEM	1995.07	해외거점 확보	3,032	3,837	63.6	165,638			3,837	63.6	165,638	1,358,641	57,036	
비상장	SEASA	1996.06	해외거점 확보	4,696	21,854	98.0	6,779			21,854	98.0	6,779	53,998	8,219	
비상장	SEDA	1994.01	해외거점 확보	13,224	77,205,709	87.0	647,620			77,205,709	87.0	647,620	6,207,458	778,124	
비상장	SECH	2002.12	해외거점 확보	597	0	4.1	597			0	4.1	597	478,751	19,700	
비상장	SESA	1989.01	해외거점 확보	3,276	8,021	100.0	142,091			8,021	100.0	142,091	993,982	33,064	
비상장	SENA	1992.03	해외거점 확보	392	1,000	100.0	69,372			1,000	100.0	69,372	967,089	34,563	
비상장	SEH	1991.05	해외거점 확보	1,954	753	100.0	650,157			753	100.0	650,157	1,894,922	90,956	
비상장	SEP	1982.09	해외거점 확보	204	1,751	100.0	37,616			1,751	100.0	37,616	207,183	5,469	
비상장	SEF	1991.08	해외거점 확보	230	2,700	100.0	234,115			2,700	100.0	234,115	1,761,117	59,956	
비상장	SEUK	1995.07	해외거점 확보	33,908	109,546	100.0	433,202			109,546	100.0	433,202	2,203,583	103,488	
비상장	SEHG	1982.02	해외거점 확보	28,042	0	100.0	354,846			0	100.0	354,846	793,465	104,065	
비상장	SEAG	2002.01	해외거점 확보	40	0	100.0	32,162			0	100.0	32,162	342,392	20,631	
비상장	SEI	1993.05	해외거점 확보	862	677	100.0	143,181			677	100.0	143,181	1,148,534	50,470	
비상장	SEBN	1995.07	해외거점 확보	236	539,138	100.0	914,751			539,138	100.0	914,751	1,673,470	29,536	
비상장	SELS	1991.05	해외거점 확보	18,314	1,306	100.0	24,288			1,306	100.0	24,288	1,904,358	19,347	
비상장	SEPOL	1996.04	해외거점 확보	5,462	106	100.0	78,267			106	100.0	78,267	783,805	41,932	
비상장	SSA	1998.12	해외거점 확보	263	2,000	100.0	32,622			2,000	100.0	32,622	421,122	6,588	
비상장	SESK	2002.06	해외거점 확보	8,976	0	55.7	263,767			0	55.7	263,767	1,302,612	81,359	
비상장	SEEH	2008.01	해외거점 확보	4,214	0	100.0	1,369,992			0	100.0	1,369,992	8,586,022	9,439	
비상장	SEO	1997.01	해외거점 확보	120	0	100.0	△10,043			0	100.0	△10,043	114,563	△422	
비상장	SERC	2006.01	해외거점	24,877	0	100.0	188,290			0	100.0	188,290	1,390,623	75,601	

			확보														
비상장	SERK	2007.07	해외거점 확보	4,600	0	100.0	204,555				0	100.0	204,555	987,881	135,778		
비상장	SEAU	1987.11	해외거점 확보	392	53,200	100.0	111,964			53,200	100.0	111,964	433,723	26,820			
비상장	SEMA	1989.09	해외거점 확보	4,378	16,247	100.0	103,402			16,247	100.0	103,402	168,590	18,107			
비상장	SGE	1995.05	해외거점 확보	827	0	100.0	32,836			0	100.0	32,836	905,591	△13,797			
비상장	SEEG	2012.07	해외거점 확보	23	0	0.1	39			0	0.1	39	600,240	65,700			
비상장	SEIN	1991.08	해외거점 확보	7,463	46	100.0	118,909			46	100.0	118,909	1,051,835	24,081			
비상장	SDMA	1995.03	해외거점 확보	21,876	71,400	75.0	18,741			71,400	75.0	18,741	24,489	△847			
비상장	SIEL	1995.08	해외거점 확보	5,414	216,787	100.0	75,263			216,787	100.0	75,263	6,410,825	309,632			
비상장	SRI-Bangalore	2005.05	해외거점 확보	7,358	17	100.0	31,787			17	100.0	31,787	256,224	31,249			
비상장	SAVINA	1995.01	해외거점 확보	5,839	0	100.0	28,365			0	100.0	28,365	251,818	29,898			
비상장	TSE	1988.01	해외거점 확보	1,390	11,020	91.8	279,163			11,020	91.8	279,163	2,465,999	171,407			
비상장	STE	1996.01	해외거점 확보	4,206	2	49.0	0			2	49.0	0	6,266	0			
비상장	SME	2003.05	해외거점 확보	4,796	17,100	100.0	7,644			17,100	100.0	7,644	474,905	17,875			
비상장	SAPL	2006.07	해외거점 확보	793	877,133	100.0	981,483			877,133	100.0	981,483	7,630,154	1,111,559			
비상장	SEHK	1988.09	해외거점 확보	349	274,250	100.0	79,033			274,250	100.0	79,033	1,208,622	26,390			
비상장	SET	1994.11	해외거점 확보	456	27,270	100.0	112,949			27,270	100.0	112,949	1,168,651	53,219			
비상장	SESS	1994.12	해외거점 확보	18,875	0	100.0	504,313			0	100.0	504,313	1,004,312	85,428			
비상장	SCIC	1996.03	해외거점 확보	23,253	0	100.0	640,452			0	100.0	640,452	16,090,629	127,448			
비상장	SEHZ	1992.12	해외거점 확보	792	0	89.6	255,535			0	89.6	255,535	6,539,392	532,767			
비상장	SSEC	1995.04	해외거점 확보	32,128	0	69.1	130,551			0	69.1	130,551	533,301	△4,872			
비상장	TSEC	1993.04	해외거점 확보	15,064	0	48.2	138,101			0	48.2	138,101	578,119	51,796			
비상장	TSTC	2001.03	해외거점 확보	10,813	0	90.0	490,041		△126,917	0	90.0	363,124	962,448	△207,087	손상 7		
비상장	SSET	2002.02	해외거점 확보	6,009	0	100.0	41,182			0	100.0	41,182	41,371	△18,603			
비상장	SESC	2002.09	해외거점 확보	5,471	0	73.7	34,028			0	73.7	34,028	920,461	47,446			
비상장	SSS	2001.01	해외거점 확보	1,200	0	100.0	19,189			0	100.0	19,189	5,400,549	286,956			
비상장	SSCR	2006.09	해외거점	3,405	0	100.0	9,332			0	100.0	9,332	30,543	2,323			

			확보													
비상장	TSLED	2012.04	해외거점 확보	119,519	0	100.0	119,519			0	100.0	119,519	439,574	47,273		
비상장	SCS	2012.09	해외거점 확보	111,770	0	100.0	4,577,360	0	698,400	0	100.0	5,275,760	10,254,900	1,489,906	증자	
비상장	SSCX	2016.04	해외거점 확보	1,141	0	100.0	1,141			0	100.0	1,141	491,590	32,077		
비상장	SJC	1975.12	해외거점 확보	273	1,560	100.0	253,108			1,560	100.0	253,108	1,196,129	△564		
비상장	SRJ	1992.08	해외거점 확보	3,120	122	100.0	117,257			122	100.0	117,257	151,975	3,694		
비상장	TSST Japan	2004.03	사업관련	1,639	30	49.0	0			30	49.0	0	274	△50		
비상장	Semiconductor Portal	2002.12	사업관련	38	0	1.2	10			0	1.2	10	1,922	56		
비상장	Nanosys	2010.08	사업관련	4,774	1,747	1.4	2,387			1,747	1.3	2,387	24,643	△10,429		
비상장	One-Blue	2011.07	사업관련	1,766	0	16.7	1,766			0	16.7	1,766	30,238	650		
비상장	TidalScale	2013.08	사업관련	1,112	2,882	8.3	1,112			2,882	8.3	1,112	15,227	△6,940		
비상장	Sentiance	2012.12	사업관련	3,422	7	7.5	3,422			7	7.5	3,422	5,688	△994		
비상장	Mantis Vision	2014.01	사업관련	1,594	355	2.1	1,980			355	2.1	1,980	8,435	△10,327		
비상장	Leman	2014.08	사업관련	1,019	17	3.4	1,019			17	3.4	1,019	2,369	△2,952		
비상장	Alces	2014.09	사업관련	4,832	421	18.5	0	△421		-	-	-	-	-	제각	
비상장	Keyssa	2016.01	사업관련	3,332	1,235	2.1	3,332			1,235	2.1	3,332	20,757	△13,515		
비상장	Zyomed	2016.01	사업관련	2,044	1,464	2.9	2,044			1,464	2.9	2,044	16,521	△304		
비상장	Sensifree	2016.01	사업관련	2,111	490	17.9	2,111			490	17.9	2,111	657	△2,407		
비상장	Unispectral	2016.02	사업관련	1,112	2,308	7.9	2,130			2,308	7.9	2,130	7,550	△4,727		
비상장	Quobyte	2016.04	사업관련	2,865	729	11.8	2,865			729	11.8	2,865	1,812	△2,264		
비상장	Afero	2016.05	사업관련	5,685	723	5.5	5,685			723	5.5	5,685	2,974	△13,954		
비상장	Graphcore	2016.06	사업관련	3,494	3,000	4.5	3,494	9,000		12,000	3.7	3,494	267,931	△57,847	분할 등	
비상장	Soundhound	2016.12	사업관련	7,059	306	1.1	7,059			306	1.1	7,059	119,637	△38,507		
비상장	Almotive	2017.12	사업관련	3,302	2	3.2	3,302			2	3.2	3,302	35,273	△12,860		
비상장	Fasetto	2019.01	사업관련	6,701	-	-	-	338	6,701	338	3.5	6,701	253,516	△8,338	취득	
합 계				17,490.0	67		57,065,723	8,915	866,093	2,572		57,934,388				

※ 별도기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

※ 최근사업연도 자료의 확보가 현실적으로 곤란하여 성원건설(주)은 2016년 12월 31일, 대우송도개발(주), Mantis Vision는 2017년 12월 31일의

재무현황을 기재하였습니다.

※ TSTC는 손자산가치평가법을 이용하여 회수가능가액을 추정하였고, 회수가능액을 초과하는 장부금액 126,917백만원을 손상차손으로 인식

하였습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

1) 국내채무보증: 해당사항 없음

2) 해외채무보증

(단위 : 천US\$)

성명(법인명)	관계	채권자	채무내용	목적	보증기간	거래내역(잔액)				채무보증 한도	이자율 (%)	보증시작일
						기초	증가	감소	기말			
SEA (미주총괄법인)	계열회사	BOA 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	1,398,000		2018.11.09
SEM (멕시코판매법인)	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2020.08.19	0	0	0	0	546,000		2018.11.09
SAMCOL (콜롬비아판매법인)	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	85,662	0	18,368	67,294	168,000	6.2%	2018.12.17
SEDA (브라질생판법인)	계열회사	BRADESCO 외	지급보증	운영자금	2019.12.17	0	0	0	0	654,000		2018.10.08
SECH (칠레판매법인)	계열회사	Santander 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	178,000		2018.11.09
SEPR (페루판매법인)	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	58,710	11,102	0	69,812	180,000	2.8%	2018.11.09
SSA (남아공판매법인)	계열회사	SCB 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	323,000		2018.11.09
SEMAG (모로코판매법인)	계열회사	SocGen 외	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	110,000		2018.11.09
SETK (터키판매법인)	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	64,519	0	64,519	0	822,000		2018.11.09
SECE (카자흐스탄판매법인)	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2020.07.19	0	0	0	0	75,463		2018.12.17
SEEG (이집트생판법인)	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	50,000		2019.06.14
SEIN (인도네시아생판법인)	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	186,000		2018.11.09
SJC (일본판매법인)	계열회사	Mizuho Bank 외	지급보증	운영자금	2020.05.31	0	0	0	0	900,828		2018.11.09
SEUC (우크라이나판매법인)	계열회사	Credit Agricole 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	150,000		2018.11.09
SEDAM (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	341,000		2018.11.09
SELA (파나마판매법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	50,000		2018.12.17
SEEH (네덜란드지주사)	계열회사	HSBC 외	지급보증	운영자금	2020.09.05	0	0	0	0	705,000		2018.11.01
SERK (러시아생산법인)	계열회사	SOCGEN 외	지급보증	운영자금	2020.07.12	0	0	0	0	245,000		2018.11.09

SELV (요르단판매법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	10,000		2018.12.17
SAPL (싱가포르법인)	계열회사	BOA 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	411,000		2018.11.09
SEV (베트남생산법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	15,000		2018.11.09
SAVINA (베트남판매법인)	계열회사	HSBC 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	71,000		2018.11.09
SET (대만판매법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	30,000		2018.11.09
SCIC (중국법인)	계열회사	HSBC 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	350,000		2018.11.09
SME (말레이시아판매법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	110,000		2018.11.09
SAMEX (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	5,000		2018.12.17
SEASA (아르헨티나판매법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	1,000		2018.12.17
SSAP (남아공생산법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	30,000		2018.11.09
SEHK (홍콩판매법인)	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0		2,000		2019.06.14
SEPM (폴란드생산법인)	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2019.06.13	7,712	0	7,712	0	0		2018.06.14
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	2,000		2018.11.09
Harman Finance International, SCA	계열회사	JP Morgan 외	지급보증	운영자금	2022.05.27	400,101	0	17,077	383,024	383,024	2.0%	2015.05.27
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	25,000		2019.06.01
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SOCGEN	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	15,000		2019.06.01
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	100,000		2019.06.14
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	30,000		2019.06.14
합 계						616,703	11,102	107,675	520,130	8,672,315		

※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결후 집행되며, 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 그 결정을

경영위원회에 위임하고 있습니다.

※ 상기 채무보증 중 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여

수수료를 수취하고 있습니다. 2018년 중 US\$464천의 수수료를 청구하여 2019년 중 전액 수취하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래일기준	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
삼성전기(주)	계열회사	사업양수	2019.06.01	양수일	기계장치 등	차세대 패키지 기술 확보	785,000	-
SCS	계열회사	자산매각/매입	2019.09.29	매각/매입일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	223,734	123,422
삼성SDI(주)	계열회사	자산매각	2019.08.23	매각일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	16,106	3,278
SESS	계열회사	자산매각/매입	2019.09.13	매각/매입일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	10,151	196
SAS	계열회사	자산매각	2019.02.21	매각일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	4,299	△89
TSTC	계열회사	자산매입	2019.03.05	매입일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	1,188	-
SEV	계열회사	자산매각/매입	2019.08.06	매각/매입일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	921	307
SEHZ	계열회사	자산매입	2019.09.12	매입일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	885	-
SEVT	계열회사	자산매각/매입	2019.08.06	매각/매입일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	743	35
TSEC	계열회사	자산매입	2019.07.22	매입일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	730	-
SEHC	계열회사	자산매각	2019.07.29	매각일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	513	13
SESK	계열회사	자산매각	2019.01.03	매각일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	210	7
SEIN	계열회사	자산매각	2019.08.22	매각일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	107	7
SIEL	계열회사	자산매각	2019.08.22	매각일	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	107	7

거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

- ※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일, 30일 이내 현금 지급조건
- ※ 등
- ※ 통상적인 조건으로 거래되었습니다.
- ※ 상기 자산양수도 거래는 삼성전기(주), 삼성SDI(주)와의 거래를 제외하고는 이사회 결의 대상이 아닙니다.

당사는 2019년 3분기 중 삼성전기(주)의 PLP 사업을 양수하였고, 법인 생산 설비 증설 등의 목적으로 자산을 Samsung China Semiconductor LLC.(SCS) 법인 등의 계열회사에 매각하였으며, 국내 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SEVT	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.09	HHP 매출입 등	20,789,742
SEA	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.09	HHP 및 가전제품 매출입 등	19,657,417
SEV	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.09	HHP 매출입 등	14,258,408
SSS	계열회사	매출 등	2019.01~2019.09	반도체 매출 등	14,191,865
SSI	계열회사	매출입 등	2019.01~2019.09	반도체 매출입 등	9,581,309

2019년 3분기 중 계열회사인 Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) 법인 등과 매출, 매입 등의 거래를 하였습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2019년 3분기말 현재 제품경쟁력 제고 및 상생경영을 위한 협력회사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 126,672백만원의 대여금이 있습니다.

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	대여금 변동 내역			
			기초잔액	증가	감소	기말잔액
세스트 외	협력업체	단기대여금	30,887	4,661	1,279	34,269
범진아이앤디 외	협력업체 및 종업원	장기대여금	91,527	23,080	22,204	92,403
합 계			122,414	27,741	23,483	126,672

※ 상기 내역은 현재가치할인차금 차감후, 대손충당금(손실충당금) 차감전 기준입니다.

3. 중요한 소송사건

(1) TFT-LCD 판매 관련

① Iiyama사 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2014년 12월 19일
소송 당사자	원고: Mouse Computer사, 유럽 내 Iiyama 5개사 피고: 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	수정 소장 접수
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

② 이스라엘 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2013년 11월 26일
소송 당사자	원고: Hatzlacha 피고: 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	소장 송달 대기 중
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

③ Puerto Rico 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2018년 08월 13일
소송 당사자	원고: Puerto Rico 검사 피고: 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	소장 송달 대기 중
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

(2) 이외에도 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

4. 채무보증내역

(1) 국내채무보증

해당사항 없음

(2) 해외채무보증

(단위 : 천US\$)

성명(법인명)	관계	채권자	채무내용	목적	보증기간	거래내역(잔액)				채무보증 한도	이자율 (%)	보증시작일
						기초	증가	감소	기말			
SEA (미주총괄법인)	계열회사	BOA 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	1,398,000		2018.11.09
SEM (멕시코판매법인)	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2020.08.19	0	0	0	0	546,000		2018.11.09
SAMCOL (콜롬비아판매법인)	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	85,662	0	18,368	67,294	168,000	6.2%	2018.12.17
SEDA (브라질생판법인)	계열회사	BRADESCO 외	지급보증	운영자금	2019.12.17	0	0	0	0	654,000		2018.10.08
SECH (칠레판매법인)	계열회사	Santander 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	178,000		2018.11.09
SEPR (페루판매법인)	계열회사	BBVA 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	58,710	11,102	0	69,812	180,000	2.8%	2018.11.09
SSA (남아공판매법인)	계열회사	SCB 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	323,000		2018.11.09
SEMAG (모로코판매법인)	계열회사	SocGen 외	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	110,000		2018.11.09
SETK (터키판매법인)	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	64,519	0	64,519	0	822,000		2018.11.09
SECE (카자흐스탄판매법인)	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2020.07.19	0	0	0	0	75,463		2018.12.17
SEEG (이집트생판법인)	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	50,000		2019.06.14
SEIN (인도네시아생판법인)	계열회사	BNP 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	186,000		2018.11.09
SJC (일본판매법인)	계열회사	Mizuho Bank 외	지급보증	운영자금	2020.05.31	0	0	0	0	900,828		2018.11.09
SEUC (우크라이나판매법인)	계열회사	Credit Agricole 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	150,000		2018.11.09
SEDAM (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	341,000		2018.11.09
SELA (파나마판매법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	50,000		2018.12.17
SEEH (네덜란드지주사)	계열회사	HSBC 외	지급보증	운영자금	2020.09.05	0	0	0	0	705,000		2018.11.01
SERK (러시아생산법인)	계열회사	SOCGEN 외	지급보증	운영자금	2020.07.12	0	0	0	0	245,000		2018.11.09
SELV (요르단판매법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	10,000		2018.12.17

SAPL (싱가포르법인)	계열회사	BOA 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	411,000		2018.11.09
SEV (베트남생산법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	15,000		2018.11.09
SAVINA (베트남판매법인)	계열회사	HSBC 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	71,000		2018.11.09
SET (대만판매법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	30,000		2018.11.09
SCIC (중국법인)	계열회사	HSBC 외	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	350,000		2018.11.09
SME (말레이시아판매법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	110,000		2018.11.09
SAMEX (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	5,000		2018.12.17
SEASA (아르헨티나판매법인)	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2019.12.16	0	0	0	0	1,000		2018.12.17
SSAP (남아공생산법인)	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	30,000		2018.11.09
SEHK (홍콩판매법인)	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0		2,000		2019.06.14
SEPM (폴란드생산법인)	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2019.06.13	7,712	0	7,712	0	0		2018.06.14
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	2,000		2018.11.09
Harman Finance International, SCA	계열회사	JP Morgan 외	지급보증	운영자금	2022.05.27	400,101	0	17,077	383,024	383,024	2.0%	2015.05.27
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	25,000		2019.06.01
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SOCGEN	지급보증	운영자금	2019.11.08	0	0	0	0	15,000		2019.06.01
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	100,000		2019.06.14
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2020.06.13	0	0	0	0	30,000		2019.06.14
합 계						616,703	11,102	107,675	520,130	8,672,315		

※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결후 집행되며, 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 그 결정을

경영위원회에 위임하고 있습니다.

※ 상기 채무보증 중 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여

수수료를 수취하고 있습니다. 2018년 중 US\$464천의 수수료를 청구하여 2019년 중 전액 수취하였습니다.

5. 제재현황 등 그 밖의 사항

당사는 2016년 12월 5일부터 12월 9일까지 진행된 기흥/화성사업장 고용노동부 PSM 이행상태점검 등과 관련하여 2016년 12월 14일 「산업안전보건법」 제49조의2(공정안전보고서 제출) 7항 등 위반으로 과태료(3.5백만원)를 부과 받아 자진 납부 완료하였습니다. 또한 2018년 6월 20일부터 6월 22일까지 진행된 평택사업장 고용노동부 PSM 이행상태점검 등과 관련하여 2018년 6월 25일 「산업안전보건법」 제49조의2(공정안전보고서 제출) 7항 등 위반으로 과태료(4.8백만원)를 부과 받아 자진 납부 완료하였습니다. 그리고 2018년 9월 10일부터 9월 13일까지 진행된 평택사업장(P1-2) 고용노동부 PSM 심사(2차)와 관련하여 2019년 1월 3일 「산업안전보건법」 제48조(유해·위험 방지 계획서의 제출 등) 1항 위반으로 과태료(10백만원)를 부과 받아 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 PSM혁신조직을 신설하여 인허가, 설계반영, 12대 실천과제, 전문성 향상 활동을 통해 PSM 상시 운영체계를 구축하여 운영 중에 있으며, 현장 공정안전 전문가를 육성하고 공정안전 자체평가를 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

'박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사'는 2017년 2월 28일 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 위반(횡령) 등의 혐의로 당사 임원 5명(이재용 부회장, 최지성 前부회장, 장충기 前사장, 박상진 前사장, 황성수 前전무)을 기소하였습니다.

서울중앙지방법원은 2017년 8월 25일 위 혐의를 일부 인정하여 이재용 부회장 징역 5년, 최지성 前부회장 징역 4년, 장충기 前사장 징역 4년, 박상진 前사장 징역 3년 및 집행유예 5년, 황성수 前전무 징역 2년 6개월 및 집행유예 4년을 선고하였습니다.

서울고등법원은 2018년 2월 5일 제1심 판결을 파기하고, 이재용 부회장에 대하여는 집행유예 4년, 최지성 前부회장 및 장충기 前사장, 박상진 前사장, 황성수 前전무에 대하여는 집행유예 2년을 선고하였습니다.

대법원은 2019년 8월 29일 원심판결 중 뇌물공여, 특정경제범죄법 위반(횡령) 부분을 파기하여 서울고등법원에 환송한다고 선고하였습니다.

이 사건은 현재 파기환송심이 진행 중으로, 당사는 향후 진행 상황을 확인할 예정입니다.

당사는 에스케이브로드밴드(주)가 2009년 5월 및 2010년 11월 실시한 광케이블 구매입찰과 관련하여 공정거래위원회로부터 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제3호 및 제8호 위반으로 2018년 2월 6일 시정명령 및 과징금(520백만원) 부과 처분을 받아 납부하였습니다. 그리고 당사는 공기청정기 등 공기청정 제품에 대한 광고와 관련하여 공정거래위원회로부터 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지) 제1항 제2호 및 동법 시행령 제3조 제2항 위반으로 2018년 10월 4일 시정명령 및 과징금(488백만원) 부과 처분을 받아 납부하였고 현재 위 부과 처분의 취소를 구하는 소송 중에 있습니다.

또한 당사는 밀크 음원서비스와 관련하여 공정거래위원회로부터 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제5조 제4항(온라인 완결서비스 제공의무) 및 제10조제1항(사이버몰 운영자의 표시의무) 위반으로 2019년 8월 23일 시정조치 및 과태료(50만원) 부과 처분을 받아 납부하였습니다. 당사는 공정거래법 및 표시광고법 등 법 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에게 대해 불공정거래 예방 교육과 부당한 표시광고를 방지하기 위한 예방 교육 등을 시행하고 있습니다.

당사는 2018년 9월 4일 기흥사업장 CO2 누출사고와 관련하여, 2018년 10월 10일부터 11월 9일까지 진행된 고용노동부 특별감독 결과에 따라 2018년 11월 16일 「산업안전보건법」 제36조(안전검사) 1항, 4항 등 위반으로 과태료(515백만원)를 부과받아 자진 납부완료하였습니다. 또한 용인소방서로부터 2018년 11월 28일 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 7항 위반으로 과태료(2백만원)를, 2018년 12월 12일 동 법률 제25조(소방시설등의 자체점검 등) 2항 위반으로 과태료(2백만원)를 부과 받아 자진 납부 완료하였습니다. 그리고 2018년 11월 27일부터 12월 6일까지 진행된 용인소방서 소방특별조사에 따라 2019년 1월 18일 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 6항 위반으로 과태료(0.5백만원)를 부과받아 자진 납부 완료하였습니다. 또한 당사 응급구조사 2명(근속연수 11년, 5년)이 「응급의료에 관한 법률」 제49조(출동 및 처치 기록 등) 위반으로 2018년 10월 23일 과태료(총 1백만원)를 부과 받아 자진 납부 완료하였으며, 당사 임직원 1명(근속연수 6년)이 2018년 11월 28일 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 6항 위반으로 과태료(0.5백만원)를 부과 받아 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 재발방지를 위하여 법적 안전검사 관리시스템을 구축하고 검사주기를 강화하는 등 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

공정거래위원회는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조 제4항에 따른 2014년도 기업집단 지정자료 제출시 (주)삼우종합건축사사무소 및 (주)서영엔지니어링을 기업집단 「삼성」 소속회사에서 누락한 허위의 자료를 제출했다는 이유로 2018년 11월 21일 당사 임원 이건희 회장을 고발 조치하였으며, 이에 따라 검찰은 이건희 회장을 약식기소 하였습니다. 서울중앙지방법원은 위 혐의를 인정하여 이건희 회장에게 2019년 4월 18일 일억원의 벌금 납입을 명령하였으며, 이건희 회장은 위 벌금을 납입하였습니다.

당사(삼성디스플레이(주) 포함)는 삼성디스플레이(주)의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 연결재무제표 및 재무제표의 우발부채와 약정사항 주석을 참조하시기 바랍니다.

6. 단기매매차익 발생 및 환수현황

당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류 작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보 받은 바 없습니다.

7. 대외후원 현황

현황	금액	내용	비고
2018년 사회공헌기금 운영 계획	122.1억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2018년 회사매칭기금으로 122.1억원 운영 계획 · 국내외 봉사활동 지원 및 지역 사회공헌 활동 등에 사용 예정	2018.01.31 이사회 의결
삼성공장학재단 기부금 출연	11.2억원	· 저소득층 고등학생 학습지원	
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	27.42억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	2018.02.23 이사회 의결
창업 80주년 기념 전자제품 기부	약 75억원	· 창업 80주년 기념 사회복지시설에 당사 전자제품 기부 · 기부처: 1,500여개 사회복지시설	2018.03.23 이사회 의결
삼성복지재단 기부금 출연	195억원	· 저소득층 중학생 학습지원	
삼성생명공익재단 기부금 출연	415억원	· 삼성의료원 운영 지원 등	2018.04.26 이사회 의결
호암재단 기부금 출연	40억원	· '호암상' 시상 등 재단사업 지원을 위한 출연	
성균관대학 기부금 출연	150억원	· 삼성장학금 지원 등	
스마트팩토리 구축사업	600억원	· 중소기업의 지속 성장을 위한 제조경쟁력 강화, 인력양성 등을 지원	2018.07.31 이사회 의결
삼성 청년 소프트웨어 아카데미 운영	4,996억원	· 양질의 소프트웨어 교육 제공을 통해 청년 취업경쟁력 제고에 기여 · 기간: 2018년 12월 ~ 2024년 6월	2018.10.31 이사회 의결
희망2019나눔캠페인 기부금 출연	252억원	· 연말 이웃돕기 성금모금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 사회복지공동모금회에 출연	2018.11.30 이사회 의결
DS부문 2차 우수협력사 인센티브	약 43.2억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 2차 우수협력사 89개사	
2019년 사회공헌기금 운영 계획	117.3억원	· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2019년 회사매칭기금으로 117.3억원 운영 계획 · 국내외 봉사활동 지원 및 지역 사회공헌 활동 등에 사용 예정	2019.01.31 이사회 의결
삼성공장학재단 기부금 출연	11.2억원	· 저소득층 고등학생 학습지원	
국제기능올림픽 후원	150만 유로 (약 19.5억원)	· 제45회 러시아 카잔 국제기능올림픽대회 최상위 스폰서 기업으로 주관기관인 국제기능올림픽위원회(WorldSkills International) 후원	2019.02.26 이사회 의결
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	29.91억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	
산업안전보건 발전기금	310억원	· 전자산업 안전보건센터 설립 및 인프라 구축	2019.04.30 이사회 의결
DS부문 우수협력사 인센티브	774.5억원	· 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산 · 대상: DS부문 1, 2차 우수협력사 296개사	
대구·경북 창조경제혁신센터 창업지원사업	120억원	· 국내 스타트업 육성을 위해 창업 생태계 활성화 및 일자리 창출에 기여 · 대경벤처창업성장재단에 기부 ※ 대경벤처창업성장재단이 당사 기부 금액을 전액 출자하여 펀드 조성	2019.07.31 이사회 의결

※ 현황 및 금액은 이사회 의결 기준으로 기재하였습니다.

8. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없음

9. 합병 등의 사후 정보

최근 3사업연도내 본사 기준(별도재무제표 기준) 주요한 분할, 영업양수 등에 대한 내역은 다음과 같으며, 종속기업의 주요한 사업결합 등의 내용은 연결재무제표의 사업결합 주석 등을 참조하시기 바랍니다.

[프린팅솔루션 사업]

- 분할 내역
 - 회사명: 에스프린팅솔루션(주)
 - 소재지: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129
 - 대표이사: 김기호
 - 분할방법: 물적분할(분할후 에스프린팅솔루션(주) 신설)
 - 분할목적: 프린팅솔루션 사업의 경쟁력 강화
 - 분할승인: 2016년 10월 27일(임시주주총회 결의)
 - 분할기일: 2016년 11월 1일
- 양도 내역
 - 당사는 2016년 9월 12일 HP Inc.(대표자: Dion Weisler, 소재지: 미국 Palo Alto)에게 에스프린팅솔루션(주) 지분을 포함한 프린팅솔루션 사업 부문을 미화 10억 5천만불에 포괄적으로 양도하는 기본양수도 계약을 체결하였으며, 양도 거래가 2017년 11월 1일 종결되었습니다.
- 상기 분할 및 양도 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트 (<http://dart.fss.or.kr/>) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

[PLP 사업]

- 양수 내역
당사는 2019년 4월 30일자 이사회 결의에 의거 2019년 6월 1일자로 차세대 패키지 기술 확보를 통한 반도체 경쟁력을 강화하기 위하여 관계기업인 삼성전기(주)(대표자: 이윤태, 소재지: 국내)의 PLP(Panel Level Package) 사업을 785,000백만원에 양수하였습니다.
- 상기 양수 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트 (<http://dart.fss.or.kr/>) 상 공시한 '특수관계인으로부터 영업양수'에서 확인할 수 있습니다.

(단위 : 억원)

구분	계정과목	예측		실적				비고
		1차연도	2차연도	1차연도		2차연도		
				실적	과리율	실적	과리율	
PLP 영업양수	매출액	101	219	-	-	-	-	
	영업이익	△1,273	△2,155	-	-	-	-	
	당기순이익	△1,273	△2,155	-	-	-	-	

※ 1차연도 예측은 영업양수일인 2019년 6월부터 12월까지 7개월분이며, 1차연도 실적과 과리율은 2019년 사업보고서에 기재할 예정입니다. [△는 부(-)의 값임]

그 밖의 주요한 사업결합 등의 내용은 연결재무제표 및 재무제표의 사업결합 주석 등을 참조하시기 바랍니다.

10. 녹색경영

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기술 인증' 취득을 확대하고 있습니다.

(녹색기술 인증)

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제32조 2항에 따라 '녹색기술 인증'을 취득하고 있습니다. 당사의 녹색기술 개발은 사람과 자연을 존중하는 기업활동을 목표로 하는 플래닛퍼스트 (PlanetFirst) 전략으로 친환경 제품 개발과 보급 확대에 주력한 결과로서 인증 제도가 시작된 2010년 이래 2019년 3분기말 현재 총 9건의 유효 녹색기술인증을 확보하고 있습니다. 또한 인증을 받은 녹색기술이 적용된 상용화 제품에 대해 부여하는 '녹색기술제품 확인' 인증을 총 42건(321모델) 취득하였습니다.

2019년 3분기말 현재 인증취득 녹색기술은 다음과 같습니다.

부문	녹색기술 명칭	건수	비고
CE	모니터 대기전력 저감 기술 등	8	
IM	사용자 및 스케줄 기반 무선랜 전력 절감 자동화 기술	1	
합 계		9	

※ 별도기준입니다.

(녹색기업 지정)

당사는 오염물질 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등 친환경기업으로서의 책임을 다하고 있으며, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의2에 따라 녹색기업으로 수원사업장, 기흥·화성 사업장 등이 지정되어 있습니다.

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2018년	2017년	2016년
온실가스(단위 : tCO ₂ e)	10,775,372	8,589,071	6,885,300
에너지(단위 : TJ)	153,681	130,834	107,740

- ※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
- ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
- ※ 삼성디스플레이 분사(2012년)로 인해 DP사업이 제외된 기준입니다.
- ※ 배출량 및 사용량은 외부 검증기관 검증 결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계